

深圳深爱半导体股份有限公司

SHENZHEN SI SEMICONDUCTORS CO.,LTD.

(深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路三号

8 号办公楼及活动楼 2-3 层)



首次公开发行股票招股说明书 (申报稿)



保荐人（主承销商）



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

(深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元)

本次发行概况

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

发行股票类型	人民币普通股（A股）
本次发行股数	不超过 6,635 万股
拟公开发行新股数量	【 】万股
拟公开发售股份数量	不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量
每股面值	1.00 元
每股发行价格	【 】元
预计发行日期	【 】年【 】月【 】日
拟上市证券交易所	深圳证券交易所
发行后总股本	不超过 26,535 万股
本次发行新股及老股转让提示	公司本次公开发行新股数量与公司股东公开发售股份数量之和不超过 6,635 万股，占发行后总股本的 25%。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。最终发行数量以本次发行募集资金投资项目所需资金量和中国证监会的最终核准文件为准。
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺	公司控股股东赛格集团承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东循杰投资、远致投资承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 通过循杰投资持有公司股份的董事、监事和高级管理人

	员寻培珏、王嘉全、王军立、邓文斌、汪德文、厉策和位培川承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所通过循杰投资间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期届满后，在其任职期间，每年转让间接持有的发行人股份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后六个月内，不转让间接持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内转让所间接持有的公司股份数量占其所间接持有公司股份总数的比例不得超过 50%。 公司股东赛格集团、循杰投资承诺：自本次发行股票上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。
保荐人（主承销商）	安信证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：

一、发行人及相关责任主体的承诺事项

（一）关于股份锁定及持股意向的承诺

公司控股股东赛格集团承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若赛格集团在锁定期满后两年内减持发行人股票，将通过合法方式进行减持，并通知发行人提前 3 个交易日予以公告。减持数量和减持价格如下：（1）锁定期满后第一年减持数量不超过其持有首次公开发行时股份总数的 10%，第二年减持数量不超过其持有首次公开发行时股份总数的 10%；（2）减持价格不低于发行价。（自发行人上市至赛格集团减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期限自动延长六个月。赛格集团如违反上述承诺，愿意承担相应的法律责任。若未履行上述关于股份减持的承诺，减持股份所得收益归发行人所有。

公司股东循杰投资承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若其在锁定期满后两年内减持发行人股票，将通过合法方式进行减持，并通知发行人提前 3 个交易日予以公告。减持数量和减持价格如下：（1）锁定期满后第一年减持数量不超过其持有首次公开发行时股份总数的 25%，第二年减持数量不超过其持有首次公开发行时股份总数的 25%；（2）减持价格不低于发行价。（自发行人上市至循杰投资减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期限自动延长六个

月。循杰投资如违反上述承诺，愿意承担相应的法律责任。若未履行上述关于股份减持的承诺，减持股份所得收益归发行人所有。

公司股东远致投资承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若其在锁定期满后两年内减持发行人股票，将通过合法方式进行减持，并通知发行人提前 3 个交易日予以公告。减持数量和减持价格如下：（1）锁定期满后第一年减持数量不超过其持有首次公开发行时股份总数的 50%，第二年减持数量不超过其持有首次公开发行时股份总数的 50%；（2）减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产。（自发行人上市至远致投资减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。远致投资如违反上述承诺，愿意承担相应的法律责任。若未履行上述关于股份减持的承诺，减持股份所得收益归发行人所有。

通过循杰投资持有公司股份的董事、高级管理人员寻培珏、王嘉全、王军立、邓文斌、汪德文和位培川承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所通过循杰投资间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而改变或无效。上述锁定期届满后，在其任职期间，每年转让间接持有的发行人股份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后六个月内，不转让间接持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内转让所间接持有的公司股份数量占其所间接持有公司股份总数的比例不得超过 50%。因违反承诺所得收益将归发行人所有。

通过循杰投资持有公司股份的监事厉策承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所通过循杰投资间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期届满后，在其任职期间，每年转让间接持有的发行人股份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后六个月内，不转让间接持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内转让所间接持有的公司股份数量占其所间接持有公司股份总数的比例不

得超过 50%。

（二）上市后三年内稳定公司股价的预案

自公司股票上市交易后三年内，公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产时，采取以下措施稳定公司股价：

1、公司控股股东应在符合相关法律法规的要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。公司控股股东应在 10 个交易日内就其增持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。控股股东应在公告后根据具体计划实施增持。控股股东承诺：①增持股票的金额不低于控股股东上年度从公司领取现金分红的 50%；②控股股东增持的股份，在增持完成后 12 个月内不得出售。

2、公司在符合相关法律法规的要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。公司应在 10 个交易日内召开董事会讨论稳定股价的具体方案，做出实施回购股份或不实施回购股份的决议，并提交股东大会审议。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者的净利润；②连续 12 个月累计回购的股份不超过公司总股本的 2%。

在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下，公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，认为公司不宜或暂无须回购股票的，经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后，应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员寻培珏、王嘉全、张帅恒、王军立、邓文斌、汪德文和位培川应在符合相关法律法规的要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员在 10 个交易日内，应就其增

持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。董事、高级管理人员应在公告后按照具体计划实施增持。有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺：①用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和（税前，下同）的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和；②公司董事、高级管理人员增持的股份，在增持完成后 6 个月内不得出售。

公司在上市后三年内新选举或聘任的在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新选举或聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。

4、约束措施

（1）对公司

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向社会公众投资者道歉。

（2）对控股股东

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如其未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司社会公众投资者道歉，并且将在前述事项发生之日起停止在公司领取股东分红，同时其持有的公司股份将不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

（3）对董事、高级管理人员

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如其未采取上述稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向社会公众投资者道歉；并且将在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至其按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

（三）对披露事项的承诺及赔偿措施

本公司承诺，本公司的招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。对于首次公开发行股票时公司控股股东公开发售的原限售股份，本公司将要求控股股东制订股份回购方案并予以公告。

本公司控股股东赛格集团承诺，发行人的招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，作为发行人的控股股东，其将购回首次公开发行股票时公开发售的原限售股份，同时督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，购回价格为发行价格加上同期银行存款利息。

本公司及控股股东、全体董事、监事和高级管理人员承诺，若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

本次发行的保荐机构、承担评估业务的评估机构承诺，因其为发行人本次发行上市出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

发行人律师承诺，本所为发行人本次发行上市出具的文件，如因本所未勤勉尽责义务导致有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，本所将根据人民法院等有权部门最终作出的生效裁决，依法赔偿投资者直接经济损失。

承担本次发行的审计业务和验资复核业务的会计师事务所瑞华所承诺，如果因其出具相关文件的执业行为存在过错，违反了法律法规、中国注册会计师协会依法拟定并经国务院财政部门批准后施行的执业准则和规则以及诚信公允的原则，从而导致相关文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并由此给基于对该等文件的合理信赖而将其用于发行人股票投资决策的投资者造成损失的，将依照相关法律法规的规定对该等投资者承担相应的民事赔偿责任。

二、本次公开发售股份情况

根据公司第二届董事会第三次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过

的关于调整《深圳深爱半导体股份有限公司申请在境内首次公开发行股票并上市方案》的议案，本次新老股份发行（售）数量安排如下：

本次新股发行数量应当根据公司实际的资金需求合理确定。根据询价结果，若预计新股发行募集资金额（扣除对应的发行承销费用后）超过本次募投项目所需资金总额的，公司将分以下两种情况操作：

（1）若本次公开发行时满足股东公开发售的条件，则相应减少本次新股发行数量，同时，股东可以公开发售适量的股份，股东公开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。新股发行数量与公司股东公开发售股份的数量合计须达到本次公开发行之后股本的 25%。

（2）若本次公开发行时不满足股东公开发售的条件，则公司将公开发行新股 6,635 万股，并将超出部分补充流动资金或调整本次新股发行价格，使得募集资金符合公司实际资金需求。

股东须同时满足以下条件才能公开发售股份：

（1）本次公开发行时，出现投资者获得本公司的配售股份且自愿为其设定 12 个月及以上限售期的情形。（自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者不得与公开发售股份的公司股东及相关利益方存在财务资助或者补偿、股份代持、信托持股等不当利益安排）。

（2）公司首次公开发行时，公司股东拟公开发售的股份，其已持有时间应当在 36 个月以上。

（3）公司股东公开发售股份后，公司的股权结构不得发生重大变化，实际控制人不得发生变更。

本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。符合条件的股东赛格集团、循杰投资和远致投资将按其各自原持有发行人的股份数占符合条件股东合计持有发行人的股份总数的比例公开发售股份。

股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

公司按公开发行新股的数量占本次公开发行新股与老股转让的总数的比例分摊承销费用；公开发售股份的股东按其发售股份的数量占本次公开发行新股与老股转让的总数的比例分摊承销费用，其他发行费用由公司承担。

本次公开发售股份的股东中，赛格集团、循杰投资和远致投资发行前分别持有本公司 79%、15%和 6%的股份，其中赛格集团为本公司的控股股东。本次发行后，赛格集团仍将保持其对本公司的控股地位，因而此次股东公开发售股份事项对公司控制权、治理结构及生产经营等不会造成不利影响。

三、利润分配发行前公司滚存未分配利润的安排

（一）发行前公司滚存未分配利润的安排

根据公司 2013 年年度股东大会决议，本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后，由公司发行后的新老股东按持股比例共享。截至 2013 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 7,465.80 万元。

（二）上市后利润分配政策

根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的公司章程（草案），本次发行后的股利分配政策为：

1、利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

2、利润分配形式和期间间隔：公司可以采取现金、股票、现金股票相结合或法律许可的其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

原则上，在符合现金分红的条件下，公司每年度进行一次现金分红，也可以进行中期现金分红。

3、现金分红的条件：

公司进行现金分红需要同时满足如下条件：

（1）公司当年可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正数；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

4、现金分红的比例：公司具备现金分红条件的，如无重大投资计划或重大资金支出，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

重大投资计划或重大资金支出是指：公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最新一期经审计净资产的 50%，且超过人民币 5,000 万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5、利润分配的决策机制与程序：

（1）进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案，公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

（2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（3）公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（4）公司当年盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表独立意见。

6、调整利润分配政策的决策机制与程序：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调

整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关利润分配政策调整的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表意见。调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

具体股利分配政策请详见本招股说明书“第十三节 股利分配政策”。

四、发行人请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并提醒投资者特别关注如下风险：

（一）市场竞争风险

公司作为国内半导体分立器件行业的主要制造企业，报告期内，公司营业收入分别为 46,396.28 万元、40,634.25 万元和 37,467.22 万元。公司现有 5 英寸芯片生产线两条，其生产能力主要用于节能照明用功率晶体管芯片的生产，拥有一定的规模优势。

公司所处半导体分立器件行业属于技术较为成熟的行业，竞争较为激烈。近年来，随着越来越多的国内生产企业开始进入半导体分立器件行业，部分同行生产企业通过增加生产线或进行技术改造，产能及质量得到较大提升，在一定程度上对公司现有市场占有率构成影响。其他部分集成电路生产厂商，如杭州士兰微等利用其设备、技术等优势，也相继进入半导体分立器件市场。同时，国际知名半导体公司对中国市场的加速开拓也可能对公司的经营带来不利影响。公司部分产品面临国内、国际同行企业的激烈竞争。如果在产品技术升级、质量控制、市场拓展等方面不能及时应对市场变化，公司面临的市场竞争风险将日益加剧。

（二）行业周期性波动风险

公司所在半导体分立器件行业受国内外宏观经济波动影响较大。一般来说，市场格局变动、电子整机市场状况、产品技术升级等因素将导致半导体行业产生周期性波动，从而间接影响公司的业务发展，出现相应的周期性波动。

2008 年我国半导体分立器件销售额为 937.80 亿元，2011 年已达到 1,388.60

亿元，年平均复合增长率为 13.98%。2012 年我国半导体分立器件的销售额为 1,390.00 亿元，同比略有增长，但增幅下降较快。由于受经济周期性波动的影响，半导体分立器件行业呈现一定的周期性特点，对公司的盈利状况影响较大。同时，尽管我国宏观经济发展长期向好的趋势不会发生改变，总体呈现较快的增长态势，但当前国内经济也存在发展不平衡、消费增长动力有所减弱等问题，不排除在未来出现周期性波动的可能性。因此，公司未来经营效益和盈利能力存在一定程度的波动风险。

（三）应收账款及应收票据金额较大的风险

报告期内，公司应收账款金额分别为 11,066.07 万元、11,355.51 万元和 10,346.21 万元，占当期营业收入的比例分别为 23.85%、27.95%、27.61%。公司应收账款虽然金额较大，但账龄较短，各年末账龄在一年以内的应收账款占比均在 98%以上。

报告期内，公司应收票据余额分别为 935.48 万元、4,368.26 万元和 6,956.30 万元，占营业收入的比例分别为 2.02%、10.75%和 18.57%。报告期内公司应收票据余额及其占营业收入的比例呈逐年增长趋势，主要原因是公司客户采用银行承兑汇票结算的规模增大，导致应收票据余额大幅增加。

未来随着公司生产销售规模的扩大，受市场环境变化及国家宏观政策等因素的影响，公司如果不能有效控制应收款项规模，或因主要客户经营状况变化而导致应收款项无法及时回收，将对生产经营和资金周转产生不利影响。

（四）核心技术失密风险

公司自1988年成立以来，一直注重对研发的投入。截至招股书签署之日，公司已获授权专利62项，其中发明专利11项，实用新型专利51项。公司是专业从事半导体分立器件芯片及成品管研发制造的高科技企业，公司建立了深圳市级技术中心，注重自主开发与产学研合作开发并行的研发管理模式，与北京大学深圳系统芯片设计（SOC）重点实验室展开科研合作和共建研发平台，建立“先进器件和工艺技术联合开发中心”。

公司所处半导体分立器件行业是典型的技术与知识密集型行业，相关知识产权和核心技术是赢得市场的关键。公司通过申请专利、与核心技术人员签订《保

密协议》、制定严格的知识产权保护管理制度等方式保护知识产权、核心技术并控制失密风险。但公司在经营过程中长期积累形成的生产工艺、工序安排等难以完全通过申请专利来加以保护，一旦外泄可能在一定程度上削弱公司的技术优势及市场竞争优势。

（五）募集资金投资项目存在的项目收益风险

本次募投6英寸0.35微米功率半导体器件芯片生产线项目主要生产MOSFET、肖特基二极管、IGBT、快恢复二极管和LED驱动电路等产品，项目投资总额为46,026万元。公司在编制项目可行性研究报告并做财务评价时，基于编制时点上述产品的市场价格和盈利水平，同时又结合近年来半导体分立器件行业的发展状况，对未来半导体分立器件的市场发展趋势进行预判。根据项目可行性研究报告，项目建成并达产后，预计年均新增销售收入33,429万元，年均新增利润总额6,427万元，项目投资内部收益率（税后）为15.32%，投资回收期（含建设期，税后）为6.37年。

由于本次募投项目所生产的产品市场竞争比较激烈，尤其是国际知名半导体厂商占据着主要地位，预计该项目达产时市场竞争将更加激烈，从而将直接影响项目的效益测算。因此，本次募投6英寸0.35微米功率半导体器件芯片生产线项目能否达到预期的盈利水平存在不确定性。

目录

重大事项提示	4
一、发行人及相关责任主体的承诺事项	4
二、本次公开发售股份情况	8
三、利润分配发行前公司滚存未分配利润的安排	10
四、发行人请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并提醒投资者特别关注如下风险：	12
目录	15
释义	19
第一节 概览	23
一、发行人简要情况	23
二、控股股东、实际控制人简要情况	24
三、主要财务数据和财务指标	25
四、本次发行情况	27
五、本次募集资金运用	28
第二节 本次发行概况	29
一、本次发行基本情况	29
二、本次发行的有关当事人	29
三、发行人与本次发行有关当事人之间的关系	31
四、预计本次发行上市的重要日期	31
第三节 风险因素	33
一、经营风险	33
二、行业风险	34
三、财务风险	35
四、技术风险	36
五、管理风险	37
七、募集资金投资项目相关风险	38
第四节 发行人基本情况	42
一、发行人基本情况	42
二、发行人改制重组及设立情况	42
三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况	46
四、发行人历次验资情况	53
五、发行人的组织结构	53
六、发行人控股子公司、参股公司情况	57
七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况	57
八、发行人股本情况	86
九、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况	87
十、发行人员工及其社会保障情况	87
十一、实际控制人、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺	89

第五节 业务与技术	93
一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况	93
二、发行人所处行业的基本情况	94
三、发行人的竞争地位	114
四、发行人主营业务的具体情况	122
五、与发行人主要业务相关的固定资产和无形资产	139
六、特许经营权情况	147
七、发行人的研发及技术储备情况	147
八、发行人核心技术人员情况	157
九、发行人境外经营情况	158
十、发行人产品质量控制情况	158
第六节 同业竞争与关联交易	161
一、同业竞争	161
二、关联方与关联交易	167
三、关联交易情况	169
四、规范关联交易决策权力与程序的安排	174
五、独立董事发表的相关意见	178
六、规范和减少关联交易的措施	178
第七节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员	180
一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历	180
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况	184
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况	185
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况	185
五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况	186
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系	188
七、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及其履行情况	188
八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员做出的重要承诺	189
九、董事、监事、高级管理人员的任职资格	190
十、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况	190
第八节 公司治理	192
一、公司治理制度的建立健全及运行情况	192
二、发行人近三年一期违法违规行情况	211
三、发行人近三年一期资金占用和对外担保情况	211
四、发行人的内部控制制度	211
第九节 财务会计信息	213
一、近三年经审计的财务报表	213
二、申报财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况	217
三、审计意见	217
四、主要会计政策和会计估计	218
五、执行的主要税收政策、缴纳的主要税种	235
六、最近一年及一期的收购兼并情况	235

七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表	235
八、发行人最近一期末主要资产	236
九、发行人最近一期末主要债项	240
十、报告期内所有者权益情况	245
十一、报告期内现金流量情况	246
十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	246
十三、报告期内主要财务指标	246
十四、资产评估情况	248
十五、股东出资、股本变化的验资情况	248
第十节 管理层讨论与分析	249
一、财务状况分析	249
二、盈利能力分析	261
三、现金流量分析	277
四、可比上市公司财务指标对比分析	279
五、资本性支出分析	280
六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项说明	281
七、未来分红回报规划	281
第十一节 业务发展目标	284
一、未来发展规划及目标	284
二、拟定上述发展规划所依据的假设条件	287
三、实现上述规划将面临的主要困难及挑战	287
四、确保实现业务发展目标的方式、方法或途径	288
五、发展规划与现有业务的关系	289
第十二节 募集资金运用	290
一、募集资金运用计划	290
二、6 英寸 0.35 微米功率半导体器件芯片生产线项目概述	291
三、补充生产经营所需营运资金概述	304
四、募集资金运用对经营成果和财务状况的影响	306
第十三节 股利分配政策	308
一、公司报告期内的股利分配政策	308
二、公司实际股利分配情况	308
三、本次发行完成前滚存利润的分配方案和已经履行的决策程序	309
四、发行后的股利分配政策	309
五、未来三年利润分配计划	311
六、发行人股东关于股利分配的承诺	312
七、保荐机构核查意见	312
第十四节 其他重要事项	313
一、信息披露和投资者关系相关情况	313
二、重要合同	313
三、对外担保情况	318

四、诉讼和仲裁事项	318
第十五节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	322
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明	322
保荐人（主承销商）声明	323
发行人律师声明	324
北京市友邦律师事务所承诺函	325
承担审计业务的会计师事务所声明	326
承担验资复核业务的机构声明	327
瑞华会计师事务所承诺函	328
承担评估业务的资产评估机构声明	329
中联资产评估集团有限公司承诺函	330
第十六节 备查文件	331

释义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、本公司、股份公司、深爱股份	指	深圳深爱半导体股份有限公司
深爱有限	指	公司前身深圳深爱半导体有限公司
赛格集团	指	深圳市赛格集团有限公司（1984 年 8 月成立，原名深圳市电子工业总公司，1985 年 11 月更名为深圳电子工业（集团）公司，1986 年 10 月更名为深圳电子集团公司，1988 年 2 月更名为深圳赛格集团公司，1997 年 7 月更名为深圳市赛格集团有限公司）
循杰投资	指	深圳市循杰投资股份有限公司
远致投资	指	深圳市远致投资有限公司
IBDT 亚洲	指	IBDT 亚洲有限公司
赛格香港	指	赛格（香港）有限公司
深圳投资	指	深圳市投资管理公司
意法半导体	指	意法半导体有限公司，简称 ST
创佳微	指	潮州市创佳微电子有限公司
绿谷工业	指	Green Valley Industries Ltd
深圳市国资委、深圳市国资局	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市国有资产监督管理局
华融资产管理	指	中国华融资产管理股份有限公司
东方资产管理	指	中国东方资产管理公司
长城资产管理	指	中国长城资产管理公司
深圳特建集团	指	深圳市特区建设发展集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
保荐人、保荐机构、主承销商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
发行人律师、友邦所	指	北京市友邦律师事务所
申报会计师、瑞华所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

本次发行	指	公司本次公开发行不超过6,635万股，每股面值为1元的人民币普通股（A股）行为
元	指	人民币元
最近三年、报告期	指	2011年、2012年、2013年
招股说明书、招股书	指	深圳深爱半导体股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
公司章程、章程	指	深圳深爱半导体股份有限公司公司章程
公司章程（草案）	指	深圳深爱半导体股份有限公司章程（草案）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
半导体器件	指	用半导体材料制成的固体电子器件
半导体分立器件	指	具有高电压、大电流、频率高、敏感等性能，不能被集成在一个芯片中的半导体器件
功率半导体器件	指	也称为电力电子器件，用于对电流、电压、频率、相位、相数等进行变换和控制，以实现整流（AC/DC）、逆变（DC/AC）、斩波（DC/DC）、开关、放大等各种功能的半导体器件
芯片	指	半导体元件产品的统称
分立器件芯片	指	在半导体片材上（单晶硅上）进行扩散、光刻、蚀刻、清洗、钝化、金属化等多道工艺加工，制成的能实现某种功能的半导体器件
封装	指	利用某种材料将芯片保护起来，并与外界环境隔离的方式和加工方法
二极管	指	晶体二极管的简称，是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面，具有单向传导电流的半导体器件
三极管	指	晶体三极管或晶体管的简称，在半导体锗或硅的单晶上制备两个能相互影响的pn结，组成一个pnp（或npn）结构。中间的n区（或p区）叫基区，两边的区域叫发射区和集电区，这三部分各有一条电极引线，分别叫基极b、发射极e和集电极c，是能起放大、振荡或开关等作用的半导体电子器件
晶体管	指	一种固体半导体器件，可基于输入的电压，控制流出的电流，可作为电流的开关，用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其他功能等，可以泛指一切以半导体材料为基础的单一元件，包括各种半导体材料制成的二极管、三极管、场效应管、可控硅等，不过国内习惯多指晶体三极管

双极型功率晶体管	指	由两个背靠背 PN 结构成的具有电流放大作用的晶体三极管，根据工作电压的极性有两种基本结构：pnp 型和 npn 型
场效应管	指	场效应晶体管（Field Effect Transistor，FET），由多数载流子参与导电，它属于电压控制型半导体器件，具有输入电阻高（ $10^8 \sim 10^9 \Omega$ ）、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点
MOSFET	指	金属氧化物半导体场效应晶体管，简称金氧半场效晶体管（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，MOSFET），是一种可以广泛使用在类比电路与数位电路的场效晶体管（field-effect transistor），依照其“通道”的极性不同，可分为 n-type 与 p-type 的 MOSFET
DMOS 功率晶体管	指	Double Diffused MOSFET，垂直双扩散金属-氧化物半导体场效应晶体管
CMOS	指	互补金属氧化物半导体场效应管
SBD/肖特基	指	肖特基二极管（Schottky Barrier Diode），不是利用 P 型半导体与 N 型半导体接触形成 PN 结原理制作的，而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的，因此，也被称为金属-半导体（接触）二极管或表面势垒二极管，是一种热载流子二极管
IGBT	指	绝缘栅双极功率晶体管（Insulated Gate Bipolar Transistor），综合了电力晶体管（Giant Transistor-GTR）和电力场效应管（Power MOSFET）的优点，具有良好的特性，应用领域很广泛
FRD	指	快恢复二极管（Fast Recovery Diode），一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的二极管，主要应用于开关电源、不间断电源、变频器等电子电路中
IC	指	Integrate Circuit 的缩写，集成电路
PIC	指	功率集成电路，即：将高压功率器件与信号处理系统及外围接口电路、保护电路、检测诊断电路等集成在同一芯片上的集成电路
英寸	指	计量半导体硅片直径的常用单位，4英寸约相当于100毫米
IDC	指	美国国际数据集团（IDG）的全资子公司（全称为 International Data Corporation简称IDC），IDG是全世界最大的信息技术出版、研究、会展与风险投资公司

GB/T	指	中华人民共和国国家标准
CSIA	指	中国半导体行业协会
ISO9001：2008	指	由 ISO（国际标准化组织）制定的质量管理和质量保证国际标准
ISO14001：2004	指	由ISO（国际标准化组织）制定的环境管理和环境保证国际标准
QC080000	指	由国际电工技术委员会下国际电子零件认证制度所核可的有害物质管理标准
RoHS	指	欧盟环境保护认证，通过该认证，指产品中不含对人体有害的 4 种重金属和 2 种阻燃剂

本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

第一节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人简要情况

（一）发行人基本情况

发行人名称	深圳深爱半导体股份有限公司
英文名称	SHENZHEN SI SEMICONDUCTORS CO.,LTD.
注册资本	19,900 万元
法定代表人	孙盛典
成立日期	1988 年 2 月 23 日（2010 年 12 月 27 日整体变更为股份有限公司）
公司住所	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路三号 8 号办公楼及活动楼 2-3 层
经营范围	生产、销售功率半导体器件（含电力电子器件）、集成电路及其有关的应用产品和整机产品；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（二）发行人设立情况

公司经深爱有限2010年第四次股东会决议通过，以及深圳国资局的批准（深圳国资局[2010]259号《关于深圳深爱半导体有限公司股份制改造方案有关事项的批复》），由深爱有限整体变更而来。2010年12月27日，深圳市市场监督管理局核发了注册号为440301501123797的营业执照，注册资本19,900万元。

公司整体变更设立时发起人的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	深圳市赛格集团有限公司	15,721	79.00
2	深圳市循杰投资股份有限公司	2,985	15.00
3	深圳市远致投资有限公司	1,194	6.00
合 计		19,900	100.00

（三）发行人主营业务及竞争优势

公司主要从事半导体分立器件芯片及成品管的研发、生产和销售，集芯片设计制造、器件封装测试、销售与服务为一体，形成了完整的半导体分立器件产业链。公司主要产品包括双极型功率晶体管、DMOS 器件、肖特基二极管、IGBT 器件、快恢复二极管、CMOS-IC 等共 10 多个系列，100 余种。公司产品广泛应用于绿色节能照明、消费类电子、LED 照明、通讯、开关电源等领域。

公司具有较强技术实力，2000 年通过“深圳市高新技术企业”认定，2001 年公司被评为深圳市 300 家最具成长性企业；2002 年被授予深圳最具竞争力企业；2003 年通过 ISO9001：2000 质量管理体系认证；2007 年通过深圳市级企业技术中心认定；2008 年被授予“深圳市自主创新行业龙头企业”；2009 年通过“高新技术企业”认定，同年，公司“MOSFET 功率晶体管”通过新产品鉴定、“功率 MOSFET 产业化项目”通过深圳发改委验收；2010 年，公司跻身国家发改委 174 家“国家高技术产业化示范工程”；2010 年 7 月和 2011 年 6 月，公司又相继承担了国家工业和信息化部“新型电力电子器件研发及产业化项目”和深圳发改委“高压系列功率 MOSFET 器件产业化项目”，2011 年获得“广东省自主创新标杆企业”，2012 年再次通过“高新技术企业”认定，2013 年获批组建深圳功率半导体器件工程实验室；自 2008 年以来，公司全面推行六西格玛管理，从根本上提升了公司的管理水平和技术创新能力。

公司为增强企业可持续发展能力，研制生产具有独立知识产权的产品，公司跟随高新技术发展趋势，抓住国家大力发展半导体产业的机遇，利用自身独具的行业和技术有利条件，积极推进 6 英寸功率半导体器件芯片生产线的筹建工作。

公司自主研发能力居于国内同行前列，目前拥有 62 项授权专利，其中发明专利 11 项，实用新型专利 51 项，另外，还有 16 项发明专利处于实质性审查或受理阶段。公司作为国内半导体分立器件行业的知名企业，在品牌、技术与研发、制造能力、生产管理与成本控制、团队等方面具有较强的竞争优势。经过多年的发展，公司与国内外多家知名企业建立了长期合作关系，主要客户包括镇江强凌、阳光照明、佛山照明、欧普照明、雷士照明、欧司朗、飞利浦、艾默生、松下、TCL、长城计算机等国内外知名企业。

二、控股股东、实际控制人简要情况

（一）控股股东简介

本次发行前，赛格集团持有发行人 15,721 万股股份，占本次发行前总股本的 79%，为发行人的控股股东。

赛格集团成立于 1984 年 8 月 23 日，住所为深圳市福田区华强北路 2 号赛格广场 61-62 楼，法定代表人为孙盛典，注册资本为 135,542 万元，经营范围为电子产品，家用电器，玩具，电子电信设备及器材、仪器仪表、汽摩配件、电脑及配件、办公自动化设备及用品、电子化工项目的生产研究（生产场地另办执照）；承接各种电子系统工程项目；开办电子通信类专业市场；人才培养；房地产开发（在合法取得土地使用权的地块上从事开发）；房地产经纪；货运代理；物流仓储；深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商场、展览业务；网络和信息工程的技术开发及维护；经营进出口业务；赛格注册商标有偿使用许可。投资咨询；投资管理；代理记账；企业登记代理。

（二）实际控制人简介

赛格集团由深圳市国有资产监督管理委员会、中国华融资产管理股份有限公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司共同投资设立，股权比例分别为：46.52%、29.51%、13.98%、9.99%，深圳市国资委持有赛格集团 46.52% 的股权，为发行人的实际控制人。

三、主要财务数据和财务指标

根据瑞华所出具的瑞华审字[2014]48130004 号《审计报告》，发行人报告期内财务数据如下：

（一）资产负债表主要数据

单位：元

项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产	371,037,671.84	314,452,606.74	295,459,928.72
非流动资产	262,610,456.12	260,835,375.16	242,945,605.68
资产总计	633,648,127.96	575,287,981.90	538,405,534.40

项目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动负债	216,899,331.89	172,586,401.62	180,002,868.34
非流动负债	26,115,066.08	18,981,813.22	10,399,999.90
负债合计	243,014,397.97	191,568,214.84	190,402,868.24
所有者权益合计	390,633,729.99	383,719,767.06	348,002,666.16

（二）利润表主要数据

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	374,672,195.91	406,342,542.23	463,962,847.43
营业利润	23,964,511.64	37,152,698.06	33,664,660.95
利润总额	29,649,295.88	40,289,386.92	38,085,118.23
净利润	26,813,962.93	35,717,100.90	34,947,937.76
非经常性损益	5,028,249.00	2,715,231.13	3,757,388.69
扣除非经常性损益后的净利润	21,785,713.93	33,001,869.77	31,190,549.07

（三）现金流量表主要数据

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	15,511,901.62	20,268,982.77	24,209,596.62
投资活动产生的现金流量净额	-57,861,913.96	-34,010,026.75	-24,838,212.51
筹资活动产生的现金流量净额	42,097,849.37	17,922,214.10	12,897,700.18
汇率变动对现金的影响额	-134,642.82	-31,965.75	-283,509.19
现金及现金等价物净增加额	-386,805.79	4,149,204.37	11,985,575.10

（四）主要财务指标

项 目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
-----	------------	------------	------------

项 目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动比率（倍）	1.71	1.82	1.64
速动比率（倍）	1.16	1.20	0.97
资产负债率（%）	38.35	33.30	35.36
每股净资产（元/股）	1.96	1.93	1.75
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例（%）	2.91	3.41	3.30
项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
应收账款周转率	3.27	3.43	4.29
存货周转率	2.44	2.61	2.92
息税折旧摊销前利润（万元）	6,792.37	7,650.61	7,319.89
净利润（万元）	2,681.40	3,571.71	3,494.79
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	2,178.57	3,300.19	3,119.05
利息保障倍数	16.88	13.49	62.73
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.08	0.10	0.12
每股净现金流量（元/股）	0.00	0.02	0.06
基本每股收益（元/股）	0.14	0.18	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.17	0.16
加权平均净资产收益率（%）	6.99	9.76	10.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.68	9.02	9.44

四、本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A 股）
股票面值	人民币 1.00 元
发行股数	公司本次公开发行新股数量与公司股东公开发售股份数量之和为不超过 6,635 万股，占发行后总股本的 25%。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。最终发行数量以本次发行募集资金投资项目所需资金量和中国证监会的最终核准文件为准。
发行价格	【】元，通过向询价对象询价确定

发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	由保荐机构（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销

五、本次募集资金运用

本次发行募集资金扣除发行费用后，全部用于与发行人主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。本次募集资金投向经发行人 2014 年第一次临时股东大会审议确定，由董事会负责实施，具体用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资额	核准文号
1	6 英寸 0.35 微米功率半导体器件芯片生产线项目	46,026	深发改备案[2013]0019 号
2	补充生产经营所需营运资金	9,000	
合 计		55,026	

上述募集资金投资项目的详细情况请参见本招股说明书“第十二节 募集资金运用”部分。上述项目资金的使用，按照轻重缓急的顺序安排。如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决；所筹资金如果有剩余，将用于补充流动资金；如本次发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自主资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

为适应经营发展需要，抢占市场先机，公司于 2013 年 9 月 6 日与绿谷工业签订关于 6 英寸线半导体设备的购置合同，预先购置部分 6 英寸线设备，合同金额共计 600 万美元。截至 2014 年 1 月 31 日，公司已全额支付设备购置款 600 万美元（合计人民币 3,669.17 万元），收到进口设备共计 274 台。目前，公司正在测试相关设备的可靠性，为启用 6 英寸生产线做前期准备。经深圳市发展和改革委员会批准，该项目被列为“深圳市 2014 年度重大项目”。

第二节 本次发行概况

一、本次发行基本情况

股票种类	人民币普通股（A股）
股票面值	1.00 元
发行股数	公司本次公开发行新股数量与公司股东公开发售股份数量之和不超过 6,635 万股，占发行后总股本的 25%。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。最终发行数量以本次发行募集资金投资项目所需资金量和中国证监会的最终核准文件为准
发行价格	【】元，发行人与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格（或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格）
发行市盈率	【】倍（按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行前每股净资产	【】元（以截至【】年【】月【】日经审计的净资产除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（以截至【】年【】月【】日经审计的净资产加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产）
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式（或届时中国证监会规定的其他方式）
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	【】万元
发行费用	合计【】万元
	其中：承销及保荐费用【】万元；公司按公开发行新股的数量占本次公开发行新股与老股转让的总数的比例分摊承销费用
	审计费用【】万元
	评估费用【】万元
	律师费用【】万元
	发行手续费用【】万元

二、本次发行的有关当事人

（一）发行人：深圳深爱半导体股份有限公司

法定代表人：孙盛典

注册地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路三号8号办公楼及活动楼2-3层

电话：0755-82260060

传真：0755-82400426

联系人：王军立

（二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

法定代表人：牛冠兴

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

电话：0755-82825427

传真：0755-82825424

保荐代表人：范文明、谢顺利

项目协办人：陈鹏

项目组其他成员：周玲、徐露、王传文

（三）律师事务所：北京市友邦律师事务所

负责人：周卫平

注册地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场10号楼307号

电话：010-58205196

传真：010-58205996

经办律师：周卫平、刘霞

（四）会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：杨剑涛

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

电话：010-88219191

传真：010-88210558

经办会计师：范江群、邱志强

（五）资产评估机构：中联资产评估集团有限公司

负责人：沈琦

注册地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层

电话：010-88000066

传真：010-88000006

经办资产评估师：睢剑安、莫少霞

（六）申请上市证券交易所：深圳证券交易所

负责人：宋丽萍

地址：深圳市深南东路 5045 号

电话：0755－82083333

传真：0755－82083164

（七）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

注册地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

（八）收款银行：

户名：

账号：

三、发行人与本次发行有关当事人之间的关系

截至招股说明书签署日，公司与本次发行有关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其它权益关系。

四、预计本次发行上市的重要日期

1、刊登发行公告的日期：【】年【】月【】日

- 2、开始询价推介的日期：【】年【】月【】日
- 3、刊登定价公告日期：【】年【】月【】日
- 4、申购日期和缴款日期：【】年【】月【】日
- 5、股票上市日期：【】年【】月【】日

第三节 风险因素

投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应认真考虑下述各项风险因素。下述风险根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、经营风险

（一）市场竞争风险

公司作为国内半导体分立器件行业的主要制造企业，报告期内，公司营业收入分别为 46,396.28 万元、40,634.25 万元和 37,467.22 万元。公司现有 5 英寸芯片生产线两条，其生产能力主要用于节能照明用功率晶体管芯片的生产，拥有一定的规模优势。

公司所处半导体分立器件行业属于技术较为成熟的行业，竞争较为激烈。近年来，随着越来越多的国内生产企业开始进入半导体分立器件行业，部分同行生产企业通过增加生产线或进行技术改造，产能及质量得到较大提升，在一定程度上对公司现有市场占有率构成影响。其他部分集成电路生产厂商，如杭州士兰微等利用其设备、技术等优势，也相继进入半导体分立器件市场。同时，国际知名半导体公司对中国市场的加速开拓也可能对公司的经营带来不利影响。公司部分产品面临国内、国际同行企业的激烈竞争。如果在产品技术升级、质量控制、市场拓展等方面不能及时应对市场变化，公司面临的市场竞争风险将日益加剧。

（二）产品应用领域较为集中的风险

目前，公司研发生产的功率晶体管主要应用于节能照明领域，在节能照明领域的销售占比近八成，产品结构较为集中。半导体分立器件行业产品更新换代快、生产厂商众多、市场竞争较为激烈，如果公司产品不能及时应对下游客户和消费者的需求变化，将会对产品的销量、价格和毛利率产生不利影响。

（三）下游行业市场波动风险

节能照明及电源是公司产品的重要应用方向，目前公司主导产品为节能照明

配套器件，下游市场对于节能照明用功率晶体管的需求将直接影响公司产品的销售。国际市场方面，欧洲主权国家债务危机的中心地区属于节能照明产品采购的主要地区，目前仍在发酵的欧债危机在一定程度上抑制了该地区的消费，也间接造成功率晶体管需求的减少。国内市场方面，由于功率晶体管具有环保、节能等特点，且契合国家节能减排的发展方针，越来越多的企业进入半导体照明领域。一旦下游市场出现竞争加剧与产业升级，公司将可能面临不利局面，从而影响公司的盈利能力。

（四）主要原材料价格波动及劳动力成本上升的风险

目前，公司产品的主要原材料包括单晶硅片、铜材引线框架、化学试剂等，均属资源类产品，原材料成本比例较高，其价格受市场供求关系的影响，存在较大幅度的波动。如果原材料价格发生波动，公司产品的成本和毛利率水平将受到直接影响，从而导致公司的盈利水平出现波动。

报告期内，国内企业职工最低工资标准呈上升趋势。目前，公司薪酬水平在深圳高新技术企业中属于中等水平，今后如果劳动力成本增长过大过快，将对公司盈利水平的持续增长带来不利影响。

二、行业风险

（一）行业周期性波动风险

公司所在半导体分立器件行业受国内外宏观经济波动影响较大。一般来说，市场格局变动、电子整机市场状况、产品技术升级等因素将导致半导体行业产生周期性波动，从而间接影响公司的业务发展，出现相应的周期性波动。

2008 年我国半导体分立器件销售额为 937.80 亿元，2011 年已达到 1,388.60 亿元，年平均复合增长率为 13.98%。2012 年我国半导体分立器件的销售额为 1,390.00 亿元，同比略有增长，但增幅下降较快。由于受经济周期性波动的影响，半导体分立器件行业呈现一定的周期性特点，对公司的盈利状况影响较大。同时，尽管我国宏观经济发展长期向好的趋势不会发生改变，总体呈现较快的增长态势，但当前国内经济也存在发展不平衡、消费增长动力有所减弱等问题，不排除在未来出现周期性波动的可能性。因此，公司未来经营效益和盈利能力存在一定

程度的波动风险。

（二）行业利润水平下降的风险

根据产品周期理论，产品毛利率水平随着产品技术成熟而降低，具有周期性特点。随着我国半导体分立器件行业中传统功率晶体管产品的逐步成熟，该等产品最终将进入技术成熟期后的价格自然下跌过程，利润率将回归行业平均利润水平。

在半导体分立器件行业内部，利润率水平的变动呈现一定的结构性特征。低端产品由于行业准入门槛低、竞争激烈等特点，将导致部分生产企业盈利水平低下、发生库存积压等问题；中高端产品如 MOSFET、IGBT，技术及资金壁垒较高，生产企业相对较少，利润率水平能够在较长一段时期内保持稳定。公司如果不能及时调整产品结构或实现技术升级，可能面临现有产品利润水平下降的风险。

三、财务风险

（一）应收账款及应收票据金额较大的风险

报告期内，公司应收账款金额分别为 11,066.07 万元、11,355.51 万元和 10,346.21 万元，占当期营业收入的比例分别为 23.85%、27.95%、27.61%。公司应收账款虽然金额较大，但账龄较短，各年末账龄在一年以内的应收账款占比均在 98%以上。

报告期内，公司应收票据余额分别为 935.48 万元、4,368.26 万元和 6,956.30 万元，占营业收入的比例分别为 2.02%、10.75%和 18.57%。报告期内公司应收票据余额及其占营业收入的比例呈逐年增长趋势，主要原因是公司客户采用银行承兑汇票结算的规模增大，导致应收票据余额大幅增加。

未来随着公司生产销售规模的扩大，受市场环境变化及国家宏观政策等因素的影响，公司如果不能有效控制应收款项规模，或因主要客户经营状况变化而导致应收款项无法及时回收，将对生产经营和资金周转产生不利影响。

（二）存货减值风险

报告期内，公司存货账面价值分别为 12,155.06 万元、10,770.24 万元和 11,969.12 万元，占公司流动资产的比例分别为 41.14%、34.25%和 32.26%，占公司总资产比例分别为 22.58%、18.72%和 18.89%，报告期内未发生存货大幅度减值的情况。报告期，针对存货中库存商品和自制半成品较多的现状，公司通过完善存货管理制度促使存货在流动资产、资产总额中所占比例逐年下降。

由于公司所属半导体分立器件行业产品更新速度较快，如果市场形势发生重大变化，公司未能及时加强生产计划管理和库存管理，可能出现存货减值及滞压，从而对公司的财务状况造成不利影响。

（三）净资产收益率下降风险

报告期内，公司净资产收益率分别为 10.57%、9.76%和 6.99%。本次募集资金到位后，公司净资产数额将有较大幅度的增长，公司经营业绩将大幅摊薄。同时，募投项目存在实施周期，新产品的市场和技术培育需要一段时间，难以在短期内实现较大收益。因此，募集资金到位后，公司盈利增长可能不会与净资产保持同步增长，将直接影响公司净资产收益率水平的提高。

（四）汇率波动风险

公司在产品出口、设备进口和原辅材料进口业务中涉及外汇交易，并主要以美元进行结算，报告期内，公司出口业务收入分别为 3,509.08 万元、3,937.87 万元和 4,470.37 万元，占主营业务收入的比例分别为 7.75%、9.85%和 12.27%。近年来，人民币汇率波动较大，公司出口业务存在一定的汇率波动风险，如果人民币汇率发生较大变动，将在一定程度上影响公司的经营业绩。

四、技术风险

（一）核心技术失密风险

公司自1988年成立以来，一直注重对研发的投入。截至招股书签署之日，公司已获授权专利62项，其中发明专利11项，实用新型专利51项。公司是专业从事半导体分立器件芯片及成品管研发制造的高科技企业，公司建立了深圳市级技术中心，注重自主开发与产学研合作开发并行的研发管理模式，与北京大学深圳系

统芯片设计（SOC）重点实验室展开科研合作和共建研发平台，建立“先进器件和工艺技术联合开发中心”。

公司所处半导体分立器件行业是典型的技术与知识密集型行业，相关知识产权和核心技术是赢得市场的关键。公司通过申请专利、与核心技术人员签订《保密协议》、制定严格的知识产权保护管理制度等方式保护知识产权、核心技术并控制失密风险。但公司在经营过程中长期积累形成的生产工艺、工序安排等难以完全通过申请专利来加以保护，一旦外泄可能在一定程度上削弱公司的技术优势及市场竞争优势。

（二）技术人才流失风险

半导体分立器件行业对研发人员专业知识和经验的要求较高。公司各项核心技术是由以核心技术人员为主的研发团队经过多年的自主技术开发和生产实践取得，是公司核心竞争力的关键组成部分。目前，公司通过提高薪酬福利待遇、加强企业文化建设等措施来确保公司核心技术人员稳定。随着公司所处行业市场竞争的日益激烈，同行业其他生产企业如果采取更为主动的人才竞争策略，同时，随着公司募集资金建设项目的投入，公司将需要更多的高素质人才。如果公司不能有效控制技术人员流失的潜在风险，并积极培养技术研发新人，将面临技术创新与业务发展受阻的风险，并对公司的技术研发及可持续发展带来一定程度的负面影响。

五、管理风险

（一）实际控制人及控股股东控制的风险

赛格集团为公司控股股东。本次发行前，赛格集团持有公司 79%的股权，持股比例较高。深圳市国资委通过持有公司控股股东赛格集团 46.52%的股权而成为公司的实际控制人。本次发行后，赛格集团持股比例仍将超过 50%，为公司第一大股东，深圳市国资委仍为实际控制人。

虽然《公司章程》就控股股东、实际控制人的诚信义务、关联股东和关联董事的回避表决制度等做出了规定，并建立了独立董事的监督制约机制。同时，公司控股股东出具了避免同业竞争的承诺函，但仍存在控股股东利用其控制地位，

公司正常持续运营的外部政策、法律环境，如果政策法规发生变化，可能对公司的生产经营、资本投资等方面带来一定影响。

（二）税收优惠政策变化风险

公司于2009年6月获得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的“高新技术企业”认定证书。根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，公司在获得认定证书的3年之内享受15%的优惠税率。公司已在高新技术企业资格期满前三个月内提出复审申请，并已通过高新技术企业资格的复审（《高新技术企业证书》编号为GF201244200277，发证日期为2012年9月12日）。

报告期内，公司因享受税收优惠政策对净利润的合计影响数分别为209.15万元、304.82万元和189.02万元，占各期利润总额的比例分别为5.49%、7.57%和6.38%。如果未来国家变更、取消高新技术企业税收优惠政策，或者公司未能通过高新技术企业资格复审，将对公司未来的经营业绩产生不利影响。

七、募集资金投资项目相关风险

（一）募集资金投资项目存在的项目收益风险

本次募投 6 英寸 0.35 微米功率半导体器件芯片生产线项目主要生产 MOSFET、肖特基二极管、IGBT、快恢复二极管和 LED 驱动电路等产品，项目投资总额为 46,026 万元。公司在编制项目可行性研究报告并做财务评价时，基于编制时点上述产品的市场价格和盈利水平，同时又结合近年来半导体分立器件行业的发展状况，对未来半导体分立器件的市场发展趋势进行预判。根据项目可行性研究报告，项目建成并达产后，预计年均新增销售收入 33,429 万元，年均新增利润总额 6,427 万元，项目投资内部收益率（税后）为 15.32%，投资回收期（含建设期，税后）为 6.37 年。

由于本次募投项目所生产的产品市场竞争比较激烈，尤其是国际知名半导体厂商占据着主要地位，预计该项目达产时市场竞争将更加激烈，从而将直接影响项目的效益测算。因此，本次募投 6 英寸 0.35 微米功率半导体器件芯片生产线

项目能否达到预期的盈利水平存在不确定性。

（二）产能扩张导致的销售风险

公司本次募集资金投资项目围绕公司的主营业务展开，符合国家产业政策，具有较好的市场前景。本次募投 6 英寸 0.35 微米功率半导体器件芯片生产线项目主要生产产品为高压功率 MOSFET 和肖特基二极管，同时根据市场需求和技术储备状况生产 IGBT、快恢复二极管和 LED 驱动电路等，项目达产后将形成年产功率半导体芯片 48 万片的能力。本项目生产出的产品属于公司的新产品品种，在现有产品已获得客户认可的情况下，新产品的产能扩张将对公司的市场开拓能力提出更高要求。如果公司推出的新产品在性能和价格方面无法满足市场需求，有可能因市场开拓不力导致新增产能无法消化，存在募集资金投资项目的效益不能如期实现的风险。

（三）新增固定资产折旧风险

受现有资本实力限制，公司目前固定资产规模相对较小。截至 2013 年 12 月 31 日，公司固定资产账面净值为 231,307,781.04 元，本次募集资金投资项目建成后，公司新增固定资产约 43,880 万元，每年新增折旧约 4,467 万元，每年新增摊销约 509 万元，合计每年新增折旧和摊销 4,976 万元。

尽管公司充分考虑了各种内外部因素对募集资金投资项目效益的影响，并且本次募投项目可行性研究结果也显示本次募投项目的总体经济效益足以抵消新增折旧摊销导致的经营成本增加，但下游产品市场环境变化存在一定的不确定性，如果公司本次募投项目研发生产的新产品无法满足目标市场需求，预期效益无法实现，新增折旧摊销可能对公司未来业绩构成不利影响。

（四）募集资金投资项目的市场风险

公司本次募集资金投资项目经过了慎重、充分的可行性论证，具有较好的市场、技术基础，并且公司已经采取各项措施加强市场拓展及售后服务工作，加快产品研发，促进产品更新换代，争取在行业中保持领先地位，应对可能出现的形势变化。但本次募投项目的可行性分析主要是基于当前市场环境、现有技术基础等因素所作出，如果未来市场环境发生较大变化或项目实施过程中发生不可预见

项目能否达到预期的盈利水平存在不确定性。

（二）产能扩张导致的销售风险

公司本次募集资金投资项目围绕公司的主营业务展开，符合国家产业政策，具有较好的市场前景。本次募投 6 英寸 0.35 微米功率半导体器件芯片生产线项目主要生产产品为高压功率 MOSFET 和肖特基二极管，同时根据市场需求和技术储备状况生产 IGBT、快恢复二极管和 LED 驱动电路等，项目达产后将形成年产功率半导体芯片 48 万片的能力。本项目生产出的产品属于公司的新产品品种，在现有产品已获得客户认可的情况下，新产品的产能扩张将对公司的市场开拓能力提出更高要求。如果公司推出的新产品在性能和价格方面无法满足市场需求，有可能因市场开拓不力导致新增产能无法消化，存在募集资金投资项目的效益不能如期实现的风险。

（三）新增固定资产折旧风险

受现有资本实力限制，公司目前固定资产规模相对较小。截至 2013 年 12 月 31 日，公司固定资产账面净值为 231,307,781.04 元，本次募集资金投资项目建成后，公司新增固定资产约 43,880 万元，每年新增折旧约 4,467 万元，每年新增摊销约 509 万元，合计每年新增折旧和摊销 4,976 万元。

尽管公司充分考虑了各种内外部因素对募集资金投资项目效益的影响，并且本次募投项目可行性研究结果也显示本次募投项目的总体经济效益足以抵消新增折旧摊销导致的经营成本增加，但下游产品市场环境变化存在一定的不确定性，如果公司本次募投项目研发生产的新产品无法满足目标市场需求，预期效益无法实现，新增折旧摊销可能对公司未来业绩构成不利影响。

（四）募集资金投资项目的市场风险

公司本次募集资金投资项目经过了慎重、充分的可行性论证，具有较好的市场、技术基础，并且公司已经采取各项措施加强市场拓展及售后服务工作，加快产品研发，促进产品更新换代，争取在行业中保持领先地位，应对可能出现的形势变化。但本次募投项目的可行性分析主要是基于当前市场环境、现有技术基础等因素所作出，如果未来市场环境发生较大变化或项目实施过程中发生不可预见

因素，公司可能将面临项目延期或不能达到预期收益的风险。

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

发行人名称	深圳深爱半导体股份有限公司
英文名称	SHENZHEN SI SEMICONDUCTORS CO., LTD.
注册资本	19,900 万元
法定代表人	孙盛典
成立日期	1988 年 2 月 23 日（2010 年 12 月 27 日整体变更为股份有限公司）
公司住所	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路三号 8 号办公楼及活动楼 2-3 层
邮政编码	518116
电 话	0755-8226 0060
传 真	0755-8240 0426
互联网址	http://www.sisemi.com.cn
电子邮箱	sisemi@sisemi.com.cn
信息披露和投资者关系的部门、负责人、电话	部门：证券部 负责人：王军立 电话：0755-2597 0821

二、发行人改制重组及设立情况

（一）公司设立方式

本公司是由深圳深爱半导体有限公司整体变更设立的股份有限公司。

2010年9月29日，深爱有限2010年第四次股东会通过了公司整体变更设立股份有限公司的决议。2010年10月27日，各发起人签署了《深圳深爱半导体股份有限公司发起人协议》，全体股东同意以截止2010年7月31日经深圳市鹏城会计师事务所审计的净资产326,169,235.01元为基础，扣除20,700,000.00元应付股东股利，按1：0.6515的比例折为股份公司总股本199,000,000股，每股面值为人民币1元；其余部分人民币106,469,235.01元作为股份公司资本公积，由全体股东按出资比例共享。

2010年12月14日，经深圳市国有资产监督管理局《关于深圳深爱半导体有限公司股份制改造方案有关事项的批复》（深国资局[2010]259号）文件批准，深

爱有限整体变更为股份有限公司。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次整体变更为股份公司注册资本实收情况进行了审验，并于2010年12月15日出具了深鹏所验字[2010]456号《验资报告》。

2010年12月27日，公司在深圳市市场监督管理局完成工商变更手续，并领取了《企业法人营业执照》（注册号：440301501123797），法定代表人为孙盛典，注册资本19,900万元人民币。

自股份公司设立以来，公司股权结构及股本规模未发生变动。

（二）发起人

本公司发起人为赛格集团、循杰投资和远致投资。发起人及其持股情况如下：

序号	发起人	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	深圳市赛格集团有限公司	15,721.00	79.00
2	深圳市循杰投资股份有限公司	2,985.00	15.00
3	深圳市远致投资有限公司	1,194.00	6.00
合 计		19,900.00	100.00

（三）改制设立发行人之前，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务

发行人的主要发起人为赛格集团。发行人改制设立前赛格集团拥有的主要资产为对各子公司的股权投资。

（四）发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务

发行人系由深爱有限整体变更设立而来，发行人承继了深爱有限的全部资产、负债和业务。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（深鹏所审字[2010]1417号），截至发行人设立审计基准日2010年7月31日，深爱有限资产总额59,129.01万元，其中流动资产35,709.65万元，固定资产16,766.95万元，净资产32,616.92万元。

发行人成立时的经营范围为：生产和销售功率半导体器件（含电力电子器

件)、集成电路及其有关的应用产品和整机产品;经营进出口业务。

发行人变更设立前后拥有的主要资产和实际从事的业务均无重大变化。

(五) 发行人成立之后,主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务

本公司成立后,主要发起人赛格集团所拥有的主要资产和从事的主要业务均未发生变化。

(六) 改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原企业和发行人业务流程间的联系

发行人系由深爱有限整体变更设立,改制前后发行人的业务流程没有发生变化。关于发行人业务流程的具体内容参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、发行人主营业务的具体情况”。

(七) 发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

公司成立以来,在生产经营方面独立运作,不存在依赖主要发起人的情形。报告期内,公司与主要关联方的关联交易具体内容,请参见本招股说明书“第六节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方与关联交易”。

(八) 发起人出资资产的产权变更手续办理情况

公司成立后,承继了深爱有限的全部资产、负债,大部分资产的产权已变更为发行人,部分商标的产权变更手续正在办理过程中,权利人由深爱有限更名至发行人不存在法律障碍。

(九) 公司独立运行情况

公司成立以来,均严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的要求规范运作。公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司股东及其控制的企业完全分开、独立运作,具有完整的业务体系和直接面向市场

独立经营的能力。

1、资产完整情况

公司在整体变更设立时，深爱有限的资产和负债全部由公司承继，公司资产与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产严格分开，并完全独立运营。公司目前业务和经营必需的资产的权属由公司独立享有。公司未以资产、权益或信誉为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立情况

公司设有独立的人力资源部。所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均系公司专职工作人员，不存在在股东单位兼任管理职务的情况；股东推荐的董事人选均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理和其他高级管理人员均由董事会聘任。公司独立发放工资。公司总经理、副总经理、董事会秘书均未在控股股东及其控制的其它企业领薪。

3、财务独立情况

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合实际情况，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。公司财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其它企业兼职的情况。公司在银行开设了独立账户，独立支配自主资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

4、机构独立情况

公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化公司分权管理与监督职能，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展日常经营活动，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业干预公司经营

营活动的情况。

5、业务独立情况

公司主要从事半导体分立器件芯片及成品管的研发、生产和销售。公司拥有主营业务所必须的独立的研发、生产以及销售系统；与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，不存在依赖控股股东及实际控制人及其控制的其他企业的情况，具备独立面向市场自主经营的能力。公司控股股东已向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不从事与公司相同或类似的业务。

三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况

（一）发行人股本形成及其变化情况

1、1988 年深爱有限设立

1987年12月15日，经深圳市人民政府以深府外复【1987】378号文《关于合资经营“深圳深爱半导体有限公司”合同书的批复》批准，赛格集团与IBDT亚洲合资设立深爱有限，注册资本为539.84万美元，投资总额为1,349.60万美元。其中，赛格集团占72.95%；IBDT亚洲占27.05%。主要经营范围为生产、销售功率半导体器件，集成电路及其有关的应用产品和整机产品。

1987年12月15日，深圳市人民政府核发外经贸深外资字【1988】19号《中外合资经营企业批准证书》。

1988年2月23日，深爱有限获准登记，领取了工商企粤深字191560号《营业执照》。1989年4月5日，深爱有限法定代表人变更工商登记，领取了新的《营业执照》（注册号：工商外企合粤深字第100170号）。

深圳中华会计师事务所于1989年3月4日出具了验资报字（1989）第019号《验资报告》，验证截至1989年1月31日，合营各方第一期缴付出资17,778,946.66元人民币，较注册资本欠缴人民币2,221,053.34元。

深圳市文武会计师事务所于1995年5月24日出具了深文验资报字（1995）第026号《验资报告书》，查定IBDT亚洲第二期缴付出资1,176,619.54元人民币。

深圳市文武会计师事务所于1995年6月8日出具深文验资报字（1995）第028号《验资报告书》，查定赛格集团第二期缴付出资1,044,433.80元人民币。截至1995年6月8日，合营各方实际缴付的出资额计2,000万人民币，占注册资本的100%。

深爱有限成立时，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	赛格集团	1,459.00	72.95
2	IBDT 亚洲有限公司	541.00	27.05
合 计		2,000.00	100.00

2、1995 年第一次增资及股权转让（注册资本 800 万美元）

根据赛格集团、IBDT亚洲与深圳市投资管理公司于1994年7月签订的注资协议书，深圳市投资管理公司向深爱有限投资100万美元（占增资后公司出资额的6.395%），再以100万美元的价格受让赛格集团持有深爱有限增资后的6.395%出资额。1994年7月18日，深爱有限董事会决议通过了上述增资转让事宜。

1995年5月13日，IBDT亚洲有限公司与赛格香港签订了股权转让协议，根据该协议，IBDT亚洲有限公司将其在深爱有限的全部股权，以163.8万美元转让与赛格香港。

1995年5月14日，赛格集团与赛格香港签订股权转让协议，根据该协议，鉴于IBDT亚洲有限公司在深爱有限的实际投入为163.8万美元，赛格香港受让IBDT亚洲有限公司的全部股份后，其实际投入占各方总投入（1,563.67万美元）的比例仅为10.48%，双方同意赛格集团将其持有深爱有限14.7%的股权以230万美元转让与赛格香港后，赛格香港持有深爱有限的股权比例共计25.18%。

1995年7月30日，赛格集团、赛格香港和深圳市投资管理公司重新签订了合资合同，约定将深爱有限的注册资本增至800万美元，投资总额变更为1,563.67万美元。

1995年8月30日，深爱有限新一届董事会对上述股权转让予以确认。

1995年9月7日，深圳市国有资产管理办公室出具《关于同意深圳赛格集团转让部分股份给赛格（香港）有限公司和深圳市投资管理公司的决定》，同意了上述的股权转让事宜。1995年12月13日，深圳市引进外资领导小组办公室业已批准了新的合资合同和公司章程。

深圳市永明会计师事务所于1996年1月17日出具了验资（1996）205号《验资报告》，对此次增资进行了审验。查定截至1996年1月16日，深爱有限实收资本为800万美元。

1995年12月21日，国家工商总局核准了上述事宜。深爱有限领取了企合粤深

总字第100170号《营业执照》。

1996年3月29日，深爱有限领取了外经贸深合资证字[1987]0022号中外合资经营企业批准证书。

上述变更完成后，深爱有限股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万美元）	出资比例（%）
1	赛格集团	496.24	62.03
2	赛格（香港）有限公司	201.44	25.18
3	深圳市投资管理公司	102.32	12.79
合 计		800.00	100.00

3、2003 年第二次增资（注册资本 1,560 万美元）

2002年12月3日，深爱有限股东赛格集团、赛格香港和深圳市投资管理公司签署合资合同之补充合同，约定以资本公积转增股本的方式将注册资本增至1,560万美元，公司投资总额增至2,980万美元，各方投资比例不变。

2003年2月25日，深爱有限召开董事会，审议批准了上述增资事宜。

2003年3月27日，深圳市对外贸易经济合作局出具《关于合资企业“深圳深爱半导体有限公司”增资、变更经营范围的批复》（深外经贸资复[2003]1072号），同意深爱有限注册资本由800万美元增至1,560万美元。

深圳鹏城会计师事务所于2003年3月14日出具深鹏所专审字[2003]27号专项审计报告，查定截止2003年2月28日公司资本公积为763.70万美元。

深圳市永明会计师事务所于2003年5月15日出具了深永验字（2003）0233号《验资报告》，对此次增资进行了审验。验证截至2003年3月31日，深爱有限新增注册资本760万美元，变更后注册资本为1,560万美元。

2003年3月31日，深圳市工商行政管理局核发《营业执照》。

本次增资后，深爱有限股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万美元）	出资比例（%）
1	赛格集团	967.668	62.03
2	赛格（香港）有限公司	392.808	25.18
3	深圳市投资管理公司	199.524	12.79
合 计		1,560.000	100.00

4、2004 年第二次股权转让

根据深圳市国有资产管理办公室于2003年9月29日出具的《关于划转深圳深

爱半导体有限公司12.79%股权问题的批复》（深国资办[2003]229号），深圳市投资管理公司将其持有的深爱有限12.79%股权划转给赛格集团，以2002年12月31日深爱有限审计后的净资产值作为划转依据，免于资产评估。

2004年1月6日，深爱有限合资双方股东赛格集团和赛格香港重新签订《深圳深爱半导体有限公司合资合同》。

2004年2月6日，深爱有限董事会同意深圳市投资管理公司将其持有的12.79%深爱有限股权划转给赛格集团。

2004年2月23日，深圳市对外贸易经济合作局出具《关于合资企业“深圳深爱半导体有限公司”股权变更的批复》（深外经贸资复[2004]0439号），同意深圳市投资管理公司将其持有的12.79%深爱有限股权划转给赛格集团。

2004年4月23日，深圳市工商行政管理局核准了上述变更事宜。

本次股权变更后，股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万美元）	出资比例（%）
1	赛格集团	1,167.192	74.82%
2	赛格（香港）有限公司	392.808	25.18%
合 计		1,560.000	100.00

5、2007 年第三次增资（注册资本 2,540 万美元）

2007年8月22日，深爱有限董事会同意公司以盈余公积金转增注册资本至2,540万美元，投资总额增至3,960万美元。

2007年8月23日，深爱有限合资双方股东赛格集团和赛格香港就上述变更事项签订合资合同的补充合同。

2007年9月21日，深圳市贸易工业局出具《关于合资企业深爱半导体有限公司增资、修改合同的批复》（深贸工资复[2007]2690号文件），同意上述增资事宜。

深圳巨源会计师事务所于2007年11月19日出具深巨验字（2007）第137号《验资报告》，对此次增资进行了审验。验证截至2007年10月31日，深爱有限已将盈余公积73,610,742.60元人民币折合美元980万元转增实收资本，变更后注册资本为2,540万美元，累计实收资本为2,540万美元。

2007年11月26日，深圳市工商行政管理局核准了上述变更事宜。

本次增资后，股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万美元）	出资比例（%）
1	赛格集团	1,900.428	74.82
2	赛格（香港）有限公司	639.572	25.18
合 计		2,540.000	100.00

6、2010年第三次股权转让及第四次增资（注册资本 176,534,972.04 元人民币）

根据深圳国资局于2009年11月25日出具的《关于深圳深爱半导体有限公司实施股份制改造前期工作有关事宜的函》（深国资局函[2009]78号），赛格集团受让赛格香港持有的全部深爱有限股权，并以协议转让的方式引入远致投资为深爱有限的战略投资者（持股比例为6%），深爱有限管理层、核心技术人员和业务骨干以现金设立投资公司向深爱有限增资持股（持股比例为15%），上述股权转让和增资认股价格均按深爱有限2009年7月31日经评估的净资产值确定。2010年6月10日，深圳国资局作出《关于深国资局函【2009】78号延期的复函》（深国资局函【2010】154号），同意将深国资局函【2009】78号函的有效期延长至2010年7月31日。

2010年4月深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具清产核资专项审计报告（深鹏所核字[2010]001号），截止2009年7月31日，深爱有限净资产清查值为24,672.16万元人民币。同月，中联资产评估有限公司出具资产评估报告（中联评报字[2010]第40号），截止2009年7月31日，深爱有限经评估的净资产值为29,169.86万元人民币。2010年6月9日，深圳国资局为上述评估报告依法进行备案（备案编号为：深国资局评备[2010]011号）。

（1）赛格集团受让赛格香港持有的25.18%股权

2010年4月19日，深爱有限召开第八届第七次董事会，董事会同意赛格香港将其持有深爱有限的全部股权协议转让与赛格集团。根据赛格集团与赛格香港签订的股权转让协议及其补充协议，以79,434,879.20元人民币的价格受让赛格香港持有深爱有限的25.18%的股权。2010年6月28日，深圳市科技工贸和信息化委员会作出《关于中外合资企业深圳深爱半导体有限公司投资者股权及企业性质变更的批复》（深科工贸信资字[2010]1610号），同意上述转让事宜。

（2）远致投资受让赛格集团持有的7.0588%股权

2010年6月23日，赛格集团作出《关于转让深爱有限股权的股东决定》，同

意以协议方式将其持有的深爱有限7.0588%股权转让与远致投资。根据赛格集团与远致投资签订的股权转让协议，以22,268,265.50元人民币对价将其持有深爱有限的7.0588%股权转让与远致投资。

（3）循杰投资向深爱有限增资

根据深国资局函[2009]78号、深国资局函[2010]154号文，深爱有限管理层、核心技术人员和业务骨干以现金设立投资公司向深爱有限以协议方式实施增资持股。2010年5月6日，深爱有限管理层、核心技术人员和业务骨干以货币投资设立了循杰投资，并于2010年6月21日召开2010年第二次临时股东大会，同意循杰投资以货币形式向深爱有限增资。2010年7月5日，深爱有限召开2010年第一次股东会，同意循杰投资以货币形式向深爱有限增资。根据赛格集团、远致投资与循杰投资签订的增资扩股协议，循杰投资以货币形式向深爱有限增资55,670,849.32元人民币，其中认缴注册资本26,480,245.81元人民币，计入资本公积29,190,603.51元人民币，占增资后的比例为15%。

上述转让及增资的价格均根据深圳国资局备案的资产评估报告，以深爱有限截止2009年7月31日经评估的净资产值为基础，加上“重大期后事项”中披露的增值部分，再加上3%的溢价比例确定。

2010年7月6日，深圳联合产权交易所就上述股权转让协议出具了深产权鉴字（2010）第10123号、第10124号《产权交易鉴证书》，鉴证上述股权转让行为符合法定程序。

2010年7月15日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字（2010）268号《验资报告》，对此次增资进行了审验。验证截至2010年7月14日，深爱有限收到循杰投资缴纳的新增投资款55,670,849.32元，其中认缴注册资本26,480,245.81元人民币，计入资本公积29,190,603.51元人民币。深爱有限实收资本176,534,972.04元人民币。

2010年7月23日，深圳市市场监督管理局核发了《营业执照》（注册号：440301501123797）。

本次股权转让及增资完成后，深爱有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）
1	赛格集团	139,462,623.21	79.00
2	循杰投资	26,480,245.81	15.00

3	远致投资	10,592,063.02	6.00
合 计		176,534,972.04	100.00

7、2010 年整体变更设立股份公司

2010年9月13日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所审字[2010]1417号《审计报告》，根据该审计报告，深爱有限截至2010年7月31日的账面净资产值为326,169,235.01元。

2010年9月29日，深爱有限按照公司章程召开了2010年第四次股东会，全体股东一致同意并作出将深爱有限整体变更为股份有限公司的决议。

2010年10月27日，赛格集团、远致投资和循杰投资作为发起人共同签署了《发起人协议》，协议约定发起人根据深爱有限经审计的净资产人民币326,169,235.01元，减去2010年第四次股东会决议已分配股利20,700,000.00元，按1: 0.6515的比例折合为股份公司总股本199,000,000股，每股面值为人民币1元；其余部分人民币106,469,235.01元作为资本公积，由全体股东按出资比例共享。股份公司全部股份由发起人根据各自所持有限公司的股权比例所对应的净资产折股认购。

2010年12月14日，深圳国资局出具《关于深圳深爱半导体有限公司股份制改造方案有关事项的批复》（深国资局[2010]259号），同意深爱有限以发起设立方式整体变更为股份有限公司。

2010年12月15日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字(2010)456号《验资报告》，对此次变更进行了审验。验证截至2010年12月15日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本199,000,000元，其中，赛格集团出资157,210,000元，占注册资本的79%，循杰投资出资29,850,000元，占注册资本的15%；远致投资出资11,940,000元，占注册资本的6%。

2010年12月27日，深圳市市场监督管理局核发了新的《营业执照》，公司名称变更为深圳深爱半导体股份有限公司，注册资本为人民币19,900万元。

整体变更为股份公司后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	赛格集团	15,721	79.00
2	循杰投资	2,985	15.00
3	远致投资	1,194	6.00
合 计		19,900	100.00

自股份公司成立后，发行人的股权未发生变化。

2011 年 12 月 5 日，由于生产基地由八卦岭工业园搬迁至龙岗宝龙工业城，公司住所由“深圳市福田区八卦三路光纤小区二栋 1-3 层”变更至“深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路三号 8 号办公室及活动楼 2-3 层”。

（二）发行人资产重组情况

发行人自整体变更设立以来，未发生过重大资产重组行为。

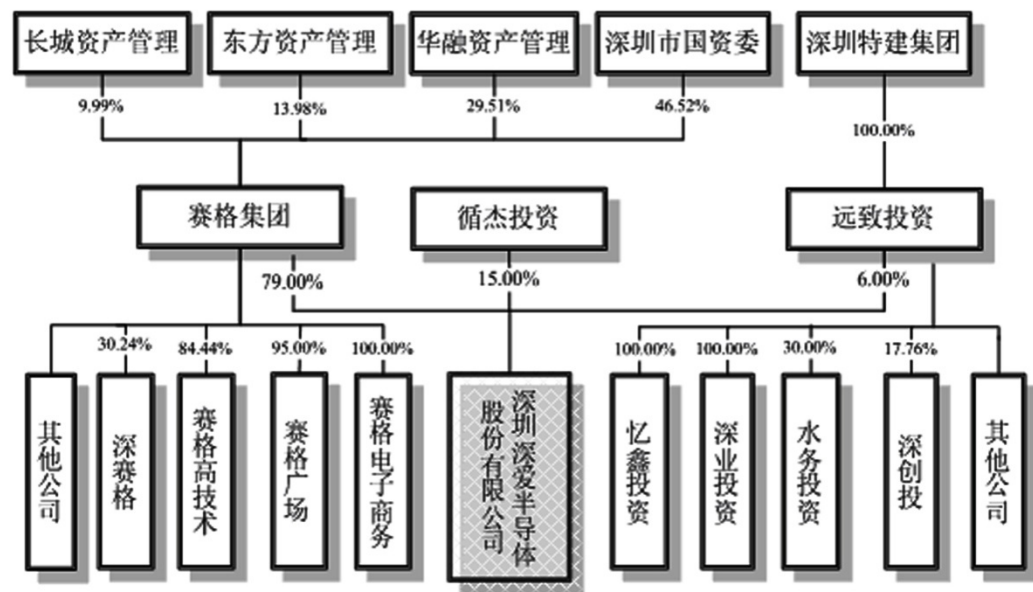
四、发行人历次验资情况

发行人历次验资情况如下：

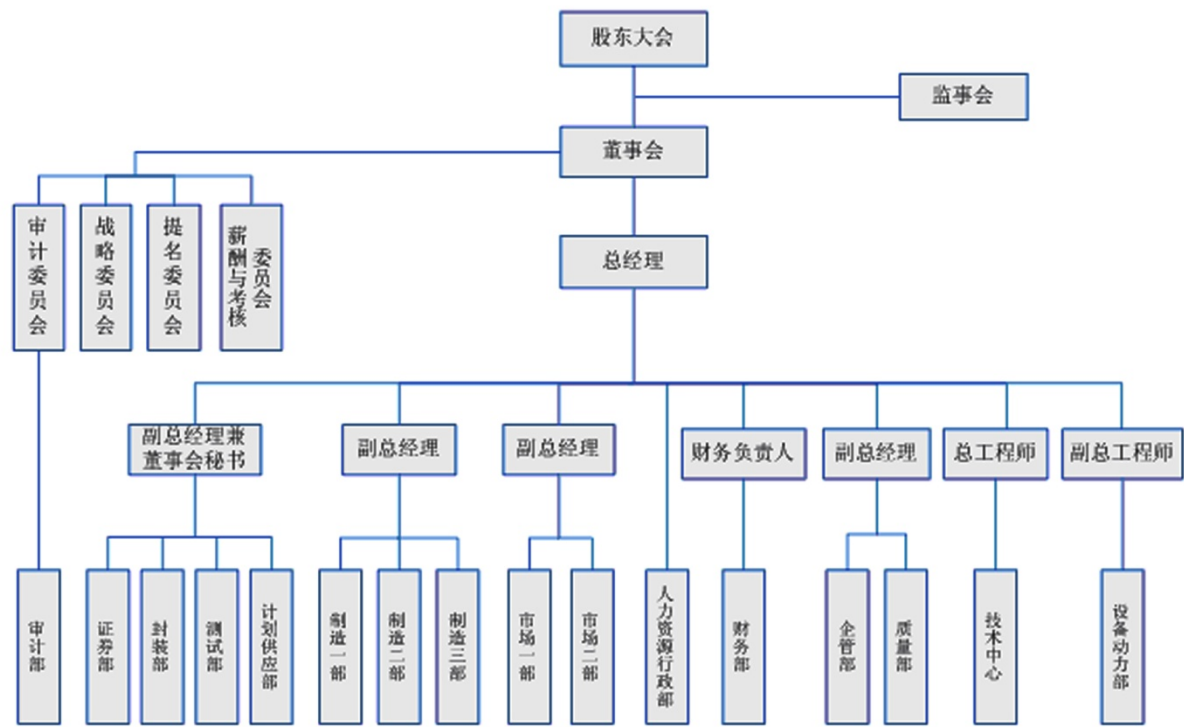
验资事项	出具时间	验资机构	验资报告
深爱有限设立	1989 年 3 月 4 日	深圳中华会计师事务所	验资报字（1989）第 019 号
	1995 年 5 月 24 日	深圳市文武会计师事务所	深文验资报字（1995）第 026 号
	1995 年 6 月 8 日	深圳市文武会计师事务所	深文验资报字（1995）第 028 号
增资至 800 万美元	1996 年 1 月 17 日	深圳市永明会计师事务所	验资（1996）205 号
增资至 1,560 万美元	2003 年 5 月 15 日	深圳市永明会计师事务所	深永验字（2003）0233 号
增资至 2,540 万美元	2007 年 11 月 19 日	深圳巨源会计师事务所	深巨验字[2007]第 137 号
增资至 176,534,972.04 元人民币	2010 年 7 月 15 日	深圳市鹏城会计师事务所有限公司	深鹏所验字[2010]268 号
整体变更设立股份公司	2010 年 12 月 15 日	深圳市鹏城会计师事务所有限公司	深鹏所验字[2010]456 号
历次验资专项复核	2013 年 9 月 26 日	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	瑞华核字[2013]第 830A0002 号

五、发行人的组织结构

（一）发行人股权结构图



（二）发行人组织结构图



（三）内部组织机构设置及运行情况

目前，发行人设置的主要业务和职能部门的职责如下：

序号	部门	主要职能
----	----	------

序号	部门	主要职能
1	封装部	负责制定生产计划，将所需的各种材料的报告给计划部；分解计划部每月的生产计划，通过自产和外加工，保证客户的及时供货；负责制定部门下一年度的设备产能预算报告；负责技术中心下达的技术文件的执行和保管；根据生产计划，安排生产数量和品种；控制部门生产质量；负责部门生产材料控制降低生产成本。
2	测试部	根据公司制订的生产计划，安排生产工作，负责开关参数测试、中测后芯片背面粘污处理、中测后芯片检验工作、外协划片、测试工作；组织做好生产现场管理；负责测试仪器日常校对保证测试仪器满足使用要求；负责测试程序维护、优化与管理；负责测试仪器日常校对；负责部门技术文件的编写、完善与管理；负责测试数据的反馈工作。
3	计划供应部	负责编制公司年度、月度生产计划，有效指导生产；负责监督生产计划进行过程；负责采购原材料；负责新供应商开发，优化供应商结构；负责原材料新样品的供货；负责海外销售业务；负责公司生产经营情况总结，指导下一阶段生产经营的安排；负责办理材料、芯片、成品的入、出库手续。
4	制造一部	安排生产并完成生产计划，进行生产现场管理；监察在制品质量；负责部门内原材料和辅料的在线监控和使用反馈；对生产工艺进行优化，提高生产过程能力和质量；负责合格率的提高，降低生产成本、提高生产效率；负责部门内技术文件的编写、完善和管理，管理并规范生产过程和技术工作；负责本部门生产设备的维护、改进、改造。
5	制造二部	组织有效生产；负责生产用原材料、辅助材料预算制定、申购、领用；制定设备采购需求计划，备品备件需求计划；负责设备评估和采购、配合报关需求资料整理准备；负责部门设备日常维护、保养及维修；负责生产工艺稳定性监控，生产工艺改善和改进，新工艺开发；承担新产品试制；负责部门现场管理和生产安全工作。
6	制造三部	安排生产并完成生产计划；监察在制品质量；安排实验生产计划，实现新品试制流程的完成；进行现场管理；负责部门内原材料和辅材的在线监控和使用反馈，协调影响生产的物料、动力条件的供应；对生产工艺进行优化；负责各项合格率的提高；负责部门生产设备的运行；编制设备及备件的采购计划；负责部门内部的质量、环境、有害物质的体系管理。
7	市场一部	参与制定芯片销售相关管理制度，规范芯片销售管理工作；参与制定市场营销方案拓展市场，配合技术中心进行新产品推广销售；负责芯片客户销售合同洽谈、签订及合同履行，开发新产品领域客户，反馈市场信息；负责货款回收，清理异常应收账款，维护公司货款安全；参与制定客户资信额度、贷款结算期标准，规范客户资信管理。
8	市场二部	负责成品管客户销售合同洽谈、签订及合同履行；负责偏档、

序号	部门	主要职能
		滞销、质量退回产品及问题库存产品的销售，减少公司损失；负责新品销售、推广，开发新产品领域客户，反馈市场信息；参与制定并实施客户管理计划，建立良好的客户关系；参与处理客户投诉，提高客户满意度，配合质量部反馈欧盟环保要求的信息。
9	人力资源行政部	规划、完善公司组织架构、职位体系，组织制定并监督实施包括招聘、培训、薪酬、员工关系、行政以及安全各类管理规章制度；负责招聘管理相关事宜；负责组织内部、外部培训，组织、协调从业人员的上岗培训；负责员工工资、福利、绩效奖金的核算；负责员工劳动合同管理，处理劳动纠纷；负责公司人事、安全档案盒机要文件管理。
10	财务部	组织各部门编制公司年度预算及月度资金预算；组织公司财务决算工作，监督日常会计核算；对各项收支及报销进行审核、管理；准确核算并按时申报缴纳各项应交税费，组织税收筹划；进行成本分析、财务分析和投资分析，为公司管理层提供决策参考；负责编制财务报表，会计凭证、账本及会计报表的归档、整理和管理。
11	企管部	组织编写或负责委托咨询公司编写项目建议书、项目可行性研究报告、项目环境影响评价表或评价书，开展项目立项工作；负责组织编写自主招标项目招标文件，提交招标委员会审查并根据审查意见对招标文件进行修改；组织招标、评标，选出中标单位并发出中标通知书；申报项目用地，取得用地合同；负责项目报建、项目验收和项目工程款的支付和结算。
12	质量部	负责对供应商和相关方按照计划实施评审，参与对供应商进行年度评审并定级；策划质量监控流程，负责生产线的关键质控点的监控并及时反馈问题；组织建立健全质量、环境、有害物质管理体系；组织公司检验、测量和试验设备的计量检定、管理工作；对公司产品或材料抽样测试；参与公司 HSF 标准的拟制。
13	技术中心	负责新产品开发策划、组织，新产品工艺开发和新材料应用评估以及多代产品开发；负责产品应用领域开发和新产品研发方向研究；负责产品、工艺改进，生产流程变更的影响评估；制定并组织实施项目管理计划；负责项目进程的监控，组织项目阶段性验收；制定并发布三级（内控、生产、检验）技术标准；负责客户技术支持及相关知识产权管理和档案管理。
14	设备动力部	负责芯片生产部门以外的生产仪器、设备采购工作；负责生产设备的维护、维修、改进、改造；负责动力运行供应，动力设施维护；负责对水、电、气等动力配套管线实施安装施工；进行能源合理性分析，及时组织实施动力能耗改善新方案；组织动力设备的采购、招投标活动，并进行设备的安装调试；负责公司生产部门的废水、废气和危险废弃物的处理。
15	审计部	负责内部控制制度的建立健全、财务预算执行情况及决算审

序号	部门	主要职能
		计、合规审计、项目审计、采购、销售和投资等经济活动的审计和监督，运用审计手段保证公司各部门的规范运作。
16	证券部	负责股东大会、董事会、监事会会议的组织筹备；负责与证券管理部门、交易所、中介机构联系；负责公司的信息披露、投资者关系管理工作；负责公司投资管理与资本运作等其他工作。

六、发行人控股子公司、参股公司情况

截至招股说明书签署日，发行人无子公司和参股公司。

七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）发起人基本情况

本公司发起人为赛格集团、循杰投资和远致投资，其基本情况如下：

1、深圳市赛格集团有限公司

赛格集团系本公司控股股东，成立于 1984 年 8 月 23 日，住所为深圳市福田区华强北路 2 号赛格广场 61-62 楼；注册资本 135,542 万元，实收资本 135,542 万元。经营范围为电子产品，家用电器，玩具，电子电信设备及器材、仪器仪表、汽摩配件、电脑及配件、办公自动化设备及用品、电子化工项目的生产研究（生产场地另办执照）；承接各种电子系统工程项目；开办电子通信类专业市场；人才培养；房地产开发（在合法取得土地使用权的地块上从事开发）；房地产经纪；货运代理；物流仓储；深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商场、展览业务；网络和信息工程的技术开发及维护；经营进出口业务；赛格注册商标有偿使用许可。投资咨询；投资管理；代理记账；企业登记代理。目前其主要的业务为持有下属子公司股权。赛格集团的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	63,053.90	46.52
2	中国华融资产管理股份有限公司	40,000.00	29.51
3	中国东方资产管理公司	18,951.47	13.98

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
4	中国长城资产管理公司	13,536.63	9.99
合 计		135,542.00	100.00

赛格集团最近一年的相关财务数据如下（财务数据经中天运会计师事务所有限公司深圳分所审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	616,600.24
净资产	183,105.11
项 目	2013 年度
净利润	17,361.55

2、深圳市循杰投资股份有限公司

2009 年 11 月 25 日，深圳国资委作出《关于深圳深爱半导体有限公司实施股份制改造前期工作有关事宜的函》（深国资局函[2009]78 号），同意深爱有限管理层、核心技术人员和业务骨干以现金设立投资公司向深爱有限以协议方式实施增资持股，持股人数控制在 200 人以内，持股比例为深爱股份公司总股本的 15%。2010 年 5 月 6 日循杰投资成立，住所为深圳市福田区华强北赛格广场 1402A；注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万元。经营范围为投资兴办实业；投资管理咨询；企业管理策划。环保、安全的技术咨询及服务（不含限制项目）。碳排放核查、能源等体系认证及其服务；节能减排业务检测认证。

截至招股说明书签署日，循杰投资的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例（%）	在发行人单位任职或 与实际控制人关系
1	寻培珏	257.10	25.71	深爱股份副董事长、总经理
2	王军立	76.20	7.62	深爱股份副总经理、董事会 秘书
3	陈志和	53.30	5.33	*
4	王嘉全	38.10	3.81	深爱股份董事、副总经理
5	李红	36.00	3.60	
6	汪德文	28.60	2.86	深爱股份总工程师
7	林国刚	22.90	2.29	*
8	武大柱	21.00	2.10	*
9	贾国平	21.00	2.10	*

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	在发行人单位任职或 与实际控制人关系
10	王新	19.40	1.94	*
11	邓文斌	19.10	1.91	深爱股份副总经理
12	黄灿文	19.10	1.91	*
13	孟军	19.10	1.91	*
14	谭咸宁	19.00	1.90	*
15	厉策	17.10	1.71	深爱股份监事
16	石青宏	15.20	1.52	*
17	曾泽华	14.10	1.41	*
18	王博	14.10	1.41	*
19	付忠诚	14.10	1.41	*
20	王云锋	13.30	1.33	*
21	杨雪艺	13.30	1.33	*
22	于兆元	11.40	1.14	*
23	傅鸣	9.50	0.95	*
24	尹逊杰	9.50	0.95	*
25	徐焱	9.50	0.95	*
26	张帆	8.50	0.85	*
27	谢文华	7.60	0.76	*
28	韩超	7.10	0.71	*
29	王智谋	7.10	0.71	*
30	柯敏	7.10	0.71	*
31	王军胜	7.10	0.71	*
32	彭进阶	7.10	0.71	*
33	李贤于	7.10	0.71	*
34	王亚斌	6.70	0.67	*
35	李甜	5.70	0.57	*
36	位培川	5.70	0.57	深爱股份财务负责人
37	刘波	5.70	0.57	*
38	于祝鹏	5.70	0.57	*
39	刘兴涛	5.70	0.57	*
40	康剑	5.70	0.57	*
41	张云碧	5.70	0.57	*
42	方雪冰	4.80	0.48	*

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	在发行人单位任职或 与实际控制人关系
43	鹿凯	4.70	0.47	*
44	马璐	4.30	0.43	*
45	李永	3.80	0.38	*
46	曹毅强	3.80	0.38	*
47	邹建和	3.80	0.38	*
48	郑维发	3.80	0.38	*
49	李杰	3.80	0.38	*
50	邱海昌	3.80	0.38	*
51	任炜强	3.80	0.38	*
52	胡继芝	3.80	0.38	*
53	胡宁	3.40	0.34	*
54	林义鹏	2.90	0.29	*
55	龚世达	2.90	0.29	*
56	黄萃华	2.90	0.29	*
57	李家红	2.90	0.29	*
58	李国延	2.30	0.23	*
59	魏书奇	2.10	0.21	*
60	聂小军	2.10	0.21	*
61	李国平	1.90	0.19	*
62	宋清君	1.90	0.19	*
63	周超	1.90	0.19	*
64	王友旺	1.90	0.19	*
65	刘新德	1.90	0.19	*
66	叶宗桂	1.90	0.19	*
67	刘胜军	1.90	0.19	*
68	林盛浩	1.90	0.19	*
69	李云洪	1.90	0.19	*
70	冯娟	1.90	0.19	*
71	项锋	1.90	0.19	*
72	业海俊	1.90	0.19	*
73	唐雁彬	1.90	0.19	*
74	王晓峰	1.90	0.19	*
75	吕劲锋	1.90	0.19	*

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	在发行人单位任职或 与实际控制人关系
76	周金廷	1.90	0.19	*
77	鲁世轩	1.90	0.19	*
78	易华波	1.90	0.19	*
79	罗卫东	1.90	0.19	*
80	唐际平	1.90	0.19	*
合 计		1,000.00	100.00	—

注：*表示深爱股份业务骨干、技术骨干。

循杰投资最近一年的相关财务数据如下（2013 年的财务数据经深圳日正会计师事务所（普通合伙）审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	5,642.65
净资产	5,628.70
项 目	2013 年度
净利润	277.73

3、深圳市远致投资有限公司

远致投资成立于 2007 年 6 月 22 日，注册资本为 525,000 万元，实收资本为 525,000 万元，经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）；对投资及其相关的资产提供管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

远致投资的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例(%)
1	深圳市特区建设发展集团有限公司	525,000.00	100.00
合 计		525,000.00	100.00

远致投资最近一年的相关财务数据如下（2013 年财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	918,428.58
净资产	904,301.29

项 目	2013 年度
净利润	19,811.58

（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况

持有发行人 5%以上股份的股东为赛格集团、循杰投资和远致投资，基本情况请参见本节之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）发起人基本情况”。

（三）实际控制人基本情况

深爱股份实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

（四）发行人控股股东和实际控制人控制的其他企业情况

截至招股说明书签署日，除本公司外，控股股东赛格集团控制的其他企业情况如下：

1、深圳赛格股份有限公司

（1）基本情况

公司名称：深圳赛格股份有限公司

成立时间：1996 年 7 月 16 日

注册资本：78,479.9010 万元

注册地址：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼

截至 2013 年 12 月 31 日，深圳赛格股份有限公司的主要股东构成情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	深圳市赛格集团有限公司	237,359,666	30.24	国有法人
2	其它股东	547,439,344	69.76	—
合 计		784,799,010	100.00	

注：截至 2013 年 12 月 31 日，深圳赛格股份有限公司持股 5%以上的主要股东仅为深圳市赛格集团有限公司。

（2）主营业务情况

国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询。物业租赁；房地产经纪；开办赛格电子专业市场

（专业市场执照另行申办）。

（3）主要财务数据

深圳赛格股份有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	213,494.06
净资产	125,022.44
项 目	2013 年度
净利润	5,433.87

赛格集团通过控制深圳赛格股份有限公司间接控制的企业包括苏州赛格电子市场管理有限公司、西安海荣赛格电子市场有限公司、深圳赛格南京电子市场管理有限公司、长沙赛格发展有限公司、西安赛格电子市场有限公司、深圳市赛格实业投资有限公司、深圳市赛格电子市场管理有限公司、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司、吴江赛格市场管理有限公司、无锡赛格电子市场有限公司、佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司、南通赛格时代广场发展有限公司、南宁赛格电子市场管理有限公司。

2、苏州赛格电子市场管理有限公司

（1）基本情况

公司名称：苏州赛格电子市场管理有限公司

成立时间：2005 年 11 月 21 日

注册资本：300 万元

注册地址：苏州高新区滨河路索山大桥西堍

苏州赛格电子市场管理有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳赛格股份有限公司	135.00	45.00
2	纵横国际电子博览城（苏州）有限公司	120.00	40.00
3	叶选钢	30.00	10.00
4	李宝爱	15.00	5.00
合 计		300.00	100.00

（2）主营业务情况

市场设施租赁，市场管理服务；物业管理；销售、维修：电子元器件，电脑及配件，数码产品，办公设备；设计、制作广告，发布公司自有资源广告业务。

（3）主要财务数据

苏州赛格电子市场管理有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	4,237.23
净资产	994.52
项 目	2013 年度
净利润	551.31

3、西安海荣赛格电子市场有限公司

（1）基本情况

公司名称：西安海荣赛格电子市场有限公司

成立时间：2011 年 8 月 15 日

注册资本：300 万元

注册地址：西安经济技术开发区凤城二路海璟国际 2 幢 1 单元 4 层

西安海荣赛格电子市场有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳赛格股份有限公司	153.00	51.00
2	西安海荣房地产集团有限公司	147.00	49.00
合 计		300.00	100.00

（2）主营业务情况

家用电器、计算机软硬件、通信产品、仪器仪表、光机电一体化设备、电子元器件、集成电路的销售；房屋租赁；物业管理；电子信息技术及产品的开发、生产、销售；广告的设计、制作、发布、代理。

（3）主要财务数据

西安海荣赛格电子市场有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
-----	------------------

总资产	2,384.18
净资产	203.64
项 目	2013 年度
净利润	90.31

4、深圳赛格南京电子市场管理有限公司

(1) 基本情况

公司名称：深圳赛格南京电子市场管理有限公司

成立时间：2011 年 4 月 29 日

注册资本：2,000 万元

注册地址：南京市玄武区珠江路 67 号 101 室

深圳赛格南京电子市场管理有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳赛格股份有限公司	2,000.00	100.00
合 计		2,000.00	100.00

(2) 主营业务情况

市场设施租赁，市场管理服务；家用电器、安防产品、音响产品、通讯产品、照相器材、物业管理；电子元器件，电脑及配件、办公设备、数码产品、通讯仪表、手机、集成电路销售及维修；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）；实业投资。

(3) 主要财务数据

深圳赛格南京电子市场管理有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	3,312.63
净资产	983.67
项 目	2013 年度
净利润	211.90

5、长沙赛格发展有限公司

(1) 基本情况

公司名称：长沙赛格发展有限公司

成立时间：1992 年 12 月 28 日

注册资本：3,500 万元

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区五一东路 1 号

长沙赛格发展有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳赛格股份有限公司	1,610.00	46.00
2	金弘集团有限公司	1,400.00	40.00
3	华亚管理有限公司	490.00	14.00
合 计		3,500.00	100.00

（2）主营业务情况

各类 IT 产品、数码电子产品、电子元器件、通讯仪表、集成电路、电脑板卡、计算机配件的批发和零售；照相器材、影楼用品批发和零售；写字楼出租；电子市场及大楼内的自有房屋物业管理。

（3）主要财务数据

长沙赛格发展有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	8,140.11
净资产	5,445.31
项 目	2013 年度
净利润	353.42

6、西安赛格电子市场有限公司

（1）基本情况

公司名称：西安赛格电子市场有限公司

成立时间：2002 年 12 月 18 日

注册资本：300 万元

注册地址：西安市电子一路西段 18 号西部电子商城 4001、4002 房

西安赛格电子市场有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳赛格股份有限公司	195.00	65.00

2	陕西西部电子发展有限公司	105.00	35.00
合 计		300.00	100.00

(2) 主营业务情况

家用电器、计算机软硬件、通信产品、仪器仪表、光机电一体化设备、电子元器件、集成电路的销售；房屋租赁；物业管理；电子信息技术及产品的开发、生产、销售；广告的制作、发布。

(3) 主要财务数据

西安赛格电子市场有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	4,283.32
净资产	1,248.21
项 目	2013 年度
净利润	778.53

7、深圳市赛格实业投资有限公司

(1) 基本情况

公司名称：深圳市赛格实业投资有限公司

成立时间：1987 年 11 月 26 日

注册资本：2,550 万元

注册地址：深圳市福田区华强北路宝华大厦 A906

深圳市赛格实业投资有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳赛格股份有限公司	2,550.00	100.00
合 计		2,550.00	100.00

(2) 主营业务情况

投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；从事广告业务；安全技术防范系统设计、施工、维修（凭资格证书经营）。

(3) 主要财务数据

深圳市赛格实业投资有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	6,380.33
净资产	2,846.24
项 目	2013 年度
净利润	278.33

8、深圳市赛格电子市场管理有限公司

(1) 基本情况

公司名称：深圳市赛格电子市场管理有限公司

成立时间：2005 年 4 月 28 日

注册资本：300 万元

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道平南社区建新路 38 号 101；201；301；
A01；A02；A03；A04；A05；A06；A07；A08；A09

深圳市赛格电子市场管理有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳赛格股份有限公司	210.00	70.00
2	陆小豹	68.00	22.67
3	张刚	15.00	5.00
4	李秋梅	7.00	2.33
合 计		300.00	100.00

(2) 主营业务情况

各类 IT 产品、数码产品、电子元器件、通讯、仪表、集成电路、电脑板卡及计算机配件、办公设备的销售、维修；开办、管理龙岗赛格电子市场。

(3) 主要财务数据

深圳市赛格电子市场管理有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	2,173.86
净资产	759.76
项 目	2013 年度
净利润	182.68

9、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司

(1) 基本情况

公司名称：深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司

成立时间：1981 年 11 月 17 日

注册资本：3,080.88 万元

注册地址：深圳市福田区华强北路深南路口宝华大厦

深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳赛格股份有限公司	2,051.28	66.58
2	内部职工股	752.40	24.42
3	深圳市伟兴达实业有限公司	118.80	3.86
4	中国电子器材深圳有限公司	39.60	1.29
5	杭州市神州房地产开发公司	39.60	1.29
6	深圳赛格计算机公司	19.80	0.64
7	深圳赛格集团服务公司	19.80	0.64
8	南京商厦股份有限公司	19.80	0.64
9	深圳市赛集保税贸易有限公司	19.80	0.64
合 计		3,080.88	100.00

(2) 主营业务情况

物业经营与管理；国内商业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

(3) 主要财务数据

深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	12,988.63
净资产	8,684.11
项 目	2013 年度
净利润	1,864.92

深圳橙果商务酒店管理有限公司为深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司之全资子公司。

10、深圳橙果商务酒店管理有限公司**(1) 基本情况**

公司名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司

成立时间：2009 年 9 月 27 日

注册资本：1,000 万元

注册地址：深圳市福田区华强北路宝华大厦第 22 层

深圳橙果商务酒店管理有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	1,000.00	100.00
合 计		1,000.00	100.00

(2) 主营业务情况

酒店管理；信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；物业服务（取得相关行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；投资兴办实业（由分支机构经营的具体项目另行申报，涉及许可项目凭相应许可证经营）；提供住宿服务（由分支机构经营）。

(3) 主要财务数据

深圳橙果商务酒店管理有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	1,721.63
净资产	1,279.56
项 目	2013 年度
净利润	165.35

11、吴江赛格市场管理有限公司**(1) 基本情况**

公司名称：吴江赛格市场管理有限公司

成立时间：2012 年 9 月 19 日

注册资本：300 万元

注册地址：吴江松陵镇人民路 500 号 2 幢 804

吴江赛格市场管理有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳赛格股份有限公司	153.00	51.00
2	苏州南海明珠房地产开发有限公司	147.00	49.00
合 计		300.00	100.00

（2）主营业务情况

市场设施租赁；市场管理服务；物业管理；电子信息技术及产品的开发、销售；五金机电、仪器仪表、光电一体化设备、计算机软硬件、通讯产品（不含地面卫星接收设备）、家用电器、数码产品、办公设备、电子元器件、集成电路的销售、维修；广告设计、制作、代理、发布。

（3）主要财务数据

吴江赛格市场管理有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据未经审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	2,611.29
净资产	350.67
项 目	2013 年度
净利润	65.07

12、无锡赛格电子市场有限公司

（1）基本情况

公司名称：无锡赛格电子市场有限公司

成立时间：2012 年 11 月 5 日

注册资本：300 万元

注册地址：无锡市惠山区惠山大道 9 号（地铁西漳站区）

无锡赛格电子市场有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳赛格股份有限公司	153.00	51.00
2	浙江信源市场经营管理有限公司	147.00	49.00
合 计		300.00	100.00

（2）主营业务情况

市场经营管理，市场设施租赁，市场营销策划，经济信息咨询（上述范围涉及专项审批的，经批准后方可经营）。

(3) 主要财务数据

无锡赛格电子市场有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据未经审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	1,514.21
净资产	284.04
项 目	2013 年度
净利润	-15.96

13、佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司

(1) 基本情况

公司名称：佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司

成立时间：2012 年 12 月 6 日

注册资本：600 万元

注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处凤山中路 12 号首层商场 B 之二

佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳赛格股份有限公司	600.00	100.00
合 计		600.00	100.00

(2) 主营业务情况

市场设施租赁及管理服务；物业管理；电子元器件、电脑及配件、办公设备、数码产品、通讯仪表、手机、集成电路销售及维修；设计、制作、代理发布国内各类广告。

(3) 主要财务数据

佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据未经审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	595.32
净资产	304.69
项 目	2013 年度
净利润	-226.44

14、南通赛格时代广场发展有限公司**(1) 基本情况**

公司名称：南通赛格时代广场发展有限公司

成立时间：2013年2月25日

注册资本：3,000万元

注册地址：南通市城港路118号北楼5层

南通赛格时代广场发展有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳赛格股份有限公司	3,000.00	100.00
合 计		3,000.00	100.00

(2) 主营业务情况

房地产开发经营（凭资质证书经营）；自由房屋租赁、销售；物业管理；电子产品销售。

(3) 主要财务数据

南通赛格时代广场发展有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013年度财务数据未经审计）：

单位：万元

项 目	2013年12月31日
总资产	11,997.97
净资产	2,738.69
项 目	2013年度
净利润	-261.31

15、南宁赛格电子市场管理有限公司**(1) 基本情况**

公司名称：南宁赛格电子市场管理有限公司

成立时间：2013年5月6日

注册资本：800万元

注册地址：南宁市兴宁区人民东路158号南宁置地广场裙楼地上一至二层

南宁赛格电子市场管理有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳赛格股份有限公司	800.00	100.00

合 计	800.00	100.00
-----	--------	--------

(2) 主营业务情况

市场管理服务、物业管理服务（以上项目涉及资质证的凭资质证经营）；商铺租赁；电子元件、电脑及配件、办公设备、数码产品（除国家专控产品）、通讯产品（除国家专控产品）、仪器仪表的销售及维修；设计、制作、代理、发布国内各类广告。

(3) 主要财务数据

南宁赛格电子市场管理有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据未经审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	1,942.73
净资产	701.68
项 目	2013 年度
净利润	-98.38

由赛格集团与深圳赛格股份有限公司共同持股且赛格集团实际控制的企业包括深圳市赛格电子商务有限公司、深圳市赛格小额贷款有限公司。

16、深圳市赛格电子商务有限公司

(1) 基本情况

公司名称：深圳市赛格电子商务有限公司

成立时间：2011 年 1 月 24 日

注册资本：4,800 万元

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场 1501A、1501B、1502A、1507B、1508B、1509A、1509B、1510B、1511A、1511B

深圳市赛格电子商务有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳赛格股份有限公司	2,448.00	51.00
2	深圳市赛格集团有限公司	1,632.00	34.00
3	深圳赛格高技术投资股份有限公司	720.00	15.00
合 计		4,800.00	100.00

(2) 主营业务情况

经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；互联网技术开发、计算机软硬件的技术开发与销售、国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）；信息服务业务（仅限互联网信息服务，并按增值电信业务经营许可证粤B2-20110530号经营，有效期至2016年9月23日）。

（3）主要财务数据

深圳市赛格电子商务有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	27,130.82
净资产	632.05
项 目	2013 年度
净利润	-690.06

17、深圳市赛格小额贷款有限公司

（1）基本情况

公司名称：深圳市赛格小额贷款有限公司

成立时间：2011 年 12 月 15 日

注册资本：15,000 万元

注册地址：深圳市福田区华强北路宝华大厦 A1168（仅限办公）

深圳市赛格小额贷款有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市赛格集团有限公司	5,700.00	38.00
2	深圳赛格股份有限公司	5,400.00	36.00
3	深圳市赛格实业投资有限公司	2,400.00	16.00
4	深圳市赛格物业发展有限公司	1,200.00	8.00
5	深圳市赛格电子商务有限公司	300.00	2.00
合 计		15,000.00	100.00

（2）主营业务情况

在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）（凭深府金小[2011]71号经营）。

（3）主要财务数据

深圳市赛格小额贷款有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	25,128.41
净资产	17,032.24
项 目	2013 年度
净利润	1,811.13

18、深圳市赛格地产投资股份有限公司

（1）基本情况

公司名称：深圳市赛格地产投资股份有限公司

（原名“深圳市赛格工程实业股份有限公司”）

成立时间：1986 年 12 月 5 日

注册资本：10,250 万元

注册地址：深圳市福田区华强北路群星广场 A38 楼

深圳市赛格地产投资股份有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市赛格集团有限公司	8,100.00	79.02
2	内部职工股	1,250.00	12.20
3	深圳市荣其机电设备有限公司	450.00	4.39
4	深圳市赛格地产投资股份有限公司工会委员会	450.00	4.39
合 计		10,250.00	100.00

（2）主营业务情况

在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营，承包各种电子系统工程，提供中外电子与机电设备配套服务，生产经销电子系统工程需要的各种材料、电子设备和有关的机电产品。经营物业物业管理、购销建筑材料、装饰材料；经营深府办函[1994] 192 号文规定的自用物品及设备的进口业务；装修工程；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行

申报)、经济信息咨询(不含限制项目)。房地产经纪。

(3) 主要财务数据

深圳市赛格地产投资股份有限公司最近一年的相关财务数据如下(2013 年度财务数据经中天运会计师事务所有限公司深圳分所审计):

单位: 万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	120,776.79
净资产	38,758.71
项 目	2013 年度
净利润	8,702.78

赛格集团通过深圳市赛格地产投资股份有限公司间接控制的企业包括惠州市群星房地产开发有限公司、深圳市赛格物业管理有限公司和深圳市赛格新城市建设发展有限公司。

19、惠州市群星房地产开发有限公司

(1) 基本情况

公司名称: 惠州市群星房地产开发有限公司

成立时间: 2003 年 5 月 19 日

注册资本: 2,300 万元

注册地址: 惠州市惠城区东平半岛环岛一路一号

惠州市群星房地产开发有限公司的股东构成情况如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	深圳市赛格地产投资股份有限公司	2,024.00	88.00
2	惠州市半岛投资有限公司	276.00	12.00
合 计		2,300.00	100.00

(2) 主营业务情况

房地产开发经营, 室内装修装饰工程。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目; 需凭资质经营的项目凭有效资质证书经营)。

(3) 主要财务数据

惠州市群星房地产开发有限公司最近一年的相关财务数据如下(2013 年度财务数据经中天运会计师事务所有限公司深圳分所审计):

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	45,378.21
净资产	23,429.51
项 目	2013 年度
净利润	5,586.14

20、深圳市赛格物业管理有限公司

(1) 基本情况

公司名称：深圳市赛格物业管理有限公司

成立时间：1993 年 3 月 17 日

注册资本：1,500 万元

注册地址：深圳市福田区华发北路赛格科技工业园 7 号楼

深圳市赛格物业管理有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市赛格地产投资股份有限公司	1,370.70	91.38
2	深圳市赛格工程实业股份有限公司工会委员会	129.30	8.62
合 计		1,500.00	100.00

(2) 主营业务情况

物业管理、物业管理顾问；高层楼宇、工业区、居住区房屋和配套设施、设备管理的维修和房屋租赁业务；电梯维修（营业执照另行申办）；购销建筑材料、电子产品、通讯器材（不含专营、专控、专卖商品）；环境卫生及园林绿化的管理服务；保安的管理服务；物业管理范围内的二次供水设施清洗消毒业务；各类机电设备的安装、维修，供配电设备、给排水设备、空调设备、防盗报警系统、电视监控系统、楼宇电子对讲系统、门禁系统、巡更系统、停车场管理系统的工程安装、维修；房地产经济咨询。（以上均不含限制项目）。

(3) 主要财务数据

深圳市赛格物业管理有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据经中天运会计师事务所有限公司深圳分所审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	13,497.42

净资产	5,562.90
项 目	2013 年度
净利润	1,021.62

21、深圳市赛格新城市建设发展有限公司

(1) 基本情况

公司名称：深圳市赛格新城市建设发展有限公司

成立时间：1999 年 12 月 21 日

注册资本：1,388 万元

注册地址：深圳市龙岗区布吉镇三联村村委办公楼 3 楼

深圳市赛格新城市建设发展有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市赛格地产投资股份有限公司	722.40	52.05
2	深圳市尊天道投资发展有限公司	388.00	27.95
3	深圳市赛格集团有限公司	277.60	20.00
合 计		1,388.00	100.00

(2) 主营业务情况

兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；种养业；建筑工程安装施工；装饰工程设计与施工；水电、机电设备安装工程。

(3) 主要财务数据

深圳市赛格新城市建设发展有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据未经审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	95,774.78
净资产	1,388.00
项 目	2013 年度
净利润	0.00

22、石家庄市赛格广场投资有限公司

(1) 基本情况

公司名称：石家庄市赛格广场投资有限公司

成立时间：2011 年 1 月 25 日

注册资本：10,000 万元

注册地址：石家庄市长安区广安大街 15 号官鲤公寓 1 号 2 号公寓 02 单元 1310 号房

石家庄市赛格广场投资有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市赛格集团有限公司	5,500.00	55.00
2	河北国源房地产开发有限公司	4,500.00	45.00
合 计		10,000.00	100.00

（2）主营业务情况

以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资，承包各种电子系统工程，电子设备、机电设备安装、维修销售，电子元器件、电子设备、机电产品、建筑材料、装饰材料销售，自营和代理一般商品的进出口业务，装修工程，经济信息咨询，房地产经纪、房地产开发经营、物业服务（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）。

（3）主要财务数据

石家庄市赛格广场投资有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据经中天运会计师事务所有限公司深圳分所审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	10,123.65
净资产	9,984.50
项 目	2013 年度
净利润	0.00

23、深圳赛格高技术投资股份有限公司

（1）基本情况

公司名称：深圳赛格高技术投资股份有限公司

成立时间：1994 年 5 月 12 日

注册资本：30,000 万元

注册地址：深圳市福田区福强路益田花园 D 区综合楼三层

深圳赛格高技术投资股份有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市赛格集团有限公司	25,330.81	84.44
2	深圳市深福保（集团）有限公司	1,813.96	6.05
3	深圳市城市建设开发（集团）公司	1,683.57	5.61
4	中国长城资产管理公司贵阳办事处	656.08	2.19
5	深圳市新产业创业投资有限公司	515.59	1.72
合 计		30,000.00	100.00

（2）主营业务情况

投资兴办各类实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口业务；电子信息产品的技术开发、销售，取得合法土地使用权的房地产开发、经营。

（3）主要财务数据

深圳赛格高技术投资股份有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据经中天运会计师事务所有限公司深圳分所审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	96,011.86
净资产	59,357.20
项 目	2013 年度
净利润	2,538.76

24、深圳市赛格物业发展有限公司

（1）基本情况

公司名称：深圳市赛格物业发展有限公司

成立时间：1994 年 6 月 10 日

注册资本：500 万元

注册地址：深圳市福田区深南中路赛格广场大厦 19 楼部分

深圳市赛格物业发展有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市赛格集团有限公司	500.00	100.00
合 计		500.00	100.00

（2）主营业务情况

物业管理及配套设施的日常管理和综合服务。建筑材料，水暖器材，金属材

料，化工产品，家用电器，建筑五金，文体用品的购销（以上各项不含专营、专控、专卖商品）。电梯维修保养（另设分公司经营此项业务）。

（3）主要财务数据

深圳市赛格物业发展有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据经中天运会计师事务所有限公司深圳分所审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	9,771.57
净资产	1,457.94
项 目	2013 年度
净利润	646.60

25、深圳市赛格康乐企业发展有限公司

（1）基本情况

公司名称：深圳市赛格康乐企业发展有限公司

成立时间：1981 年 10 月 20 日

注册资本：500 万元

注册地址：深圳市福田区华强北路康乐大厦九楼（仅作办公）

深圳市赛格康乐企业发展有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市赛格集团有限公司	275.00	55.00
2	哈尔滨海格集团有限公司	225.00	45.00
合 计		500.00	100.00

（2）主营业务情况

自有房屋出租；物业管理；开办、管理深圳市赛格康乐企业发展有限公司赛格康乐通信市场（分支机构经营）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控产品）；国际货运代理；经济信息咨询；进出口业务。

（3）主要财务数据

深圳市赛格康乐企业发展有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度经中天运会计师事务所有限公司深圳分所审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
-----	------------------

总资产	6,649.81
净资产	3,123.15
项 目	2013 年度
净利润	1,887.98

26、深圳市赛格广场投资发展有限公司

(1) 基本情况

公司名称：深圳市赛格广场投资发展有限公司

成立时间：1994 年 12 月 8 日

注册资本：2,000 万元

注册地址：深圳市福田区青海大厦 24I（仅限办公）

深圳市赛格广场投资发展有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市赛格集团有限公司	1,900.00	95.00
2	深圳市赛格地产投资股份有限公司	100.00	5.00
合 计		2,000.00	100.00

(2) 主营业务情况

投资兴办各类实体（具体项目另行申报），开展各类技术咨询，国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）的购销；自有物业管理；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务。

(3) 主要财务数据

深圳市赛格广场投资发展有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据经中天运会计师事务所有限公司深圳分所审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	7,353.84
净资产	4,616.81
项 目	2013 年度
净利润	-1,883.92

27、深圳市赛润达科技有限公司

(1) 基本情况

公司名称：深圳市赛润达科技有限公司

成立时间：2013 年 5 月 13 日

注册资本：1,000 万元

注册地址：深圳市福田区华强北街道华强北路 2 号赛格广场 2109A

深圳市赛润达科技有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	认缴出资金额（万	出资比例（%）
1	深圳市赛格集团有限公司	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

（2）主营业务情况

无实际经营。

（3）主要财务数据

深圳市赛润达科技有限公司最近一年相关财务数据如下（财务数据未经审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	0
净资产	0
项 目	2013 年度
净利润	0

28、赛格（香港）有限公司

（1）基本情况

公司名称：赛格（香港）有限公司

成立时间：1986 年 8 月 8 日

注册资本：50 万港元

注册地址：FLAT/RM 701, CONIC INVESTMENT BUILDING, 13 HOK YUEN STREET, KL

赛格（香港）有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万港元）	出资比例（%）
1	深圳市赛格集团有限公司	50.00	100.00
合 计		50.00	100.00

（2）主营业务情况

主要经营进出口业务。

（3）主要财务数据

赛格（香港）有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据经中天运会计师事务所有限公司深圳分所审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	9,653.24
净资产	7,223.20
项 目	2013 年度
净利润	6.67

29、好望角投资有限公司

（1）基本情况

公司名称：Good Hope Corner Investments Ltd

（好望角投资有限公司）

成立时间：2001 年 12 月 12 日

注册资本：100,000 美元

注册地址：英属维尔京群岛

好望角投资有限公司的股东构成情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万美元）	出资比例（%）
1	深圳市赛格集团有限公司	10.00	100.00
合 计		10.00	100.00

（2）主营业务情况

无实际经营。

（3）主要财务数据

好望角投资有限公司最近一年的相关财务数据如下（2013 年度财务数据未经审计）：

单位：万元

项 目	2013 年 12 月 31 日
总资产	0.00
净资产	0.00
项 目	2013 年度
净利润	0.00

上述赛格集团直接或间接控制的公司不包括已长期处于停止经营状态或已被吊销营业执照的公司。

（五）发行人股份质押或其他有争议的情况

截至招股说明书签署日，公司股东持有的公司股份均不存在任何质押、抵押、担保等权利受限制的情形，也不存在其它权属有争议的情况。

八、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本情况

本公司发行前总股本 19,900 万股，本次拟向社会公开发行不超过 6,635 万股（包括发行人公开发行新股和股东公开发售的股份），占发行后总股本的 25%。

（二）本次发行前公司前十名股东

本次发行前，本公司共有 3 名股东，持股情况及股份性质如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	股权性质
1	深圳市赛格集团有限公司	15,721	79.00	国有法人股（SS）
2	深圳市循杰投资股份有限公司	2,985	15.00	社会法人股
3	深圳市远致投资有限公司	1,194	6.00	国有法人股（SS）
合 计		19,900	100.00	—

（三）本次发行前公司前十名自然人股东及其在公司任职情况

本次发行前，本公司不存在自然人股东。

（四）最近一年发行人新增股东情况

本公司最近一年不存在新增股东。

（五）本次发行前各股东的关联关系及关联股东的各自持股比例

发行人各股东间不存在关联关系。

发行人各间接股东之间的关联关系，请参见“第七节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况”。

（六）本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份承诺

公司股东已就发行前所持股份做出了自愿锁定的承诺，具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、发行人及相关责任主体的承诺事项”之“（一）关于股份锁定及持股意向的承诺”。

九、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况

本公司不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。

十、发行人员工及其社会保障情况

（一）员工人数及变化情况

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司的员工人数分别为 1,124 人、1,059 人和 1,067 人。

（二）员工专业结构

2013 年 12 月 31 日		
专业分工	人数	占员工总数比例（%）
技术人员	167	15.65
管理人员	135	12.65
财务人员	8	0.75
销售人员	25	2.34
生产人员	720	67.48
其他人员	12	1.12
合计	1,067	100.00

（三）员工受教育程度

2013 年 12 月 31 日

受教育程度	人数	占员工总数比例（%）
硕士及以上学历	33	3.09
本科学历	106	9.93
大专学历	109	10.22
中专及以下学历	819	76.76
合 计	1,067	100.00

（四）员工年龄分布

2013 年 12 月 31 日		
受教育程度	人数	占员工总数比例（%）
25 岁以下	391	36.64
25-35 岁	502	47.05
35-45 岁	129	12.09
45 岁以上	45	4.22
合 计	1,067	100.00

（五）社会保障情况

报告期内，发行人依据《劳动法》等有关法律法规聘用员工，并严格执行国家有关社会保障的法律法规规定。发行人按照国家有关社会保障的法律法规的规定，为员工缴纳了养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。

报告期内，发行人社会保险及住房公积金缴纳情况如下：

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
社会保险	796.64	600.96	617.34
其中：养老保险	578.94	446.20	474.82
医疗保险	141.10	119.31	101.53
失业保险	51.55	12.05	18.36
工伤保险	10.78	10.75	9.73

生育保险	14.28	12.64	12.89
住房公积金	263.64	225.59	231.57
合 计	1,060.28	826.55	848.91

2014年3月19日，深圳市社会保险基金管理局为公司出具了相关证明：深圳深爱半导体股份有限公司在2010年1月1日至2013年12月31日期间无因违反社会保险法律、法规或者规章而被我局行政处罚的记录。

2014年2月25日，深圳市住房公积金管理中心为公司出具了相关证明，深圳深爱半导体股份有限公司自2010年12月至2014年1月没有违法违规而受该中心处罚的情况。

十一、实际控制人、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺

（一）关于股份锁定及持股意向的承诺

本次发行前公司股东及通过循杰投资持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员关于发行人上市后股份锁定及持股意向的承诺，请参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、发行人及相关责任主体的承诺事项”之“（一）关于股份锁定及持股意向的承诺”。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东赛格集团于2013年3月6日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

“1、本公司目前并未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未拥有与发行人可能产生同业竞争的企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何利益。

2、在本公司直接或间接持有发行人股份的期间内，除非经发行人事先书面同意，本公司不会，并将促使本公司控制的企业不会直接或间接地从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。

3、如果本公司发现同发行人或其控制的企业经营的业务相同或类似的商业

机会，而该商业机会可能直接或间接地与发行人业务相竞争或可能导致竞争，本公司将于获悉该商业机会后立即书面告知发行人，并尽最大努力促使发行人在不差于本公司及下属企业的条件下优先获得此商业机会。

4、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的企业将来从事的业务与发行人之间可能构成同业竞争或同业竞争不可避免时，则本公司将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的企业及时转让或终止上述业务，发行人享有上述业务在同等条件下的优先受让权。

如本公司违反上述承诺，发行人及发行人股东有权根据本承诺书依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人股东因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的收益归发行人所有。”

（三）稳定公司股价的预案及相关承诺

自公司股票上市交易后三年内，公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产时，控股股东、通过循杰投资持股的董事、高管将采取措施稳定公司股价。

1、公司控股股东赛格集团的相关承诺

公司控股股东应在符合相关法律法规的要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。公司控股股东应在 10 个交易日内就其增持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。控股股东应在公告后根据具体计划实施增持。控股股东承诺：①增持股票的金额不低于控股股东上年度从公司领取现金分红的 50%；②控股股东增持的股份，在增持完成后 12 个月内不得出售。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如其未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向社会公众投资者道歉，并且将在前述事项发生之日起停止在公司领取股东分红，同时其持有的公司股份将不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

2、通过循杰投资持有公司股份，且在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员的相关承诺

通过循杰投资持有公司股份，且在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员寻培珏、王嘉全、王军立、邓文斌、汪德文和位培川应在符合相关法律法规的要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员在 10 个交易日内，应就其增持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。董事、高级管理人员应在公告后按照具体计划实施增持。有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺：①用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和（税前，下同）的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和；②公司董事、高级管理人员增持的股份，在增持完成后 6 个月内不得出售。

公司在上市后三年内新选举或聘任的在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新选举或聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如其未采取上述稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向社会公众投资者道歉；并且将在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至其按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

（四）对披露事项的承诺及赔偿措施

本公司、控股股东、董事、监事和高级管理人员，及本次发行的保荐机构、发行人律师、承担审计业务和验资复核业务的会计师事务所、承担评估业务的评估机构做出相关承诺，请参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、发行人及相关责任主体的承诺事项”之“（三）对披露事项的承诺及赔偿措施”。

（五）关于公开发售股份的承诺

发行前本公司股东赛格集团、循杰投资和远致投资均承诺，同意按照《深圳深爱半导体股份有限公司申请在境内首次公开发行股票并上市方案》参与公开发

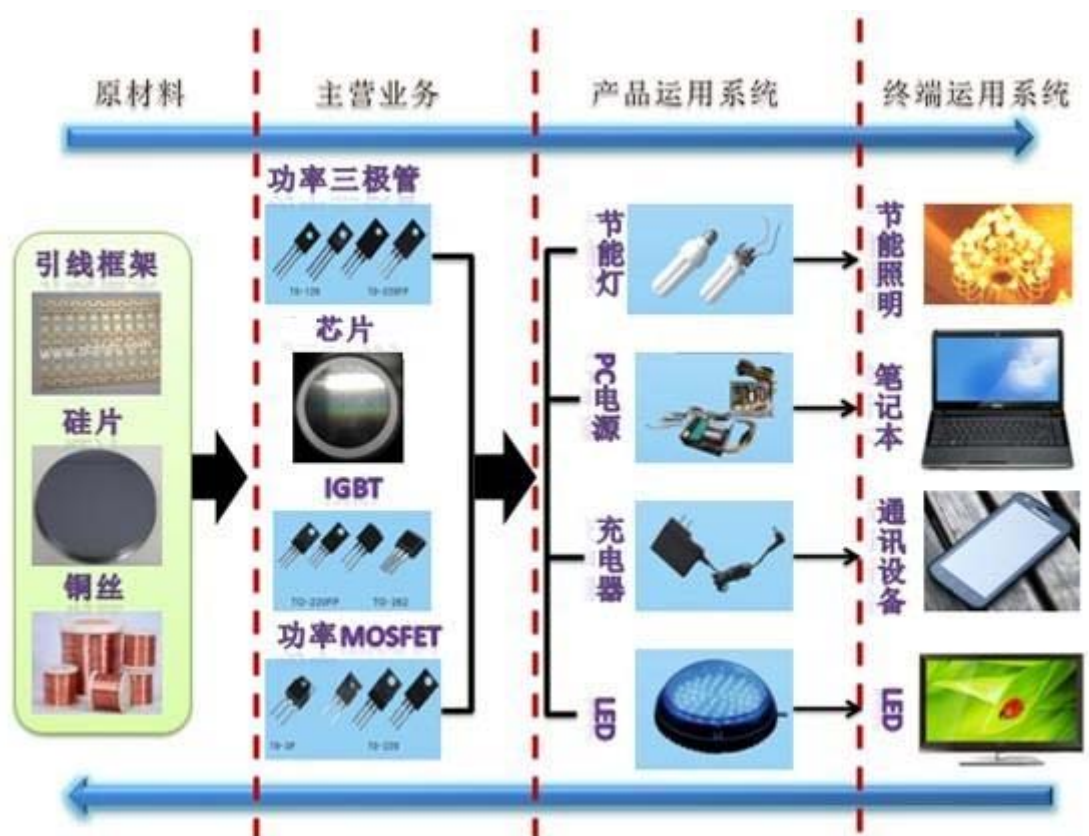
售股份。

第五节 业务与技术

一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况

公司主要从事半导体分立器件芯片及成品管的研发、生产和销售，集芯片设计制造、器件封装测试、销售与服务为一体，形成了完整的半导体分立器件产业链。公司主要产品包括双极型功率晶体管、MOSFET器件、肖特基二极管、IGBT器件、快恢复二极管、LED驱动芯片及模块、CMOS-IC等共10多个系列，100 余种。公司产品广泛应用于绿色节能照明、消费类电子、LED照明、通讯、开关电源等领域。

公司产品间产业链关系具体如下图所示：



截至目前，公司是深圳市唯一一家具有完整半导体芯片制造和产品封装生产线、自主进行半导体分立器件芯片和封装产品研发制造的高科技企业。公司是国家高新技术企业，建立了深圳市级技术中心和深圳功率半导体器件工程实验室，注重自主开发与产学研合作开发并行的研发管理模式，与北京大学深圳系统芯片

设计（SOC）重点实验室展开科研合作和共建研发平台，建立“先进器件和工艺技术联合开发中心”。公司通过ISO9001：2008 质量体系、ISO14001：2004环境体系、QC080000有害物质过程管理体系等多项权威认证，公司各个体系运作规范，正常有效，得到认定机构的认可。

报告期内，公司一直从事双极型器件、MOSFET 器件、二极管等半导体分立器件产品的研发、制造与销售，主营业务未发生重大变化。

二、发行人所处行业的基本情况

（一）所处行业概述

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为 C396 电子器件制造下的 C3962 半导体分立器件制造业。

根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司从事的行业属于 C39 类“计算机、通信和其他电子设备制造业”。

（二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

1、行业主管部门及行业监管体制

半导体分立器件业的行业宏观管理职能由国家工业和信息化部承担，主要负责产业政策制定、引导扶持行业发展、指导产业结构调整等。中国半导体行业协会是行业的自律组织和协调机构，下设集成电路分会、半导体分立器件分会、半导体封装分会、集成电路设计分会、半导体支撑业分会等专业机构。行业协会主要承担行业引导和服务职能，负责产业及市场研究、行业自律管理以及开展业务交流等。公司是中国半导体行业协会的会员单位。

2、行业主要法律、法规及政策

半导体分立器件是支撑工业与信息化发展的基础性元器件，属于国家重点鼓励、扶持发展的战略性新兴产业。行业主要法律、法规及政策如下：

序号	政策名称	主要相关内容
1	原信息产业部《信息产业科技发展“十一五”规划和2020 年中长期规划纲要》	重点围绕计算机、网络和通信、数字化家电、汽车电子、环保节能设备及改造传统产业等的需求，发展相关的片式电子元器件、机电元件、印制电路板、敏感

序号	政策名称	主要相关内容
	(2006 年 8 月)	元件和传感器、频率器件、新型绿色电池、光电线缆、新型微特电机、电声器件、半导体功率器件、电力电子器件和真空电子器件。
2	原信息产业部《信息产业“十一五”规划》(2007 年 3 月)	推动元器件产业结构升级。继续巩固我国在传统元器件领域的优势,加强引进消化吸收再创新和产业垂直整合,加快新型元器件的研发和产业化。重点发展片式化、微型化、集成化、高性能的新型元器件;鼓励环保型电子元器件的发展。
3	国务院办公厅《电子信息产业调整和振兴规划》(2009 年 4 月)	加快完善体制机制,改善投融资环境,培育骨干企业,扶持中小创新型企业,促进产业持续健康发展;加大财税、金融政策支持力度,增强集成电路产业的自主发展能力;实现电子元器件产业平稳发展;加快电子元器件产品升级;完善集成电路产业体系;在集成电路领域,鼓励优势企业兼并重组;继续保持并适当加大部分电子信息产品出口退税力度,发挥出口信用保险支持电子信息产品出口的积极作用,强化出口信贷对中小电子信息企业的支持。
4	国务院办公厅《装备制造业调整和振兴计划》(2009 年 5 月)	结合实施电子信息产业调整和振兴规划,以集成电路关键设备、平板显示器件生产设备、新型元器件生产设备、表面贴装及无铅工艺整机装联设备、电子专用设备仪器及工模具等为重点,推进电子信息装备自主化。
5	国家发展改革委员会办公厅《关于组织实施 2010 年新型电力电子器件产业化专项的通知》(2010 年 3 月)	重点支持金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、集成门极换流场效应管(IGCT)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)、超快恢复二极管(FRD)等量大面广的新型电力电子芯片和器件的产业化。
6	国家发展改革委员会《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2011 年 3 月)	将“新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等)制造”列入鼓励类。
7	十一届全国人大《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(2011 年 3 月)	优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能,发展先进装备制造业,推进重点产业结构调整,电子信息行业要提高研发水平,增强基础电子自主发展能力,引导向产业链高端延伸。
8	国家发展改革委员会、科技部等五部委《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011 年度)》(2011 年 6 月)	将集成电路电路、信息功能材料与器件、新型元器件等列入重点领域,其中包括“中大功率高压绝缘栅双极晶体管(IGBT)、快恢复二极管(FRD)芯片和模块,中小功率智能模块;高电压的金属氧化物半导体场效应管(MOSFET);大功率集成门极换流场效应管(IGCT);6 吋大功率场效应管。”
9	国家发改委等五部门《中国逐步淘汰白炽灯路线图》	决定从 2012 年 10 月 1 日起按功率大小,分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。

序号	政策名称	主要相关内容
	(2011 年 11 月)	
10	深圳市政府《深圳市科学技术发展“十二五”规划》(2011 年 12 月)	以应用为先导, 优先发展集成电路设计技术, 提升高密度封装及集成电路测试能力, 加快形成以设计业为龙头、制造业为核心、设备制造和配套产业为基础的较为完整的集成电路产业链。
11	工业和信息化部《电子基础材料和关键元器件“十二五”专项规划》(2012 年 2 月)	紧紧围绕节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业发展需求, 发展相关配套元器件及电子材料。
12	国家发展和改革委员会等 6 部委《半导体照明节能产业规划》(2013 年 1 月)	以市场需求为导向、根据产品技术成熟度和经济性, 逐步加大 LED 照明产品推广力度。到 2015 年, 节能灯等传统高效照明产品市场占有率稳定在 70%左右, LED 功能性照明产品市场占有率达 20%以上。

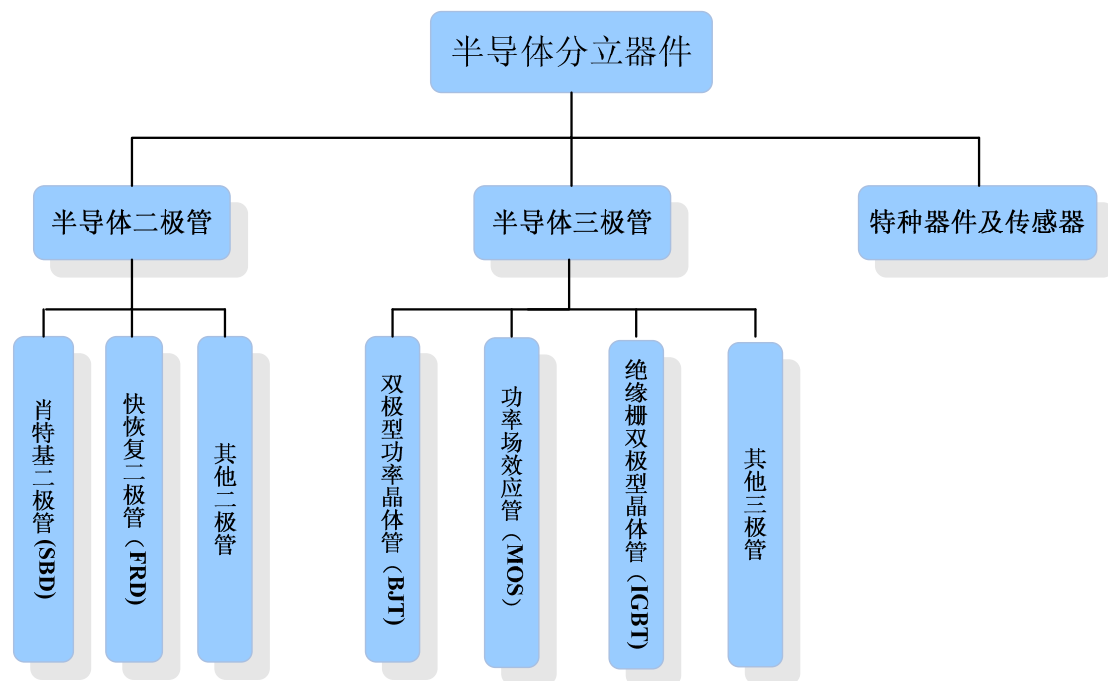
(三) 行业概况

以下行业分析的资料来源, 如无特殊说明, 皆来自于中国半导体行业协会(CSIA)与中国电子信息产业发展研究院(CCID)编写的《中国半导体产业发展状况报告(2013 年版)》。

半导体分立器件行业属于半导体行业的细分行业。半导体产业按照大类划分, 细分为两大分支: 一是集成电路产业, 用以实现对信息的处理、存储与转换, 具体细分为 IC 设计业、芯片制造业、封装测试业; 二是半导体分立器件产业, 主要用于涉及高频、高压、大功率的终端产品或照明等领域, 具体细分为双极型三极管、场效应管、IGBT、肖特基二极管、快恢复二极管和其他分立器件。

半导体分立器件作为介于电子整机行业以及上游原材料行业之间的中间产品, 是半导体产业的基础及核心领域之一。随着世界各国对节能减排产业的日益重视, 半导体分立器件的应用已从传统的工业控制和 4C(通信、计算机、消费电子、汽车)领域扩展到新能源、轨道交通、智能电网、变频家电等诸多产业, 未来应用前景极为广阔。

按照产品类别, 半导体分立器件细分如下图:



1、半导体产业

半导体是指一种导电性可受控制，常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体作为高新技术产业的核心，是构成计算机、消费类电子以及通信等各类信息技术产品的基本元素。

（1）全球半导体行业概况

2010 年以来，全球半导体行业较好地适应了欧美经济动荡、中国经济增速放缓所产生的影响。与此同时，智能手机、平板电脑、电子阅读器、车载信息设备、计算机、电信基础设施都推动了半导体产业的增长。

市场研究公司 IDC 公开披露的数据显示，受宏观经济不景气和电子消费市场需求减少的影响，2012 年全球半导体行业销售收入为 2,950 亿美元，同比降低 2.2%。但 IDC 预计 2013 年全球半导体产业将恢复增长，届时销售收入达到 3,200 亿美元，同比增长 6.9%，2014 年全球半导体产业销售收入将同比增长 2.9%至 3,290 亿美元。预计到 2017 年，全球半导体销售收入将达到 3,660 亿美元。

从应用领域分析，半导体产品主要应用领域集中于消费电子、PC、手机、汽车电子、节能照明等领域，其中2009年近80%的半导体主要应用于消费电子、PC和手机领域。此外，随着电子产品的升级，半导体在电子产品的含量将逐步

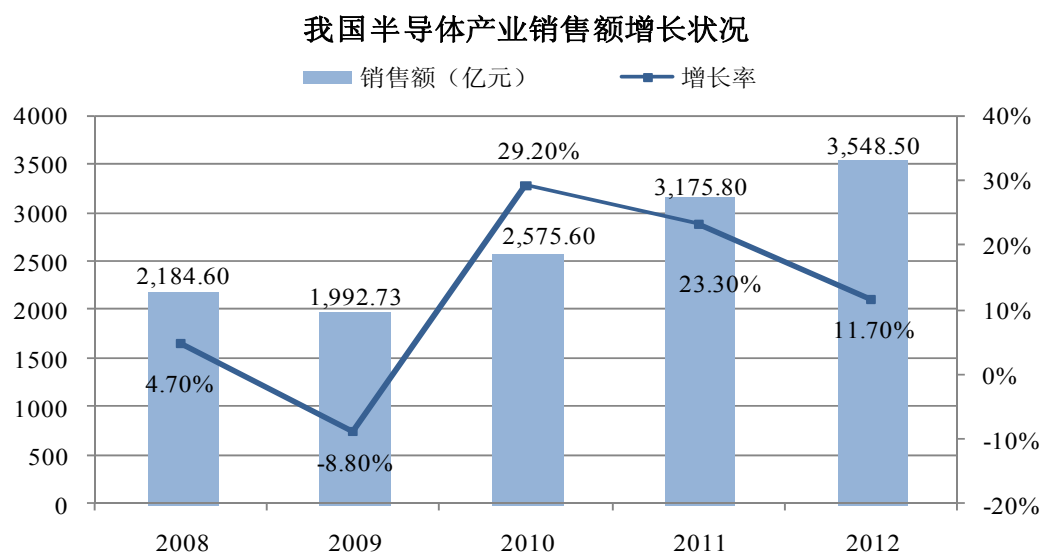
提高,未来在下游电子产品市场需求增长的带动下,半导体产业将保持较好的增长态势。

从地区分布分析,美国、日本、德国、韩国、中国台湾与大陆是半导体产品的主要生产国。美国一直保持着半导体技术的行业龙头地位,中国台湾则主要以世界集成电路代工企业产业集聚为主。中国大陆凭借数量庞大的电子消费群体,在2005年已超越美国和日本,成为全球最大的半导体消费市场。

(2) 国内半导体产业发展状况

根据中国半导体行业协会数据统计,2008年-2011年,我国半导体产业销售额分别为2,184.60亿元、1,992.73亿元、2,575.60亿元和3,175.80亿元,增长率分别为4.70%、-8.80%、29.20%和23.30%,呈现稳中有升的市场格局。

2012年,受国内外半导体市场增速放缓的影响,中国半导体产业发展速度也有所放缓。2012年我国半导体产业实现销售额3,548.50亿元,增速减缓至11.7%,但增速依然较高。



数据来源: CSIA,《中国半导体产业发展状况报告(2013年版)》

2、国内半导体分立器件产业发展状况

(1) 概况

半导体分立器件是电力电子应用产品的基础,也是构成电力电子变化装置的核心器件,主要用于电力电子设备的整流、稳压、开关、混频等方面,具有应用

范围广、用量大等特点，在节能照明、消费电子、汽车电子、电子仪器仪表、工业及自动控制、计算机、网络通讯等领域均有广泛的应用。

近年来，受益于国际电子制造产业的转移，以及下游计算机、通信、消费电子等需求的拉动，我国半导体分立器件行业保持了较快的发展态势。

（2）我国半导体分立器件行业的发展现状

凭借良好的政策环境、低廉的生产要素成本以及充分的资源供给等优势，“十一五”期间，全球半导体分立器件的制造环节以较快速度向我国转移。目前，我国已经成为全球最重要的半导体分立器件制造基地。

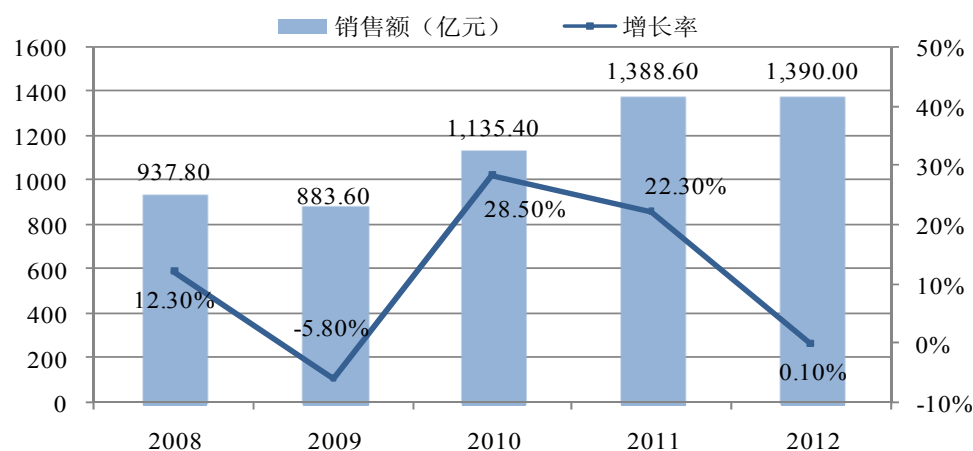
从技术发展水平看，目前国内半导体分立器件行业技术水平仍与国际领先水平存在较大的差距。2009年《电子信息产业调整和振兴规划》明确提出，需提高新型电力电子器件的研发能力，形成完整配套、相互支撑的产业体系。随着半导体分立器件国产化趋势的显现以及下游应用领域需求增长的拉升，我国半导体分立器件行业蕴含着巨大的发展契机。

2010年以来，受益于经济刺激政策的实施以及新能源、新材料及物联网的应用，我国电子整机制造产业出现快速回升，计算机、消费电子、通信等整机产量增长及产品结构持续升级，大大拉动了对上游分立器件产品需求的增长。

根据中国半导体行业协会数据统计，2008年-2011年，我国半导体分立器件产业销售额分别为937.80亿元、883.60亿元、1,135.40亿元和1,388.60元，增长率分别为12.30%、-5.80%、28.50%和22.3%，同样呈现稳中有升的市场格局。2012年半导体分立器件产业在电子整机需求不旺的影响下，产业没能延续之前两年的快速增长态势。2012年中国分立器件产业销售额为1,390.00亿元，同比虽略有增长，但增幅同比下降较大，主要是由于海外市场，特别是欧洲、日本区域市场订单有所减少，消费电子、汽车电子、网络通信市场普遍需求不旺，直接影响了对上游分立器件产品需求的增长。

2008-2012年我国半导体分立器件产业销售额增长状况如下图：

我国半导体分立器件产业销售额增长状况



数据来源：CSIA，《中国半导体产业发展状况报告（2013 年版）》

自 2011 年起，随着新能源、节能环保、新材料及物联网等一系列“十二五”规划的陆续出台，在推动经济结构转型、发展低碳经济等新兴发展理念的推动下，应用于绿色能源、能源智能管理、电动汽车等新兴领域的半导体分立器件成为市场的新热点。在传统应用领域，一方面与节能密切相关的智能电表等领域需求持续快速增长，另一方面，传统消费电子产品向更为节能的功率电子领域发展，如变频控制等。半导体分立器件新兴应用领域的持续快速发展，成为支撑分立器件市场保持较好发展势头的重要源泉。

从行业细分领域分析，2012 年功率器件和 LED（发光二极管）是引领我国半导体分立器件产业增长的主要推动力量，其销售额增长率明显高于其他产品。功率器件和 LED 具有绿色、环保、节能等多方面的优势，并且也符合国家节能减排的大政方针，因此近几年市场总体趋势持续向好。在功率器件领域，新能源（如风能、太阳能等）、电动汽车、变频家电以及逆变焊机等应用对新型功率器件的需求较为旺盛。半导体制造商的扩产速度远落后于市场增长速度，新型功率器件供需之间的矛盾在短期内仍难以达到平衡。因此，功率半导体器件设计、制造能力的提高，将为国内半导体分立器件产业提供新的发展机遇。在 LED 领域，随着产业环境的逐步成熟、企业技术实力的快速提升，LED 上游外延、芯片环节近年来也呈现快速发展的势头，其年平均增长率要高于 LED 封装环节。在国家节能减排战略的带动下，LED 应用市场逐步扩大，市场渗透率不断提高。2011

年，LED 背光源在笔记本电脑的市场渗透率已经接近 100%，在电视产品中的市场渗透率达到 90%，在 LED 监视器中的市场渗透率已经超过 60%。LED 逐步替代 CCFL（冷阴极荧光灯管），成为中大尺寸液晶面板背光源主流。

在国家产业政策支持 and 国民经济发展的推动下，我国高频场控类电力电子器件的研发和产业化取得了喜人的成绩，产品种类日益齐全，规模效应逐渐显现。目前，从芯片设计到芯片封装、测试的完整产业链正在形成。100V、200V，小于 30A 的 MOSFET 和 600V、1,200V，100A 的 FRD（快恢复二极管）已进入批量生产阶段。600V、1,200V，100A 的 IGBT（绝缘栅双极型晶体管）芯片在多家企业进入量产阶段，1,700V，100A 的 IGBT 芯片已研发成功，进入中试阶段。IGBT 模块的封装技术也上了一个台阶，国产品牌正在形成之中，已与国际品牌展开竞争态势。采用 IGBT 模块所制造的装置，如动车组的变频器、风力发电的变流器、光伏发电的逆变器、高压风机水泵的变频器、UPS、高频电焊机等都已批量生产，得到广泛应用，有的已替代进口产品。

（3）我国半导体分立器件行业的市场前景

①我国半导体分立器件行业市场增长的主要因素

总体而言，2012 年起我国分立器件市场增速有所放缓，主要是受到国际经济环境的不利影响。欧洲债务危机蔓延导致西方发达国家市场陷入需求疲软的状态，进而加重全球经济发展放缓的趋势，再加上日本大地震的冲击，带来出口市场的萎缩。总体来看，2012 年国内 LED 价格降幅较大，其中 LED 封装器件的平均价格下降幅度达到 20%-30%。同时，LED 和功率晶体管两类产品占我国半导体分立器件的市场份额接近 80%，这两类产品增长速度的放缓导致 2012 年我国分立器件市场增速有所降低。

从产品结构来看，目前三极管和二极管仍然是我国半导体分立器件市场的主力产品，且两者的市场份额基本维持不变。功率晶体管仍是占中国分立器件市场份额最高的产品，与 2011 年相比其市场份额略有下降；但 LED 的市场表现较好，市场份额略有增加。

从应用领域分析，各领域的市场基本保持了平稳的增长，占据中国分立器件市场主要份额的应用领域为消费电子、计算机与外设、网络通信、汽车电子、指示灯/显示屏。其中，消费电子、网络通信、计算机与外设领域的增长速度超过

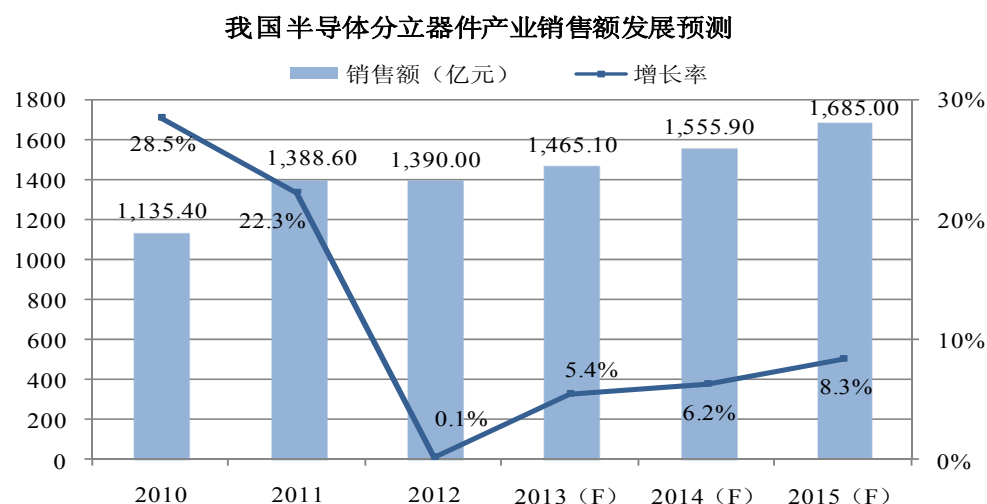
整体市场的平均水平，表现良好，显示出这些市场未来的发展潜力；受益于笔记本产量的大幅增长，计算机与外设市场份额有所上升，仍然牢牢占据着市场最大的份额。

未来，随着欧债危机影响的逐渐消除，全球经济形势也趋向好转，从我国半导体分立器件市场来看，在产品升级和电子整机需求的带动下，在下游应用市场逐步消化过剩产能的背景下，2012 年之后，中国半导体分立器件市场产品结构升级将有所加快，将继续保持平稳的发展态势。在细分市场方面，半导体分立器件产业加速增长的动力将主要来自于 LED、MOSFET、IGBT 等新兴产品的快速增长。在应用市场方面，平板电脑、智能手机、轨道交通、新能源、便携医疗电子设备等将成为国内半导体产业新的增长点。

②国内半导体分立器件的市场前景

2008 年我国半导体分立器件销售额为 937.80 亿元，2011 年已达到 1,388.60 亿元，年平均复合增长率为 13.98%。2012 年我国半导体分立器件的销售额为 1,390.00 亿元，同比略有增长，但增幅下降较快。受全球金融危机和欧债危机的影响，我国国内经济增速将逐步放缓，预计未来短期内我国半导体分立器件市场的增长速度将保持稳定。

根据中国半导体行业协会的预期，2013-2015 年，我国半导体分立器件市场的增长率分别为 5.4%、6.2%和 8.3%，届时我国半导体分立器件的销售额分别为 1,465.10 亿元、1,555.90 亿元和 1,685.00 亿元。



数据来源：CSIA，《中国半导体产业发展状况报告（2013 年版）》

A、节能照明领域的市场前景

目前，世界各国开始禁用白炽灯，并推广节能灯，节能照明产业迅速发展。中国节能照明技术和产品质量基本代表了国际先进水平，中国已成为全球的节能灯生产大国，产量占全球总产量的 80%以上，产品出口到 100 多个国家和地区。目前欧盟市场的节能灯有 50%以上来自中国，欧盟市场每年销售节能灯 3.5 亿只和白炽灯 18 亿只，市场替换空间巨大。另外，美国、澳大利亚、日本、韩国、加拿大、阿根廷、中国等近年也出台了鼓励使用节能照明产品的政策，全球节能照明市场需求旺盛。

2011 年 11 月，国家发改委等 5 部门联合发布公告，决定从 2012 年 10 月 1 日起按功率大小，分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯，并公布了《中国逐步淘汰白炽灯路线图》（以下简称“《路线图》”），此举对于促进我国照明电器行业结构优化升级、推动实现“十二五”节能减排目标任务、积极应对全球气候变化具有重要意义。中国是照明产品的生产和消费大国，节能灯、白炽灯产量均居世界首位，中国照明用电约占全社会用电量的 12%左右。实施《路线图》，采用高效照明产品替代白炽灯，节能减排潜力巨大，逐步淘汰白炽灯的举措将有力促进中国照明电器行业的健康发展，并将取得良好的节能减排效果，预计可新增照明电器行业产值约 80 亿元，年节电约 480 亿千瓦时。

2013 年 1 月，国家发改委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家质检总局等六部委发布《关于印发半导体照明节能产业规划的通知》（发改环资[2013]188 号），文件指出，与传统照明产品相比，LED 道路照明节电 30%以上，室内照明节电 60%以上，背光应用节电 50%以上，景观照明节电 80%以上，实现年节电 600 亿千瓦时，相当于节约标准煤 2,100 万吨，减少二氧化碳排放近 6,000 万吨。到 2015 年，60W 以上普通照明用白炽灯全部淘汰，市场占有率将降到 10%以下；节能灯等传统高效照明产品市场占有率稳定在 70%左右；LED 功能性照明产品市场占有率达 20%以上。

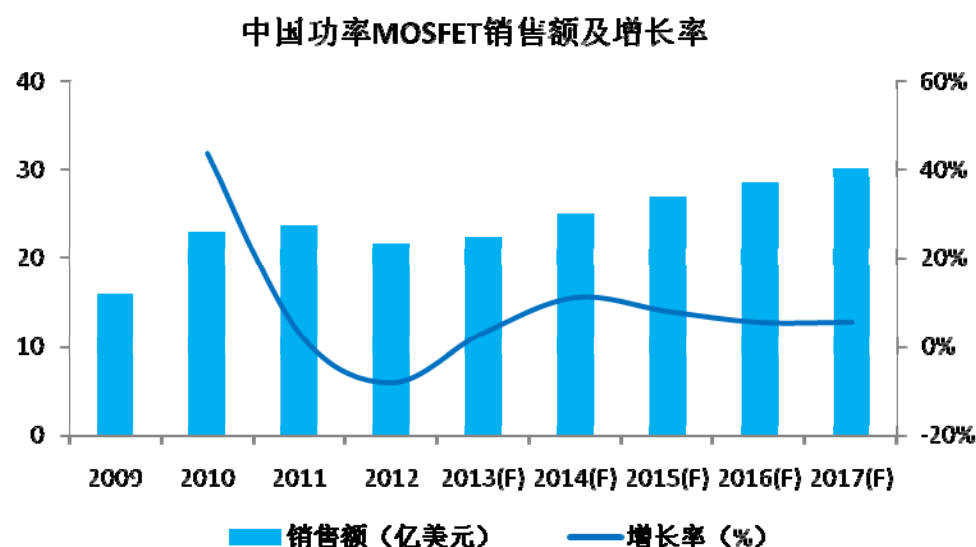
B、功率 MOSFET 的市场前景

自 2010 年以来，从功率半导体器件市场的产品结构分析，电源管理 IC、功率 MOSFET 及绝缘栅双极型晶体管（IGBT）等产品所占份额快速增长。其中，IGBT 成为我国功率半导体器件市场增长最快的产品，这主要得益于国家大力促

进节能减排和大规模基础建设的实施。

根据 IHS iSuppli 公司的统计, 2012 年, 我国功率 MOSFET 市场总体销售额为 21.8 亿美元, 同比 2011 年的 23.7 亿美元降低 8%, 下降幅度较大。这主要受两方面的影响, 一方面, 全球经济放缓导致 MOSFET 市场份额有所萎缩; 另一方面, 政府在投资方面更趋于谨慎。根据 IHS 的预测, 2013 年我国功率 MOSFET 销售额将增长 3 个百分点至 22.5 亿美元, 2014 年将增长 11% 攀升至 25 亿美元, 并保持平稳增长的态势, 预计 2017 年功率 MOSFET 销售额将突破 30 亿美元, 2013-2017 年功率 MOSFET 销售额年均复合增长率为 7.5%。

根据 IHS iSuppli 公司公开披露的数据, 2009-2017 年, 我国功率 MOSFET 销售额及预测情况如下图:



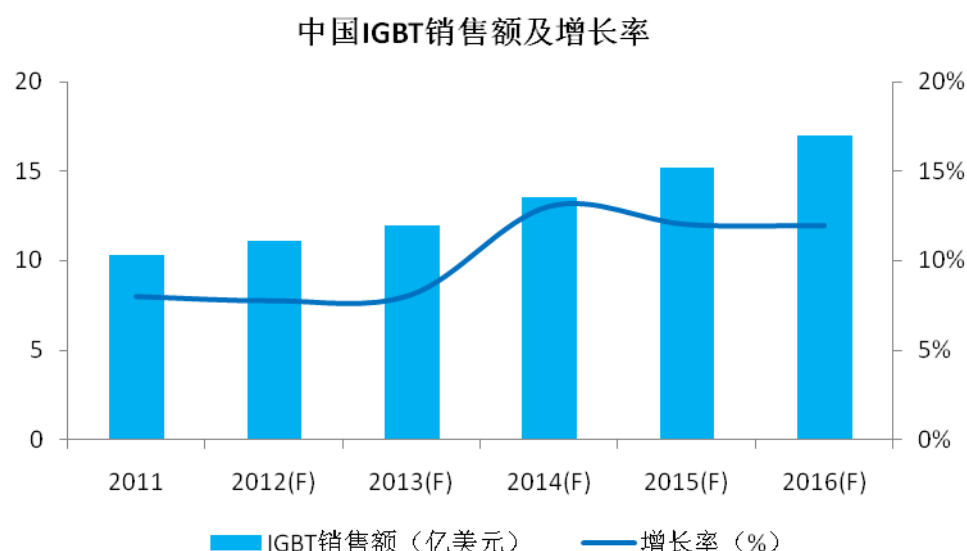
数据来源: 根据 IHS iSuppli 公司公布的数据整理而成。

C、绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 的市场销售前景

据 IHS iSuppli 公司预测, 我国绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 2012 年销售额将从 2011 年的 10.30 亿美元上升到 11.10 亿美元, 增长幅度接近 8%, 同比 2009 年的 4.3 亿美元同比增长 158%。这主要得益于两个方面的影响: 经济复苏带动工业与消费电子的需求增长, 以及我国政府在节能减排等领域推出的刺激政策。从 IGBT 产品类别来看, IGBT 模组和分立器件作为最主要的两种产品, 分别占据 2012 年市场份额的 81% 和 19%, 同比而言, IGBT 模组市场份额比 2010 年增加 8 个百分点, 分立器件市场份额相对有所减少。

此外，受益于绿色能源等新兴产业的发展和政府部门的大力推动，IGBT 市场未来几年将保持平稳快速增长，预计 2016 年我国 IGBT 销售额将达到 17.00 亿美元，2011-2016 年间复合增长率为 12%。

2011-2016 年，我国 IGBT 销售额及预测情况如下图：



数据来源：根据 IHS iSuppli 公司公布的数据整理而成。

(4) 半导体分立器件行业发展趋势

从半导体分立器件的市场发展看，功率器件产品已成为市场的热点。由于功率器件在高频状态工作时更加节能、节材，也能大幅减少整机设备的体积和重量，功率半导体技术已成为促进分立器件产品持续发展的主要动力。在产品应用方面，电子整机产品对功率变换、电源管理等日益增长的需求直接推动了功率晶体管产品的向前发展。随着全球经济对节能环保的重视，功率半导体技术将进一步得到发展，从而带动分立器件市场的快速增长。

当前，我国国内半导体分立器件行业的整体发展水平尚处于初级阶段，产能也主要集中于低端产品领域。然而，在以功率器件为代表的高技术、高附加值、市场份额更大的中高端领域，国外半导体企业凭借显著的竞争优势，占据着国内分立器件的大量市场。随着国内半导体分立器件行业技术水平的提高，实现高端产品替代进口将为国内半导体分立器件产业创造巨大的发展空间。

对于我国半导体功分立器件行业的发展方向，从产品结构分析，随着整机电子产品的体积越来越小，分立器件将向着复合型、模块化方向发展。从产品性能

分析，大电流、高速、高反压功率半导体分立器件有着稳定的市场需求，由于其不易集成或集成成本太高，具有较强的不可替代性，今后仍是市场需求的主流。特别是随着分立器件的产品创新、制造技术的日趋成熟和应用技术的不断升级，功率半导体分立器件的产品格局正在发生重大改变，大电流、高速、高反压功率半导体分立器件将得到越来越广泛的应用，未来市场前景广阔。

公司作为国内半导体分立器件行业的知名企业，在分立器件产品方面研发能力强、制造技术先进。公司通过引进国外专家的方式，提高产品质量，目前MOSFET产品合格率已有较大幅度提高，销量也显著增加。公司拟采用先建立IGBT封装线，再自主量产IGBT芯片的策略，逐步提高IGBT制造水平和自主研发能力，拓展IGBT市场份额。公司与多家半导体制造公司合作开发LED驱动芯片，目前已向市场推出相关产品。随着功率MOSFET、IGBT等新型功率半导体器件产品和LED驱动产品的稳定推广和使用，公司将获得新的更广阔的盈利空间。

（四）进入行业的主要壁垒

1、技术壁垒

尽管我国已经成为全球半导体分立器件产业的重要市场，但我国半导体分立器件的设计、制造能力还有待提高，我国半导体分立器件企业的生产条件和工艺技术大多仍停留在国外上世纪 90 年代水平，关键技术依旧掌握在少数国外半导体公司手中。目前，我国新型功率半导体器件尤其是 IGBT 产业还处于起步阶段，上下游的配套尚不完善。据统计，目前国内所需的高端半导体分立器件仍然依赖进口，缺乏核心技术将严重制约我国半导体分立器件产业的健康发展。

2、资金壁垒

半导体分立器件产业涉及芯片设计、工艺制造、封装测试等全部环节，生产过程中需使用包括外延、光刻、蚀刻、离子注入、扩散等工序所需的生产加工设备和测试设备。为确保产品质量，主要关键生产设备仍需进口，价格相对比较高。同时，为提升企业竞争实力，满足行业认证等要求，半导体分立器件企业在技术、资金、环保等方面的投入也越来越大。对于行业新进入企业来说，只有具备一定的规模实力才能与现有半导体分立器件企业展开竞争。

3、人才壁垒

半导体分立器件制造业属于技术密集型产业，需要大量高素质复合型的技术人才和操作人员，涉及物理、化学、精密机械、自动控制、光机电一体化等多个学科，需要综合掌握外延、微细加工、封装等多领域技术工艺，并加以整合集成。我国目前这方面的专业技术人才与实际需求尚有较大差距。

4、质量壁垒

半导体分立器件作为嵌入于电子整机产品内部的关键零部件，在电流、电场、湿度以及温度等外界应力激活的影响下，存在潜在的失效风险，进而将直接影响电子整机产品的质量和性能。因此，半导体分立器件企业在批量生产过程中，对产品良率、失效率等级及产品一致性水平等方面要求较高。为了实现上述目标，丰富的现场管理、长期的技术经验积累以及领先的生产加工和测试设备是确保产品质量性能可靠性的基本保障。行业新进入企业往往因缺乏较长时间的生产实践经验沉淀以及可靠的质量管理体系，较难达到相关质量控制要求。

5、市场壁垒

半导体分立器件作为电子信息产业中一种基础性的功能元器件，主要服务于中大型的下游厂商，包括节能照明、消费电子、PC、手机、汽车电子等。为了保证产品的品质及性能的稳定性，下游客户对于供应商有较为严格的认证条件，要求供应商除了具备在行业内领先的技术、产品、服务以及稳定的量产能力外，还须通过行业内认可的权威质量管理体系认证。

（五）市场供需状况及变化原因

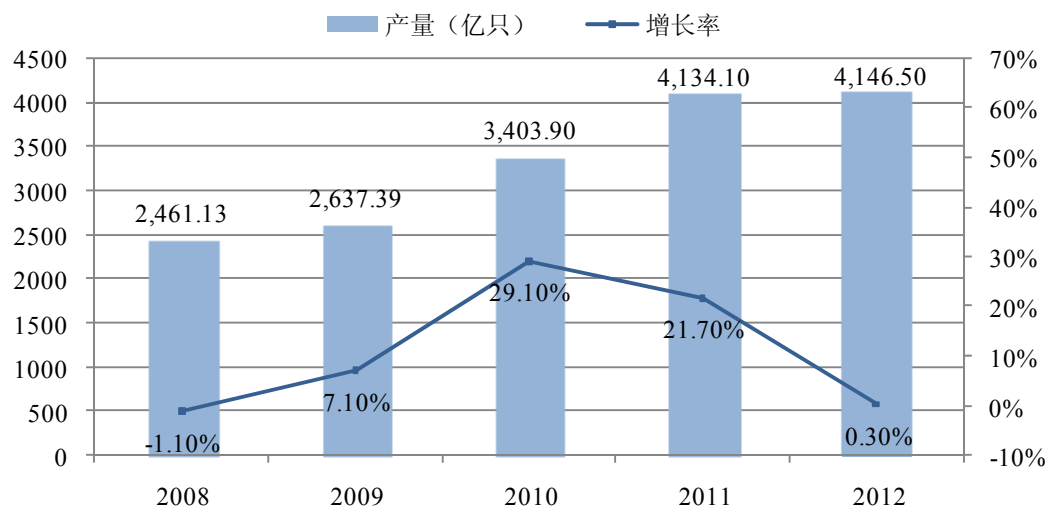
1、行业市场供需状况

（1）市场产量情况

伴随着下游应用领域市场容量的加速增长，我国半导体分立器件的生产规模持续扩大。根据中国半导体行业协会数据统计，2008年-2011年，我国半导体分立器件产业产量分别为2,461.13亿只、2,637.39亿只、3,403.90亿只和4,134.10亿只，增长率分别为-1.10%、7.10%、29.10%和21.7%，呈现快速上升的市场格局。2012年中国分立器件产业产量为4,146.50亿只，同比2011年略有增加。

2008-2012年我国半导体分立器件产业产量增长状况如下图：

我国半导体分立器件产业产量增长状况



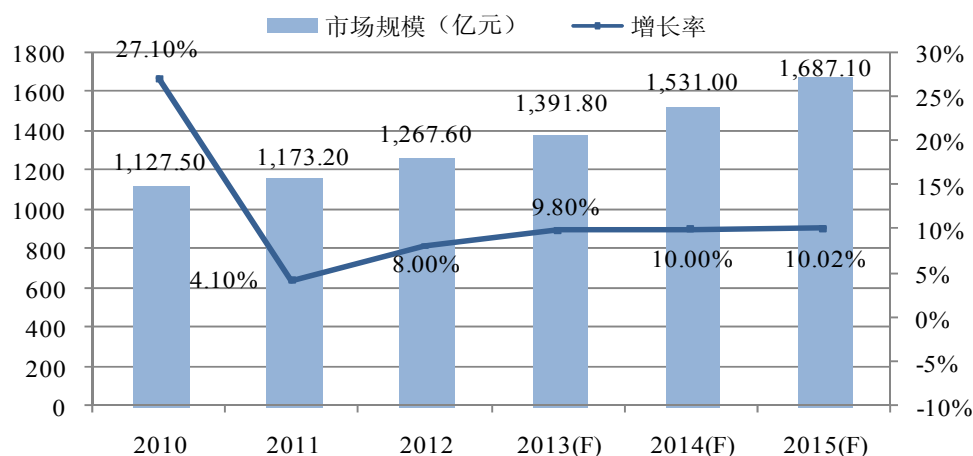
数据来源：CSIA，《中国半导体产业发展状况报告（2013 年版）》

（2）市场需求量情况

在国家城镇化、3G及4G牌照发放、国家产业振兴规划、节能补贴等一系列政府支持政策的直接影响下，半导体分立器件应用市场仍将持续保持稳定增长，产品需求逐步提升。在下游整机市场的需求拉动下，半导体分立器件行业将保持良好的发展势头。根据中国半导体行业协会数据预计，2013-2015年，我国半导体分立器件市场规模将保持年均10%左右的快速增长态势，市场规模年均增加超过100亿元。

2010-2015 年我国半导体分立器件产业需求量增长状况如下图：

我国半导体分立器件市场需求发展预测



数据来源：CSIA，《中国半导体产业发展状况报告（2013年版）》

（3）总体供需态势

综合来看，半导体分立器件产品的供需总体保持基本平衡，部分行业优秀企业凭借良好的技术、品牌、规模等优势稳步扩张，在保持市场份额相对稳定的同时，通过产品升级、适度扩产、产业链延伸，推出新产品、新技术来拓展新的市场领域。

2、市场供需状况发生变化的原因

（1）下游市场需求的变化

目前，我国电子信息产业仍处在快速发展时期，与电子信息产品相配套的电子元器件品种日益增多。随着我国信息技术的升级换代、3G及4G网络、智能电网等新兴产业的快速发展，将有力带动半导体分立器件的市场需求。

（2）行业内竞争企业实力的变化

优秀的半导体分立器件企业是市场主要的竞争力量，其凭借综合实力优势进行产品升级、规模扩大来满足日益扩大的市场需求。然而，企业之间竞争实力的此消彼长，新旧企业的更新换代对半导体分立器件市场的格局将产生一定影响。

3、行业利润水平的变动趋势及变动原因

近年来，我国半导体分立器件行业利润水平总体上呈现平稳波动态势，在细分市场领域行业利润水平存在着一定的差异。低端产品由于行业准入门槛低、竞争激烈等特点，将导致部分生产企业盈利处于中等水平。在中高端市场，由于产品技术含量较高，具有较高的进入壁垒，市场竞争程度相对较低，故而该领域的行业利润水平相对较高。

（六）影响行业发展的有利因素及不利因素

1、有利因素

（1）产业政策的支持

半导体行业是我国信息产业化的支柱产业之一，我国相继出台了一系列鼓励半导体企业发展的政策，为我国半导体企业营造良好的政策环境。从而极大地调动了国内外各方面投资半导体产业的积极性，有力地促进了我国半导体产业的发展。

2007 年《信息产业“十一五”规划》中提出推动元器件产业结构升级，继

续巩固我国在传统元器件领域的优势，加强引进消化吸收再创新和产业垂直整合，加快新型元器件的研发和产业化，重点发展片式化、微型化、集成化、高性能的新型元器件。

2009年《电子信息产业调整和振兴规划》中提出，加快电子元器件产品升级，充分发挥整机需求的导向作用，围绕国内整机配套调整元器件产品结构，提高片式元器件、新型电力电子器件、高频频率器件、半导体照明、混合集成电路、新型锂离子电池、薄膜太阳能电池和新型印刷电路板等产品的研发生产能力，初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系。加快发展无污染、环保型基础元器件和关键材料，提高产品性能和可靠性，提高电子元器件和基础材料的回收利用水平，降低物流和管理成本，进一步提高出口产品竞争力，保持国际市场份额。

2012年《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》指出，我国电子材料和元器件产业在“十一五”期间产量、销售额、进出口总额都有较大幅度提升，增强了我国作为基础电子生产大国的地位。“十一五”期间，我国电子材料行业销售收入从2005年的540亿元增长至1,730亿元，年均增长率26%；电子元器件销售收入年均增长率16%，从2005年的6,100亿元增长到超过13,000亿元，发展重点是紧紧围绕节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业发展需求，发展相关配套元器件及电子材料。

（2）半导体分立器件下游产业发展提升市场需求

2010年以来，在国际市场需求提升，以及扩大内需政策成效显现的共同作用下，我国电子整机制造产业出现明显回升，节能照明、PC、消费电子、手机通信等整机产量的增长及产品结构的升级换代，拉动了对上游半导体分立器件产品的需求。同时，随着我国经济的逐步转型和产业结构的调整，新能源、节能环保、智能电网等新兴产业快速发展，我国半导体分立器件应用领域将得到进一步拓展。根据中国半导体行业协会数据预计，2015年中国半导体分立器件产业将达到1,685亿元，仍将保持较高的增长态势。

（3）全球半导体产业制造产业的转移

从本世纪初开始，全球半导体制造企业将半导体分立器件制造产业逐步向我

国大陆转移，带动了我国半导体分立器件行业的发展。近年来，我国半导体分立器件进出口顺差逐年提高，产业转移趋势明显，并带来了较大的进口替代空间。根据中国半导体行业协会统计，2011年，我国半导体分立器件进出口额分别为174.2亿美元、335.8亿美元，较上年同期增长8.3%、11%，实现了161.6亿美元的顺差。但受欧债危机和国内经济放缓的影响，2012年，我国半导体分立器件进出口额分别为263.1亿美元、273.4亿美元，出口顺差有所减小。

2、不利因素

（1）贸易保护主义的限制

全球主要经济体国家经济的乏力复苏，加上新兴与发展中经济体增速进一步放缓的预期，都将引发新的贸易、投资和金融保护主义。目前美国在经合组织中积极推动的旨在限制国有企业行为的所谓“竞争中立框架”，便是典型的例子。这将对我国出口导向型经济产生消极影响，在一定程度上制约我国整机产业的发展，从而导致上游元器件产业的发展也受到压制。

（2）新产品新技术开发能力弱

我国半导体行业的核心技术长期受制于人，主要关键设备和技术依赖进口。此外，国外先进技术外溢效应减弱，国内企业自主创新能力弱，新产品新技术开发周期长，难以形成竞争力。

（3）人才短缺和成本上升

我国目前劳动力供求的结构性矛盾突出，总量过剩与部分岗位“招工难”并存，满足半导体分立器件行业需要的高素质操作人员以及专业人才和技术人才明显短缺。

同时，我国劳动力成本已经步入上升通道，行业上游原材料以及矿产、能源、环境成本也在提高，对行业利润空间造成挤压，经营难度加大。

（七）行业的技术水平及发展趋势

半导体分立器件技术研发的重点是提高效率、增加功能和减小体积，不断发展新的器件理论和结构，促进各种新型功率半导体器件的发明和应用。因此，未来技术发展将呈现以下特点：

1、新型功率半导体器件将不断出现

在替代原有市场应用的同时，将开拓出新的应用领域。如美国 Cree 公司开发出用于移动 WiMAX 用途的新的功率晶体管，在 40V、3.3GHz 下峰值脉冲输出功率达到创记录的 400W。

2、新材料、新技术不断得到发展和应用

为了使现有功率半导体器件能适应市场需求的快速变化，需要采用新技术，不断改进材料性能或开发新的应用材料、继续优化完善结构设计、制造工艺和封装技术等，提高器件的性能。

3、体积小化、组装模块化、功能系统化趋势明显

电子信息产品的小型化，甚至微型化，必然要求其各部分，包括功率半导体分立器件在内的零部件尽可能小型化、微型化、多功能化。为适应整机装备效率和提高整机性能的可靠性、稳定性的要求，功率半导体器件将趋向模块化、集成化。

未来功率半导体器件应用市场除稳定增长的节能照明、消费电子、工业控制等传统领域外，随着汽车中电子产品逐渐增加以及通信和电子玩具市场的持续活跃，功率半导体器件的市场规模有望实现较大增长。

（八）行业的周期性、区域性和季节性

1、周期性

半导体分立器件行业受国内外宏观经济波动的影响较大。2002-2007 年随着经济的快速平稳发展，我国半导体分立器件市场保持快速增长。但自 2008 年三季度以来，受全球金融危机迅速波及实体经济的影响，国内市场对半导体下游产品的需求有所萎缩，我国半导体分立器件行业的增速回落。2010 年以来，随着国内宏观经济的回暖以及一系列促消费保增长政策效应的显现，节能照明、消费电子、计算机等产业的市场需求回升，半导体分立器件市场呈现稳定的发展态势。受宏观经济周期的影响，半导体分立器件行业呈现一定的周期性波动特征。

2、区域性

国内半导体分立器件的生产主要集中在经济较发达、工业基础配套完善的电子信息产业制造地区。经过近三十年的发展，我国已初步形成三大电子信息产业

集聚带，分别是以上海、江浙地区为中心的长三角地区，以广州、深圳为龙头的珠三角地区以及以北京、天津为轴线的环渤海地区。

3、季节性

受终端消费市场的影响，半导体分立器件行业具有一定的季节性特征，通常三、四季度为行业销售旺季，主要是因为圣诞节和春节电子产品消费需求的拉动，而一季度为行业淡季。但近年来行业的季节性特征有所减弱，全年销售呈逐渐平滑的趋势。

（九）与所处行业上、下游行业的关联性

半导体分立器件产业链上游为原材料（单晶硅片或外延片、化学品、金属靶材及蒸发材料、引线框架和塑封料等）产业及半导体设备业，涉及材料工业、装备制造工业、化学工业、金属加工业等，下游覆盖 4C（通信、计算机、消费电子、汽车）产业和工业控制领域，对实现节能减排起着核心作用。

半导体分立器件只是产业链的一个环节，产业的发展需要得到产业链上下游的支持，需要材料、制造设备、检测仪器仪表等多个环节的完整配套，要求研发、生产和应用紧密结合。

1、上游行业发展状况及关联性

上游行业发展状况对半导体分立器件行业的发展有着举足轻重的影响。首先，从上游行业来看，长期以来我国半导体制造业上游行业发展水平低下，严重制约了我国半导体制造业的发展，行业发展水平大大落后于国际先进水平。改革开放之后，随着全球发达经济体解除了一些关键装备对我国的出口限制，以及上世纪末国家适时出台的一系列鼓励半导体行业发展的政策，我国半导体制造业水平得到较大提升。尽管如此，我国半导体行业上游发展水平仍远远不能满足行业的发展要求，特别在大尺寸硅片、外延及 CVD 设备、光刻机、干法工艺设备、金属化设备、离子注入设备、亚微米和深亚微米器件、化学试剂等方面与世界先进水平还存在相当大的差距。由于大部分生产设备国内不能生产，而进口设备价格昂贵，为降低成本，国内半导体分立器件生产厂商绝大部分靠引进二手生产设备的方式建线，因此，国内半导体分立器件行业技术水平难以实现超越，这在很大程度上影响了我国半导体产业的发展。

2、下游行业发展状况及关联性

半导体分立器件的下游企业包括节能照明、消费电子、手机、仪器仪表等生产厂家，通过该等客户与家用电器、计算机、汽车等终端消费品配套。下游市场的需求变动对半导体分立器件行业的发展具有较大影响。近年来，在国家经济刺激政策的实施以及新能源、新技术应用的推动下，下游终端产品的市场需求保持良好的增长态势，为半导体分立器件行业的发展带来新的市场空间。

（十）出口市场情况

在全球半导体分立器件产业转移的大背景下，给我国半导体分立器件行业带来了巨大的进口替代空间。报告期内，公司出口业务收入占比较小，产品出口市场主要为欧洲、香港、印度、新加坡等国家及地区。该等出口市场不存在针对公司主要产品的特殊贸易限制，也未发生针对公司的贸易摩擦。公司产品品质良好，完全符合最新欧盟RoHS指令的环保要求，出口市场销量逐年增长，在出口市场具有显著的竞争优势。

三、发行人的竞争地位

（一）行业竞争格局

半导体分立器件行业经过数十年的发展，已进入成熟期，市场化程度较高。全球半导体分立器件中高端产品生产厂商主要集中在欧美、日本和我国台湾地区。美国、日本和欧洲半导体分立器件厂商大部分属于垂直整合制造（IDM）厂商，而我国台湾的厂商则大多数属于代工厂商。

1、全球半导体分立器件市场竞争情况

美国半导体分立器件产业处于世界领先地位，拥有一批具有全球影响力的厂商，例如德州仪器（TI）、飞兆（Fairchild）、国家半导体（NS）、国际整流器（IR）等厂商。美国厂商在电源管理芯片领域具有绝对的领先优势。从美国厂商的市场客户分布来看，亚太地区（不包括日本）是最大的市场，也是发展速度最快的地区。其次是美国市场，此外日本市场也占据了一定的市场份额。近年来，得益于市场需求，特别是亚洲市场的旺盛，美国半导体分立器件厂商一直保持快速的发

展。相对于其它地区的企业，美国厂商在技术和市场上都保持世界领先地位。

欧洲拥有英飞凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、意法（ST）、安森美（ONSEMI）等全球知名半导体厂商，产品线齐全，无论是 IC 还是分立器件都具有领先实力。从市场客户分布来看，亚太地区是欧洲厂商最大的应用市场，其次是欧洲市场。

日本半导体分立器件厂商主要包括东芝（Toshiba）、瑞萨（Renesas）、罗姆（Rohm）、富士电机（Matsushita Fuji）等，日本厂商在半导体分立器件方面具有较强竞争力且厂家众多，但很多厂商的核心业务并非半导体分立器件，从整体市场份额来看，日本厂商落后于美国厂商。从日本厂商的市场客户分布来看，日本国内是其最大的市场，其次是亚太（不包括日本）市场，在欧美市场占有少量的市场份额。

近年来，我国台湾地区的半导体分立器件芯片及成品市场发展较快，拥有立铸（NichTek）、富鼎先进（A-Power）、茂达（Anpec）、崇贸（SG）等厂商。从台湾地区厂商的市场客户分布来看，我国内地和台湾地区是其最大的应用市场。产品方面，除了崇贸（SG）提供 AC/DC 产品之外，台湾地区厂商主要偏重于 DC/DC 领域，主要产品包括线性稳压器和功率 MOSFET 等。总体来看，台湾地区半导体分立器件厂商的发展较快，技术方面和国际领先厂商间的差距进一步缩小，产品主要应用于计算机主板、显卡和 LCD 等设备。

具体来看，2012 年，安森美（ONSEMI）在并购三洋半导体的基础上，连续两年占据我国半导体分立器件市场的首位。英飞凌（Infineon）凭借市场的良好表现带动整体较快增长，市场份额超过飞兆（Fairchild）和意法半导体，位列第二。而 NXP 依靠稳定的增长，在我国半导体分立器件市场份额超过东芝半导体，排名第五。整体来看，欧美日企业占有优势地位，市场前十大品牌供应商几乎全部为欧美日企业。

2、国内半导体分立器件行业竞争情况

我国本土半导体分立器件厂商起步较晚，技术升级换代较国外滞后，主要厂家包括公司、吉林华微电子、无锡华润华晶、天津中环、士兰微、苏州固锟、东光微电、江阴长电等。我国半导体分立器件产业发展现状是封装强于芯片制造，芯片制造强于设计。由于相关原因，我国半导体分立器件市场绝大部分份额被国外厂商占领，市场份额前十的地位一直被欧美日企业占据。另外，我国半导体分

立器件厂商的产品主要集中于竞争最为激烈的中低端市场，高端市场大部分被欧美日厂家瓜分，这也意味着未来国内厂商若能掌握功率半导体核心技术，将会有巨大的进口替代市场空间。随着国内厂商整体实力的不断增强，目前，某些国内厂商凭借成本优势已经在国内市场占有一定的市场份额，并逐步在个别产品或领域挤占国际厂商的市场份额，比如在节能照明领域，包括华润华晶、华微电子、公司为代表的节能灯用系列产品，已经成功替代了国外企业的产品。

（二）主要竞争对手

1、以飞兆（Fairchild）、英飞凌（Infineon）、国际整流器（IR）等为代表的国际品牌厂商

国际知名半导体厂商在研发、产品质量、市场上等方面占有绝对优势。在以功率 MOSFET、IGBT 主要高端半导体分立器件市场，前 10 大供应商市场占有率均达到或超过 50%，集中度较高。这些厂商牢牢掌握着中、高端半导体分立器件市场，如国际知名消费电子、计算机等市场。

2、以华润华晶和吉林华微电子等为代表的国内功率半导体IDM厂商

国内主要芯片制造厂商在半导体分立器件市场耕耘多年，拥有完善的销售网络、市场知名度等方面的优势。尽管以前主要局限于 CRT 电视、节能照明等半导体分立器件市场，但这些厂商近几年都在功率 MOSFET 上大力投资以形成新的增长点，并均已开始量产。这些厂商拥有自己的芯片制造和封装能力，也拥有相应的供应链管理优势及成本优势。

3、以江阴长电为代表的半导体封装厂

国内主要芯片封装厂商原来主要为国际知名半导体厂商贴牌生产（OEM），经营模式呈现从 OEM 向自有品牌转变的趋势。这些厂商通过外包设计（或自建芯片设计队伍）、外包芯片制造等，可以短时间内快速切入功率 MOSFET 市场。这些厂商除了拥有规模化生产带来的成本优势外，还通过为国际知名半导体厂商 OEM，进入他们的供应链，积累一定的市场知名度。

（三）发行人的竞争地位

1、公司核心产品竞争地位

公司作为国内少数集半导体分立器件芯片设计制造、器件封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体的半导体分立器件规模企业，具有较为成熟的技术研发和市场推广经验。凭借较强的综合优势，公司在节能照明等细分市场具有领先的市场地位及较高的市场占有率。

公司主要核心产品介绍如下：

产品/业务分类	产品技术特征
双极型功率晶体管	双极型功率晶体管系列产品主要用于节能照明设备电子电路的功率晶体管产品，具有电压击穿特性好、高温漏电流小、温度变化率低、二次耐量高、可靠性高等特点。
DMOS 功率晶体管	DMOS 功率晶体管，以节能照明领域和电源应用的高压 MOSFET（400/500/600/650/700/800/900V 产品）为主导方向，产品涵盖 Id 电流 1-18A，Vds 耐压 400-900V 的系列功率 MOSFET 器件芯片产品及其封装成品，具有导通电阻小、输入阻抗高、开关速度快、可靠性高等特点。
肖特基二极管	肖特基二极管系列产品具有功耗小、正向压降低、开关响应速度快和可靠性高等特点。
CMOS 电路	CMOS 制造工艺技术项目是公司拓展产业领域，进行 PIC（半导体功率 IC 器件）研发试制而立项实施的研发项目，主要进行 CMOS-IC 电路的制造工艺研究，贯通整条 CMOS-IC 制造链，形成 0.8-0.5 μ m 线宽 CMOS-IC 电路的制造流片工艺平台，建立稳定的 0.8-0.5 μ m 线宽 CMOS 制造工艺技术核心规范。
LED 驱动芯片及模块	LED 是 2~3 伏的低电压驱动，必须要设计复杂的变换电路，不同用途的 LED 灯，需配备不同的电源适配器。LED 驱动芯片是驱动电源的核心器件，决定了驱动电源的系统效率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容和各项保护功能。

2、市场份额

公司主要产品双极型功率晶体管应用于节能照明领域，即主要用在节能照明产品上。以每个节能照明产品需双极型功率晶体管2只的配置计算，近三年公司双极型功率晶体管在节能照明领域的市场占有率情况具体如下：

项目名称	2012 年	2011 年	2010 年
国内节能照明产品产量（亿只）（A）	62.04	63.40	61.12
国内节能照明产品双极型功率晶体管需求量（亿只）（B=2×A）	124.08	126.80	122.24
公司双极型功率晶体管及芯片销售数量（亿只）（C）	34.92	37.13	36.50
市场占有率（%）（D=C/B）	28.14	29.28	29.85

数据来源：根据中国照明电器协会公布的数据整理而成。

报告期内，公司主要产品市场份额接近30%，在节能照明领域属于行业龙头企业之一。同时，公司正在积极开拓LED市场，目前已与国内多家公司合作开发LED驱动产品，拓展LED市场。

3、行业主要企业情况

在半导体分立器件领域，行业内主要企业包括吉林华微电子股份有限公司、无锡华润华晶微电子有限公司、江苏东光微电子股份有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、苏州固锟电子股份有限公司等。上述公司的具体情况如下（信息来源于各公司官网和年报）：

（1）吉林华微电子股份有限公司

吉林华微电子股份有限公司成立于 1999 年，系于上海证券交易所挂牌的上市公司（600360.SH）。该公司拥有功率半导体芯片从设计、研发、制造、封装到销售的完整产业链，拥有 6 英寸、5 英寸、4 英寸和 3 英寸等多条生产线，是目前国内最大的功率晶体管提供商，产品结构覆盖半导体器件、集成电路芯片、小型服务器及计算机配件和其他等。

（2）无锡华润华晶微电子有限公司

无锡华润华晶微电子有限公司是华润微电子有限公司下属公司，主要从事集成电路、分立器件两大类产品的设计开发、圆片制造、测试及封装业务，生产国内著名的“华晶”牌集成电路和分立器件，已有四十多年的历史，是中国规模领先、品牌优异的功率器件供应商。该公司拥有一条 6 英寸、一条 5 英寸与两条 4 英寸功率半导体圆片生产线，以及与之相配套的硅材料衬底制备和较为齐全的功率半导体封装测试生产线，产品广泛应用于电子照明、绿色电源、电视机、电动车等产品领域。

（3）江苏东光微电子股份有限公司

江苏东光微电子股份有限公司成立于 1998 年，系于深圳证券交易所挂牌的上市公司（002504.SZ）。该公司是专业从事半导体分立器件、集成电路的开发、设计、制造和销售的高新技术企业，主要产品涵盖防护功率器件系列产品、VDMOS 系列产品、可控硅系列产品、1300X 系列产品，产品广泛应用于通信设备、网络设备、数字电视、民用电路等领域。

（4）杭州士兰微电子股份有限公司

杭州士兰微电子股份有限公司成立 1997 年，系于上海证券交易所挂牌的上市公司（600460.SH），主要从事 CMOS、BiCMOS 和双极型等消费类整机用集成电路产品和开关二极管、稳压管、肖特基、MOS 功率晶体管等半导体分立器件产品的开发、生产与销售。

（5）苏州固锟电子股份有限公司

苏州固锟电子股份有限公司成立于 1998 年，系于深圳证券交易所挂牌的上市公司（002079.SZ）。该公司属于分立器件二极管行业主要制造商，主要从事各种二极管、桥堆产品、表面贴装器件、光伏旁路集成模块和相关封装集成电路产品设计、生产和销售。

（四）发行人的竞争优势

公司作为国内半导体分立器件行业的知名企业，在品牌、技术与研发、制造能力、生产管理与成本控制、团队等方面具有较强的竞争优势。

1、品牌优势

公司拥有二十余年的功率半导体器件的生产经营历史，拥有从功率半导体芯片设计、研发、制造、封装到销售的完整产业链，是深圳市唯一一家具有完整半导体芯片制造和产品封装生产线、自主进行功率器件芯片和封装产品研发制造的高科技企业，行业地位比较突出。

公司与国内外知名企业建立了长期合作关系，目前公司主要客户包括阳光照明、佛山照明、欧普照明、雷士照明、欧司朗、艾默生等企业。

2、技术与研发优势

公司自主研发能力居于国内同行前列，目前拥有专利 62 项，其中发明专利 11 项，实用新型专利 51 项，另外，还有 16 项发明专利处于授予发明专利权、实质性审查或受理阶段。公司近年承担了系列国家级项目，包括国家发改委 2008-2009 年“功率 MOSFET 产业化项目”、工信部 2010 年“新型电力电子器件研发及产业化（高压大电流 MOSFET）项目”、国家发改委 2011-2012 年“高压系列功率 MOSFET 器件产业化项目（II 期）”项目。

公司技术水平处于国内先进行列，部分产品达到国内领先水平，具体情况如

下:

主要研发成果	简要介绍
功率晶体管生产线全 线开通技术	通过深圳市科技成果鉴定, 获得《科学技术成果鉴定书》、《成果登记证书》, 荣获“深圳市科技进步二等奖”。
MJE13003 系列大功率 晶体管生产定型	获得《科学技术成果鉴定证书》、《成果登记证书》、广东省优秀新产品奖: 三等奖。
三重扩散、掺氧多晶硅 (SIPOS) 表面钝化等 全平面工艺生产技术	掺氧多晶硅(SIPOS)表面钝化技术: 该技术 1998 年在广东省科技情报研究所《科技查新报告》指出, 至今未见国内有与本项技术特点完全相同, 将 SIPOS 钝化工艺应用于双极型晶体管, 使其击穿电压达 1,000V 以上的应用成果及其相关文献报道。 三重扩散平面工艺技术: 经深圳市科技局等单位组织的联合科技成果鉴定认为, 处于国内领先水平。
BUL6800 系列功率晶 体管	通过深圳市新产品鉴定, 获得《新产品新技术鉴定验收证书》, 成为公司的主导产品系列, 在国内绿色照明领域具有较高的“深爱”品牌效应, 为知名节能灯制造厂商所认证、采用, 对推动中国的节能灯产业向前发展起着一定作用。
D 型功率晶体管	通过深圳市新产品鉴定, 获得《新产品新技术鉴定验收证书》、《成果登记证书》, 性能、质量达到国内同类产品的领先水平。
L 型功率晶体管	通过深圳市新产品鉴定, 获得《新产品新技术鉴定验收证书》、《成果登记证书》, 性能、质量达到国内同类产品的领先水平。
DMOS 功率晶体管制 造工艺技术	完成场效应晶体管(MOSFET)系列产品自主试制, 开始拓展市场销售, 进入规模生产。
肖特基二极管	通过深圳市新产品鉴定, 获得《新产品新技术鉴定验收证书》、《成果登记证书》, 性能、质量达到国内同类产品的领先水平, 有效改善公司产品结构, 有助于公司拓展半导体功率器件应用新的市场领域。
CMOS 电路制造工艺 技术	成功研制 CMOS 电路(IC)系列产品, 目前已形成成熟工艺并进入生产。
复合型半导体硅器件 钝化膜研究	氮氧化硅钝化工艺形成稳定的工艺规范, 成功应用于公司芯片制造生产中, 采用氮氧化硅钝化工艺, 可有效减少一道芯片制造工序, 可节省芯片制造成本近 1/6。
充电器用功率晶体管 (H 系列) 产品研制	本系列是公司针对充电器电路研发的专用功率晶体管, 现已经形成稳定成熟的生产控制工艺。

3、制造能力优势

公司建立了深圳市级技术中心和深圳功率半导体器件工程实验室, 负责公司的产品和工艺研发工作, 具备根据不同客户不同特殊需求进行针对性开发的能力。公司研发人员从事生产制造、研究和开发工作, 经过多年实践, 积累了丰富的半导体分立器件研发、制造和工艺技术经验。

公司工艺研发团队由技术中心人员主导，并配备专业技术研究骨干人员，同时根据需要，由技术研究骨干人员与生产部门技术人员组成研究课题组工作形式，从事专项、专题的研究、开发工作。技术研究骨干人员负责参与生产线流片试制监控与工艺管理，有效提高研发速度，降低研究试验的运作成本。在此机制下，生产部门技术人员参与工艺研究工作有利于研发成果的产业化转移。

公司技术中心配置了新产品、工艺研发的关键试验试制专用设备和检测分析仪器，进行新产品、新工艺的研究实验工作，已具备进行器件设计结构前瞻性研究实验的基本工艺设备条件。

4、生产管理和成本控制优势

生产管理、品质控制和成本控制是最能体现电子产品制造企业核心竞争力的三个方面。公司自 1998 年起陆续通过 ISO9002、ISO9001: 2008、ISO14001: 2004 及 QC080000 等多项质量体系认证，建立了严格的生产管理流程、品质控制体系以及供应商评估与控制体系，能够确保原材料供应、生产和销售等各个环节的质量控制。公司聘请专业机构导入六西格玛管理，在优化生产流程的同时提高产品的合格率和稳定性，直接优化产品质量。

成本控制对制造业尤为重要。公司的成本控制，从最初的成本分析开始，到后来的成本控制和部门独立核算，公司已摸索出一套适合自己的成本控制办法，并建立了完整的成本管理和控制体系，从上至下控制各个部门和产品项目的成本费用。在组织结构上，公司采用扁平化的管理结构，建立了生产和物料管理系统，提高了公司的经营管理水平和效率，在保障信息流高效顺畅的同时，有效降低各级部门管理费用。同时，公司作为国内领先的半导体分立器件制造商之一，与上游供应商具有很强的议价能力。

5、团队优势

公司坚持以人为本理念，对人才梯队建设、员工培训成长、员工薪酬激励、公司文化熏陶等进行中长期规划，形成了适应自身发展需要的人才开发管理机制，培养出一批理念一致、稳定诚信、爱岗敬业、专业精湛的经营管理团队和人才队伍。

目前，公司拥有技术研发人员 113 名，其中，本科及以上学历的研发人员 71 人。研发人员中专业构成合理，具有较强的科研创新能力。公司高级管理层、

核心技术人员在半导体分立器件行业平均工作年限超过 10 年，具有丰富的从业经验。

（五）发行人的竞争劣势

1、产能受限

公司主导产品需要通过扩大生产规模、迅速占领并稳固市场，这样才能使企业及时抓住市场机遇、进一步巩固市场地位。目前，公司拥有两条 5 英寸功率半导体芯片生产线，在现有产能情况下，如不能随着市场容量和需求的上升而扩大生产规模，将不利于公司提高在行业中的竞争能力和快速扩大市场份额。

2、生产线未能及时升级换代

目前公司拥有两条 5 英寸功率半导体芯片生产线。现有行业内竞争对手普遍都在进行生产线的升级换代。一般而言，6 英寸生产线与 5 英寸生产线相比，具有生产效率更高、备品备件更有保障的优势。如果公司不能及时地进行生产线的升级换代，不引进更新设备和技术，将不能保证产品结构的调整和优化，公司工艺技术、产品技术及设备技术也得不到提升，缺乏更高端半导体分立器件的研发生产平台来增强公司的可持续发展能力。

四、发行人主营业务的具体情况

（一）主要产品及用途

公司主要产品包括半导体分立器件的芯片和成品管，具体分类如下：

1、芯片的分类

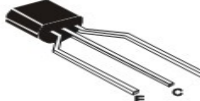
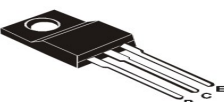
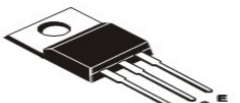
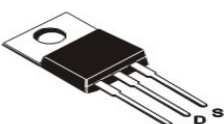
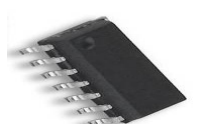
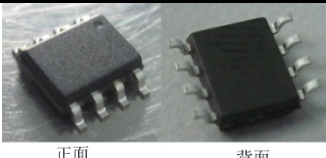
公司生产的半导体分立器件芯片主要包括二极管芯片、双极型功率晶体管芯片、场效应管芯片和其他芯片。

2、成品管的分类

公司生产的半导体分立器件成品管主要包括二极管、双极型功率晶体管、场效应管和其他分立器件。

3、公司的主要产品及用途

具体来说，公司的主要产品及用途如下：

产品/业务分类		产品图示	具体用途
双极型功率晶体管	MJE13000 系列		主要用于节能照明设备电子电路，广泛应用于节能灯、电子镇流器、开关电源等电子电路。
	BUL6800 系列		主要用于节能照明设备电子电路，广泛应用于节能灯、电子镇流器、开关电源等电子电路。
	D 系列		主要用于节能照明设备电子电路，广泛应用于节能灯、电子镇流器、开关电源等电子电路。
	L 系列		主要用于出口型 110V 电源区用节能灯、电子镇流器、开关电源等电子电路。
DMOS 功率晶体管			主要用于节能照明、开关电源、不间断电源、变频器等领域。
肖特基二极管系列			主要用于高速开关、整流电路、开关电源、通讯设备、汽车电子等应用领域。
CMOS 电路			公司 CMOS 电路的制造工艺已经形成，具备代工流片的能力。
LED 驱动芯片及模块		 正面 背面	用于 LED 照明应用领域

（二）主要产品生产流程

公司的生产流程分为试产阶段和根据计划批量生产阶段：

1、试产阶段

试产是批量生产前对新产品方案设计、功能、结构、工艺及可靠性进行全面验证的过程，是生产过程的开始，也是产品开发设计的延续，是将开发的新产品及相关的专利、软件等技术成果最终实现批量生产的一个关键环节。

2、根据计划批量生产阶段

新产品在通过试产验证及评审合格后，转入批量生产阶段。

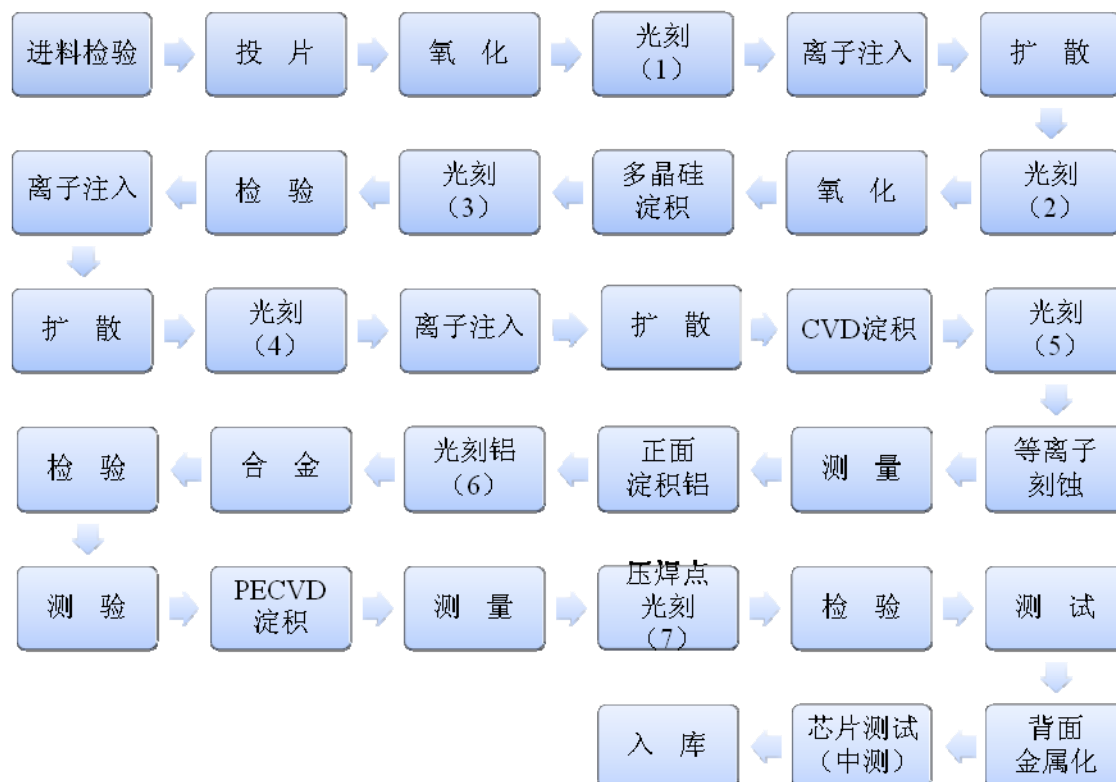
公司计划部门根据本年度的年产量、生产能力及市场情况在每年的十二月份编制下一年度的综合计划，计划内容包括全年及各月生产的品种、数量，完成日期以及年产值、销售收入等主要经济指标，经公司总经理批准后执行。计划部门在每月 25 日之前根据市场部门接到的定单及市场情况编制下一个月的综合计划，经主管领导批准后执行。生产部门依据月综合计划，根据生产实际情况，在必要时编制各自的作业计划，作业计划是落实月计划的重要保证，作业计划中明确规定各工序具体完成的工作内容。

（三）工艺流程图

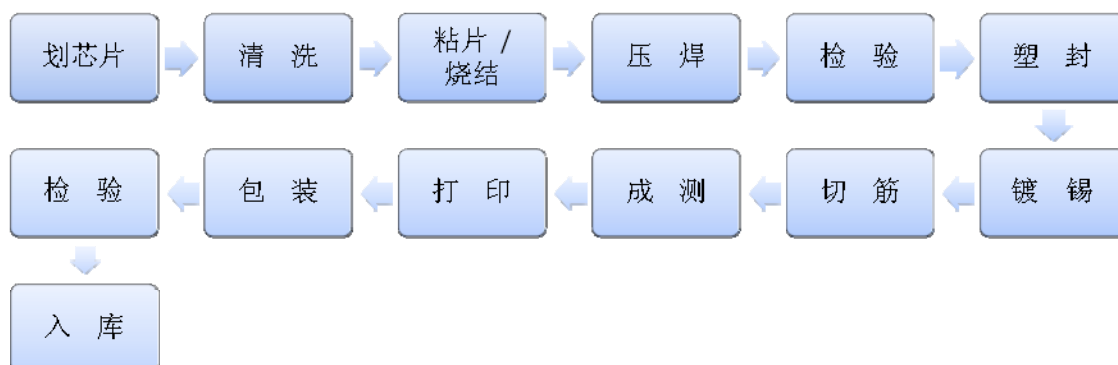
1、双极型芯片制造工艺流程图



2、DMOS芯片制造工艺流程图



3、成品管封装工艺流程图



（四）主要的经营模式

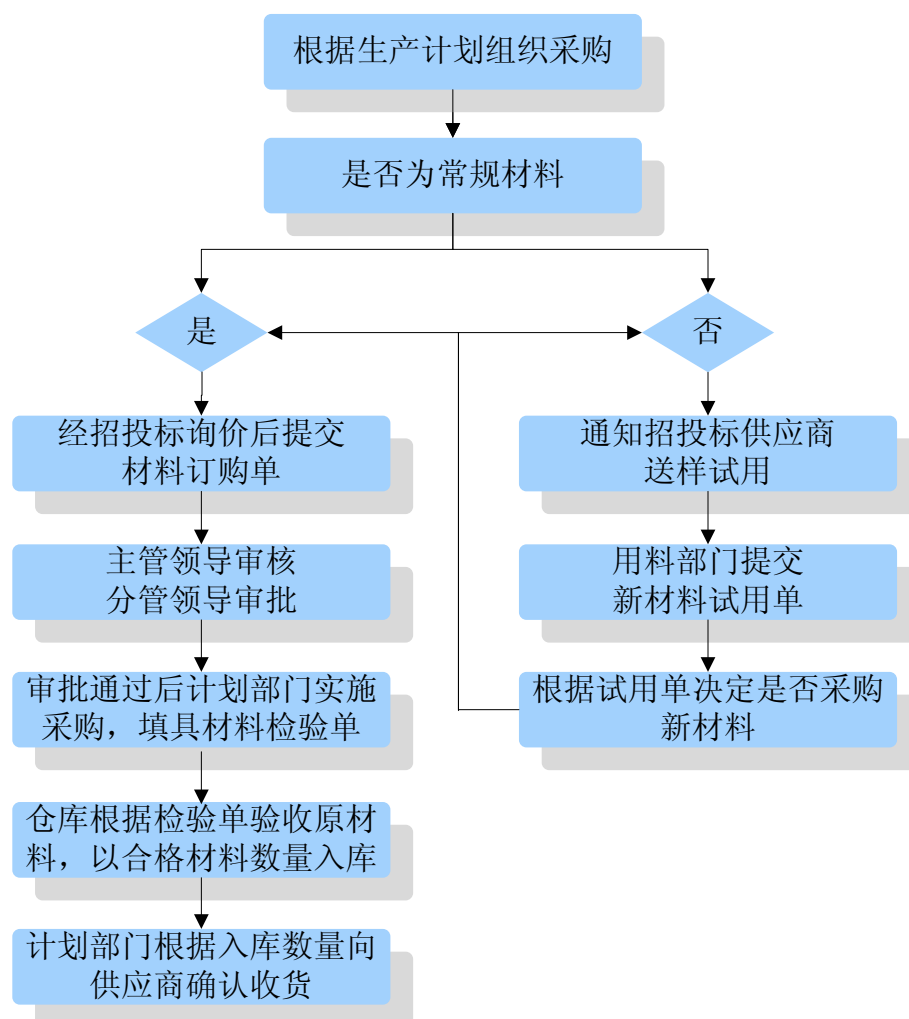
1、采购模式

公司生产产品所需的主要原辅材料包括单晶硅片、外延片、塑封料、引线框架、蒸发金、化学试剂及配套试剂等，上述材料均需从市场上采购。公司大部分原材料和辅助材料均从国内市场采购，仅少量单晶硅片、化学试剂需进口。为应对原材料价格波动对生产经营的影响，公司结合所处行业、原材料供应市场特点

和自身实际情况，以“适质、适量、适价、适时、适地”为指导原则，按照“以销定产、以产定购、适当安全储备”的采购策略，采取多种有效措施控制原材料价格波动对生产经营的影响。

公司所需的主要原材料采购渠道比较集中，价格相对透明，公司充分利用行业优势地位，通过对比价格、付款期、质量、服务等内容，选择市场信誉好、产品质量有保证的厂商作为主要供应商，双方建立相对稳定的合作关系，将主要原材料的采购额度按一定比例合理分配给通过公司认证的供应商，实现对主要原材料采购价格的一定控制。公司所需的通用性材料主要采取招标采购，通过考察经营资质和供货能力，选定若干个具备稳定供货能力、质优价廉的意向供应方并通过竞标确定最终的供应商。公司所需的备品备件供应商较多，市场供应也较为充分，公司依据技术部门认定的合格供应商名录，按照“询价、比价、议价”的工作方式，选择最终的供应商。

公司计划供应部负责采购业务的具体实施，主要流程如下：

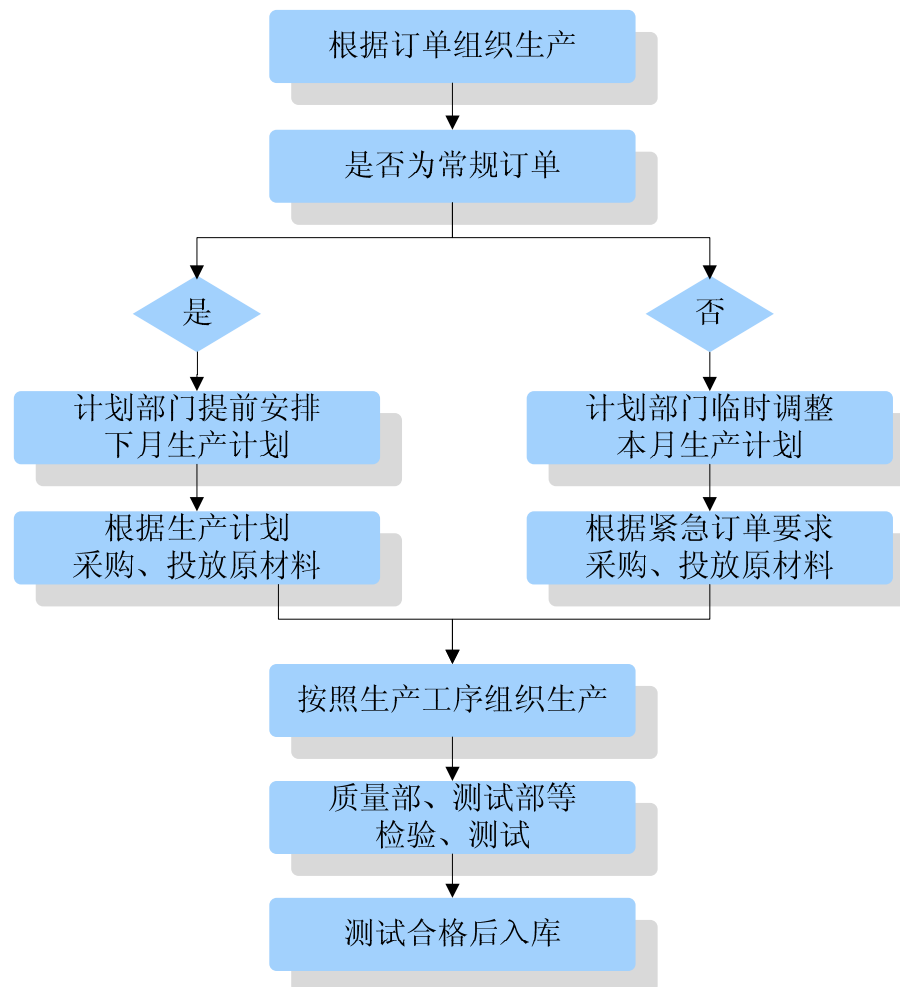


近年来，随着中国半导体行业技术水平的不断提升，部分原先依赖进口的原材料逐步实现国产化，公司也相应减少进口采购量，加大国产原材料的采购量，从而降低采购成本。公司对于生产所需的部分金属等关键原材料，依据对市场行情的研究与判断，采取集中采购模式，对采购价格实现一定的锁定，缓解价格波动对生产经营的不利影响。公司配备专业人员，提高采购的专业性，加强采购环节管控，同时充分发挥自身的行业地位优势，借助份额分配、招标采购、集中采购等方式，与主要供应商建立相对稳固的合作关系，实现了对采购成本的有效控制。

2、生产模式

公司市场部门按照客户的订单情况汇总，编制月销售计划，将月销售计划提交给计划部门。计划部门根据月销售计划结合产成品库存情况制定月生产计划，月生产计划制定完成后，下发各个生产部门，同时根据生产计划结合原材料库存情况制定原材料采购计划。生产部门根据月生产计划提出的产品和数量，进行分解自产和外包部分，安排产品生产，其中，外包部分主要指委托外协厂商进行成品管封装。产品生产完成后经检验合格入成品仓库，业务人员凭借成品出库单发货。对于一些临时追加的销售订单，由计划部门下达临时订单需求或者计划调度工作指令安排临时生产，由于临时订单会打乱原有生产计划，根据交期紧迫程度与生产部门进行协调，保证交期。

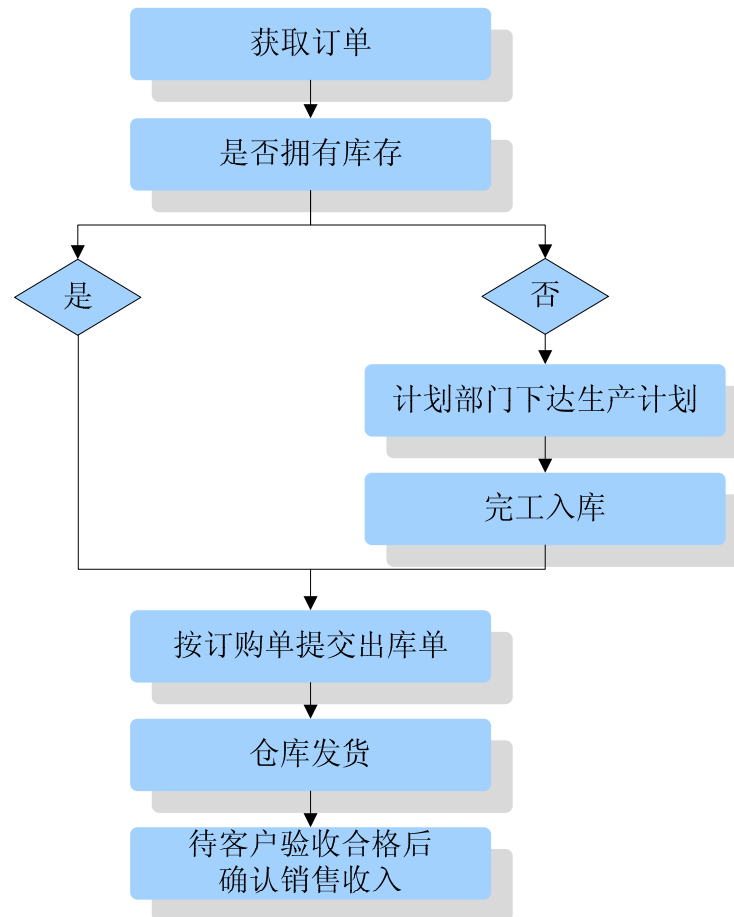
公司芯片生产主要由制造二部、制造三部负责，成品管封装主要由封装部负责，主要生产流程如下：



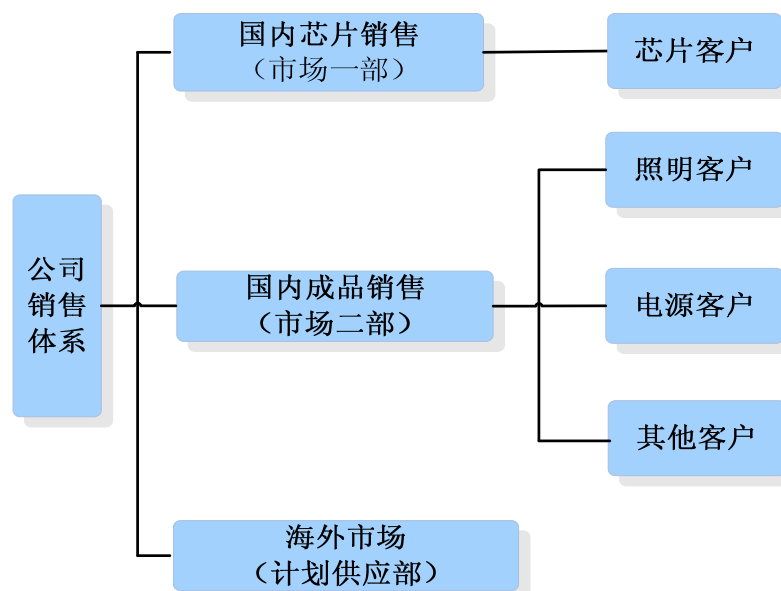
公司新品研发及生产由技术中心负责，技术人员根据自己的新品项目，全程负责协调新品的材料采购、投片生产及产品出货前与销售人员的沟通。

3、销售模式

公司产品销售模式主要为直销模式，主要销售流程如下：



公司产品以境内销售为主，境外出口销售为辅，销售体系如下：



（1）境内销售模式

目前，公司在境内销售的产品全部是自主品牌产品，主要通过公司市场部门

实现最终销售。公司市场一部和市场二部分别负责境内芯片和成品管的销售、新产品的推广应用及售后服务工作，并负责市场调研（包括同行发展）、广告策划等业务，每季度出具市场变化与预测报告。

公司境内业务销售一般以 30-90 天为信用期，具体期限根据客户信用情况进行调整，并主要采取电汇或承兑汇票方式结算。

（2）境外销售模式

目前，公司部分产品向境外出口，主要通过计划供应部实现最终销售。公司海外销售对象主要为欧洲、香港、印度、新加坡等国家及地区。

公司海外业务遵循国际通行的商贸规则和惯例，主要采取 T/T 等结算方式，信用期一般为 30-60 天。

由于国内经济增速放缓、半导体行业景气度降低，2013 年公司境内销售收入为 31,971.09 万元，同比有所下降。受益于海外市场的复苏，公司境外销售保持持续平稳增长，2013 年境外销售收入达 4,470.37 万元，同比增长 13.52%。报告期内公司主营业务收入按境内外销售收入情况如下：

单位：万元

分类	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
境内销售	31,971.09	87.73%	36,021.31	90.15%	41,760.81	92.25%
境外销售	4,470.37	12.27%	3,937.87	9.85%	3,509.01	7.75%
合计	36,441.46	100.00%	39,959.18	100.00%	45,269.82	100.00%

（五）主要产品的产销情况

1、主营业务收入构成

公司主要产品为半导体分立器件芯片和成品管，两者合计占公司营业收入 95%以上。报告期内公司主营业务收入分产品构成如下：

年 度	产品类别	主营业务收入 (元)	占公司营业收入 总额比重
2013 年度	成品管	223,767,119.90	59.72%
	芯片	140,647,481.78	37.54%
	合 计	364,414,601.68	97.26%

2012 年度	成品管	240,257,705.61	59.13%
	芯片	159,334,065.49	39.21%
	合 计	399,591,771.10	98.34%
2011 年度	成品管	269,449,972.13	58.08%
	芯片	183,248,225.00	39.50%
	合 计	452,698,197.13	97.57%

2、主要产品产销情况

报告期内，公司成品管和芯片的销量均有所减少。随着 MOSFET 产品质量的提高，其销量增加较快，2013 年增幅超过 150%。未来新产品规模化量产，将成为公司新的业务增长点，从而提升公司盈利能力。报告期内公司主要产品的产能、产量及销量情况如下：

年度	产品类别	单位	年产能	自产产量	外协产量	自用数量	销售量	产销率	产能利用率
2013 年度	成品管	万只	78,000.00	70,993.21	43,736.95		106,320.71	92.67%	91.02%
	芯片	片	1,100,000.00	1,012,662.00		366,251.00	568,468.00	92.30%	92.06%
2012 年度	成品管	万只	78,000.00	67,014.40	42,817.51		109,257.96	99.48%	85.92%
	芯片	片	1,000,000.00	965,015.00		383,419.00	603,323.00	102.25%	96.50%
2011 年度	成品管	万只	75,000.00	67,956.55	50,583.33		118,933.93	100.33%	90.61%
	芯片	片	1,200,000.00	1,108,977.00		455,867.00	707,886.00	104.94%	92.41%

注①：产销率=（销售量+自用数量）/（自产产量+外协产量）×100%；

注②：产能利用率=自产产量/年产能×100%；

注③：年产能为公司自产产能，产量、销量数据均不含报废品数量。

3、主要产品销售价格变动情况

报告期内，受原材料价格持续下降和国内半导体分立器件市场竞争格局强化等多重因素的影响，公司产品价格略有波动，整体保持平稳。报告期内公司产品平均售价（不含税）情况如下：

单位：元/只、元/片

项目	产品类别	2013 年度	2012 年度	2011 年度
平均售价（不含税）	成品管	0.21	0.22	0.23
	芯片	247.42	264.09	258.87

注：芯片（包括 4 英寸芯片和 5 英寸芯片）售价为一类品、二类品等不同等级芯片（不含报废品）的平均售价。

4、主要客户销售情况

报告期内，公司主要客户较为稳定，其中，受益于国外需求的增加，公司出口销售额保持较快增长，印度 NTL 电子有限公司成为公司 2013 年度前五大客户。报告期内公司向前五名客户销售情况如下：

年度	序号	客户名称	销售内容	销售收入（元）	占营业收入比例（%）
2013 年度	1	镇江强凌电子有限公司	成品管	24,485,053.54	6.54
	2	芯域半导体有限公司	芯片	19,074,897.37	5.09
	3	深圳市晶导电子有限公司	芯片	18,552,330.82	4.95
	4	深圳市盛元半导体有限公司	芯片	11,379,055.11	3.04
	5	印度 NTL 电子有限公司	成品管	11,332,250.30	3.02
	合计			84,823,587.14	22.64
2012 年度	1	镇江强凌电子有限公司	成品管	26,627,097.47	6.55
	2	深圳市晶导电子有限公司	芯片	21,779,706.68	5.36
	3	深圳市盛元半导体有限公司	芯片	17,961,356.31	4.42
	4	芯域半导体有限公司	芯片	12,255,128.50	3.02
	5	欧普照明电器（中山）有限公司	成品管	12,109,370.55	2.98
	合计			90,732,659.51	22.33
2011 年度	1	镇江强凌电子有限公司	成品管	30,447,840.09	6.56
	2	深圳市晶导电子有限公司	芯片	19,567,459.44	4.22
	3	深圳市盛元半导体有限公司	芯片	18,450,169.49	3.98
	4	中山市欧普照明股份有限公司	成品管	17,351,399.84	3.74
	5	深圳市芯域联合半导体有限公司	芯片	12,953,314.49	2.79
	合计			98,770,183.35	21.29

报告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过 50%或严重依赖于少数客户的情况。

此外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方、其他持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中不占有任何权益，无其他应披露的关

联交易。

（六）主要产品的原材料和能源及其供应情况

1、原材料和能源供应情况

公司主要原材料为：单晶片、抛光片、外延片、引线框架、蒸发金、塑封料、化学试剂及配套试剂等，供应渠道主要通过市场采购。公司在物资采购方面制定了严格的管理办法和业务操作流程，具体请参见本节之“四、发行人主营业务的具体情况”之“（四）主要的经营模式”。

原材料	在产品中的用途	定价依据
5"单晶片	芯片主材	市场定价
5"外延片	芯片主材	市场定价
抛光片	芯片主材	市场定价
引线框架	成品管支架	市场定价
塑封料	成品管封装材料	市场定价
蒸发金	背面金属化	市场定价
化学试剂	清洗	市场定价

公司生产所用主要能源包括水、电、液氮，水电由当地市政部门供应，能够保证公司的生产用水和用电，液氮由空气化工产品（广州）有限公司供应。公司于2013年3月正式启用现场制氮设备，供应生产用氮气。在制氮设备检修期间，需对外采购少量液氮。

2、主要原材料和能源的价格变动趋势

报告期内，公司所采购原材料的价格呈平稳下降的趋势，其中，个别原材料价格波动较大。具体情况如下：

项目	单位	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
		单价	变动比	单价	变动比	单价	变动比
5"单晶片	元/片	39.04	-10.07%	43.41	-26.92%	59.40	4.25%
5"外延片	元/片	175.69	-6.42%	187.74	-8.75%	205.74	9.13%
抛光片	元/片	86.65	-6.90%	93.07	-7.60%	100.72	-0.72%
引线框架	元/千只	41.55	-6.02%	44.21	-6.99%	47.53	11.42%
蒸发金	元/克	253.19	-16.28%	302.41	9.48%	276.22	142.87%

项目	单位	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
		单价	变动比	单价	变动比	单价	变动比
塑封料	元/千克	21.08	-4.15%	21.99	-1.79%	22.39	0.40%
化学试剂	元/升	19.49	-9.60%	21.56	1.51%	21.24	-5.73%
水	元/立方米	4.210	0.00%	4.210	21.85%	3.455	0.00%
电	元/千瓦时	0.649	0.00%	0.649	4.17%	0.623	1.30%
液氮	元/千克	0.684	-4.47%	0.716	0.00%	0.716	7.35%

注：由于制造工艺改进，公司自 2013 年下半年开始采用蒸发银进行背面金属化。

3、主要原材料和能源占成本的比重

报告期内，公司所用原材料占主营业务成本的比重基本保持稳定，具体情况如下：

年度	原材料（万元）	原材料占主营业务成本比重（%）	能源（万元）	能源占主营业务成本比重（%）
2013 年度	14,495.73	50.63	4,418.42	15.43
2012 年度	16,808.46	54.80	5,062.31	16.50
2011 年度	19,138.93	54.82	5,048.90	14.46

4、主要供应商采购情况

报告期内，公司主要供应商较为稳定，其中，由于公司改进生产工艺，自 2013 年下半年开始不再使用较昂贵的蒸发金，蒸发料采购金额有所减少，有研半导体材料股份有限公司成为公司 2013 年前五大供应商。报告期内公司向前五名供应商采购情况如下：

年度	序号	供应商名称	采购内容	采购金额（元）	占采购总额比例（%）
2013 年度	1	宁波华龙电子股份有限公司	框架	32,282,752.03	19.47
	2	杭州海纳半导体有限公司	单晶片	23,280,013.68	14.04
	3	浙江金瑞泓科技股份有限公司	单晶片	20,172,646.84	12.17
	4	江阴化学试剂厂有限公司	化学试剂	7,941,383.76	4.79
	5	有研半导体材料股份有限公司	抛光片	7,331,926.50	4.42

年度	序号	供应商名称	采购内容	采购金额 (元)	占采购总额比例 (%)
		合计		91,008,722.80	54.88
2012年度	1	杭州海纳半导体有限公司	单晶片	29,028,594.87	17.08
	2	宁波华龙电子股份有限公司	框架	26,565,679.91	15.63
	3	浙江金瑞泓科技股份有限公司	单晶片	18,362,162.39	10.80
	4	北京达博有色金属焊料有限责任公司	蒸发料	10,845,125.81	6.38
	5	江阴化学试剂厂有限公司	化学试剂	7,134,890.94	4.20
		合计		91,936,453.93	54.09
2011年度	1	宁波华龙电子股份有限公司	框架	49,838,553.50	19.96
	2	杭州海纳半导体有限公司	单晶片	44,281,050.26	17.73
	3	浙江金瑞泓科技股份有限公司	单晶片	21,134,223.50	8.46
	4	江阴化学试剂厂有限公司	化学试剂	11,500,984.96	4.61
	5	北京达博有色金属焊料有限责任公司	蒸发料	9,990,641.38	4.00
		合计		136,745,453.61	54.75

报告期内,公司不存在向单个供应商采购比例超过 50%或严重依赖于少数供应商的情况。

此外,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方、其他持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中不占有任何权益,无其他应披露的关联交易。

5、外协生产情况

报告期内,公司受制于半导体分立器件成品管封装生产线的产能瓶颈,成品管生产数量长期无法满足市场需求。为更好地满足客户需求,公司在积极扩大产能的同时,也通过组织外协生产拓宽生产渠道。外协生产主要是通过向同类半导体封装厂商提供芯片、由其封装后再收回成品管的方式实现的。

(1) 外协生产情况说明

①外协生产的背景原因

公司主要产品是半导体分立器件芯片及成品管，公司具有完整的半导体芯片制造及产品封装生产线，能够自主进行半导体分立器件芯片和封装产品的研发、生产及销售。公司主要产品的生产分为芯片设计、芯片制造、封装测试几个步骤，芯片产品既可以直接对外销售，也可以经封装测试后生产为成品管。

随着市场对成品管销售数量、品种种类的需求增加，公司封装测试产能已不能完全满足市场需求，因此，自 2000 年起，公司开始寻找一些优秀的封装测试厂家协助加工成品管，由公司提供芯片给外协厂商封装，外协厂商自行采购所需原辅材料，按照公司要求的技术标准将芯片封装测试后交回给公司。

②外协生产的流程

公司外协生产成品管的主要流程如下：

- A、根据成品管的生产需求总量和自产量确定需要外协加工的成品管数量；
- B、根据各外协厂商的产能情况对外协成品管总数量制定分配计划；
- C、根据外协加工分配计划形成每个外协厂商的加工订单，并将订单发给各外协厂商；
- D、根据加工订单将对应数量的芯片发货给各外协厂商，外协厂商将封装测试好的成品管发给公司；
- E、公司对收到的成品管进行检验，检验无误后进行入库。

（2）外协生产的结算模式

①购销模式

公司采取购销结算模式的主要目的在于提高外协采购成品管的质量。公司曾经采用委托加工的方式处理外协业务，即按照收取加工费的方式结算外协加工的成品管。但是随着业务量的扩大，委托加工方式的弊端逐渐显现。由于外协厂商除经营委托加工业务之外，还向公司采购部分芯片用于自主加工、销售。因此在委托加工模式下，部分外协厂商将质量好的芯片留为自用，质量较差的芯片用于为公司加工成品管，导致公司收回的成品管出现参数范围离散、发出芯片数量与收回成品管数量存在较大差异等问题。为杜绝此类问题，公司自 2003 年开始采用购销模式处理外协加工业务。近十年的实践经验表明，购销模式能够较好地解决委托加工方式带来的问题，因此一直沿用至 2014 年 1 月底。

在购销模式下，公司将外协加工分为芯片销售与成品管采购两个环节分别结

算：

A、芯片销售环节。公司自主设计、生产外协成品管制造所需的芯片，再将部分芯片发货给外协厂商，外协厂商收到芯片后进行抽检，经检验合格后作入库处理。同时，公司在收到验收通知后，向外协厂商开具销售发票，并确认该批芯片销售收入；

B、成品管采购环节。外协厂商按照公司的技术要求对采购的芯片进行封装，加工为成品管，并按照芯片采购价加上加工费的价格销售给公司。公司对成品管抽检合格后，并通知外协厂商开具销售发票，公司收到发票后确认进货成本。

②委托加工模式

近年来，随着六西格玛（6 σ ）精益管理工具和 5S 标准化管理方法的推行，公司对产品质量的管理水平不断提高，对外协业务质量的管控能力也显著增强。在开展外协业务时，公司基本可以杜绝外协厂商以次充好、交付不合格成品管等情形，因此，即便采用委托加工模式结算外协业务也完全可以保证外协成品管的质量。在保证产品质量可靠的前提下，公司决定自 2014 年 2 月 1 日起，对外协加工业务采用委托加工模式进行结算。

③报告期内购销模式的会计调整

为保持申报期间会计政策的一致性，发行人各期末参考委托加工模式将未对外销售的成品管（包括外协厂商尚未加工为成品管和发行人购回成品管后未实现销售两部分）中含有的未实现芯片销售毛利冲销，同时将已最终对外实现销售的委托加工成品管对应的芯片销售收入和成本冲销，彻底消除了该项业务对公司收入、成本和净利润的影响

（3）外协加工情况

2011-2013 年，公司与前五大外协厂商发生的外协加工业务具体情况如下：

年度	序号	外协厂商名称	委托加工费（元）	占同类交易比例（%）	占主营业务成本比例（%）
2013 年度	1	广东万源创宝新科技股份有限公司	12,549,036.79	52.89	4.38
	2	厦门尚明达机电工业有限公司	7,090,952.06	25.16	2.48
	3	佛山市蓝箭电子股份有限公司	6,006,667.35	9.43	2.10
	4	深圳市晶导电子有限公司	1,215,170.05	5.30	0.42

年度	序号	外协厂商名称	委托加工费（元）	占同类交易比例（%）	占主营业务成本比例（%）
	5	西安高科卫光电子有限公司	900,846.92	3.35	0.31
	合计		27,762,673.17	96.12	9.70
2012年度	1	创佳微	16,615,116.97	39.07	5.42
	2	厦门尚明达机电工业有限公司	11,473,151.77	26.98	3.74
	3	佛山市蓝箭电子股份有限公司	7,515,235.69	17.67	2.45
	4	西安高科卫光电子有限公司	5,645,762.61	13.28	1.84
	5	南通华隆微电子有限公司	607,476.61	1.43	0.20
	合计		41,856,743.65	98.44	13.65
2011年度	1	创佳微	23,620,202.22	45.01	6.77
	2	厦门尚明达机电工业有限公司	11,235,667.06	25.43	3.22
	3	佛山市蓝箭电子股份有限公司	4,209,021.46	21.54	1.21
	4	南通华隆微电子有限公司	2,365,273.24	4.36	0.68
	5	宁波明昕微电子股份有限公司	1,494,144.22	3.23	0.43
	合计		42,924,308.20	99.57	12.29

注①：创佳微与广东万源创宝新科技股份有限公司为同一实际控制人控制的公司。2012年广东万源创宝新科技股份有限公司的外协加工费为 1,435,454.29 元，合并计入创佳微。

注②：除创佳微在报告期内曾为公司关联方以外，其他外协厂商与公司不存在关联关系。

（七）公司的安全生产、环境保护措施

公司遵照《中华人民共和国安全生产法》、《劳动防护用品管理规定》、《危险化学品安全管理条例》制定了《深圳深爱半导体股份有限公司安全手册》，实施安全生产岗位责任制，各部门每日进行安全生产例行检查，公司定期组织安全生产巡查、培训及宣传教育，定期组织消防演习，确保了生产的安全无重大责任事故。

公司目前已全面执行欧盟RoHS 指令，已建立公司RoHS 保障体系，在物料选择、供应商管理、来料、储存、生产等各个运行环节均按照该体系进行控制，RoHS 保障体系运行有效。公司生产经营活动执行国家相关强制性的质量技术标

准和业务规程及技术监督标准。

公司生产过程产生少量的废水、废气和废渣，公司对影响环境的因素采取了切实有效的措施，已达到国家法规要求的排放标准。2014年2月19日，根据深圳市人居环境委员会出具的《关于深圳深爱半导体股份有限公司等公司环保守法情况的证明》（深人环法证字[2014]第113号），公司及公司龙岗分厂自2011年1月1日起至2013年12月31日未发生环境污染事故和环境违法行为；现阶段未对环境造成污染，已达到国家和地方规定的环保要求。

五、与发行人主要业务相关的固定资产和无形资产

（一）主要固定资产

截至2013年12月31日，公司固定资产原值合计503,424,867.64元，累计折旧272,117,086.60元，固定资产净值231,307,781.04元，具体情况如下：

单位：元

资产类别	资产原值	累计折旧	资产净值	成新率
房屋及建筑物	195,112,074.99	54,674,243.91	140,437,831.08	71.98%
机器设备	45,574,633.13	24,446,049.63	21,128,583.50	46.36%
运输设备	2,642,832.00	2,446,590.20	196,241.80	7.43%
电子设备	226,510,283.29	165,737,521.89	60,772,761.40	26.83%
其他设备	33,585,044.23	24,812,680.97	8,772,363.26	26.12%
合 计	503,424,867.64	272,117,086.60	231,307,781.04	45.95%

公司固定资产综合成新率为45.95%，整体运行情况良好。公司主要生产设备系购买取得，不存在租赁生产设备情形，主要设备情况如下：

设备名称	数量（台）	部门	功能描述	资产原值（元）	资产净值（元）
磨片机	11	芯片制造部门	芯片减薄	7,204,371.35	4,640,845.09
抛光机	10	芯片制造部门	芯片表面抛光	1,627,688.78	251,102.24
离子注入机	13	芯片制造部门	离子掺杂	11,812,626.79	2,386,999.66
扩散炉	35	芯片制造部门	扩散、合金	16,834,761.31	8,295,945.25
匀胶机	15	芯片制造部门	光刻匀胶	1,119,309.92	82,815.41
显影机	5	芯片制造部门	光刻显影	2,614,938.73	1,270,121.85
光刻机	35	芯片制造部门	光刻设备	23,272,119.05	11,210,640.86
刻蚀机	32	芯片制造部门	薄膜刻蚀	4,144,065.96	1,020,374.49

设备名称	数量（台）	部门	功能描述	资产原值（元）	资产净值（元）
去胶机	14	芯片制造部门	去胶	1,390,961.94	531,705.96
清洗机/台	62	芯片制造部门	清洗	1,838,845.20	588,406.87
甩干机	69	芯片制造部门	清洗甩干	2,619,078.00	910,453.89
蒸发台	19	芯片制造部门	正、背面金属化	28,136,862.00	6,183,891.26
溅射台	14	芯片制造部门	正、背面金属化	5,176,128.13	1,254,840.38
沉淀系统	2	芯片制造部门	CVD 化学淀积	3,337,611.73	2,629,981.39
测试系统	70	芯片制造部门、封装部、测试部、质量部	芯片和成品测试、检验	11,470,903.36	2,483,126.89
图示仪	22	芯片制造部门、封装部、测试部、质量部	测试分析	1,037,793.99	53,186.48
探针台	76	测试部	芯片测试	6,403,513.59	1,080,450.40
划片机	18	封装部	划片	7,629,337.63	1,275,401.81
粘片机	34	封装部	粘片	25,325,336.57	3,804,782.18
压焊机	24	封装部	压焊	8,043,435.73	3,162,057.43
焊线机	20	封装部	芯片压焊	11,727,848.50	4,518,806.09
塑封机/模具	33	封装部	塑封成形	7,659,333.11	3,279,474.58
编带机	5	封装部	整形包装	1,380,204.21	351,745.35
打标机	15	封装部	标识打印	2,336,153.85	1,255,115.17
切筋机	23	封装部	切筋	2,099,824.69	693,425.22
去溢料机	3	封装部	去溢料	662,660.59	520,957.48
分选机	43	封装部	成品分类	5,370,052.13	2,242,103.33
筛选仪	13	封装部、质量部	测试分析	56,352.14	18,090.32
实验台	3	质量部	可靠性实验	291,071.04	115,909.75
合计	738	-	-	202,623,190.02	66,112,757.08

（二）房屋建筑物

1、公司拥有的房屋建筑物

截至招股说明书签署日，公司共拥有 11 处房屋产权，建筑面积合计 54,719.68 平方米。具体如下：

序号	房产权证号	产权人	坐落	用途	面积（平方米）	他项权利	终止日期	取得方式
----	-------	-----	----	----	---------	------	------	------

序号	房产权证号	产权人	坐落	用途	面积 (平方米)	他项 权利	终止日期	取得 方式
1	深房地字第 3000676169 号	发行人	深圳市福田区八卦三路光纤小区一号厂房 1 栋 1、2、3 层	其他	6,479.70	抵押	2033.10.11	购买
2	深房地字第 3000719520 号	发行人	深圳市福田区赛格工业区 101 栋 1-718	公寓	44.96	无	2038.03.20	购买
3	深房地字第 3000719521 号	发行人	深圳市福田区赛格工业区 101 栋 1-720	公寓	44.96	无	2038.03.20	购买
4	深房地字第 3000719522 号	发行人	深圳市福田区赛格工业区 101 栋 1-719	公寓	44.96	无	2038.03.20	购买
5	深房地字第 3000719523 号	发行人	深圳市福田区赛格工业区 101 栋 1-721	公寓	44.57	无	2038.03.20	购买
6	深房地字第 6000513548 号	发行人	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路三号 8 号办公及活动房	工业 配套	2,462.29	抵押	2053.6.30	自建
7	深房地字第 6000513549 号	发行人	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路三号 4 号厂房	厂房	2,791.82	抵押	2053.6.30	自建
8	深房地字第 6000513550 号	发行人	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路三号 2 号厂房	厂房	21,061.39	抵押	2053.6.30	自建
9	深房地字第 6000513551 号	发行人	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路三号 10 号单身宿舍	宿舍	5,172.56	抵押	2053.6.30	自建
10	深房地字第 6000512069 号	发行人	深圳市龙岗区宝龙工业城深爱芯园单身宿舍	宿舍	6,071.89	抵押	2054.11.28	自建
11	无	发行人	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路深爱测试封装厂房及化学品库	厂房及 仓库	10,500.58	无	-	自建

注①：房地产证字第 3000676169 号因开发商的原因，发行人至今未能就该房产办理正式的房产证，发行人现持有该房产的代用证。

注②：公司位于深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路的深爱封装厂房及化学品库工程已于 2011 年 11 月取得深圳市建设工程规划验收合格证，建筑用途为厂房及仓库，建筑面积共计 10,500.58 平方米，公司正在办理工程决算，房产证书尚待办理。

注③：截至招股说明书签署日，公司将房地产证字第 3000676169、6000513548、6000513549、6000513550、6000513551、6000512069 号房产设置抵押，为取得授信额度为人民币 22,000 万元的借款，目前该授信合同尚在办理。

2、公司租赁的房屋建筑物

2013年6月13日，公司与自然人洪斌签署《房屋租赁合同》，租赁厦国土房证第00754787号房产。该房产位于厦门市湖里区枋湖东一里26号602室，面积为92.84平方米，月租金为4,300元，租赁期限为2013年6月14日至2015年6月13日。

除以上租赁房地产外，公司未租赁其他房屋建筑物。

（三）主要无形资产

1、土地使用权

除前述11项房产外，公司还拥有2项土地使用权。公司拥有的位于深圳龙岗宝龙工业城土地使用权（宗地号为G02314-0013、G02402-0004）系公司前身深爱有限以出让方式取得，具体如下：

（1）根据深爱有限签署的深地合字（2003）5066号《深圳市土地使用权出让合同书》，宗地号为G02314-0013的土地使用权属于高新技术项目用地，面积105,269.67平方米，土地使用年限为50年，自2003年7月1日至2053年6月30日，土地用途为工业用地。该地只能用于集成电路生产项目，否则政府将依法收回土地；该用地按50元/平方米计收地价，如转让须按照转让时的市场地价标准补交差价。

（2）根据深爱有限签署的深地合字（2004）5113号《深圳市土地使用权出让合同书》，宗地号为G02402-0004的土地使用权的实际用途为高新技术项目配套宿舍用地，面积4,733.17平方米，土地使用年限为50年，自2004年11月29日至2054年11月28日，土地用途为工业用地。该地仅限于自用，不能做营利性用途，不得转让；如因特殊原因转让的，须与G02314-0013号宗地捆绑处理，深圳市国土资源和房产管理局享有优先收回土地使用权的权利。

公司在上述土地建设厂房、工业配套及宿舍等房产并取得房地产证后，已将《土地使用证》上报相关部门收回。公司上述土地使用权系合法取得，该土地上的房产均用于发行人的生产经营。

2、专利

（1）已取得授权的专利

截至招股说明书签署日，公司拥有 62 项授权专利，其中发明专利 11 项，实用新型专利 51 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类别	专利申请日	专利号	专利权有效期	取得方式
1	复合型半导体硅器件钝化膜及钝化生成工艺	发明专利	2007.09.04	ZL 2007 1 0076873.0	20 年	自主研发
2	半导体芯片金硅焊料的合金工艺	发明专利	2008.05.09	ZL 2008 1 0066975.9	20 年	自主研发
3	防止 VDMOS 管二次击穿的方法	发明专利	2008.05.27	ZL 2008 1 0067461.5	20 年	自主研发
4	硅片清洗液及其清洗方法	发明专利	2008.05.29	ZL 2008 1 0067515.8	20 年	自主研发
5	显影机	发明专利	2008.08.12	ZL 2008 1 0142415.7	20 年	自主研发
6	双极晶体管的表面钝化结构及其制造方法	发明专利	2008.11.19	ZL 2008 1 0217386.6	20 年	自主研发
7	重掺杂锑硅片的减薄腐蚀方法	发明专利	2008.06.17	ZL 2008 1 0067868.8	20 年	自主研发
8	垂直双扩散金属氧化物半导体场效应管	发明专利	2009.11.10	ZL 2009 1 0110065.0	20 年	自主研发
9	清洗系统	发明专利	2011.03.09	ZL 2011 1 0056074.3	20 年	自主研发
10	VDMOS 器件及其制作方法	发明专利	2010.05.10	ZL 2010 1 0173133.0	20 年	自主研发
11	垂直双扩散金属氧化物半导体场效应器件及其制造方法	发明专利	2011.08.08	ZL 2011 1 0226207.7	20 年	自主研发
12	低电压三极管电子镇流荧光灯	实用新型专利	2006.03.24	ZL 2006 2 0056997.3	10 年	协议受让
13	腐蚀槽鼓泡装置及腐蚀槽	实用新型专利	2008.03.03	ZL 2008 2 0092369.X	10 年	自主研发
14	芯片承片台	实用新型专利	2008.03.04	ZL 2008 2 0092499.3	10 年	自主研发
15	基片装取片台以及包含这种装取片台的基片镀膜设备	实用新型专利	2008.03.14	ZL 2008 2 0092599.6	10 年	自主研发
16	光刻版夹具	实用新型专利	2008.03.14	ZL 2008 2 0092598.1	10 年	自主研发
17	一种加热缸	实用新型专利	2008.03.24	ZL 2008 2 0092762.9	10 年	自主研发
18	无级调压装置	实用新型专利	2008.03.26	ZL 2008 2 0092794.9	10 年	自主研发
19	一种碳化硅舟专用夹具	实用新型专利	2008.03.31	ZL 2008 2 0093118.3	10 年	自主研发

序号	专利名称	专利类别	专利申请日	专利号	专利权有效期	取得方式
20	扩散炉保温帽	实用新型专利	2008.03.31	ZL 2008 2 0093119.8	10 年	自主研发
21	温控腐蚀槽	实用新型专利	2008.04.15	ZL 2008 2 0093343.7	10 年	自主研发
22	匀胶机加湿器	实用新型专利	2008.04.30	ZL 2008 2 0093836.0	10 年	自主研发
23	防热散失挡板以及含有该挡板的扩散炉	实用新型专利	2008.05.07	ZL 2008 2 0093920.2	10 年	自主研发
24	酸槽温度控制系统	实用新型专利	2008.05.30	ZL 2008 2 0094251.0	10 年	自主研发
25	扩散氢气互锁装置	实用新型专利	2008.06.17	ZL 2008 2 0094859.3	10 年	自主研发
26	匀胶机的排液装置	实用新型专利	2008.06.17	ZL 2008 2 0094858.9	10 年	自主研发
27	刻蚀机的装片装置	实用新型专利	2008.07.08	ZL 2008 2 0095331.8	10 年	自主研发
28	夹取高温盖的夹钳	实用新型专利	2008.07.08	ZL 2008 2 0095330.3	10 年	自主研发
29	夹取硅片的石英舟	实用新型专利	2008.07.21	ZL 2008 2 0095691.8	10 年	自主研发
30	一种靶盘	实用新型专利	2008.07.21	ZL 2008 2 0095690.3	10 年	自主研发
31	用于冲水溢水的控制电路	实用新型专利	2008.09.12	ZL 2008 2 0147439.7	10 年	自主研发
32	离子源弧室	实用新型专利	2010.12.16	ZL 2010 2 0662788.X	10 年	自主研发
33	匀胶机的滴胶结构	实用新型专利	2010.12.30	ZL 2010 2 0689485.7	10 年	自主研发
34	扩散炉	实用新型专利	2010.12.31	ZL 2010 2 0694064.3	10 年	自主研发
35	气动水阀	实用新型专利	2010.12.31	ZL 2010 2 0693615.4	10 年	自主研发
36	靶材和内磁极	实用新型专利	2010.12.31	ZL 2010 2 0695866.6	10 年	自主研发
37	匀胶机	实用新型专利	2010.12.31	ZL 2010 2 0693622.4	10 年	自主研发
38	气动排水阀以及溢水装置	实用新型专利	2010.12.31	ZL 2010 2 0693725.0	10 年	自主研发
39	金属氧化物半导体场效应管参数测试盒	实用新型专利	2011.08.29	ZL 2011 2 0319249.0	10 年	自主研发

序号	专利名称	专利类别	专利申请日	专利号	专利权有效期	取得方式
40	悬臂石英炉	实用新型专利	2011.08.30	ZL 2011 2 0322988.5	10 年	自主研发
41	石英舟和夹具	实用新型专利	2011.08.30	ZL 2011 2 0321686.6	10 年	自主研发
42	抛光盘清洗装置	实用新型专利	2011.10.09	ZL 2011 2 0380451.4	10 年	自主研发
43	炉管清洗台	实用新型专利	2011.10.11	ZL 2011 2 0384709.8	10 年	自主研发
44	抛光腐蚀架	实用新型专利	2011.10.12	ZL 2011 2 0387288.4	10 年	自主研发
45	有害气体处理装置	实用新型专利	2011.10.28	ZL 2011 2 0420173.0	10 年	自主研发
46	显影机废液箱报警控制装置及显影控制系统	实用新型专利	2011.11.15	ZL 2011 2 0452488.3	10 年	自主研发
47	清洗控制电路	实用新型专利	2011.12.23	ZL 2011 2 0548567.4	10 年	自主研发
48	TO220 封装引线框架	实用新型专利	2012.12.13	ZL 2012 2 0688396.X	10 年	自主研发
49	防水引线框架	实用新型专利	2012.12.13	ZL 2012 2 0689028.7	10 年	自主研发
50	扩散炉的氢氧输入控制装置	实用新型专利	2012.12.13	ZL 2012 2 0689016.4	10 年	自主研发
51	半导体激光打标机	实用新型专利	2012.12.17	ZL 2012 2 0698614.8	10 年	自主研发
52	晶体管测试装置	实用新型专利	2012.12.10	ZL 2012 2 0676725.9	10 年	自主研发
53	探片器	实用新型专利	2012.12.17	ZL 2012 2 0698632.6	10 年	自主研发
54	晶体管特性测试探针台及测试系统	实用新型专利	2012.12.17	ZL 2012 2 0698612.9	10 年	自主研发
55	扩散悬臂炉及其硅片承载装置	实用新型专利	2012.12.18	ZL 2012 2 0703299.3	10 年	自主研发
56	热电偶保护组件	实用新型专利	2013.1.9	ZL2013 2 0010603.0	10 年	自主研发
57	硅舟	实用新型专利	2013.2.21	ZL2013 2 0080769.X	10 年	自主研发
58	硅舟	实用新型专利	2013.2.22	ZL2013 2 0082841.2	10 年	自主研发
59	扩散炉管	实用新型专利	2013.3.6	ZL2013 2 0102132.6	10 年	自主研发

序号	专利名称	专利类别	专利申请日	专利号	专利权有效期	取得方式
60	氮氧化硅炉气体互锁控制系统	实用新型专利	2013.4.10	ZL2013 2 0177667.X	10 年	自主研发
61	旋转密封装置及使用该旋转密封装置的匀胶机	实用新型专利	2013.4.25	ZL2013 2 0216804.6	10 年	自主研发
62	分片器	实用新型专利	2013.7.11	ZL2013 2 0414065.1	10 年	自主研发

注：上述“低电压三极管电子镇流荧光灯”实用新型专利系发行人于叶文浩处受让取得，双方签署专利转让协议并于 2008 年 6 月 6 日经国家知识产权局备案。

（2）已被受理的专利申请

截至招股说明书签署日，公司拥有 16 项发明专利申请已被受理，具体情况如下：

序号	发明名称	专利类别	申请日	申请号
1	芯片薄膜的生成方法及生成芯片薄膜的载体	发明专利	2010.11.30	201010565252.0
2	单晶片加工方法及单晶片	发明专利	2010.11.25	201010562136.3
3	甩版清洗机及光刻版的清洗方法	发明专利	2011.08.22	201110241637.6
4	匀胶清洗装置及匀胶清洗方法	发明专利	2011.11.24	201110378938.3
5	硅片的抛光方法	发明专利	2011.12.07	201110403658.3
6	热电偶焊接装置及其焊接方法	发明专利	2011.12.27	201110445533.7
7	具结终端扩展结构的功率半导体器件及该结构的制造方法	发明专利	2012.07.20	201210253295.4
8	流质输送装置	发明专利	2012.11.13	201210453950.0
9	晶圆中芯片的测试方法	发明专利	2012.12.10	201210528268.3
10	已做发射区推进的三极管 hfe 的二次增大方法	发明专利	2012.12.17	201210548254.8
11	芯片级测试装置	发明专利	2012.12.17	201210548259.0
12	接触孔的刻蚀方法	发明专利	2012.12.18	201210552382.X
13	半导体器件场氧化层的腐蚀方法	发明专利	2012.12.18	201210552385.3
14	晶体管筛选仪校准装置	发明专利	2012.12.21	201210562978.8

序号	发明名称	专利类别	申请日	申请号
15	具非对准型超级结结构的半导体器件及其制造方法	发明专利	2013.5.14	201310177871.6
16	测试控制装置	发明专利	2013.8.5	201310337254.8

(3) 专利的年费缴纳与法律状态情况

发行人已经足额缴纳以上专利应交的专利年费，不存在未缴或拖欠专利年费的情况。

3、商标

发行人产品所适用的申请注册商标使用商品类别为第 9 类，具体主要包括：大功率晶体管；集成电路；半导体器件；晶体管（电子）等。发行人目前获得受理的第 9 类注册商标申请如下：

序	商标	注册号	商品和服务分类	有效期限	取得方式
1		840619	(第 9 类) 大功率晶体管，集成电路	2006.05.21-2016.05.20	申请
2		840540	(第 9 类) 大功率晶体管，集成电路	2006.05.21-2016.05.20	申请
3		3202501	(第 9 类) 半导体器件，晶体管（电子）等	2013.08.07-2023.08.06	申请
4		1717395	(第 9 类) 半导体器件等	2008.08.01-2018.08.01	申请

由于发行人所经营的业务涉及出口产品至印度，上表中第 4 项商标为发行人于 2008 年 8 月 1 日委托印度律师在印度注册的商标。

六、特许经营权情况

截至招股说明书签署日，发行人未拥有特许经营权。

七、发行人的研发及技术储备情况

（一）公司的核心技术情况

公司拥有的核心技术主要是在多年的生产过程中自主研发和积累而来，具有自主知识产权，同其他单位和个人不存在纠纷。公司拥有的核心技术在国内均处于领先水平，部分技术达到国际先进水平。公司拥有的核心技术具体如下：

1、掺氧多晶硅（SIPOS）、氮氧化硅（SiO_xN_y）钝化技术

半导体表面钝化对半导体器件和集成电路的发展有着极其重要的影响。热生长二氧化硅的发现奠定了平面晶体管和集成电路的基础，但 Si-SiO₂ 结构的器件在靠近硅衬底界面的二氧化硅中有固定正电荷，难于制造高压平面晶体管和集成电路。掺氧半绝缘多晶硅(Semi-Insulating Polycrystalline Silicon, 简写 SIPOS) 表面钝化工艺即是为解决这些问题而研制的。由于 SIPOS 薄膜的电中性和半绝缘性，具备作为一种良好钝化膜的基础条件，可兼用于 P 型和 N 型硅的钝化。SIPOS 弥补了二氧化硅的不足，从根本上改变了二氧化硅的钝化效果。

公司在SIPOS工艺基础上开发了氮氧化硅(SiO_xN_y)钝化工艺，其膜层具有氮化硅和二氧化硅的优良特性，在微电子和光学中得到广泛应用。目前该钝化工艺已形成稳定的工艺规范，成功应用于公司芯片制造生产中，该工艺技术“复合型半导体硅器件钝化膜及钝化生成工艺”已获发明专利授权。

2、温度特性变化控制技术

节能照明产品由于自身的发热量很大，加上内部发热元器件的影响，功率晶体管管壳表面温度达到120-130℃，已接近硅半导体器件本征化的极限温度，在如此高的温度环境下，双极型功率晶体管由于载流子运动速率的增加，各项特性发生巨大变化。为适应市场需要，公司经过多年努力开发出系列具有温度特性变化率低且具有耐高温特点的产品，并得到市场广泛的认可。

3、开关时间（存储时间）控制技术

在节能照明线路中，广泛采用自振荡线路中，其振荡频率与功率晶体管的储存时间有部分关系，上下管储存时间的一致性非常重要，否则将影响线路的功率和对功率晶体管的温升造成不良影响。公司在国内首先提出存储时间控制的方法，并系统地应用于生产实践中，目前存储时间控制技术处于同行业的领先地位。

4、高二次击穿耐量、宽安全工作区（SOA, Safe Operating Area）技术

在节能照明和开关电源工作过程中，经常有异常甚至恶劣的工作情况，这就要求功率晶体管具有高二次击穿耐量、宽安全工作区的特性，以抵抗在异常或余量小的恶劣工作条件，提高晶体管在浪涌时的可靠性。公司根据市场的需求，在材料、横向结构、纵向结构方面进行针对性设计，使产品具有以上特性，并得到市场广泛的认可。

5、终端设计和生产控制技术

功率半导体分立器件的阻断能力是衡量发展水平的重要标志，其依据应用击穿电压的范围可以从25V到6,000V。由于现代半导体工艺采用平面型终端结构，结深较浅，结边缘弯曲使得耐压降低、耐压稳定性差、器件的安全工作区较小，器件易破坏。为提高和稳定器件的耐压特性，除了体内各参数间的配合外，更重要的是对表面终止的PN结进行适当的处理，以改善器件边缘的电场分布，减弱表面电场集中，提高器件的耐压能力和稳定性。目前普遍应用的终端设计结构有场板、场限环、结终端扩展、横向变掺杂等结构。公司产品综合运用了上述技术，达到占用面积小、击穿耐压高的目标。其中公司自主研发的“复合终端结构MOSFET功率晶体管”成功通过深圳市新产品鉴定，获得科技成果证书。

6、LPCVD Si₃N₄ 铝下介质层制造技术

金属离子沾污对半导体加工工艺来说是致命的，但也不可避免，因为这些活跃的离子能在普通的膜层中活动，从而影响功率半导体器件的参数。公司采用LPCVD Si₃N₄ 铝下介质层制造技术，有效隔离金属离子，对器件的可靠性起到很好的保护作用。

7、提高 MOSFET 电流密度技术

通过优化MOSFET产品设计，使电流走向均匀，在不影响导通电阻的情况下降低阱区的面积，因此在相同的面积下能有效地提高沟道的宽长比，从而提高电流密度。

8、提高 MOSFET 抗雪崩击穿能量（EAS）技术

雪崩击穿能量（EAS）标定了器件可以容忍的瞬时过冲电压的安全值，其依赖于雪崩击穿需要消散的能量。公司通过降低导通电阻及降低体二极管的正向导

通压降技术使器件的抗EAS能力明显提升。

9、降低米勒电容技术

MOSFET在源极接地的情况下，测得的漏极和栅极之间的电容为反向传输电容，反向传输电容也常被称为米勒电容。米勒电容是影响开关上升和下降时间的重要参数，同时还影响关断延时时间。公司采用优化工艺，在不影响其它电参数的情况下，有效降低米勒电容，提高了MOSFET产品的性能。

（二）主要产品生产技术所处阶段

公司主要产品处于批量生产阶段。同时，根据市场和客户要求，公司适时推出新产品。

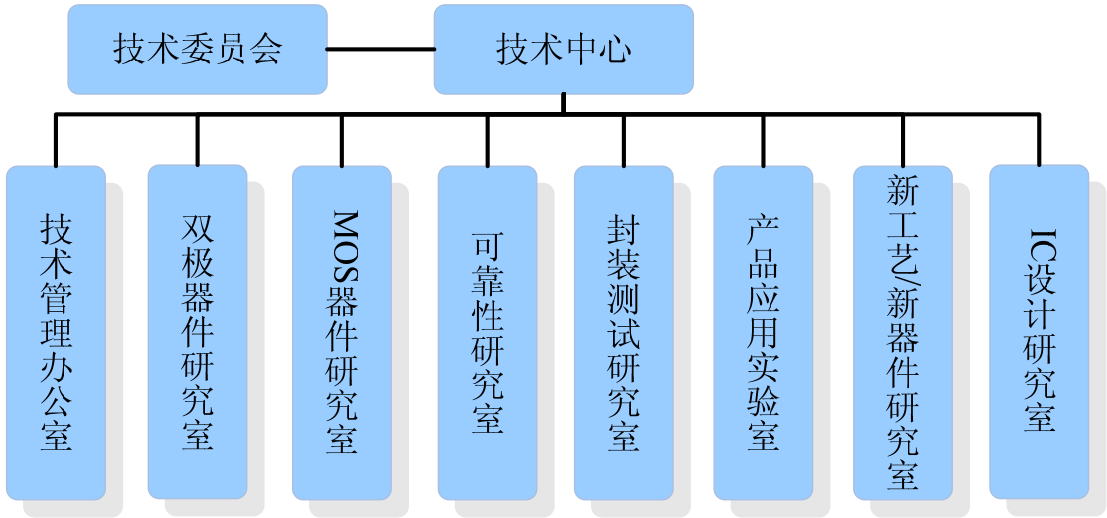
（三）技术和产品储备情况

序号	项 目	所处阶段
1	肖特基 Trench 系列	基础研究
2	窄终端结构 MOSFET 功率晶体管	量产
3	超级结 MOSFET 功率晶体管	基础研究
4	NPT IGBT	试生产
5	RC-IGBT	试生产
6	Trench IGBT	基础研究
7	专用芯片设计流片制造	试生产（2014 年上半年开始投放市场，包括 LED 驱动芯片及模块等）

（四）技术研究开发体系

公司以“科技创新就是公司发展的动力，技术领先就是公司的竞争力”作为公司发展的指导思想，建立了深圳市级技术中心，承担公司新产品、新工艺的研发及改进等工作，自主开发研制适应市场需求的新产品、新技术、新工艺，不断完善产品结构，提升产品质量，适时引进国内外先进技术、工艺，不断拓展新产品应用市场；参与制定公司产品、技术发展的规划，收集行业发展动态及市场信息，为公司制定技术发展战略提供决策依据。公司将技术中心建设成为深圳市半导体业分析、研究、开发的科研平台，逐步将其发展成为功率半导体器件设计中

心。公司研发组织结构图如下：



技术中心下属各研究室职能如下：

序号	名称	主要职责
1	技术委员会	主要负责统筹技术中心的技术发展决策研究，督导技术中心的研究开发工作和方向。
2	技术管理办公室	主要负责统筹技术中心的研究开发工作，进行研发项目实施管理以及公司的技术管理工作。
3	双极器件研究室	承担双极型功率器件领域的研发实验工作，跟踪双极型功率器件领域国际行业发展趋势，进行新材料、新型结构器件以及新型工艺技术的研究开发，研发新型功率半导体分立器件和 BIMOS 混合 IC 器件。
4	MOSFET 器件研究室	承担 MOSFET 功率器件领域的研发实验工作，研究开发 DMOS、IGBT、FRD 和 PIC 等 MOSFET 场控型功率器件，进行超级结器件结构、新型 RC-IGBT、新材料、电力电子功率器件等领域的研究试验和工艺开发工作。
5	可靠性研究室	承担器件可靠性的研究实验工作，研究功率半导体器件高可靠性考核规程和方法，为提升功率半导体器件可靠性提供解决方案，建设发展成为半导体器件可靠性检测、分析机构。
6	封装测试研究室	承担功率半导体器件封装测试的研究实验工作，研究高可靠性大功率半导体器件的封装工艺技术及其开发，进行汽车工业级大功率器件、模块的封装工艺和可靠性研究，进入电力电子大功率器件领域，逐步达到军工级产品规范要求。
7	产品应用试验室	承担功率半导体器件的应用研究实验工作，解决功率半导体器件的应用问题，拓展应用领域，为公司新产品提供应用解决方案，以新产品、新技术应用引导市场。
8	新工艺/新型器件	承担新系列器件、新工艺结构、新型应用材料等领域的

序号	名称	主要职责
	研究室	研发实验工作，跟踪相关领域发展趋势，进行新型结构器件、新工艺的研究、试验和工艺开发工作。
9	IC 设计研究室	承担 CMOS-IC 工艺的研发实验工作，研究开发消费类应用 IC 和专用集成电路（ASIC）以及 PIC 等领域系列品种，跟踪相关领域发展趋势，发展成为 IC 设计中心。

（五）技术创新机制

1、建立创新机制

（1）营造企业文化氛围

公司秉承“爱、诚、勤、进”的“深爱文化”，发扬“至诚至爱、共创未来”的企业精神，倡导“以事业留人，以感情留人”的人性化管理，体现“以人为本”的经营哲学，有效保证技术团队的稳定性，充分发挥员工工作的积极性和创造力。

（2）导入和建立六西格玛（6 σ ）研发工作流程

公司采用六西格玛（6 σ ）精益管理工具，导入和建立六西格玛（6 σ ）重塑研发工作流程，改变以往凭借主观判断和经验为基础分析解决问题的方式，形成客观的、以数据为基础的分析解决问题新模式，提高了研发人员系统地分析问题和解决问题的能力，有效提升了研发工作效率和综合管理水平。

（3）建立技术研发激励机制

公司实施技术等级和行政等级分道并行和“技术骨干经济待遇差异化”管理机制，使技术职称岗位与经济利益挂钩，提高技术研发人员经济收入，极大提高了研发人员工作的积极性。

公司实施产品研发成效与研发责任人经济考核挂钩制度，设立项目开发奖，根据项目完成情况调整相应的项目开发奖发放额度。

公司实施“产品经理”模式，将技术开发人员与业务人员组合集成，形成产品研发与市场开拓的经营小组，市场与技术人员共同承担产品策划、市场研判及技术开发等工作。

公司设立了“深爱公司科技进步奖”奖励办法，充分调动研发、技术人员主观能动性和聪明才智，结合研发、改进产品的成果以及实现经济效益情况，奖励主导研发创新的科技人员，有效地激励了研发人员的积极性和创造性。

2、建立产学研合作机制

公司注重与企业及科研院校的“产学研”合作，充分利用科研院校的设备、人才、技术资源，以提升技术中心产品研发能力和开发水平。

（1）长期聘请研究院所专家教授，指导新产品的研发工作，提高研发质量和缩短开发周期，已取得显著成效；

（2）展开校企合作，与上海复旦大学合作，利用院校研究开发成果，进行产业化合作开发；

（3）与电子科技大学合作，安排技术中心研发人员到该校进行专项培训学习，提高公司半导体分立器件设计水平和仿真系统的分析能力。同时，缩短器件研制、改进周期，同时有效降低了研试、材料等费用，提高研制的成功率，为公司参与市场竞争提供有力的技术保障。

（4）注重人才培养，与电子科技大学合作，开办在职硕士研究生班和大专班，为公司培养硕士研究生和量身定制企业急需的专业技术人才。

（5）注重校企的“产学研”合作，与电子科技大学合作，实施“省部企业科技特派员派驻”工作，进行 MOSFET 类半导体功率器件的设计仿真和工艺设计指导，提高企业的研发和产业化速度。

（6）开展国际间合作研究开发项目，与美国北卡罗来纳州立大学（North Carolina State University）电子和计算机工程系合作，共同展开新型 IGBT 器件研究开发。

（7）与北京大学深圳系统芯片设计（SOC）重点实验室展开科研合作和建立研发平台，建立“先进器件和工艺技术联合开发中心”。

通过展开产学研协作，公司研发水平得到有效提升。公司与有关院校以及各领域专家共同组成了专家顾问组，为公司各项重点科技项目以及一些前瞻性的研究提供技术支撑。

3、技术保密措施

公司建立知识产权保护机制，促进自主创新，通过制定“知识产权管理制度及奖励办法”，鼓励提请专利提案。公司将专利申请作为技术人员职称评定、晋升的重要指标，激励其积极参与创新活动。

公司制定了《保密管理规定》，与核心关键员工签订员工保密协议，内容涵盖销售、采购、生产、研发等内部管理及其他与公司市场竞争力、企业声誉有关

的所有信息，明确员工的信息使用权限及保密义务。针对研发部门，公司研发人员涉及到的技术资料保密事项在使用权限、处置细则等方面作出了明确的规定，同时，对公司使用的电脑设备采取必要的技术手段，以防止非许可使用安装软件以及相关技术资料外泄。

（六）研发费用占营业收入比重

公司坚持创新发展的理念，注重在技术与产品研发上的投入，以确保公司可持续稳定发展。公司技术中心研发经费全部由公司根据研发项目实施计划，每年从经营销售收入中提取投入。报告期内，公司累计投入研发经费 9,408.92 万元，为累计销售收入的 7.56%，高于高新技术企业的平均研发投入水平要求，有效保证了公司研发机构的顺利运作。

报告期内，公司研发费用占营业收入的比例如下：

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
研发费用（万元）	2,688.36	2,810.49	3,910.07
营业收入（万元）	37,467.22	40,634.25	46,396.28
比例（%）	7.18	6.92	8.43

（七）公司正在进行的研发项目

1、DMOS制造工艺技术及产品研发项目

DMOS是功率半导体器件的一个重要分支，是国家大力支持发展的电力电子半导体器件研发、生产的领域，也是公司完善产品结构、拓展产业的主要方向。公司技术中心的MOSFET器件研究室承担公司MOSFET产品设计及工艺研发等工作。

公司依靠自身的技术力量，独立自主进行DMOS器件版图设计、自主开发制造工艺，在公司0.8-0.5 μ m线宽MOSFET件芯片制造线平台上，已形成稳定成熟的DMOS器件制造工艺技术规范。在此平台上，研究试制Id电流1-50A、Vds耐压400-900V的系列10多个型号功率MOSFET器件产品，稳定批量生产DMOS器件。通过产品型号系列化的研究开发以及MOSFET器件制造生产线的建设完成，形成规模化生产能力，实现MOSFET制造产业化。

2、肖特基（大芯片）产品研制项目

半导体二极管在电子制造产业器件中具有举足轻重的份量,随着计算机、通信产品、消费类电子产品的迅猛发展,导致配套电源及驱动电路中的半导体二极管使用量呈现快速增长。肖特基二极管的研制是公司拓展产品结构、提高公司综合竞争力而组织研发的新系列半导体器件。目前,公司技术中心研发人员通过自主创新,摆脱国外企业的专利束缚,在制造中采用金属硅化物和扩散势垒两项工艺技术,技术中心研究探索不同要求下的金属势垒形成工艺条件,根据自身的生产工艺技术条件,设计出工艺参数控制方案,形成成熟的制造方法。

经过研制开发,公司已经形成肖特基二极管制造基础工艺的技术规范,设计、研制开发出MBR1060-3060、MBR10H100-30H100等型号大芯片大功率产品,产品已开始推向市场,在技术性能上处于国内领先水平,生产材料基本达到国产化,可替代同类进口产品。

3、IGBT产品研制项目

为促进电力电子技术和产业的发展,国家大力推进新型电力电子器件产业发展,专项重点支持芯片和器件的设计开发及产业化,支持绝缘栅双极晶体管(IGBT)、快恢复二极管(FRD)等量大面广的新型电力电子芯片和器件的产业化。研究开发IGBT器件,是公司产业规划的重要方向,由技术中心MOSFET研究室研发人员同相关技术人员组成专项研究小组,展开IGBT产品的研制工作。

技术中心研发人员通过进行器件结构分析,评估现有生产线开展新型结构制造的工艺适应性,开始工艺制造设备配备的研究。通过展开IGBT版图结构设计,进行仿真考核、单项工艺试验分析、设计,并与材料厂家合作研究IGBT材料的结构及制备。在完成各个制造流程单项初步工艺的研试基础上,形成工艺初步规范,进行功能样品试验试制、评估。目前,公司正进行20A-50A/600V-1500V IGBT器件设计研制试验。2013年计划形成稳定的20A-50A/600V-1500V IGBT器件制造工艺规范,进行IGBT器件封装技术研发,形成IGBT器件封装能力,批量规模进入市场。同时,公司还将进行100A-200A/1500V-3300V IGBT器件研发,逐步形成制造工艺规范,进行可靠性考核,提供客户使用评估,逐步拓展电力电子应用市场。

经过初步研试,公司研制小组已进行1200V/15-25A器件的设计、样品试制,通过与国内材料厂家合作,根据自身工艺设备条件,自主设计制造工艺,完成试

制流片，并进行样品评估工作，目前相关产品的参数性能已基本达到设计目标要求，也推动了IGBT器件国产硅材料产业的向前拓展。

4、快恢复二极管产品研制项目

快恢复二极管（FRD）器件是IGBT应用紧密关联的器件，是公司产业拓展规划的重要方向，由技术中心MOSFET研究室研发人员同相关芯片制造车间技术人员组成专项研究小组，展开快恢复二极管（FRD）产品研制工作。

技术中心研发人员通过进行器件结构分析，评估现生产线开展新型结构制造的工艺适应性，开始工艺制造设备配备的研究。通过展开快恢复二极管版图结构设计研究，进行仿真考核、单项工艺试验分析、设计，并与材料厂家合作研究快恢复二极管材料的结构及制备。通过快恢复二极管制造工艺设备配备和单项工艺试验，形成工艺初步规范，进行样品试验试制、评估。2013年计划完成20A-50A/1200V-1500V 快恢复二极管器件设计研制试验，进行可靠性考核，形成稳定的快恢复二极管器件制造工艺规范，进行快恢复二极管器件封装技术研发，批量规模进入市场，逐步进入电力电子应用市场。

经过初步研试，研制小组已展开了1200V/20A器件的版图设计研究工作，自主规划设计制造工艺，同国内材料制造厂家协同进行材料制备，目前已进入试制流片阶段。

5、双极型JTE结构产品研发项目

本项目是公司技术中心进行新型结构研究的研发项目。相对于场限环而言，利用JTE结构结终端扩展技术可以用较小的终端面积，获得较高的平面结击穿电压，从而达到提高击穿性能，减少材料成本的目标。目前，公司技术中心的双极型器件研究室承担着双极型JTE结构产品的研发工作，根据自身工艺设备状况，制定研制试验计划，设计版图，自主制定工艺技术路线，实施工艺攻关，形成稳定生产工艺，应用于生产之中，提升公司产品的市场竞争力。公司现已完成JTE结构产品的设计和工艺技术改进、优化工作，展开JTE结构器件试制，形成稳定设计和工艺规范，通过进一步优化JTE结构器件的设计和制造工艺，形成稳定生产能力。

研发小组通过采用新型结构版图设计，结合自身的工艺设备条件，自主设计试验工艺，试制流片，实验评估取得理想的参数性能指标，并达到预期目标。目

前，双极型JTE结构研究已经开始进入批量试制阶段，进一步通过优化设计和工艺技术后，将可以投入生产实践。

（八）与其他单位合作开发情况

公司在坚持自主研发的同时，注重推进产学研结合的技术创新模式。先后与电子科技大学、复旦大学等知名院校及建立人才培训和技术开发合作关系，与国外院校开展国际间合作研究开发项目，以充分实现公司与高校间的技术优势互补。公司与上述主要研究单位合作开发的具体情况如下：

2010年8月，公司与复旦大学专用集成电路与国家重点实验室签订LED驱动电路《合作开发协议》。协议约定双方就“LED驱动电路”的开发进行合作。复旦大学专用集成电路与国家重点实验室主要负责项目关键技术的设计，公司主要负责该项目的工艺流程设计和试制流片。公司享有本合同技术成果的使用权、依法转让权和申报奖励权及专利申请权。协议规定，该项目实施取得利润后，公司将给予复旦大学专用集成电路与国家重点实验室3年8%的利润分成。

2012年2月，公司与美国北卡罗来纳州立大学（North Carolina State University）电子和计算机工程系合作，签订《新型逆导型IGBT研究》技术开发合作协议。协议约定双方就“新型逆导型IGBT研究”项目进行合作开发，公司享有本合同技术成果的使用权、依法转让权和署名权、荣誉权、申报奖励权及专利申请权。该项目技术开发费用由公司合作方垫付，其他研发经费、关键设备购置、产品试制、产品试验及市场开拓等主要由公司负责。

八、发行人核心技术人员情况

截至2013年12月31日，公司共拥有研发人员113人，占公司员工总数的10.59%，其中，具有本科及以上学历的研发人员71人，占研发人员总数的62.83%。核心技术人员具体情况详见本招股说明书“第七节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”。

核心技术人员在公司技术体系中占有重要地位，公司长期以来高度重视研发人才的培养和研发团队的稳定。通过建立一系列的管理机制和措施，保证研发团队人员的稳定性和研发项目的稳定实施。一方面，公司十分注重研发团队人员的

年龄结构配置。在技术中心研发人员中，中青年研发人员占 80%以上，形成较为理想的年龄结构；另一方面，公司积极加强研发人员的素质培养，通过外部行业专家和内部培训讲师相结合的方式，为研发人员提供专业培训和业务指导，提高研发人员理论知识水平和应用创新能力。

公司现技术中心研发人员中高级技术人员占比近 9 成，主要由多年从事半导体研发工作的资深工程师和攻读半导体及相关专业的大学生等构成，通过研发工作的历练，研发人员积累了较为丰富的半导体器件研发、制造、工艺技术经验，形成了一支素质较高且具有较强开发和创新能力的研发团队。

公司努力为核心技术人员搭建良好的事业发展平台，通过签署长期劳动合同，建立技术研发激励机制以及一系列的管理机制和措施，保持核心技术人员队伍的稳定，为公司持续推进技术创新及产品升级打下了良好的基础。同时，公司采用竞聘上岗的方式，择优提拔研究能力突出的研发人员，有利于激发研发人员工作的积极性和创造性，提高研究团队的稳定性。公司对于主要的研发项目采取双承担人的配置机制，建立较为完善的工作流程，以确保项目实施工作按工作流程运作，有效避免因人员变动造成的不利影响。

2013 年 9 月，公司聘请国外半导体专家加入研发团队，旨在改进制造工艺、提高成品合格率。此后，公司 MOSFET 成品管合格率有所提高，销售量也显著增加。今后公司将继续加大与国内外半导体公司、行业专家合作力度，在 MOSFET、IGBT 等新型功率半导体产品领域展开深入合作。

九、发行人境外经营情况

公司无境外经营情况。

十、发行人产品质量控制情况

（一）质量控制部门

公司始终将产品品质确定为企业建设的第一目标，设置质量部全面负责公司质量管理体系的建设与维护。在产品的设计开发、制造与销售过程中，坚持以“全员参与、精细规范、优质高效、客户满意”为质量方针全面控制生产流程、提升产品品质。目前，公司已通过 ISO9001: 2008 以及 ISO14001: 2004 及 QC080000

管理体系认证。

（二）质量控制标准

自设立以来，公司严格按照国内外行业领先标准执行质量管控程序，以满足市场及客户需求。公司主要执行的通用控制标准如下：

序号	名称	标准号
1	《半导体器件—分立器件分规范》	GB/T12560-1999
2	《美国军用标准》	MIL-STD-750D
3	《国际电工委员会标准》	—

（三）产品质量控制体系

为保证公司产品质量符合业内技术标准要求，公司结合自身生产经营特点，制定了高于行业标准的企业内部控制制度，具体包括质量手册、质量体系程序文件、作业指导书及质量记录等一整套详细、完备的文件化质量管理体系。公司主要质量程序文件如下：

序号	名称	编号
1	不合格产品控制程序	YJQEC203
2	产品的监视和测量控制程序	YJQEC205
3	采购控制程序	YJQEC206
4	供方评定控制程序	YJQEC207
5	生产过程控制程序	YJQEC208
6	客户投诉处理程序	YJQEC219
7	产品标识及可追溯性控制程序	YJQEC224
8	产品防护控制程序	YJQEC225
9	生产能力控制程序	YJQEC226
10	产品质量先期策划控制程序	YJQEC230
11	设计控制管理程序	YJQEC231
12	生产管理控制程序	YJQEC244
13	产品审核程序	YJQEC246
14	SPC 管理控制程序	YJQEC249
15	6S 管理控制程序	YJQEC238

（四）质量控制措施

公司始终坚持“全面质量管理”理念，建立了覆盖产品开发、持续改进、供应商管理、原材料检验、生产过程控制、产品出厂检验及售后服务全过程系统化的质量管理体系。

1、产品质量控制标准的制定

产品的质量源于产品的设计及生产、检验等过程的控制。公司产品研发部门在新产品设计之初就依据《产品质量先期策划控制程序》对生产过程及可能产生的失效原因及失效模式进行分析，制定相应的《控制计划》，并依据《新产品立项书》的要求对所使用的物料、成本、仪器设备、生产流程、制程能力、生产效率、研发进度进行验证。根据《控制计划》，公司技术部门制订各工序的作业指导书，品管部制订《进料检验规范》、《过程检验规范》、《出货检验规范》、《产品的试验规范》等相关文件。在产品开发的各个阶段及批量生产前，公司组织相关部门及专家对产品开发各个过程的验证结果及相关文件的标准化进行评审，杜绝产品设计的先天不足。

2、产品质量的过程控制

产品生产过程中的质量控制以预防和消除过程变异为重点，公司将可能产生过程变异的工序列为关键控制点，对其所产生变异及其管理因素进行实时监控。

3、产品质量的检验控制

质量检验是质量管理的基础工作，主要功能是将产品及生产过程中的不良信息及时进行反馈处理。公司产品质量检验过程严格依据《控制计划》和检验标准制订抽样方案，对原物料、半成品、成品、制程质量状况以及产品的可靠性进行评价，评价的项目包括产品电性、外观、尺寸、包装及制程能力。公司对质量评价设置进料检验、制程检验、出货检验、产品稽核及过程稽核等程序。

（五）质量的控制结果

报告期内，公司未出现重大质量纠纷情况，也未因产品质量不符合要求而受到处罚。

第六节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）同业竞争情况

1、公司与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争

公司主营业务为半导体分立器件芯片及成品管的研发、生产及销售。

公司控股股东为赛格集团，其经营范围为：电子产品，家用电器，玩具，电子电信设备及器材、仪器仪表、汽摩配件、电脑及配件、办公自动化设备及用品、电子化工项目的生产研究（生产场地另办执照）；承接各种电子系统工程项；开办电子通信类专业市场；人才培养；房地产开发（在合法取得土地使用权的地块上从事开发）；房地产经纪；货运代理；物流仓储；深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商场、展览业务；网络和信息工程的技术开发及维护；经营进出口业务；赛格注册商标有偿使用许可。投资咨询；投资管理；代理记账；企业登记代理。赛格集团的经营范围与公司的主营业务未有重合，不存在同业竞争的情况。

截至招股说明书签署日，除本公司外，赛格集团直接控制及间接控制的企业基本情况如下：

序号	单位名称	经营范围
1	深圳赛格股份有限公司	国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询。物业租赁；房地产经纪；开办赛格电子专业市场（专业市场执照另行申办）。
2	苏州赛格电子市场管理有限公司	市场设施租赁，市场管理服务；物业管理；销售、维修；电子元器件，电脑及配件，数码产品，办公设备；设计、制作广告，发布公司自有资源广告业务。
3	西安海荣赛格电子市场有限公司	家用电器、计算机软硬件、通信产品、仪器仪表、光机电一体化设备、电子元器件、集成电路的销售；房屋租赁；物业管理；电子信息技术及产品的开发、生产、销售；广告的设计、制作、发布、代理。（以上经营范围凡涉及国家有关专项专营规定的从其规定）
4	深圳赛格南京电子市场管理有限公司	家用电器、安防产品、音响产品、通讯产品、照相器材、物业管理；电子元器件，电脑及配件、办公设备、数码产品、通讯仪表、手机、集成电路销售及维修；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经

序号	单位名称	经营范围
		营的除外)；实业投资。
5	长沙赛格发展有限公司	各类 IT 类产品、数码电子产品、电子元器件、通讯仪表、集成电路、电脑板卡、计算机配件的批发和零售(以上不含专营、专控、专卖商品)；照相器材、影楼用品批发和零售；写字楼出租；电子市场及大楼内的自有房屋物业管理。(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理。)(涉及审批及许可经营的凭批准文件及许可证经营)
6	西安赛格电子市场有限公司	家用电器、计算机软硬件、通信产品、仪器仪表、光机电一体化设备、电子元器件、集成电路的销售；房屋租赁、物业管理；电子信息技术及产品的开发、生产、销售；广告的制作、发布。
7	深圳市赛格实业投资有限公司	投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；从事广告业务；安全技术防范系统设计、施工、维修(凭资格证书经营)。
8	深圳市赛格电子市场管理有限公司	各类 IT 产品、数码产品、电子元器件、通讯、仪表、集成电路、电脑板卡及计算机配件、办公设备的销售、维修。开办、管理龙岗赛格电子市场。
9	深圳市赛格电子商务有限公司	经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)；互联网技术开发、计算机软硬件的技术开发与销售、国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营)；经营进出口业务(法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营)；信息服务业务(仅限互联网信息服务,并按增值电信业务经营许可证粤 B2-20110530 号经营,有效期至 2016 年 9 月 23 日)。
10	深圳市赛格小额贷款有限公司	在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)(凭深府金小[2011]71 号经营)。
11	深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	物业经营与管理；国内商业(不含专营、专控、专卖商品)；投资兴办实业(具体项目另行申报)。
12	深圳橙果商务酒店管理有限公司	酒店管理；信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)；物业服务(取得相关行政主管部门颁发的资质证书后方可经营)；投资兴办实业(由分支机构经营的具体项目另行申报,涉及许可项目凭相应许可证经营)；提供住宿服务(由分支机构经营)。

序号	单位名称	经营范围
13	深圳市赛格地产投资股份有限公司	在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营，承包各种电子系统工程，提供中外电子与机电设备配套服务，生产经销电子系统工程需要的各种材料、电子设备和有关的机电产品。经营物业物业管理、购销建筑材料、装饰材料；经营深府办函[1994]192号文规定的自用物品及设备的进口业务；装修工程；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）、经济信息咨询（不含限制项目）。房地产经纪。
14	惠州市群星房地产开发有限公司	房地产开发与销售，室内装修装饰工程。
15	深圳市赛格物业管理有限公司	物业管理、物业管理顾问；高层楼宇、工业区、居住区房屋和配套设施、设备管理的维修和房屋租赁业务；电梯维修（营业执照另行申办）；购销建筑材料、电子产品、通讯器材（不含专营、专控、专卖商品）；环境卫生及园林绿化的管理服务；保安的管理服务；物业管理范围内的二次供水设施清洗消毒业务；各类机电设备的安装、维修，供配电设备、给排水设备、空调设备、防盗报警系统、电视监控系统、楼宇电子对讲系统、门禁系统、巡更系统、停车场管理系统的工程安装、维修；房地产经济咨询。（以上均不含限制项目）
16	深圳市赛格新城市建设发展有限公司	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；种养殖业；建筑工程安装施工；装饰工程设计与施工；水电、机电设备安装工程。
17	石家庄市赛格广场投资有限公司	以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资，承包各种电子系统工程，电子设备、机电设备安装、维修销售，电子元器件、电子设备、机电产品、建筑材料、装饰材料销售，自营和代理一般商品的进出口业务，装修工程，经济信息咨询，房地产经纪、房地产开发经营、物业服务（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）。
18	深圳赛格高技术投资股份有限公司	投资兴办各类实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口业务；电子信息产品的技术开发、销售，取得合法土地使用权的房地产开发、经营。
19	深圳市赛格物业发展有限公司	物业管理及配套设施的日常管理和综合服务。建筑材料，水暖器材，金属材料，化工产品，家用电器，建筑五金，文体用品的购销（以上各项不含专营、专控、专卖产品）。电梯维修保养（另设分公司经营此项业务）。
20	深圳市赛格康乐企业发展有限公司	自有房屋出租；物业管理；开办、管理深圳市康乐通

序号	单位名称	经营范围
		信器材批发专业市场（分支机构经营）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控产品）；国际货运代理；经济信息咨询；进出口业务。
21	赛格（香港）有限公司	主要经营进出口业务。
22	深圳市赛格广场投资发展有限公司	投资兴办各类实体（具体项目另行申报），开展各类技术咨询，国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）的购销；自有物业管理；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务。
23	GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS, LTD	未实际经营。
24	吴江赛格市场管理有限公司	市场设施租赁；市场管理服务；物业管理；电子信息技术及产品的开发、销售；五金机电、仪器仪表、光电一体化设备、计算机软硬件、通讯产品（不含地面卫星接收设备）、家用电器、数码产品、办公设备、电子元器件、集成电路的销售、维修；广告设计、制作、代理、发布。
25	无锡赛格电子市场有限公司	市场经营管理，市场设施租赁，市场营销策划，经济信息咨询（上述范围涉及专项审批的，经批准后方可经营）。
26	佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司	市场设施租赁及管理服务；物业管理；电子元器件、电脑及配件、办公设备、数码产品、通讯仪表、手机、集成电路销售及维修；设计、制作、代理发布国内各类广告。（经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可经营的项目）
27	南通赛格时代广场发展有限公司	房地产开发经营（凭资质证书经营）；自由房屋租赁、销售；物业管理；电子产品销售。
28	南宁赛格电子市场管理有限公司	市场管理服务、物业管理服务（以上项目涉及资质的凭资质证书经营）；商铺租赁；电子元件、电脑及配件、办公设备、数码产品（除国家专控产品）、通讯产品（除国家专控产品）、仪器仪表的销售及维修；设计、制作、代理、发布国内各类广告。
29	深圳市赛润达科技有限公司	未实际经营。

上述赛格集团直接或间接控制的公司不包括已长期处于停止经营状态或已被吊销营业执照的公司。

截至招股说明书签署日，公司控股股东赛格集团控制的其他企业没有从事与公司相同、相近的业务。

综上，公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

2、公司与控股股东参股的企业不存在同业竞争

深圳赛意法微电子有限公司（以下简称“赛意法”）于1994年12月8日成立，注册资本1亿美元。赛意法注册地址为深圳市福田区桃花路16号，经营范围为生产经营封装和测试半导体器件及封装和测试半导体器件而提供有关的服务，提供集成电路设计服务。赛意法由意法半导体（中国）投资有限公司控股并持有其60%的股权，深圳赛格高技术投资股份有限公司（以下简称“赛格高投”）持有赛意法40%的股权，为赛意法的参股股东。赛格高投为赛格集团的控股子公司。

按照大类划分，半导体行业分为集成电路与分立器件两大分支。赛意法主要从事集成电路的封装和测试，公司主要从事半导体分立器件的研发、生产、销售、封装和测试，公司与赛意法之间从事的业务存在明显差异，不存在同业竞争关系。

另外，公司与赛意法在原材料采购、生产技术、销售市场、产品种类等方面存在较大差异，不存在同业竞争关系。

（1）原材料采购方面的差异

公司拥有独立的采购系统，主要从国内厂商采购原材料，包括宁波华龙电子股份有限公司、杭州海纳半导体有限公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司、江阴市化学试剂厂有限公司等，采购的原材料主要为单晶片、化学试剂等。

赛意法主要为意法半导体加工集成电路产品，主要原材料芯片全部由意法半导体提供，未对外采购芯片。

（2）生产技术方面的差异

公司主要业务为半导体分立器件的芯片设计、芯片制造、芯片的封装与测试，拥有自主的半导体分立器件芯片设计技术，配置有完整的半导体晶圆芯片制造和成品封装生产线。

赛意法的业务主要集中于集成电路制造工艺的后半段，即封装和测试环节，

前段的芯片设计与制造工艺主要由意法半导体完成，赛意法向意法半导体采购芯片后用于加工集成电路。赛意法的生产技术主要为集成电路封装与测试技术，生产设备为封装和测试设备。

（3）销售市场方面的差异

公司绝大部分产品为境内销售，市场区域主要分布在珠三角、长三角及厦门等地区，客户包括镇江强凌、佛山照明、阳光股份、杭州飞达、欧普照明、雷士照明等节能灯厂商，以及宁波明昕、深圳晶导、深圳盛元等半导体封装厂商。公司主要竞争对手为无锡华润华晶、吉林华微电子等国内厂商。

赛意法为意法半导体的控股子公司，也是意法半导体在中国的生产基地。赛意法未设立独立的销售系统，而是根据意法半导体的要求直接发货给指定客户，主要客户包括手机厂商（诺基亚、索尼爱立信、摩托罗拉）、汽车厂商（博世、戴姆勒-克莱斯勒、福特）、硬盘驱动厂商（惠普、西捷、柯达）、通讯厂商（西门子、IBM、三星、LG、Thomson）等，赛意法主要竞争对手均为国际知名的半导体公司，包括英特尔、德州仪器、三星电子、东芝等公司。

（4）产品种类方面的差异

公司主要产品包括双极型功率晶体管、DMOS 器件、IGBT 器件、肖特基二极管、快恢复二极管和 CMOS-IC 等共 10 多个系列，100 余品种，均属于半导体分立器件。公司产品主要应用于绿色节能照明、消费类电子、LED 照明、通讯、开关电源等领域。

赛意法的主要产品为集成电路产品，主要应用于电视机、程控交换机、汽车电子、医疗器械、自动化控制、手机等产品。

综上，公司与赛意法从事于不同的业务，在原材料采购、生产技术、销售市场和产品种类等方面都存在很大差异，因此公司与赛意法不存在同业竞争。

2013 年 2 月 18 日，中国半导体行业协会出具证明，认为公司与赛意法之间不存在同业竞争关系。

3、公司与其他股东不存在同业竞争

公司其他股东为循杰投资和远致投资。循杰投资为深爱公司员工的持股公司，未经营其他具体业务。远致投资的经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报），对投资及其相关的资产提供管理，未与公司的经营业务重合。因此，

公司与其他股东不存在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免发生同业竞争，公司控股股东赛格集团于 2013 年 3 月 6 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、本公司目前并未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未拥有与发行人可能产生同业竞争的企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何利益。

2、在本公司直接或间接持有发行人股份的期间内，除非经发行人事先书面同意，本公司不会，并将促使本公司控制的企业不会直接或间接地从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。

3、如果本公司发现同发行人或其控制的企业经营的业务相同或类似的商业机会，而该商业机会可能直接或间接地与发行人业务相竞争或可能导致竞争，本公司将于获悉该商业机会后立即书面告知发行人，并尽最大努力促使发行人在不差于本公司及下属企业的条件下优先获得此商业机会。

4、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的企业将来从事的业务与发行人之间可能构成同业竞争或同业竞争不可避免时，则本公司将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的企业及时转让或终止上述业务，发行人享有上述业务在同等条件下的优先受让权。

如本公司违反上述承诺，发行人及发行人股东有权根据本承诺书依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人股东因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的收益归发行人所有。”

二、关联方与关联交易

根据《公司法》和《企业会计准则》等相关规定，公司的关联方及关联关系如下：

（一）公司控股股东及其控制的其他企业

公司控股股东为赛格集团，直接持有公司 15,721 万股，占总股本比例为 79%。

赛格集团控制的其他企业情况请参见本招股说明书之“第六节 同业竞争与

关联交易”之“（一）同业竞争情况”之“1、公司与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争”部分。

（二）持有公司 5%以上股权的其他股东

持有公司 5%以上股权的股东有循杰投资和远致投资，具体情况请参见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”部分。

（三）关键管理人员或与其关系密切的家庭成员，及上述人员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

上述关联方具体情况参见本招股说明书“第七节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”。

（四）其他关联方

公司名称	备注
潮州市创佳微电子有限公司	深圳市赛格物业发展有限公司持有其 20%的股权，2013 年 6 月 27 日，创佳微完成注销。

潮州市创佳微电子有限公司，成立于 2002 年 10 月 11 日，系深爱有限与潮州市创佳集团有限公司、香港德铭国际投资公司在潮州市投资设立的中外合作经营企业。创佳微的注册资本是 3,450 万元人民币，深爱有限持股 20%。经营范围是设计、生产、销售各式新型半导体电子器件。

2009 年 1 月 26 日，赛格集团签发《办公会议纪要》，同意深爱有限将所持潮州创佳 20%股权无偿划转给赛格物业。2009 年 4 月 30 日，深爱有限与深圳市赛格物业发展有限公司（以下简称“赛格物业”）签订《股权转让协议书》，协议约定深爱有限将其持有的创佳微 20%股权无偿转让与赛格物业，股权交割日为 2009 年 4 月 30 日，自交割日起，转让股权的权利义务由赛格物业享有和承担。2009 年 4 月 30 日，创佳微根据上述股权转让协议将赛格物业记载于公司股东名册。2009 年 5 月 10 日，创佳微召开董事会，同意上述股权转让。2009 年 6 月 1 日，创佳微的新股东赛格物业与原股东潮州市创佳集团有限公司和香港德铭国际投资公司修订《潮州市创佳微电子有限公司章程》和《潮州市创佳微电子有限公

司合同》。2009年6月2日，赛格物业根据合同和章程向创佳微委派董事和监事。

2011年1月28日，广州潮州经济开发区管理委员会核发《关于“潮州市创佳微电子有限公司”<合同>、<章程>变更等有关问题的批复》，同意深爱有限与赛格物业签订的上述《股权转让协议》的内容，同意深爱有限将其持有的创佳微20%股权无偿转让与赛格物业。2011年2月24日，广东省人民政府签发商外资粤港合作证字【2002】0011号《批准证书》。2011年4月20日，上述股权转让办妥工商变更登记手续。

2012年12月18日，深圳国资局出具《关于潮州创佳微电子有限公司股权变动事宜的复函》（深国资委函【2012】430号），确认上述股权变动不存在国有资产流失问题。

本次股权转让完成后，深爱有限不再持有创佳微的股权。

2012年10月创佳微因经营期限届满申请清算注销，2013年6月27日，潮州市工商局对创佳微注销申请予以核准。

三、关联交易情况

（一）经常性关联交易

1、关联外协交易

（1）关联外协交易规模

报告期内，公司与创佳微发生的关联外协交易情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
创佳微	委托加工	-	-	1,517.97	36.84%	2,362.02	52.89%

由上表数据可看出，公司与创佳微发生的外协交易金额在报告期内逐年减少。自2012年11月起，公司与其已不再发生关联交易，目前创佳微已完成注销程序。

（2）关联外协交易的必要性

外协加工是对公司成品管封装产能的补充，在客户下达的成品管订单型号、

数量较多情况下，公司现有的封装产能无法完全满足客户需要，因此公司向具有一定产能规模和质量保证的封装厂商发出外协生产订单，委托其外协生产部分成品管。关于外协交易的模式参见招股说明书之“第五节业务与技术”之“四、发行人主营业务的具体情况”之“（六）主要产品的原材料和能源及其供应情况”。

通过多年的积累，公司与多家封装厂商建立了稳定的合作关系，公司外协厂商包括创佳微、厦门尚明达、佛山市蓝箭电子股份有限公司、西安高科卫光电子有限公司等，由于不同封装厂商拥有的机器设备不尽相同，工艺技术方面也各有所长，因此具体某个型号的成品管外协生产通常固定由 1-2 家企业外协生产。

创佳微能够生产 BUL 系列、MJE 系列大功率晶体管（用于绿色照明设备及开关电源等领域）、场效应可控硅等半导体分立器件，业务主要集中于封装、测试环节，不具有芯片设计制造的能力。公司与创佳微经过较长时间的合作，已经建立起良好的互信关系，创佳微为公司外协生产的成品管质量稳定、供货及时。公司自有品牌在下游客户群里具有较大的影响力，因此外协生产的产品均标记公司的品牌。创佳微为公司外协是公司成品管封装产能的重要补充，对于创佳微自身而言，公司下发的外协生产订单也有利于其充分发挥机器设备的产能利用率，双方能够实现互利共赢。

（3）关联外协交易价格公允性

公司外协加工的经济实质为委托加工，外协厂商实际收取的是加工费。除芯片由公司提供以外，其他的原辅材料、人工费及各项费用均由外协厂商承担，加工费包括了上述费用以及外协厂商的利润。由于成品管的型号、封装形式不同，所需的原材料以及工艺要求也不相同，收取的加工费也存在较大差异，但对于同种型号、同种封装形式的成品管，不同外协厂商收取的加工费差异较小。

创佳微通常为公司生产的成品管型号为 MJE13005-220、BUL6822TO-92、MJE13003TO-220、MJE13001TO-92 等，非关联外协厂商厦门尚明达为公司封装的成品管型号与创佳微最为相似，两家公司具有较强的可比性，具体对比分析如下：

单位：元/只

2012 年度			
成品管型号	创佳微加工费	厦门尚明达加工费	差异率
MJE13001TO-92	0.039	0.037	4.71%

MJE13005TO-220	0.233	0.247	-5.39%
BUL6822TO-92	0.043	0.047	-9.90%
MJE13003TO-220	0.256	0.251	1.97%
2011 年度			
成品管型号	创佳微加工费	厦门尚明达加工费	差异率
MJE13005TO-220	0.241	0.251	-3.67%
MJE13001TO-92	0.040	0.040	-0.62%
MJE13003TO-220	0.242	0.241	0.22%
BUL6822TO-92	0.043	0.042	4.31%
BUL6802TO-126	0.125	0.122	2.84%

根据上表比较结果，在成品管型号相同的情况下，公司向创佳微收取的加工费与向非关联方厦门尚明达收取的加工费差异率全部在 10%以内，差异较小，价格公允。

2、关联销售

创佳微除为公司外协生产成品管以外，还自主封装并对外销售成品管，由于不具备芯片设计制造能力，其生产所需的芯片主要向公司采购。

报告期内，公司向创佳微销售自用芯片的情况如下：

单位：万元

交易内容	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
自用芯片销售金额	-	-	240.28	0.59%	609.69	1.31%

注：占比指自用芯片销售金额占营业收入的比例。

根据上表数据，公司向创佳微销售的自用芯片金额及占营业收入比例较小，对公司经营业绩不构成重大影响。

公司向创佳微销售其自用芯片的价格采用市场定价，根据市场需求的变化调整售价。由于芯片种类繁多，下表选取每年公司向创佳微销售金额排名前五的芯片型号，将该型号的芯片单价与对应非关联客户的销售单价进行对比，具体情况如下：

单位：元/粒

2012 年度					
芯片型号	创佳微	非关联方最高价	非关联方最低价	非关联方平均价	与非关联方均价差异

BUL4083(Au)	0.021	0.022	0.019	0.022	-1.74%
BUL4160DA	0.078	0.082	0.067	0.074	4.56%
BUL4252	0.214	0.234	0.190	0.199	7.63%
BUL4260D	0.219	0.216	0.175	0.188	16.39%
BUL4142A	0.065	0.071	0.057	0.064	2.46%
2011 年度					
芯片型号	创佳微	非关联方 最高价	非关联方 最低价	非关联方 均价	与非关联方 均价差异
BUL4142A	0.066	0.073	0.064	0.069	-3.47%
BUL4160DA	0.089	0.091	0.078	0.080	10.78%
BUL4180	0.110	0.131	0.074	0.090	22.25%
BUL4252	0.238	0.251	0.212	0.220	8.53%
BUL4260D	0.249	0.246	0.199	0.219	13.60%

根据上表对比结果,报告期内公司向创佳微销售其自用芯片单价大多在向非关联方销售的最高价与最低价之间,与向非关联方销售均价比较接近。2011 年、2012 年部分型号的芯片与均价差异超过 10%的原因:公司对大客户销售价格更加优惠,创佳微自用芯片采购金额较小,其采购的芯片价格折扣较少,上述价格差异较大的芯片型号主要因为大客户采购较多,使该型号的芯片均价偏低,剔除大客户采购价格的影响后,公司向创佳微销售自用芯片单价与向非关联方销售均价的差异均在 10%以内。

综上分析,公司向创佳微销售的自用芯片价格公允。

3、公司向关联方租赁房屋

2012 年以前,公司向关联方深圳市赛格工程实业股份有限公司以市场价租赁位于深圳市福田区八卦三路光纤小区综合楼首层 A 号的房屋,总面积为 211 平方米,每年租赁费用为 139,260 元,该房屋被用作光纤小区一号厂房的配套食堂。由于光纤小区一号厂房的机器设备已全部搬迁至深圳龙岗,自 2012 年起,公司停止了对该食堂的租赁。

报告期内,公司向关联方租赁房屋的情况如下:

单位: 元

关联方名称	交易内容	2013 年度	2012 年度	2011 年度
深圳市赛格工程实业股份有限公司	房屋租赁	-	-	139,260.00

注：深圳市赛格工程实业股份有限公司已更名为深圳市赛格地产投资股份有限公司。

房屋租赁价格均参照当地市场价执行，租赁价格公允。

4、关联方为公司提供物业管理服务

深圳市赛格物业管理有限公司一直担任公司在深圳市福田区八卦三路光纤小区一号厂房等物业的管理公司，公司每年向深圳市赛格物业管理有限公司支付物业管理费和水电费。报告期内，该关联交易情况如下：

单位：元

关联方名称	交易内容	2013 年度	2012 年度	2011 年度
深圳市赛格物业管理有限公司	物业管理及水电费	-	82,148.60	282,845.47

随着公司八卦岭生产基地陆续搬迁到龙岗新厂区后，公司将空出的厂房对外租赁，并由租赁方承担物业管理费及水电费，因此报告期内深圳市赛格物业管理有限公司向公司收取的物业管理费及水电费逐年减少。物业费与水电费均按照当地市场价收取，价格公允。

（二）偶发性关联交易

报告期内，公司无偶发性关联交易发生。

（三）关联方往来款项

1、关联方往来款项余额

报告期内各期末，公司与关联方往来款项余额情况如下：

单位：元

项目名称	关联方	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
应付账款	潮州市创佳微电子有限公司	-	-	3,502,839.78

注：由于创佳微合资期限到期拟注销，2012 年 9 月份以后，公司与创佳微交易逐渐减少，至 2012 年年末已无往来款项余额。

2、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	借款时间	还款时间
拆入：			
深圳市赛格集团有限公司①	35,000,000.00	2009 年	2011 年

深圳市赛格集团有限公司②	19,000,000.00	2003 年	2011 年
--------------	---------------	--------	--------

①此项为 2009 年公司向赛格集团借款 3,500 万元，用于补充公司流动资金，已于 2011 年全部偿还；

②此项为最初公司向深圳市经济贸易局借款 1,100 万元，向深圳市投资管理公司借款 800 万元，后因深圳市经济贸易局、深圳市投资管理公司决定将前述借款转为对赛格集团的国家资本金，因而转为公司向赛格集团的借款 1,900 万元。公司已于 2011 年全部偿还。

（四）关联交易对公司财务状况、经营成果的影响

公司具有独立的采购、生产及销售系统，不存在对关联方产生依赖的情形，且上述关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则，交易价格公允、交易行为合理，无利用关联交易损害本公司及股东的情况。

上述关联交易金额较小且逐渐减少，不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。

四、规范关联交易决策权力与程序的安排

公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》等规章制度中对关联交易的决策权力与程序作出了严格的规定，具体如下：

（一）《公司章程》对关联交易决策权力与程序的规定

公司现行的《公司章程》中对关联交易决策权力与程序的规定内容如下：

第三十一条股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：

.....（十八）审议公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易；

第六十六条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议关联交易事项的具体表决程序如下：

（一）关联股东应当在股东大会召开前主动向召集人说明其关联关系。股东大会召集人如认为拟提交股东大会审议的事项构成关联交易，但该关联股东未主动说明，应以书面形式事先通知该关联股东。

（二）股东大会召开时，关联股东应主动提出回避申请，其他股东也有权

向召集人要求该股东回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联关系，并有权决定该股东是否回避。

（三）关联股东可以参加股东大会对关联交易的审议，并可就该关联交易是否合法、公平及实施该关联交易的原因等向股东大会进行解释和说明，但关联股东无权参与股东大会对该关联交易的表决。

（四）关联股东回避表决后，由出席股东大会的非关联股东按照本章程的规定对该关联交易事项进行表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同等法律效力。

（五）股东大会决议应注明关联股东回避表决的情况。

（六）关联股东未就关联事项回避表决，股东大会有权撤销有关关联事项的相关决议。

第八十四条.....对关联关系事项的表决，该关联交易涉及的董事应当回避并放弃表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系的董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，且该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

第九十五条董事会行使下列职权：.....

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；.....

第九十七条.....股东大会对董事会的授权如下：.....

（三）决定公司与关联人发生的交易金额在 1,000 万元人民币以下，且不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易事项。

前述股东大会对董事会的授权事项应当经董事会 2/3 以上董事通过。

（二）《关联交易管理制度》对关联交易决策权力与程序的规定

1、关联交易的基本原则

(1) 关联交易活动应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益；

(2) 公司在履行有关关联交易决策时符合《公司法》等规定的关联人回避表决原则；

(3) 公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准；

(4) 书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体；

(5) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司利益，必要时应当聘请专业评估机构或独立财务顾问；

(6) 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款；

(7) 公司对于关联交易应按相关规定切实履行信息披露义务；

(8) 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、关联交易的审批权限

第十条符合下列标准的关联交易事项应当由股东大会审议批准：

(一) 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；

(二) 属于本制度第三条（十一）至（十四）项规定的与日常经营相关的关联交易，且订立的协议没有具体交易金额的；

(三) 法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定应由股东大会审议的其他关联交易事项。

审议涉及前款第（一）项关联交易事项的，应当聘请具有证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行评估或审计，按照《上市规则》规定经独立董事认可及董事会批准后，提交股东大会审议。

审议前款第（二）项所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。

第十一条符合下列标准的关联交易事项由董事会审议批准：

- （一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易事项；
- （二）公司与关联法人发生的交易总额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项；
- （三）法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定可由董事会审议的其他关联交易事项。

第十二条符合下列标准的关联交易事项由总经理批准：

- （一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下(不含30万元)的关联交易事项；
- （二）公司与关联法人发生的交易总额在300万元以下（不含300万元），或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下（不含0.5%）的关联交易事项。

第十三条公司为关联人提供担保的，无论数额大小，均应当在董事会会议审议通过后，提交股东大会审议。

3、关联交易的决策权力与程序的规定

第十七条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东在股东大会表决关联交易事项时，应当主动回避，并放弃表决权；如关联股东未主动回避表决的，会议主持人及见证律师应当要求其回避。如会议主持人需要回避，到会董事或股东及见证律师应当要求会议主持人及关联股东回避并推选临时会议主持人（临时会议主持人应当经到会非关联股东所持表决权半数以上通过）。

第十九条董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

第二十条公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，应及时通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具专门报告，作为其判断的依据。

（三）《独立董事工作制度》对关联交易决策权力与程序的规定

第十五条为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权：

（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；……

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。经全体独立董事的二分之一以上同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

第十六条独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：……

（四）关联交易（含公司向股东、实际控制人及其关联企业提供资金）；……

五、独立董事发表的相关意见

公司报告期内发生的上述关联交易已经由发行人于 2014 年 3 月 20 日召开的 2013 年年度股东大会予以确认，关联股东在审议该议案时采取了回避表决的措施。独立董事已于 2014 年 2 月 28 日对上述关联交易的公允性出具独立意见，认为：公司与关联方发生的上述关联交易内容真实，协议条款公平、合理、有效，关联交易定价按照市场价格确定，定价方式公允、不存在损害公司及股东利益的情形；上述关联交易履行了必要的审批程序，未违反公司章程及其他有关规定，表决程序合法有效；上述关联交易有利于公司业务的发展。

六、规范和减少关联交易的措施

创佳微由于合资合同约定的经营期限到期，经各方表决一致同意不再延长经营期限，并对创佳微进行注销清算，创佳微目前正在履行注销程序，公司不再与其发生关联交易。

报告期内，公司关联交易的金额及比例得到较大幅度的降低，今后将尽量避免发生不必要的关联交易。未来若出现难以避免的关联交易，公司将严格按照《公

公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等相关制度要求履行必要的程序，遵循公平、公正、公开以及等价有偿的商业原则，切实履行信息披露的有关规定，不损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

第七节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历

（一）董事会成员

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。各董事简历如下：

孙盛典先生，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，高级经济师、高级工程师。历任中国机械部干部司企事业领导干部管理处科长，物资部成套设备管理局人事处处长，国内贸易部行业管理司综合处处长，中国电子信息产业集团（CEC）部门经理，深圳中康玻璃公司副总经理，深圳市赛格日立彩色显示器件有限公司副总经理、总经理和董事长，深圳市华星光电技术有限公司董事，创维数码控股有限公司独立董事，赛格集团副总经理、董事和总经理。现任赛格集团董事长、党委书记，兼任深圳华控赛格股份有限公司副董事长，深圳赛意法微电子有限公司副董事长、中国电子商会副会长、广东电子商会副会长、深圳市电子商会副会长、深圳市电子行业协会会长。2010 年 12 月起任公司董事长。

寻培珏先生，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，高级工程师。历任深圳市德达磁技术公司开发部经理，深圳资源磁电有限公司总经理，赛格集团副总经理，公司总经理助理、副总经理、总经理。2010 年 12 月起任公司副董事长、总经理。

王嘉全先生，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任浙江绍兴 871 厂前工序车间副部长，公司动力设备部部长、封装部部长、前工序生产部部长、总工程师、副总经理。现任公司董事、副总经理，循杰投资董事。2010 年 12 月起任公司董事、副总经理。

唐崇银先生，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。历任武汉大学政治与行政学院教师。现任深圳市赛格集团有限公司资产部部长，深圳市大明电子有限公司董事长，深圳赛格高技术投资股份有限公司董事，深圳赛格股份有限公司监事。2010 年 12 月起任公司董事。

严冬霞女士，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师。历任赛格集团财务部出纳、会计、会计主管和副部长。现任赛格集团财务部副部长，石家庄赛格广场投资有限公司董事，深圳市赛格新城市建设发展有限公司董事，深圳市赛格小额贷款有限公司董事，深圳市赛格广场投资发展有限公司董事，深圳市赛润达科技有限公司监事。2013年12月起任公司董事。

何欣纲先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中级经济师。历任华为技术有限公司市场部高级经理，深圳市机场（集团）有限公司投资发展部主管。现任远致投资投资部部长。2010年12月起任公司董事。

张波先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教授。历任电子科技大学教师。现任电子科技大学微电子与固体电子学院教授、博士生导师，兼任江苏东光微电子股份有限公司独立董事、四川和芯微电子股份有限公司独立董事，深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事，中国半导体行业协会理事。2012年3月起任公司独立董事。

杨小强先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，教授。历任中山大学法学院助教、讲师、副教授、教授。现任中山大学法学院教授，兼任广州普邦园林股份有限公司独立董事、珠海润都制药股份有限公司独立董事。2012年3月起任公司独立董事。

李斌先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师。历任四川省陇县财政局科员，四川南充市资产评估事务总所副所长，深圳南方民和会计师事务所总审计师、高级经理，国海证券有限公司投资银行总部业务董事，深圳信益会计师事务所有限公司主任会计师。现任深圳市汇金财务有限公司总经理，深圳市劲创生物技术有限公司董事，深圳市纳芯威科技有限公司董事，雅致集成房屋股份有限公司独立董事。2012年3月起任公司独立董事。

（二）监事会成员

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1人。各监事简历如下：

张光柳先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级

会计师。历任深圳天虹商场有限公司振华商场副经理，深圳华盛实业股份有限公司董事、财务总监，深圳市医药总公司董事、财务总监，深圳市建材集团公司董事、财务总监。现任赛格集团副总经理、董事会秘书，深圳市赛格康乐企业发展有限公司董事长，深圳赛格股份有限公司董事。2010年12月起任公司监事会主席。

肖春林先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。历任深圳市赛格集团有限公司办公室副主任、审计监察部副部长、部长。现任深圳市赛格集团有限公司战略管理部部长，深圳市赛格广场投资发展有限公司董事，深圳赛格高技术投资股份有限公司监事，深圳市赛格电子商务有限公司董事。2010年12月起任公司监事。

厉策先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。历任公司制造一部部长助理、部长。现任公司副总工程师、制造三部部长。2011年7月起任公司职工监事。

（三）高级管理人员

截至招股说明书签署日，公司共有高级管理人员7名，其基本情况如下：

寻培珏先生，现任公司总经理。简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“（一）董事会成员”。

王嘉全先生，现任公司副总经理。简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“（一）董事会成员”。

张帅恒先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工程师。历任陕西彩色显像管总厂锥车间副主任，深圳市赛格三星股份有限公司车间主任、制造部部长、保障部部长、常务副总经理和总经理。2013年7月起任公司副总经理。

王军立先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工程师。历任公司设备动力部部长助理、副部长和部长，计划供应部部长、总经理助理。2010年12月起任公司董事会秘书，2011年7月起任公司副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书，深圳市循杰投资股份有限公司董事。

邓文斌先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，工

程师。历任公司技术开发部部长、总经理助理。2011年7月起任公司副总经理，深圳市循杰投资股份有限公司董事长。

汪德文先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工程师。历任公司质量部部长、技术中心主任。2011年7月起任公司总工程师、公司技术中心主任，深圳市循杰投资股份有限公司监事。

位培川先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，会计师。历任公司财务部会计人员、部长助理、财务部副部长、审计部负责人。2013年7月起任公司财务负责人。

（四）核心技术人员

王嘉全先生，简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“（一）董事会成员”。

汪德文先生，简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“（三）高级管理人员”。

厉策先生，简历参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“（二）监事会成员”。

（五）董事、监事的提名和选聘情况

1、董事的提名和选聘情况

2010年12月22日，公司召开创立大会暨2010年第一次股东大会，经赛格集团提名，选举孙盛典、叶军、李祥天、唐崇银、朱龙清为公司第一届董事会成员；经循杰投资提名，选举寻培珏、王嘉全为公司第一届董事会成员；经远致投资提名，选举何欣纲为公司第一届董事会成员，上述人员与职工代表董事王军立共同组成第一届董事会。

同日，公司召开第一届董事会第一次会议，经赛格集团提名，选举孙盛典为第一届董事会董事长；经循杰投资提名，选举寻培珏为副董事长，聘任王军立为董事会秘书。

2012年3月15日，公司召开2012年度第一次临时股东大会，经公司董事会提名，选举张波、杨小强、李斌为公司独立董事，原公司董事李祥天、朱龙清、

王军立不再担任公司董事职务。

2013年12月26日，公司召开2013年第三次临时股东大会，经第一届第十次董事会提名，选举孙盛典、寻培珏、王嘉全、唐崇银、严冬霞、何欣纲、张波、杨小强和李斌为第二届董事会董事，其中张波、杨小强和李斌为独立董事。

2、监事的提名和选聘情况

2010年12月22日，公司召开创立大会暨2010年第一次股东大会，经赛格集团提名，选举张光柳、肖春林为第一届监事会成员，与职工代表监事邓文斌共同组成第一届监事会。

同日，公司召开第一届监事会第一次会议，经赛格集团推荐，选举张光柳为监事会主席。

2011年7月28日，公司召开2011年职工代表大会，选举厉策担任公司职工监事，邓文斌不再担任职工监事职务。

2013年12月20日，公司召开职工代表大会，选举厉策担任公司职工监事。

2013年12月26日，公司召开2013年第三次临时股东大会，经第一届第六次监事会提名，选举张光柳和肖春林为第二届监事会监事。

二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况

（一）直接持有公司股份情况

公司不存在董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份的情况。

（二）间接持有公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属通过循杰投资间接持有公司股份的情况如下：

姓名	与发行人的关系	占循杰投资股权比例	近三年增减变动情况	质押冻结
寻培珏	副董事长、总经理	25.71%	2010年5月6日，出资257.10万元	无
王嘉全	董事、副总经理	3.81%	2010年5月6日，出资38.10万元	无

王军立	副总经理、董事会秘书	7.62%	2010年5月6日，出资76.20万元	无
邓文斌	副总经理	1.91%	2010年5月6日，出资19.10万元	无
汪德文	总工程师	2.86%	2010年5月6日，出资28.60万元	无
厉策	监事	1.71%	2010年5月6日，出资17.10万元	无
位培川	财务负责人	0.57%	2010年5月6日，出资5.70万元	无

2010年5月6日，循杰投资成立。截至本招股说明书签署日，上述人员间接持股比例未发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况

截至招股说明书签署日，除通过循杰投资间接持有发行人股权外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的其他对外投资情况如下：

姓名	被投资公司	出资额	持股比例	与发行人关联关系	备注
李斌	深圳市汇金财务有限公司	8.00 万元	80%	无关联关系	
	深圳劲创生物技术有限公司	9.37 万元	7.50%	无关联关系	
	深圳市纳芯威科技有限公司	20.00 万元	10.00%	无关联关系	

公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在与发行人有利益冲突的对外投资。

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

2013 年度，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬（所得税前）情况如下：

姓名	职务	2013 年薪酬（元）	备注
孙盛典	董事长	-	未在公司领薪
寻培珏	副董事长、总经理	628,672	-
王嘉全	董事、副总经理	523,432	-
唐崇银	董事	-	未在公司领薪
严冬霞	董事	-	未在公司领薪

何欣纲	董事	-	未在公司领薪
李斌	独立董事	50,000	
杨小强	独立董事	50,000	
张波	独立董事	50,000	
张光柳	监事会主席	-	未在公司领薪
肖春林	监事	-	未在公司领薪
厉策	监事	409,049	-
张帅恒	副总经理	204,260	2013年7月12日开始任职
王军立	副总经理、董事会秘书	469,228	-
邓文斌	副总经理	469,145	-
汪德文	总工程师	469,231	-
位培川	财务负责人	229,172	2013年7月12日开始任财务负责人

2013年12月26日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于深圳深爱半导体股份有限公司发放独立董事津贴的议案》，确定独立董事的津贴为每年5万元（含税）。2014年3月20日，公司2013年年度股东大会审议通过《关于董事、监事和高级管理人员2013年薪酬的议案》。

公司董事长孙盛典、董事唐崇银和严冬霞、监事会主席张光柳、监事肖春林在控股股东赛格集团领取薪酬，董事何欣纲在股东单位远致投资领取薪酬。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在从其他关联企业领取收入的情况。

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

姓名	职务	其他兼职情况		兼职公司与发行人的关联关系
		任职公司	所任职务	
孙盛典	董事长	深圳市赛格集团有限公司	董事长 党委书记	控股股东
		深圳华控赛格股份有限公司	副董事长	控股股东的控股子公司
		深圳赛意法微电子有限公司	副董事长	控股股东的控股子公司的参股公司（参股40%）

		其他兼职情况		
		中国电子商会	副会长	无关联关系
		广东电子商会	副会长	无关联关系
		深圳市电子商会	副会长	无关联关系
		深圳市电子行业协会	会长	无关联关系
王嘉全	董事、副总经理	深圳市循杰投资股份有限公司	董事	股东
唐崇银	董事	深圳市赛格集团有限公司	资产部部长	控股股东
		深圳市大明电子有限公司	董事长	控股股东的参股子公司
		深圳赛格高技术投资股份有限公司	董事	控股股东的控股子公司
		深圳赛格股份有限公司	监事	控股股东的控股子公司
严冬霞	董事	深圳市赛格集团有限公司	财务部副部长	控股股东
		石家庄赛格广场投资有限公司	董事	控股股东的控股子公司
		深圳市赛格新城市建设发展有限公司	董事	控股股东的控股子公司
		深圳市赛格小额贷款有限公司	董事	控股股东的控股子公司
		深圳市赛格广场投资发展有限公司	董事	控股股东的控股子公司
		深圳市赛润达科技有限公司	监事	控股股东的控股子公司
何欣纲	董事	深圳市远致投资有限公司	投资部部长	股东
张波	独立董事	电子科技大学微电子与固体电子学院	教授、博士生导师	无关联关系
		江苏东光微电子股份有限公司	独立董事	无关联关系
		四川和芯微电子股份有限公司	独立董事	无关联关系
		深圳市汇顶科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
		中国半导体行业协会	理事	无关联关系
杨小强	独立董事	中山大学法学院	教授	无关联关系
		广州普邦园林股份有限公司	独立董事	无关联关系
		珠海润都制药股份有限公司	独立董事	无关联关系
李斌	独立董事	深圳市汇金财务有限公司	总经理、执行董事	无关联关系
		雅致集成房屋股份有限公司	独立董事	无关联关系
		深圳市劲创生物技术有限公司	董事	无关联关系

		其他兼职情况		
		深圳市纳芯威科技有限公司	董事	无关联关系
张光柳	监事会主席	深圳市赛格集团有限公司	副总经理、 董事会秘书	控股股东
		深圳市赛格康乐企业发展有限公司	董事长	控股股东的控股 子公司
		深圳赛格股份有限公司	董事	控股股东的控股 子公司
肖春林	监事	深圳市赛格集团有限公司	战略管理部 部长	控股股东
		深圳市赛格广场投资发展有限公司	董事	控股股东的控股 子公司
		深圳赛格高技术投资股份有限公司	监事	控股股东的控股 子公司
		深圳市赛格电子商务有限公司	董事	控股股东的控股 子公司
厉策	监事	深圳市循杰投资股份有限公司	监事	股东
王军立	副总经理、 董事会秘书	深圳市循杰投资股份有限公司	董事	股东
邓文斌	副总经理	深圳市循杰投资股份有限公司	董事长	股东
汪德文	总工程师	深圳市循杰投资股份有限公司	监事	股东

除上表列示的兼职情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未在其他单位兼职。

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在近亲属关系。

七、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及其履行情况

除董事孙盛典、唐崇银、何欣纲、严冬霞及三位独立董事、监事张光柳和肖春林外，其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均与公司签订了《劳动合同》和《员工保密合同》，对上述人员的工作时间与条件，劳动报酬和保险、福利，劳动纪律等权利义务做出了详细规定。

截至招股说明书签署日，上述《劳动合同》和《员工保密合同》得到了切实履行。

八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员做出的重要承诺

通过循杰投资持有公司股份的高级管理人员寻培珏、王嘉全、王军立、邓文斌、汪德文和位培川承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所通过循杰投资间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而改变或无效。上述锁定期届满后，在其任职期间，每年转让间接持有的发行人股份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后六个月内，不转让间接持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内转让所间接持有的公司股份数量占其所间接持有公司股份总数的比例不得超过 50%。因违反承诺所得收益将归发行人所有。

通过循杰投资持有公司股份的监事厉策承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所通过循杰投资间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期届满后，在其任职期间，每年转让间接持有的发行人股份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后六个月内，不转让间接持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内转让所间接持有的公司股份数量占其所间接持有公司股份总数的比例不得超过 50%。

在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）和高级管理人员寻培珏、王嘉全、张帅恒、王军立、邓文斌、汪德文和位培川承诺：（1）已了解并知悉《关于稳定深圳深爱半导体股份有限公司股价的预案》的全部内容；（2）愿意遵守和执行《关于稳定深圳深爱半导体股份有限公司股价的预案》的内容并承担相应的法律责任。该预案的具体内容参见“重大事项提示”之“一、发行人及相关责任主体的承诺事项”之“（二）上市后三年内稳定公司股价的预案”。

本公司的董事、监事和高级管理人员承诺，若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司的全体董

事、监事和高级管理人员将依法赔偿投资者损失。

九、董事、监事、高级管理人员的任职资格

公司董事、监事由公司股东大会和职工代表大会依法定程序选举产生；公司高级管理人员由董事会聘任并履行了相关的程序；上述人员的任职资格和选聘不存在违反法律法规和公司章程规定的情形。

十、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

（一）董事变动情况

报告期内，公司董事变动情况如下：

序号	变动时间	原董事	变更后董事
1	2012年3月15日	孙盛典、叶军、李祥天、唐崇银、朱龙清、寻培珏、王嘉全、何欣纲、王军立	孙盛典、叶军、唐崇银、寻培珏、王嘉全、何欣纲、张波、杨小强、李斌
2	2013年12月26日	孙盛典、叶军、唐崇银、寻培珏、王嘉全、何欣纲、张波、杨小强、李斌	孙盛典、唐崇银、严冬霞、寻培珏、王嘉全、何欣纲、张波、杨小强、李斌

2012年3月15日，公司召开2012年第一次临时股东大会，经公司董事会提名，选举张波、杨小强、李斌为公司独立董事，李祥天、朱龙清、王军立不再担任公司董事。

2013年12月26日，公司召开2013年第三次临时股东大会，经第一届第十次董事会提名，选举孙盛典、寻培珏、王嘉全、唐崇银、严冬霞、何欣纲、张波、杨小强和李斌为第二届董事会董事。

（二）监事变动情况

报告期内，公司监事变动情况如下：

序号	变动时间	原监事	变更后监事
1	2011年7月19日	张光柳、肖春林、邓文斌	张光柳、肖春林、厉策
2	2013年12月26日	张光柳、肖春林、厉策	同左

2010年7月19日，深爱有限召开2010年第二次股东会，选举张光柳、肖春林担任监事，与职工代表监事邓文斌组成第一届监事会。

2011年7月28日，公司召开2011年职工代表大会，选举厉策为公司职工监事，邓文斌不再担任职工监事职务。

2013年12月20日，公司召开职工代表大会，选举厉策担任公司职工监事。

2013年12月26日，公司召开2013年第三次临时股东大会，经第一届第六次监事会提名，选举张光柳、肖春林为第二届监事会监事，与职工代表监事厉策共同组成公司第二届监事会。

（三）高级管理人员变动情况

报告期内，公司高级管理人员变动情况如下：

序号	变动时间	原高级管理人员	变更后高级管理人员
1	2011年7月12日	寻培珏、王嘉全、李祥天、王军立	寻培珏、王嘉全、李祥天、王军立、邓文斌、汪德文
2	2013年7月12日	寻培珏、王嘉全、李祥天、王军立、邓文斌、汪德文	寻培珏、王嘉全、张帅恒、王军立、邓文斌、汪德文、位培川
3	2013年12月26日	寻培珏、王嘉全、张帅恒、王军立、邓文斌、汪德文、位培川	寻培珏、王嘉全、张帅恒、王军立、邓文斌、汪德文、位培川

2011年7月12日，公司召开第一届董事会第三次会议，增聘王军立、邓文斌为公司副总经理，汪德文为公司总工程师。

2013年7月12日，公司召开第一届董事会第七次会议，聘任张帅恒为公司副总经理，位培川为公司财务负责人。李祥天不再担任公司副总经理。

2013年12月26日，公司召开第二届董事会第一次会议，聘任寻培珏任公司总经理，王嘉全、张帅恒、王军立和邓文斌任副总经理，王军立任董事会秘书，汪德文任总工程师，位培川任财务负责人。

公司上述人员职务变动系正常的工作变动，报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化，核心管理层稳定，上述人员变动未导致高级管理人员发生重大变化，未对公司经营战略、经营模式和管理模式产生影响。

第八节 公司治理

一、公司治理制度的建立健全及运行情况

公司按照《公司法》、《证券法》并参照《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规章的要求，已建立并逐步完善由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，为公司的高效运营提供了制度保证。

自公司成立以来，股东大会、董事会、监事会和高级管理层能够按照公司章程和有关规定、规定赋予的职权依法独立规范运作，履行各自的权利和义务，切实保障股东的利益，推进公司法人治理结构的科学化和规范化。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会是公司的最高权力机构。2010年12月22日，公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了第一届董事会和第一届监事会，审议通过了《公司章程》及《股东大会议事规则》，对股东的权利义务、股东大会的职权、议事规则等做了详细规定，符合《公司法》等法律法规的要求。2012年3月15日，经公司2012年度第一次临时股东大会审议，通过了修订《股东大会议事规则》的议案。2013年4月2日，经公司2012年度股东大会审议，通过了修改《公司章程》的议案。

根据《公司章程》第三十一条，股东大会依法行使下列职权：

- 1、决定公司的经营方针和投资计划；
- 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- 3、审议批准董事会的报告；
- 4、审议批准监事会的报告；
- 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- 8、对发行公司债券作出决议；

- 9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
 - 10、修改公司章程；
 - 11、对聘用、解聘会计师事务所作出决议；
 - 12、审议批准以下投资项目：
 - (1) 在主业范围内投资金额超过 3,000 万元人民币的投资事项；
 - (2) 主业范围内符合下列条件之一且不论投资额大小的投资项目：
 - ①境外投资项目；
 - ②与非国有经济主体进行合资、合作或交易的项目；
 - ③对投资性平台公司或从事配套服务的企业进行股权投资；
 - ④本公司资产负债率超过 70%进行的投资项目；
 - (3) 公司不得在主业范围以外投资；
 - 13、审议批准符合第三十二条规定的担保事项；
 - 14、审议公司在一年内单次或累计购买、出售重大资产达到或超过公司最近一期经审计总资产 10%的事项；

“重大资产”是指房地产、固定资产、无形资产、商誉以及其他并非日常经营中经常性购买或出售的资产。公司购买日常经营所需的原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产不属于前述“重大资产”的范畴；
 - 15、审议批准公司及其所属企业国有产权变动事项；
 - 16、审议委托理财事项；
 - 17、审议公司董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上有表决权股份的股东的提案；
 - 18、审议公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易；
 - 19、审议股权激励计划；
 - 20、审议批准法律、行政法规和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项；

法律、法规、规章及政府有关规范性文件对上述事项规定了专门审批程序和权限的，按有关规定办理。
- 《公司章程》第三十二条规定，公司对外担保行为须经股东大会审议通过，且应符合《深圳市属国有企业贷款担保管理暂行规定》规定的下列条件：

- 1、公司对外贷款担保余额累计不得超过公司净资产的百分之五十；
 - 2、被担保人应当符合下列条件：
 - （1）企业经营情况、财务状况良好，有按期还本付息的能力；
 - （2）无挤占挪用贷款资金、无逃废银行债务等不良信用记录；
 - （3）原到期借款本息已清偿，没有清偿的，已经出具了贷款银行认可的偿还计划。
 - 3、被担保的贷款项目应当符合下列条件：
 - （1）符合国家和本市有关产业政策要求；
 - （2）符合深圳市属国有经济布局战略性调整要求；
 - （3）符合被担保人主导产业和发展方向，不属于非主业投资项目；
 - （4）不属于高风险的投资项目（包括任何形式的委托理财，投资股票、期货、期权等）。
 - 4、被担保人有下列情形之一的，公司不得提供担保：
 - （1）被担保人与公司之间无产权关系的，或者虽有产权关系，但是公司的参股企业的；
 - （2）被担保人为自然人或非法人单位的；
 - （3）提供担保的贷款资金可能用于偿还先前已有贷款，且该已有贷款不是本公司提供担保的；
 - （4）被担保人从事境外融资的；
 - （5）续保金额高于原贷款担保金额的；
 - （6）法律、法规、规章及相关规范性文件规定不得提供担保的其他情形。
- 公司对外担保提交董事会审议时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
- 截至招股说明书签署日，公司自股份公司设立以来的股东大会召开情况如下：

（1）创立大会暨第一次股东大会

会议召开时间	2010 年 12 月 22 日
出席会议股东	股东及其代表 3 名，代表公司股份总数的 100%
会议审议议案	1. 审议《关于审议深圳深爱半导体股份有限公司筹备工作报告的议案》 2. 审议《关于设立深圳深爱半导体股份有限公司的议案》 3. 审议《关于增加深圳深爱半导体股份有限公司经营范围的议案》

	4. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司章程》 5. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司股东大会议事规则》 6. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司董事会议事规则》 7. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司监事会议事规则》 8. 审议《关于选举深圳深爱半导体股份有限公司第一届董事会成员的议案》 9. 审议《关于选举深圳深爱半导体股份有限公司第一届监事会成员的议案》 10. 审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司筹建费用报告的议案》 11. 审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所担任股份公司 2011 年度审计工作的议案》 12. 审议《关于授权董事会办理股份公司设立登记有关事宜的议案》
会议表决情况	上述各项议案均经审议获通过

(2) 2011 年第一次临时股东大会

会议召开时间	2011 年 6 月 3 日
出席会议股东	股东及其代表 3 名，代表公司股份总数的 100%
会议审议议案	1. 审议深圳市赛格集团有限公司和赛格（香港）有限公司签订关于深圳深爱半导体股份有限公司外资转内资之股权转让协议之补充协议 2. 审议股份公司董事会按照相关法律法规到政府部门办理相关事宜
会议表决情况	上述各项议案均经审议获通过

(3) 2010 年度股东大会

会议召开时间	2011 年 6 月 28 日
出席会议股东	股东及其代表 3 名，代表公司股份总数的 100%
会议审议议案	1. 审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司 2010 年度决算方案的议案》 2. 审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司 2011 年度预算方案的议案》 3. 审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司 2010 年度利润分配方案的议案》 4. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》 5. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》 6. 审议《关于申请深圳深爱半导体股份有限公司住所变更的议案》 7. 审议《关于修改<深圳深爱半导体股份有限公司章程>的议案》
会议表决情况	上述各项议案均经审议获通过

(4) 2012 年第一次临时股东大会

会议召开时间	2012 年 3 月 15 日
出席会议股东	股东及其代表 3 名，代表公司股份总数的 100%
会议审议议案	1. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司章程》 2. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司股东大会议事规则》 3. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司董事会议事规则》 4. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司独立董事工作制度》 5. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司对外担保管理制度》

	6. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司关联交易管理制度》 7. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司募集资金管理制度》 8. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司信息披露管理制度》 9. 审议《关于选举独立董事和更换公司第一届董事会成员的议案》 10. 审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司发放独立董事津贴的议案》
会议表决情况	上述各项议案均经审议获通过

(5) 2011 年度股东大会

会议召开时间	2012 年 5 月 16 日
出席会议股东	股东及其代表 3 名，代表公司股份总数的 100%
会议审议议案	1. 审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司 2011 年度决算方案的议案》 2. 审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司 2012 年度预算方案的议案》 3. 审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司 2011 年度利润分配方案的议案》 4. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》 5. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》
会议表决情况	上述各项议案均经审议获通过

(6) 2012 年第二次临时股东大会

会议召开时间	2012 年 9 月 12 日
出席会议股东	股东及其代表 3 名，代表公司股份总数的 100%
会议审议议案	审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司聘任会计师事务所的议案》
会议表决情况	上述各项议案均经审议获通过

(7) 2012 年度股东大会

会议召开时间	2013 年 4 月 2 日
出席会议股东	股东及其代表 3 名，代表公司股份总数的 100%
会议审议议案	1. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》 2. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》 3. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司 2010-2012 年财务报告》的议案 4. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2012 年度财务决算》的议案 5. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2013 年度预算方案》的议案 6. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2012 年度利润分配方案》的议案 7. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司董事及高级管理人员 2012 年度薪酬》的议案 8. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司监事 2012 年度薪酬》的议案 9. 审议《续聘会计师事务所》的议案 10. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司未来三年具体利润分配计划和长期回报规划》的议案

	11. 审议修订《深圳深爱半导体股份有限公司章程》的议案 12. 审议制订《深圳深爱半导体股份有限公司章程（草案）》的议案 13. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2010-2012 年度关联交易事项予以确认》的议案 14. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司符合发行 A 股条件》的议案 15. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司申请在境内首次公开发行 A 股募集资金使用的可行性》的议案 16. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司申请在境内首次公开发行人民币普通股（A 股）具体方案》的议案 17. 审议修订《深圳深爱半导体股份有限公司关联交易管理制度》的议案 18. 审议修订《深圳深爱半导体股份有限公司对外担保管理制度》的议案 19. 审议修订《深圳深爱半导体股份有限公司信息披露管理制度》的议案 20. 审议修订《深圳深爱半导体股份有限公司募集资金专项存储制度》的议案 21. 审议修订《深圳深爱半导体股份有限公司独立董事工作制度》的议案 22. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2013 年度申请银行综合授信额度》的议案 23. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司关于 2012 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告》的议案
会议表决情况	上述各项议案均经审议获通过

(8) 2013 年第一次临时股东大会

会议召开时间	2013 年 9 月 16 日
出席会议股东	股东及其代表 3 名，代表公司股份总数的 100%
会议审议议案	审议《关于预先投入 6 英寸 0.35 微米功率半导体器件生产线项目（募投项目）》的议案
会议表决情况	上述议案经审议获通过

(9) 2013 年第二次临时股东大会

会议召开时间	2013 年 10 月 16 日
出席会议股东	股东及其代表 3 名，代表公司股份总数的 100%
会议审议议案	1. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2010-2012 年及 2013 年 1-6 月财务报告》 2. 审议对《深圳深爱半导体股份有限公司 2010-2012 年及 2013 年 1-6 月关联交易事项》予以确认的议案 3. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司申请在境内首次公开发行股票并上市方案》的议案 4. 审议《授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜》的议案 5. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司募集资金投资项目》的议案 6. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司关于 2013 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告》的议案

会议表决情况	上述各项议案均经审议获通过
--------	---------------

(10) 2013 年第三次临时股东大会

会议召开时间	2013 年 12 月 26 日
出席会议股东	股东及其代表 3 名，代表公司股份总数的 100%
会议审议议案	1. 关于深圳深爱半导体股份有限公司董事会换届选举的议案 2. 关于深圳深爱半导体股份有限公司发放独立董事津贴的议案 3. 关于深圳深爱半导体股份有限公司监事会换届选举的议案
会议表决情况	上述各项议案均经审议获通过

(11) 2013 年年度股东大会

会议召开时间	2014 年 3 月 20 日
出席会议股东	股东及其代表 3 名，代表公司股份总数的 100%
会议审议议案	1. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》的议案 2. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》的议案 3. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司 2011-2013 年度财务报告》的议案 4. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司 2013 年度财务决算》的议案 5. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司 2014 年度预算方案》的议案 6. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司 2013 年度利润分配方案》的议案 7. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司董事及高级管理人员 2013 年度薪酬》的议案 8. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司监事 2013 年度薪酬》的议案 9. 审议关于《续聘会计师事务所》的议案 10. 审议关于调整《深圳深爱半导体股份有限公司未来三年（2013-2015 年）具体利润分配计划和长期回报规划》的议案 11. 审议关于修订《深圳深爱半导体股份有限公司章程（草案）》的议案 12. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司 2014 年度申请银行综合授信额度》的议案 13. 审议关于对《深圳深爱半导体股份有限公司 2011-2013 年度关联交易事项》予以确认的议案 14. 审议关于调整《深圳深爱半导体股份有限公司申请在境内首次公开发行股票并上市方案》的议案 15. 审议关于调整《授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜》的议案 16. 审议关于制订《关于稳定深圳深爱半导体股份有限公司股价的预案》的议案

	17. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》的议案 18. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司就首次公开发行股票并上市项目作出公开承诺》的议案
会议表决情况	上述各项议案均经审议获通过

(15) 2014年第一次临时股东大会

会议召开时间	2014 年 4 月 10 日
出席会议股东	股东及其代表 3 名，代表公司股份总数的 100%
会议审议议案	1. 审议关于调整《深圳深爱半导体股份有限公司申请在境内首次公开发行股票并上市方案》的议案 2. 审议关于修改《深圳深爱半导体股份有限公司募集资金投资项目》的议案
会议表决情况	上述各项议案均经审议获通过

公司历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范，对公司董事、监事的选举，财务预决算，利润分配，《公司章程》及其他主要管理制度的制定和修改，首次公开发行股票的决策和募集资金投向等重大事宜作出了有效决议。

(二) 董事会制度的建立健全及运行情况

董事会对股东大会负责。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。

2010年12月22日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《董事会议事规则》，2012年3月15日，经公司2012年度第一次临时股东大会审议，修订了《董事会议事规则》，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

截至招股说明书签署日，公司设立以来的董事会召开情况如下：

(1) 第一届董事会第一次会议

会议召开时间	2010 年 12 月 22 日
出席会议董事	应到董事 9 人，实到董事 9 人
会议审议议案	1. 审议《关于选举深圳深爱半导体股份有限公司董事长和副董事长的议案》 2. 审议《关于聘任深圳深爱半导体股份有限公司总经理的议案》 3. 审议《关于聘任深圳深爱半导体股份有限公司副总经理的议案》 4. 审议《关于聘任深圳深爱半导体股份有限公司董事会秘书的议案》

	5. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 6. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 7. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 8. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 9. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司总经理工作条例》 10. 审议《关于选举深圳深爱半导体股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》 11. 审议《关于选举深圳深爱半导体股份有限公司董事会战略委员会委员的议案》 12. 审议《关于选举深圳深爱半导体股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 13. 审议《关于选举深圳深爱半导体股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》
会议表决情况	上述各项议案均获全体与会董事一致同意通过

(2) 2010年第一次临时董事会

会议召开时间	2010年12月28日
出席会议董事	应到董事9人，实到董事9人
会议审议议案	审议对应收账款按账龄提取坏账准备的议案
会议表决情况	上述各项议案均获全体与会董事一致同意通过

(3) 第一届董事会第二次会议

会议召开时间	2011年5月30日
出席会议董事	应到董事9人，实到董事9人
会议审议议案	1. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司2010年度总经理工作报告》 2. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司2010年度董事会工作报告》 3. 审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司2010年度决算方案的议案》 4. 审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司2011年度预算方案的议案》 5. 审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司2010年度利润分配方案的议案》 6. 审议《关于申请深圳深爱半导体股份有限公司固定资产报废的议案》 7. 审议《关于申请深圳深爱半导体股份有限公司住所变更的议案》 8. 审议《关于修改<深圳深爱半导体股份有限公司章程>的议案》 9. 审议《关于召开深圳深爱半导体股份有限公司2010年度股东大会的议案》
会议表决情况	上述各项议案均获全体与会董事一致同意通过

(4) 第一届董事会第三次会议

会议召开时间	2011年7月12日
出席会议董事	应到董事9人，实到董事9人

会议审议议案	审议并通过了《关于聘任深圳深爱半导体股份有限公司副总经理和总工程师的议案》
会议表决情况	上述各项议案均获全体与会董事一致同意通过

(5) 2011年第一次临时董事会

会议召开时间	2011 年 12 月 12 日
出席会议董事	应到董事 9 人，实到董事 9 人
会议审议议案	审议通过公司以龙岗厂房和宿舍抵押，向中行深圳罗湖支行申请 13000 万元授信额度的议案
会议表决情况	上述议案获全体与会董事一致同意通过

(6) 2012年第一次临时董事会

会议召开时间	2012 年 2 月 10 日
出席会议董事	应到董事 9 人，实到董事 9 人
会议审议议案	1. 审议修改后的《深圳深爱半导体股份有限公司章程》 2. 审议修改后的《深圳深爱半导体股份有限公司股东大会议事规则》 3. 审议修改后的《深圳深爱半导体股份有限公司董事会议事规则》 4. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司独立董事工作制度》 5. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司对外担保管理制度》 6. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司关联交易管理制度》 7. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司募集资金管理制度》 8. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司信息披露管理制度》 9. 审议《关于选举独立董事和更换公司第一届董事会成员的议案》 10. 审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司发放独立董事津贴的议案》
会议表决情况	上述各项议案均获全体与会董事一致同意通过

(7) 第一届董事会第四次会议

会议召开时间	2012 年 3 月 15 日
出席会议董事	应到董事 9 人，实到董事 9 人
会议审议议案	1. 审议《关于设立深圳深爱半导体股份有限公司审计部和证券部的议案》 2. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司组织架构》 3. 审议修订《深圳深爱半导体股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 4. 审议修订《深圳深爱半导体股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 5. 审议修订《深圳深爱半导体股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 6. 审议修订《深圳深爱半导体股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 7. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司内部审计制度》 8. 审议《关于选举和更换深圳深爱半导体股份有限公司董事会审计委员

	会委员的议案》 9. 审议《关于选举和更换深圳深爱半导体股份有限公司董事会薪酬和考核委员会委员的议案》 10. 审议《关于选举和更换深圳深爱半导体股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》 11. 审议《关于选举和更换深圳深爱半导体股份有限公司董事会战略委员会委员的议案》 12. 审议《关于聘任深圳深爱半导体股份有限公司审计部负责人的议案》 13. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司投资者关系管理制度》 14. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司董事会秘书工作制度》 15. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司内幕信息知情人登记制度》 16. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》 17. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司重大信息内部报告制度》 18. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司内部控制制度》 19. 审议《2011 年度深圳深爱半导体股份有限公司全面风险管理报告》
会议表决情况	上述各项议案均获全体与会董事一致同意通过

(8) 第一届董事会第五次会议

会议召开时间	2012 年 4 月 25 日
出席会议董事	应到董事 9 人，实到董事 9 人
会议审议议案	1. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2011 年度总经理工作报告》 2. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》 3. 审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司 2011 年度决算方案的议案》 4. 审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司 2012 年度预算方案的议案》 5. 审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司 2011 年度利润分配方案的议案》 6. 审议《关于召开深圳深爱半导体股份有限公司 2011 年度股东大会的议案》
会议表决情况	上述各项议案均获全体与会董事一致同意通过

(9) 2012年第二次临时董事会

会议召开时间	2012 年 8 月 28 日
出席会议董事	应到董事 9 人，实到董事 9 人
会议审议议案	1. 审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司聘任会计师事务所的议案》 2. 审议《关于召开深圳深爱半导体股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》
会议表决情况	上述各项议案均获全体与会董事一致同意通过

(10) 第一届董事会第六次会议

会议召开时间	2013 年 3 月 12 日
出席会议董事	应到董事 9 人，实到董事 9 人
会议审议议案	1. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2012 年度总经理工作报告》

	2. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》 3. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2010-2012 年财务报告》 4. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2012 年度财务决算》的议案 5. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2013 年度预算方案》的议案 6. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2012 年度利润分配方案》 7. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司董事及高级管理人员 2012 年度薪酬》的议案 8. 审议《续聘会计师事务所》的议案 9. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司未来三年具体利润分配计划和长期回报规划》的议案 10. 审议修订《深圳深爱半导体股份有限公司章程》的议案 11. 审议制订《深圳深爱半导体股份有限公司章程（草案）》的议案 12. 审议对《深圳深爱半导体股份有限公司 2010-2012 年度关联交易事项予以确认》的议案 13. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司符合发行 A 股条件》的议案 14. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司申请在境内首次公开发行 A 股募集资金使用的可行性》的议案 15. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司申请在境内首次公开发行人民币普通股（A 股）具体方案》的议案 16. 审议修订《深圳深爱半导体股份有限公司关联交易管理制度》的议案 17. 审议修订《深圳深爱半导体股份有限公司对外担保管理制度》的议案 18. 审议修订《深圳深爱半导体股份有限公司信息披露管理制度》的议案 19. 审议修订《深圳深爱半导体股份有限公司募集资金专项存储制度》的议案 20. 审议修订《深圳深爱半导体股份有限公司独立董事工作制度》的议案 21. 审议修订《深圳深爱半导体股份有限公司投资者关系管理制度》的议案 22. 审议修订《深圳深爱半导体股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案 23. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》的议案 24. 审议修订《深圳深爱半导体股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案 25. 审议修订《深圳深爱半导体股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案 26. 审议修订《深圳深爱半导体股份有限公司内部审计制度》的议案 27. 审议《支付安信证券股份有限公司部分保荐费用》的议案 28. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2013 年度申请银行综合授信额度》的议案 29. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司关于 2012 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告》的议案 30. 审议《召开公司 2012 年度股东大会》的议案
会议表决情况	第 12 项经非关联董事表决一致同意通过，其余各项议案均获全体与会董事一致同意通过。

(11) 第一届董事会第七次会议

会议召开时间	2013 年 7 月 12 日
出席会议董事	应到董事 9 人，实到董事 9 人
会议审议议案	1. 审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司聘任副总经理的议案》 2. 审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司聘任财务负责人的议案》 3. 审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司聘任审计负责人的议案》
会议表决情况	上述各项议案均获全体与会董事一致同意通过

(12) 第一届董事会第八次会议

会议召开时间	2013 年 8 月 28 日
出席会议董事	应到董事 9 人，实到董事 9 人
会议审议议案	1. 审议《关于调整一年以内应收账款坏账准备提取比例的议案》 2. 审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》 3. 审议《关于预先投入 6 英寸 0.35 微米功率半导体器件生产线项目（募投项目）的议案》
会议表决情况	上述各项议案均获全体与会董事一致同意通过

(13) 第一届董事会第九次会议

会议召开时间	2013 年 9 月 26 日
出席会议董事	应到董事 9 人，实到董事 9 人
会议审议议案	1. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2010-2012 年及 2013 年 1-6 月财务报告》 2. 审议对《深圳深爱半导体股份有限公司 2010-2012 年及 2013 年 1-6 月关联交易事项》予以确认的议案 3. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司申请在境内首次公开发行股票并上市方案》的议案 4. 审议《授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜》的议案 5. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司募集资金投资项目》的议案 6. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司关于 2013 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告》的议案 7. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司合同管理制度》的议案 8. 审议《召开深圳深爱半导体股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会》的议案
会议表决情况	第 2 项经非关联董事表决一致同意通过，其余各项议案均获全体与会董事一致同意通过

(14) 第一届董事会第十次会议

会议召开时间	2013 年 12 月 9 日
出席会议董事	应到董事 9 人，实到董事 9 人

会议审议议案	1. 审议关于深圳深爱半导体股份有限公司董事会换届选举的议案 2. 审议关于选举深圳深爱半导体股份有限公司发放独立董事津贴的议案 3. 审议关于召开深圳深爱半导体股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会的议案
会议表决情况	上述各项议案均获全体与会董事一致同意通过

(15) 第二届董事会第一次会议

会议召开时间	2013 年 12 月 26 日
出席会议董事	应到董事 9 人，实到董事 9 人
会议审议议案	1. 审议关于选举深圳深爱半导体股份有限公司董事长和副董事长的议案 2. 审议关于选举深圳深爱半导体股份有限公司董事会战略委员会委员的议案 3. 审议关于选举深圳深爱半导体股份有限公司董事会提名委员会委员的议案 4. 审议关于选举深圳深爱半导体股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案 5. 审议关于选举深圳深爱半导体股份有限公司董事会审计委员会委员的议案 6. 审议关于聘任深圳深爱半导体股份有限公司总经理的议案 7. 审议关于聘任深圳深爱半导体股份有限公司董事会秘书的议案 8. 审议关于聘任深圳深爱半导体股份有限公司副总经理的议案 9. 审议关于聘任深圳深爱半导体股份有限公司总工程师的议案 10. 审议关于聘任深圳深爱半导体股份有限公司财务负责人的议案 11. 审议关于聘任深圳深爱半导体股份有限公司审计部负责人的议案
会议表决情况	上述各项议案均获全体与会董事一致同意通过

(16) 第二届董事会第二次会议

会议召开时间	2014 年 2 月 28 日
出席会议董事	应到董事 9 人，实到董事 9 人
会议审议议案	1. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》的议案 2. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司 2013 年度总经理工作报告》的议案 3. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司 2011-2013 年度财务报告》的议案 4. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司 2013 年度财务决算》的议案 5. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司 2014 年度预算方案》的议案 6. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司 2013 年度利润分配方案》的议案

	7. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司董事及高级管理人员 2013 年度薪酬》的议案 8. 审议关于《续聘会计师事务所》的议案 9. 审议关于调整《深圳深爱半导体股份有限公司未来三年（2013-2015 年）具体利润分配计划和长期回报规划》的议案 10. 审议关于修订《深圳深爱半导体股份有限公司章程（草案）》的议案 11. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司 2014 年度申请银行综合授信额度》的议案 12. 审议关于对《深圳深爱半导体股份有限公司 2011-2013 年度关联交易事项》予以确认的议案 13. 审议关于调整《深圳深爱半导体股份有限公司申请在境内首次公开发行股票并上市方案》的议案 14. 审议关于调整《授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜》的议案 15. 审议关于制订《关于稳定深圳深爱半导体股份有限公司股价的预案》的议案 16. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》的议案 17. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司就首次公开发行股票并上市项目作出公开承诺》的议案 18. 审议关于《召开深圳深爱半导体股份有限公司 2013 年年度股东大会》的议案
会议表决情况	第 12 项经非关联董事表决一致同意通过，其余各项议案均获全体与会董事一致同意通过

（17）第二届董事会第三次会议

会议召开时间	2014 年 3 月 26 日
出席会议董事	应到董事 9 人，实到董事 9 人
会议审议议案	1. 审议关于调整《深圳深爱半导体股份有限公司申请在境内首次公开发行股票并上市方案》的议案 2. 审议关于修改《深圳深爱半导体股份有限公司募集资金投资项目》的议案 3. 审议关于《召开深圳深爱半导体股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会》的议案
会议表决情况	上述议案均获全体与会董事一致同意通过

公司历次董事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

监事会为公司的监督机构。公司监事会负责监督检查公司的财务状况，对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务进行监督，维护公司和股东利益。监事列席董事会会议。公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，其中职工代表监事一名，由职工代表大会选举产生。

2010年12月22日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《监事会议事规则》，对监事会的职权、议事规则等做了详细规定，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

截至招股说明书签署日，公司设立以来的监事会召开情况如下：

(1) 第一届监事会第一次会议

会议召开时间	2010 年 12 月 22 日
出席会议监事	应到监事 3 人，实到监事 3 人
会议审议议案	审议《关于选举深圳深爱半导体股份有限公司监事会主席的议案》
会议表决情况	上述各项议案均获全体与会监事一致同意通过

(2) 第一届监事会第二次会议

会议召开时间	2011 年 5 月 30 日
出席会议监事	应到监事 3 人，实到监事 3 人
会议审议议案	审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》
会议表决情况	上述各项议案均获全体与会监事一致同意通过

(3) 第一届监事会第三次会议

会议召开时间	2012 年 4 月 25 日
出席会议监事	应到监事 3 人，实到监事 3 人
会议审议议案	1. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》 2. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2011 年度审计报告》
会议表决情况	上述各项议案均获全体与会监事一致同意通过

(4) 第一届监事会第四次会议

会议召开时间	2013 年 3 月 12 日
出席会议监事	应到监事 3 人，实到监事 3 人
会议审议议案	1. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》 2. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2010-2012 年度财务报告》 3. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2012 年度审计报告》 4. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2012 年度利润分配方案》 5. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司监事 2012 年度薪酬》 6. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司关于 2012 年 12 月 31 日与财务

	报表相关的内部控制自我评价报告》 7. 审议关于续聘会计师事务所的议案
会议表决情况	上述各项议案均获全体与会监事一致同意通过

(5) 第一届监事会第五次会议

会议召开时间	2013 年 9 月 26 日
出席会议监事	应到监事 3 人，实到监事 3 人
会议审议议案	1. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2010-2012 年及 2013 年 1-6 月财务报告》 2. 审议《深圳深爱半导体股份有限公司 2013 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告》
会议表决情况	上述各项议案均获全体与会监事一致同意通过

(6) 第一届监事会第六次会议

会议召开时间	2013 年 12 月 9 日
出席会议监事	应到监事 3 人，实到监事 3 人
会议审议议案	审议《关于深圳深爱半导体股份有限公司监事会换届选举的议案》
会议表决情况	上述各项议案均获全体与会监事一致同意通过

(7) 第二届监事会第一次会议

会议召开时间	2013 年 12 月 26 日
出席会议监事	应到监事 3 人，实到监事 3 人
会议审议议案	审议《关于选举深圳深爱半导体股份有限公司监事会主席的议案》
会议表决情况	上述各项议案均获全体与会监事一致同意通过

(8) 第二届监事会第二次会议

会议召开时间	2014 年 2 月 28 日
出席会议监事	应到监事 3 人，实到监事 3 人
会议审议议案	1. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》的议案 2. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司 2011-2013 年度财务报告》的议案 3. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司 2013 年度利润分配方案》的议案 4. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司监事 2013 年度薪酬》的议案 5. 审议关于调整《深圳深爱半导体股份有限公司未来三年（2013-2015 年）具体利润分配计划和长期回报规划》的议案 6. 审议关于修订《深圳深爱半导体股份有限公司章程（草案）》的议案 7. 审议关于《深圳深爱半导体股份有限公司 2013 年度内部控制评价报

	告》的议案
	8. 审议关于《续聘会计师事务所》的议案
会议表决情况	上述各项议案均获全体与会监事一致同意通过

公司监事会虽然2011年和2012年每年仅召开一次监事会会议，但是严格按照《公司法》和《公司章程》规定的职权范围对公司重大事项进行了审议监督，会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

为进一步完善公司法人治理结构，保护中小股东利益，公司聘请了独立董事，建立了独立董事制度。目前公司共有3名独立董事，其中李斌先生为会计专业人士。公司独立董事占董事会的1/3以上。

公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，制订了《独立董事工作制度》，2013年4月2日经公司2012年度股东大会审议通过了修订《独立董事工作制度》的议案。对独立董事任职资格、选举、任期、享有职权、发表独立意见等作了详细的规定。独立董事负有诚信与勤勉义务，独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益。独立董事制度进一步完善了本公司的法人治理结构，为保护中小股东利益，科学决策等方面提供了制度保障。

2013年7月12日，独立董事张波、杨小强和李斌签署了《关于聘任公司副总经理的独立意见》，对公司聘任副总经理发表了独立意见。2013年9月26日，独立董事张波、杨小强和李斌签署了《独立董事对相关事项的独立意见》，对公司报告期内的关联交易、内部控制自我评价报告等事项发表了独立意见。2013年12月9日，独立董事张波、杨小强和李斌签署了《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》，对董事会换届选举发表了独立意见。2013年12月23日，独立董事张波、杨小强和李斌签署了《独立董事关于聘任公司总经理等高级管理人员的独立意见》，对公司聘任总经理等高级管理人员发表了独立意见。2014年2月28日，独立董事张波、杨小强和李斌签署了《独立董事对相关事项的独立意见》，对公司报告期内的关联交易、内部控制评价报告、调整公司章程（草案）的利润分配政策等事项发表了独立意见。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司董事会秘书承担法律、行政法规以及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，也享有相应的工作职权，对提升公司治理和促进公司运作规范有着重要作用。公司已聘请王军立先生为董事会秘书，负责本公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及本公司股权管理、信息披露等事宜。2012年3月15日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《董事会秘书工作制度》。2013年3月12日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了修订《董事会秘书工作制度》的议案。报告期内董事会秘书遵循公司制定的《董事会秘书工作制度》，忠实地履行了职责。

（六）董事会专门委员会设立及运行情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与提名委员会和审计委员会。2010年12月22日公司第一届董事会第一次会议审议通过了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》，对专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容做出了详尽要求。2012年3月15日经过第一届董事会第四次会议审议批准，公司对上述工作细则做出修改，进一步完善公司治理结构。公司第二届董事会各专门委员会的组成如下：

委员会名称	召集人	成员
战略委员会	孙盛典	孙盛典、寻培珏、何欣纲、张波、王嘉全
提名委员会	张波	张波、孙盛典、杨小强
薪酬与考核委员会	杨小强	杨小强、严冬霞、李斌
审计委员会	李斌	李斌、唐崇银、杨小强

战略委员会的主要职责权限：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意见；董事会授权的其他事宜。

提名委员会的主要职责权限：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准

和程序，并向董事会提出建议；选择合格的董事候选人和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员的人选进行初步审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。

薪酬与考核委员会的主要职责权限：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策、计划或方案；薪酬政策、计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；拟订董事和高级管理人员基本薪酬方案，报公司董事会审议通过后提交股东大会或董事会审议，经批准后实施；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，拟订年终奖励方案，报董事会决定实施；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

审计委员会的主要职责：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度，对公司重大关联交易进行审查；公司董事会授予的其他事宜。

二、发行人近三年一期违法违规行情况

公司报告期内不存在因违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规受到行政处罚且情节严重的情形。

三、发行人近三年一期资金占用和对外担保情况

公司报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

报告期内，公司不存在对外担保的情形。

四、发行人的内部控制制度

（一）公司管理层的自我评估意见

公司管理层对公司 2013 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存

在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

瑞华所对公司与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并于 2014 年 2 月 28 日出具了瑞华核字[2014]48130005 号《内部控制鉴证报告》。认为：公司于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。

第九节 财务会计信息

本公司近三年的财务报表已经瑞华所审计，并出具了标准无保留意见的瑞华审字[2014]48130004号《审计报告》。

本节的财务会计数据及有关分析引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表。投资者欲对本公司进行更详细的了解，应当认真阅读审计报告全文。

一、近三年经审计的财务报表

（一）资产负债表

单位：元

资 产	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产			
货币资金	34,298,746.00	36,835,381.36	33,174,219.21
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	69,563,029.72	43,682,582.61	9,354,782.05
应收账款	103,462,060.77	113,555,143.21	110,660,655.76
预付款项	36,260,535.48	12,239,424.13	17,713,524.64
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	232,650.00	187,648.39	808,491.63
存货	119,691,156.47	107,702,427.04	121,550,597.73
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	7,529,493.40	250,000.00	2,197,657.70
流动资产合计	371,037,671.84	314,452,606.74	295,459,928.72
非流动资产			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	5,702,352.04	6,700,052.20	2,640,076.86

资 产	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
固定资产	231,307,781.04	229,950,346.03	221,096,802.88
在建工程	4,532,409.01	2,417,476.32	755,661.07
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	14,686,228.71	16,503,930.21	14,993,633.46
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	6,381,685.32	5,263,570.40	3,459,431.41
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	262,610,456.12	260,835,375.16	242,945,605.68
资产总计	633,648,127.96	575,287,981.90	538,405,534.40

资产负债表（续）

单位：元

负债及股东（所有者）权益	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动负债			
短期借款	73,959,360.59	49,840,463.79	28,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	51,975,887.80	41,133,975.50	31,823,175.40
应付账款	71,361,830.03	63,122,294.02	100,064,010.52
预收款项	245,051.47	764,058.68	2,147,090.35
应付职工薪酬	8,840,979.29	5,465,727.04	4,677,110.71
应交税费	2,547,268.34	4,981,850.17	1,529,383.33
应付利息	367,551.22	50,823.61	57,773.56
应付股利	-	-	-
其他应付款	1,934,655.96	1,319,326.12	9,704,324.43
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	5,666,747.19	5,907,882.69	2,000,000.04
流动负债合计	216,899,331.89	172,586,401.62	180,002,868.34
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-

负债及股东（所有者）权益	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
专项应付款	-	-	3,000,000.00
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	26,115,066.08	18,981,813.22	7,399,999.90
非流动负债合计	26,115,066.08	18,981,813.22	10,399,999.90
负债合计	243,014,397.97	191,568,214.84	190,402,868.24
股东（所有者）权益	-	-	-
股本（实收资本）	199,000,000.00	199,000,000.00	199,000,000.00
资本公积	106,469,235.01	106,469,235.01	106,469,235.01
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	10,506,449.50	7,825,053.21	4,253,343.12
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	74,658,045.48	70,425,478.84	38,280,088.03
股东（所有者）权益合计	390,633,729.99	383,719,767.06	348,002,666.16
负债和股东（所有者）权益总计	633,648,127.96	575,287,981.90	538,405,534.40

（二）利润表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	374,672,195.91	406,342,542.23	463,962,847.43
减：营业成本	288,066,811.00	307,638,242.31	356,836,886.63
营业税金及附加	718,389.16	1,840,749.61	2,453,331.07
销售费用	8,673,332.77	6,665,801.89	8,685,279.60
管理费用	49,122,280.26	47,009,031.09	58,951,596.75
财务费用	4,646,177.72	4,010,362.16	1,875,851.11
资产减值损失	-519,306.64	2,025,657.11	1,495,241.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,964,511.64	37,152,698.06	33,664,660.95
加：营业外收入	7,085,543.21	3,627,898.39	6,246,317.39

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
减：营业外支出	1,400,758.97	491,209.53	1,825,860.11
其中：非流动资产处置损失	350,000.31	24,505.97	312,745.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,649,295.88	40,289,386.92	38,085,118.23
减：所得税费用	2,835,332.95	4,572,286.02	3,137,180.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,813,962.93	35,717,100.90	34,947,937.76

（三）现金流量表

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	257,904,377.88	242,331,935.25	288,156,667.33
收到的税费返还	2,481,294.33	4,619,324.26	3,613,957.81
收到其他与经营活动有关的现金	23,545,783.09	39,968,598.08	15,381,636.32
经营活动现金流入小计	283,931,455.30	286,919,857.59	307,152,261.46
购买商品、接受劳务支付的现金	155,819,997.39	165,220,506.34	178,386,645.39
支付给职工以及为职工支付的现金	77,994,355.70	64,507,709.74	69,341,477.39
支付的各项税费	21,547,724.78	23,357,411.92	28,404,840.59
支付其他与经营活动有关的现金	13,057,475.81	13,565,246.82	6,809,701.47
经营活动现金流出小计	268,419,553.68	266,650,874.82	282,942,664.84
经营活动产生的现金流量净额	15,511,901.62	20,268,982.77	24,209,596.62
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	311,046.00	565,000.00	50,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	311,046.00	565,000.00	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	58,172,959.96	34,575,026.75	24,888,212.51
投资支付的现金	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	58,172,959.96	34,575,026.75	24,888,212.51
投资活动产生的现金流量净额	-57,861,913.96	-34,010,026.75	-24,838,212.51
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	-

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
借款收到的现金	73,959,360.59	84,840,463.79	36,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	73,959,360.59	84,840,463.79	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	63,000,000.00	22,095,542.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,861,511.22	3,918,249.69	1,006,757.78
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	31,861,511.22	66,918,249.69	23,102,299.82
筹资活动产生的现金流量净额	42,097,849.37	17,922,214.10	12,897,700.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-134,642.82	-31,965.75	-283,509.19
五、现金及现金等价物净增加额	-386,805.79	4,149,204.37	11,985,575.10
加：期初现金及现金等价物余额	34,685,551.79	30,536,347.42	18,550,772.32
六、期末现金及现金等价物余额	34,298,746.00	34,685,551.79	30,536,347.42

二、申报财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况

（一）申报财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）合并报表范围及变化情况

报告期本公司无子公司，亦未发生企业合并，无需编制合并报表。

三、审计意见

瑞华所对公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日的资产负债表， 2011 年度、2012 年度及 2013 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了瑞华审字[2014]48130004 号标准无保留意见审计报告。

四、主要会计政策和会计估计

（一）收入

1、销售商品

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

公司收入确认的具体会计政策和时点：根据公司与客户签订的销售合同约定，公司按照客户订单的要求将货物发送给客户，客户收到货物后必须在指定期限对收到货物进行验收并告知是否合格，若无告知则视同已验收合格。一般情况下，指定期限为 7 天。

在实际执行中，部分客户能够按照公司要求验收后进行签收确认，公司根据发货单、客户验收单确认收入。但由于客户订单具有批次多、数量少的特点，部分客户收到货物后未进行签收确认，针对该部分客户公司确认收入的截止发货日期为每月的 24 号，到月底时也已过了验收期限，届时视同已验收合格。同时，公司月末会将当月的发货情况与主要客户进行对账，若对账无误才根据发货单确认收入。以上两种情况，公司均没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，并将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，符合《企业会计准则》对收入确认的要求。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当

期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二）金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

2、金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、

债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

3、金融资产转移

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

5、金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

（三）应收款项

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

① 单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额 100 万元以上的应收账款、单项金额 10 万元以上的其他应收款。

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	30	30
2—3 年	50	50
3—5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额 100 万元以下的应收账款和单项金额 10 万元以下的其他应收款需单独计提坏账准备应收款项
坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备

（四）存货

1、存货的分类

公司存货主要包括原材料（包括辅助材料）、在产品、库存商品、周转材料（包括低值易耗品、包装物）、自制半成品及委托加工物资。

2、发出存货的计价方法

发出存货时按全月一次加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出

售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。包装物在其领用时采用一次转销法摊销。

（五）长期股权投资

1、初始投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以公司在被合并方于合并日按公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

（2）非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

（3）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资

成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认方法

公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时：

（1）长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

（2）取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

（3）确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负

有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(4) 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

(5) 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

持股比例减少后被投资单位仍然是公司的联营企业或合营企业时，公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。

持股比例增加后被投资单位仍然是公司的联营企业或合营企业时，公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

(2) 重大影响的判断依据

重大影响，是指对公司的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，公司按照本节之“（十五）资产减值”所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，公司按照本节之“（二）金融工具”之“5、金融资产减值”的方法计提资产减值准备。

（六）投资性房地产

1、投资性房地产的种类和计量模式

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、出租的建筑物。

2、采用成本模式核算政策

公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

3、减值测试方法及减值准备计提方法

用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本节之“（十五）资产减值”。

（七）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	3	4.85
机器设备	10	3	9.70
电子设备	5	3	19.40
运输工具	5	3	19.40
其他设备	5	3	19.40

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司固定资产减值准备的计提方法见本节之“（十五）资产减值”。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

5、其他说明

①每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

（八）在建工程

1、在建工程核算方法

公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可

使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

公司在建工程减值准备的计提方法见本节之“（十五）资产减值”。

（九）无形资产

1、无形资产的初始计量

公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2、无形资产的后续计量

①无形资产的使用寿命

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

②无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

项目	摊销年限	备注
土地使用权	50 年	
软件	5 年	外购商业软件
专利及专有技术	5 年、10 年	

公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③公司期末预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

④无形资产的减值

公司无形资产的减值准备计提方法见本节之“（十五）资产减值”。

（十）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化金额的确定方法

公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,应当予以资本化,计入符合资本化条件的资产成本。

(十一) 预计负债

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务,其履行很可能导致经济利益的流出,在该义务的金额能够可靠计量时,确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债,同时计入相关油气资产的原价,金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

不符合预计负债确认条件的,在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

(十二) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类

型。

2、政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3、政府补助的会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，

（十三）递延所得税资产和递延所得税负债

公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

1、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2、具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

3、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司

以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

1、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

（十四）外币业务核算方法

公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

（十五）资产减值

公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

（1）公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

（2）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（3）资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（4）就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

（5）资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十六）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

报告期内，公司会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

2013年8月28日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于调整一年以内应收账款坏账准备提取比例的议案》，将1年以内的应收账款计提比例由1.5%提高到5%。除此以外，报告期内公司会计估计未发生变更。

五、执行的主要税收政策、缴纳的主要税种

（一）主要税种及税率

税 种	2013 年度	2012 年度	2011 年度
增值税	17%	17%	17%
营业税	5%	5%	5%
城市维护建设税	7%	7%	7%
教育费附加	3%	3%	3%
地方教育费附加	2%	2%	2%
企业所得税	15%	15%	15%

（二）税收优惠及批文

2009年6月27日，公司经深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准，取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR200944200036，有效期3年，公司按15%的税率缴纳企业所得税。

2012年4月25日，深圳市龙岗区地方税务局龙岗税务所出具深地税龙龙岗备（2012）22号《税务事项通知书》，完成对公司“国家需要重点扶持的高新技术企业所得税优惠税率减免”备案登记。

2012年9月12日，公司经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准，取得高新技术企业证书，证书编号：GF201244200277，有效期3年，公司按15%税率缴纳企业所得税。

六、最近一年及一期的收购兼并情况

最近一年及一期，公司未发生收购兼并情况。

七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

经瑞华所审计，报告期内公司非经常性损益明细情况如下：

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置损益	-349,178.58	224,679.53	-273,594.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,034,982.64	3,376,169.41	6,168,500.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,001,019.82	-464,160.08	-1,474,448.01
非经常性损益总额	5,684,784.24	3,136,688.86	4,420,457.28
减：非经常性损益的所得税影响数	-656,535.24	-421,457.73	-663,068.59
非经常性损益净额	5,028,249.00	2,715,231.13	3,757,388.69

报告期内，公司非经常性损益主要为政府补助，非经常性损益净额占同期净利润的比重分别为 10.75%、7.60%和 18.75%。

八、发行人最近一期末主要资产

截至 2013 年 12 月 31 日，公司的资产总计为 633,648,127.96 元，主要包括货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、存货等流动资产和固定资产、无形资产等非流动资产。

（一）主要流动资产

1、货币资金

截至2013年12月31日，公司货币资金余额为34,298,746.00元，以银行存款为主，货币资金中其他货币资金为购买设备向银行开立信用证的保证金。具体情况如下：

单位：元

项 目	2013-12-31	2012-12-31
库存现金	62,453.89	21,691.61
银行存款	34,236,224.31	34,663,860.18
其他货币资金	67.80	2,149,829.57
合 计	34,298,746.00	36,835,381.36

2、应收票据

截至2013年12月31日，公司应收票据余额为69,563,029.72元。公司应收票据全部为银行承兑汇票，具体情况如下：

单位：元

项 目	2013-12-31	2012-12-31
银行承兑汇票	69,563,029.72	43,682,582.61
合 计	69,563,029.72	43,682,582.61

3、应收账款

截至2013年12月31日，公司应收账款账面价值为103,462,060.77元。公司应收账款账龄主要为1年以内，已足额计提坏账准备，具体情况如下：

单位：元

账 龄	2013-12-31			2012-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	107,975,777.90	98.80	5,398,788.89	118,310,647.32	98.54	5,915,532.37
1 至 2 年	1,228,127.60	1.12	368,438.28	1,500,087.49	1.25	450,026.25
2 至 3 年	24,622.54	0.02	12,311.27	198,409.30	0.17	99,204.65
3 至 5 年	65,355.84	0.06	52,284.67	53,811.87	0.04	43,049.50
合 计	109,293,883.88	100.00	5,831,823.11	120,062,955.98	100.00	6,507,812.77

4、预付款项

截至2013年12月31日，公司预付款项余额为36,260,535.48元。公司预付款项主要为预付设备供应商的款项，具体情况如下：

单位：元

账 龄	2013-12-31		2012-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	36,260,535.48	100.00	11,071,258.83	90.46
1 至 2 年	-	-	645,578.22	5.27
2 至 3 年	-	-	65,318.00	0.53
3 年以上	-	-	457,269.08	3.74
合 计	36,260,535.48	100.00	12,239,424.13	100.00

5、存货

截至2013年12月31日，公司存货账面价值为119,691,156.47元。公司存货主要为在产品、库存商品、自制半成品及原材料，并已足额计提存货跌价准备。具体情况如下：

单位：元

项 目	2013-12-31			2012-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,255,322.70	57,957.30	7,197,365.40	9,653,522.84	-	9,653,522.84
在产品	38,126,924.50	-	38,126,924.50	39,165,241.12	-	39,165,241.12
库存商品	35,793,492.17	1,879,336.15	33,914,156.02	30,280,847.47	2,682,927.00	27,597,920.47
周转材料	2,821,535.79	161,719.12	2,659,816.67	3,321,923.36	-	3,321,923.36
自制半成品	37,893,011.90	2,047,856.90	35,845,155.00	26,040,135.66	1,299,700.29	24,740,435.37
发出商品	1,947,738.88	-	1,947,738.88	3,223,383.88	-	3,223,383.88
委托加工物资	208,674.98	208,674.98	-	208,674.98	208,674.98	-
合 计	124,046,700.92	4,355,544.45	119,691,156.47	111,893,729.31	4,191,302.27	107,702,427.04

（二）主要非流动性资产

1、固定资产

截至2013年12月31日，公司固定资产账面价值为231,307,781.04元，具体情况如下：

单位：元

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
一、账面原值合计	488,842,699.55	35,550,675.90	20,968,507.81	503,424,867.64
其中：房屋及建筑物	192,755,915.52	2,356,159.47		195,112,074.99
机器设备	47,102,511.04	665,427.64	2,193,305.55	45,574,633.13
运输设备	2,777,732.00	-	134,900.00	2,642,832.00
电子设备	209,217,307.37	31,897,293.53	14,604,317.61	226,510,283.29
其他设备	36,989,233.62	631,795.26	4,035,984.65	33,585,044.23
二、累计折旧合计	258,892,353.52	33,460,219.68	20,235,486.60	272,117,086.60
其中：房屋及建筑物	45,203,551.81	9,470,692.10	-	54,674,243.91
机器设备	21,443,306.13	4,736,924.31	1,734,180.81	24,446,049.63
运输设备	2,502,924.39	74,518.81	130,853.00	2,446,590.20
电子设备	165,262,653.09	14,949,855.06	14,474,986.26	165,737,521.89
其他设备	24,479,918.10	4,228,229.40	3,895,466.53	24,812,680.97
三、固定资产账面净值合计	229,950,346.03	-	-	231,307,781.04
其中：房屋及建筑物	147,552,363.71	-	-	140,437,831.08
机器设备	25,659,204.91	-	-	21,128,583.50

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
运输设备	274,807.61	-	-	196,241.80
电子设备	43,954,654.28	-	-	60,772,761.40
其他设备	12,509,315.52	-	-	8,772,363.26
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	229,950,346.03	-	-	231,307,781.04
其中：房屋及建筑物	147,552,363.71	-	-	140,437,831.08
机器设备	25,659,204.91	-	-	21,128,583.50
运输设备	274,807.61	-	-	196,241.80
电子设备	43,954,654.28	-	-	60,772,761.40
其他设备	12,509,315.52	-	-	8,772,363.26

公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、电子设备。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已将部分房地产设置抵押，合计账面价值为 46,212,665.10 元。

2、投资性房地产

截至2013年12月31日，公司投资性房地产账面价值为5,702,352.04元，主要为房屋、建筑物，具体情况如下：

单位：元

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
一、账面原值合计	20,140,544.29	45,000.00	-	20,185,544.29
1.房屋、建筑物	20,140,544.29	45,000.00	-	20,185,544.29
二、累计折旧和累计摊销合计	13,440,492.09	1,042,700.16	-	14,483,192.25
1.房屋、建筑物	13,440,492.09	1,042,700.16	-	14,483,192.25
三、投资性房地产账面净值合计	6,700,052.20	-	-	5,702,352.04
1.房屋、建筑物	6,700,052.20	-	-	5,702,352.04
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
1.房屋、建筑物	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	6,700,052.20	-	-	5,702,352.04
1.房屋、建筑物	6,700,052.20	-	-	5,702,352.04

3、无形资产

截至2013年12月31日，公司无形资产账面价值为14,686,228.71元，主要由土地使用权、软件、专利及专有技术构成，具体情况如下：

单位：元

项 目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
一、账面原值合计	22,010,590.62	86,415.09	-	22,097,005.71
土地使用权	4,141,714.40	-	-	4,141,714.40
软件	810,148.18	-	-	810,148.18
专利及专有技术	17,058,728.04	86,415.09	-	17,145,143.13
二、累计摊销合计	5,506,660.41	1,904,116.59	-	7,410,777.00
土地使用权	720,572.93	82,834.32	-	803,407.25
软件	405,872.65	95,123.64	-	500,996.29
专利及专有技术	4,380,214.83	1,726,158.63	-	6,106,373.46
三、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
专利及专有技术	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	16,503,930.21	-	-	14,686,228.71
土地使用权	3,421,141.47	-	-	3,338,307.15
软件	404,275.53	-	-	309,151.89
专利及专有技术	12,678,513.21	-	-	11,038,769.67

九、发行人最近一期末主要债项

截至2013年12月31日，公司负债总额为243,014,397.97元，主要为短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、其他流动负债和其他非流动负债。

（一）短期借款

截至2013年12月31日，公司短期借款为73,959,360.59元，主要为银行借款与已贴现未到期的应收票据，其中银行借款为41,000,000.00元，已贴现未到期的应收票据32,959,360.59元。

（二）应付票据

截至2013年12月31日，公司应付票据余额为51,975,887.80元，均为银行承兑汇票。

（三）应付账款

截至2013年12月31日，公司应付账款账面价值为71,361,830.03元，具体账龄情况如下：

单位：元

账 龄	2013-12-31	2012-12-31
1 年以内	67,728,469.77	59,267,821.69
1 至 2 年	3,055,805.21	2,797,284.88
2 至 3 年	346,090.82	917,969.10
3 年以上	231,464.23	139,218.35
合 计	71,361,830.03	63,122,294.02

（四）应付职工薪酬

截至2013年12月31日，公司应付职工薪酬余额为8,840,979.29元，占负债总额的比例为3.64%，具体明细情况如下：

单位：元

项 目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
工资、奖金、津贴和补贴	4,420,848.70	63,702,171.79	60,219,328.85	7,903,691.64
职工福利费	-	1,669,827.48	1,669,827.48	-
社会保险费	593,942.34	8,074,883.79	7,966,426.58	702,399.55
住房公积金	-	2,871,318.20	2,636,430.10	234,888.10
工会经费和职工教育经费	-	1,527,027.26	1,527,027.26	-
年金	450,936.00	1,839,570.00	2,290,506.00	-
外包劳务	-	2,158,754.56	2,158,754.56	-
合 计	5,465,727.04	81,843,553.08	78,468,300.83	8,840,979.29

（五）其他流动负债

截至2013年12月31日，公司其他流动负债余额为5,666,747.19元，均为下一年将递延计入损益的政府补助，具体情况如下：

单位：元

项 目	2013-12-31	2012-12-31
MOSFEET 产业化政府补贴	1,999,999.90	2,000,000.04
高压系列功率 MOSFET 器件产业化政府补贴	2,600,000.00	2,600,000.00
产业技术进步资金	1,066,747.29	1,307,882.65
合 计	5,666,747.19	5,907,882.69

1、MOSFEET 产业化政府补贴说明

2008年6月18日，深圳市发展和改革局出具深发改〔2008〕1071号《关于转发国家发展改革委办公厅关于新型电力电子器件产业化专项项目的复函》的通知：国家发改委以发改高技〔2008〕1135号文批复“深圳市深爱半导体有限公司功率 MOSFET 产业化”项目安排资金 800 万元。2009 年 3 月 17 日，深圳市发展和改革局出具深发改〔2009〕416 号文件，安排“深圳市深爱半导体有限公司功率 MOSFET 产业化”项目资金 200 万元。公司分别于 2008 年、2009 年、2010 年分别收到深圳市财政局拨款 500 万元、250 万元、250 万元，合计 1,000 万元。

公司功率 MOSFET 产业化技术已于 2009 年 12 月获得了深圳市企业技术创新促进会鉴字（2009）9 号验收，具备批量生产条件。根据深圳中勤万信会计师事务所有限责任公司出具的深中勤万信特审字[2009]063 号对“功率 MOSFET 产业化”项目资金使用情况的专项审核报告，公司已将政府补贴 1,000 万用于购置相关固定资产，该类资产按 5 年折旧，公司按 5 年摊销“功率 MOSFET 产业化”项目补贴的递延收益。

2、高压系列功率 MOSFET 器件产业化政府补贴说明

2012 年 1 月 4 日，深圳市发展和改革委员会根据深发改[2012]3 号《关于下达金融信息系统灾难恢复专业化服务等高技术产业化示范工程项目 2011 年政府投资计划的通知》文件为公司安排高压系列功率 MOSFET 器件产业化补助资金 300 万元，主要用于公司高压系列功率 MOSFET 器件产业化项目，公司于当年全部收到深圳市财政委员会拨付的该款项。2012 年 4 月 12 日，深圳市发展和改革

革委员会根据深发改[2012]438 号《关于转发国家发展改革委关于下达自主创新和高新技术产业化项目 2012 年中央预算内投资计划的通知》文件，对公司高压系列功率 MOSFET 器件产业化项目补贴 1,000 万元，公司于当年全部收到深圳市财政委员会拨付的该项政府补贴。上述合计收到政府补贴 1,300 万元。

该项目于 2012 年 11 月 2 日经深圳市发展和改革委员会验收，并出具深发改[2012]1252 号文《深圳市发展改革委员会关于深圳深爱半导体股份有限公司高压系列功率 MOSFET 产业化项目通过验收的通知》，同意该项目通过验收。公司将与该项目相关的资产按 5 年折旧，年摊销金额为 260 万元。

3、产业技术进步资金说明

2008 年 7 月 7 日，公司收到深圳市财政局根据深贸工技字〔2008〕54 号文拨入的技术中心建设购买设备专用款 300 万元。2011 年 11 月 8 日公司向深圳市科技工贸和信息化委员会提出资金使用验收申请。2012 年 9 月 25 日深圳日浩会计师事务所出具深浩专审字[2012]419 号《关于深圳深爱半导体股份有限公司企业技术中心建设资助资金使用情况是专项审计报告》，确认公司已按《深圳市产业技术进步资金使用合同书》（合同号 2008-CJ-007）要求购买相关设备。

公司购置的该类设备按 5 年折旧，该专项资金与设备的折旧金额匹配，其中下一年度计入营业外收入为 1,066,747.29 元，其余款项于以后年度递延确认。

（六）其他非流动负债

截至2013年12月31日，公司其他非流动负债余额为26,115,066.08元，均为递延确认的政府补助，具体明细如下：

单位：元

项 目	2013-12-31	2012-12-31
MOSFEET 产业化政府补贴	-	1,999,999.86
新型电力电子器件研发及产业化项目	3,750,000.00	3,750,000.00
高压系列功率 MOSFET 器件产业化政府补贴	7,866,666.67	10,466,666.67
IGBT（绝缘栅双极晶体管）器件研发及产业化	8,500,000.00	1,000,000.00
新型逆导型 IGBT 开发和关键技术攻关	400,000.00	400,000.00
产业技术进步资金	298,399.41	1,365,146.69
功率半导体器件工程实验室	5,300,000.00	-
合 计	26,115,066.08	18,981,813.22

MOSFET 产业化政府补贴、产业技术进步资金说明请参见本节之“（五）其他流动负债”。

1、新型电力电子器件研发及产业化项目说明

工业和信息化部根据《财政部关于下达 2010 年度电子信息产业发展基金第一批项目安排和资金使用计划的通知》下发工信部财[2010]301 号文，规定此款用于新型电力电子器件研发及产业化，项目周期为 2 年，届时需经相关部门验收。2010 年 6 月 29 日，公司收到拨款 300 万元。

深圳市经济贸易与信息化委员会根据深科技创新[2012]267 号文无偿资助公司 75 万元用于新型电力电子器件研发及产业化项目，规定项目完成之日起 6 个月内进行验收并备案。2012 年 12 月 12 日，公司收到拨款 75 万元，该项目尚在申请验收阶段。

2、高压系列功率 MOSFET 器件产业化说明

请参见本节之“（五）其他流动负债”。

另外，2012 年 5 月 17 日，深圳市科技创新委员会根据深科技创新[2012]139 号文向公司拨款 50 万元，并约定此款用于资助高压大电流大功率 MOSFET 新型电力电子器件研发及产业化，届时需有相关部门验收。

3、IGBT（绝缘栅双极晶体管）器件研发及产业化说明

2012 年 12 月 17 日，深圳市国资委出具的《关于对 2012 年度深圳市属国有企业自主创新项目进行奖励扶持的通报》（深国资委[2012]194 号）文件，公司 IGBT（绝缘栅双极晶体管）器件及产业化项目获三等扶持项目，2012 年 12 月 24 日，公司收到深圳市国资委创新扶持资金 100 万元。

2013 年 1 月 7 日，深圳市发展和改革委出具深发改【2013】30 号《深圳市发展改革委关于深圳深爱半导体股份有限公司 IGBT（绝缘栅双极晶体管）器件研发及产业化项目资金申请报告的批复》，同意该项目列入深圳市 2012 年高技术产业发展专项扶持计划，安排政府投资计划国家创新型城市建设专项补助资金 500 万元；公司分别于 2013 年 4 月 27 日、2013 年 9 月 2 日收到深圳市财政委员会拨款 300 万元、150 万元，文件约定此款用于项目研发生产仪器设备和软硬件购置，企业不得随意更改项目建设内容和延迟项目建设进度，项目建设期为 2012-2014 年。

依据《深圳市国资委对市属企业自主创新奖励扶持暂行办法》，深圳市国资委自主创新领导小组对 2013 年市属国企申报的自主创新奖励扶持项目进行了综合评审，将公司的 IGBT 绝缘栅双极晶体管器件研发及产业化评定为二等扶持，奖励 300 万元，公司于 2013 年 12 月 25 日收到拨款 300 万元。

4、新型逆导型 IGBT 开发和关键技术攻关说明

2012 年 12 月 6 日，公司与深圳市科技创新委员会签订《深圳市科技研发资金项目合同书》，资助公司新型逆导型 IGBT 开发和关键技术攻关项目 40 万元，待项目完成之日起 6 个月内，由公司提出项目验收申请，目前项目尚未完成。

5、功率半导体器件工程实验室

2013 年 5 月 23 日，深圳市发展和改革委员会出具深发改【2013】747 号《深圳市发展改革委关于深圳深爱半导体股份有限公司深圳功率半导体器件工程实验室项目资金申请报告的批复》文件，同意组建深圳功率半导体器件工程实验室，建设期为 2012 年-2014 年。2013 年 8 月 5 日，公司收到深圳市财政委员会拨款 500 万元。

依据《深圳市国资委对市属企业自主创新奖励扶持暂行办法》，深圳市国资委自主创新领导小组对 2013 年市属国企申报的自主创新奖励扶持项目进行了综合评审，将公司的深圳功率半导体器件工程实验室评定为市级企业技术中心专项奖励项目，奖励 30 万元。2013 年 12 月 25 日，公司收到深圳市国资委拨款 30 万元。

十、报告期内所有者权益情况

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 348,002,666.16 元、383,719,767.06 元和 390,633,729.99 元，具体情况如下：

单位：元

项 目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
股本	199,000,000.00	199,000,000.00	199,000,000.00
资本公积	106,469,235.01	106,469,235.01	106,469,235.01
盈余公积	10,506,449.50	7,825,053.21	4,253,343.12
未分配利润	74,658,045.48	70,425,478.84	38,280,088.03
所有者权益合计	390,633,729.99	383,719,767.06	348,002,666.16

十一、报告期内现金流量情况

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	15,511,901.62	20,268,982.77	24,209,596.62
投资活动产生的现金流量净额	-57,861,913.96	-34,010,026.75	-24,838,212.51
筹资活动产生的现金流量净额	42,097,849.37	17,922,214.10	12,897,700.18

十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

2014 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，批准 2013 年度利润分配预案：公司不进行利润分配。

2、其他资产负债表日后事项说明

截至本招股说明书签发日止，公司无其他资产负债表日后事项说明。

（二）或有事项

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无或有事项发生。

（三）其他重要事项

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无其他重要事项说明。

十三、报告期内主要财务指标

（一）主要财务指标

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动比率	1.71	1.82	1.64
速动比率	1.16	1.20	0.97
资产负债率（%）	38.35	33.30	35.36

无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例（%）	2.91	3.41	3.30
项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
应收账款周转率（次）	3.27	3.43	4.29
存货周转率（次）	2.44	2.61	2.92
息税折旧摊销前利润（万元）	6,792.37	7,650.61	7,319.89
利息保障倍数（倍）	16.88	13.49	62.73
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.08	0.10	0.12
每股净现金流量（元/股）	0.00	0.02	0.06

注：上述指标的计算公式如下：

流动比率 = 流动资产 ÷ 流动负债

速动比率 = (流动资产 - 存货) ÷ 流动负债

资产负债率 = (负债总额 ÷ 资产总额) × 100%

应收账款周转率 = 营业收入 ÷ 应收账款平均余额

存货周转率 = 营业成本 ÷ 存货平均余额

息税折旧摊销前利润 = 利润总额 + 利息支出 + 折旧支出 + 待摊费用摊销 + 长期待摊费用摊销 + 无形资产摊销

利息保障倍数 = (利润总额 + 利息支出) / 利息支出

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动的现金流量净额 ÷ 期末普通股份总数

每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 ÷ 期末普通股份总数

（二）净资产收益率和每股收益

按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算的公司净资产收益率和每股收益如下：

期间	净利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2013 年	净利润	6.99	0.14	0.14
	扣除非经常性损益后的净利润	5.68	0.11	0.11
2012 年	净利润	9.76	0.18	0.18
	扣除非经常性损益后的净利润	9.02	0.17	0.17
2011 年	净利润	10.57	0.18	0.18
	扣除非经常性损益后的净利润	9.44	0.16	0.16

注：上述指标的计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率

$$= P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；

E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

2、基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

3、稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

十四、资产评估情况

公司由有限公司整体变更设立股份公司时，中联资产评估有限公司于2010年9月30日出具了中联评报字[2010]第813号《资产评估报告》，对公司截至2010年7月31日的全部资产和负债情况采用成本法（即资产基础法）评估，评估结果为：净资产账面价值32,616.92万元，评估值40,132.16万元，评估增值7,515.24万元，增值率23.04%。

本次资产评估仅作为折股参考，公司未根据评估结果进行账务处理。

十五、股东出资、股本变化的验资情况

发行人及其前身设立时及设立后的历次验资情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人历次验资情况”。

第十节 管理层讨论与分析

公司管理层认为，报告期内公司的财务状况、盈利能力、现金流量状况良好，财务结构、各项财务指标等均处于正常水平，符合所从事业务的发展阶段和行业特点。公司主营业务较为稳定，显示出较好的盈利能力和持续发展能力。

一、财务状况分析

（一）资产构成分析

报告期内各期末，公司各类资产金额及占总资产的比例如下：

单位：万元

资 产	2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	37,103.77	58.56%	31,445.26	54.66%	29,545.99	54.88%
非流动资产	26,261.05	41.44%	26,083.54	45.34%	24,294.56	45.12%
资产总计	63,364.81	100.00%	57,528.80	100.00%	53,840.55	100.00%

报告期内，随着公司经营规模扩大，公司资产总额呈现平稳增长态势。截至2011年12月31日、2012年12月31日和2013年12月31日，公司资产总额分别为53,840.55万元、57,528.80万元和63,364.81万元。

从资产构成来看，报告期内流动资产占资产总额的比例较大，表明公司资产流动性较好。截至2011年12月31日、2012年12月31日和2013年12月31日，公司流动资产占资产总额的比例分别为54.88%、54.66%和58.56%，非流动资产占资产总额的比例分别为45.12%、45.34%和41.44%。

1、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产构成如下：

单位：万元

项 目	2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	3,429.87	9.24%	3,683.54	11.71%	3,317.42	11.23%
应收票据	6,956.30	18.75%	4,368.26	13.89%	935.48	3.17%
应收账款	10,346.21	27.88%	11,355.51	36.11%	11,066.07	37.45%

项 目	2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
预付款项	3,626.05	9.77%	1,223.94	3.89%	1,771.35	6.00%
其他应收款	23.27	0.06%	18.76	0.06%	80.85	0.27%
存货	11,969.12	32.26%	10,770.24	34.25%	12,155.06	41.14%
其他流动资产	752.95	2.03%	25.00	0.08%	219.77	0.74%
合 计	37,103.77	100.00%	31,445.26	100.00%	29,545.99	100.00%

报告期内，公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、预付款项及存货组成。

（1）货币资金

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司货币资金余额分别为 3,317.42 万元、3,683.54 万元和 3,429.87 万元，占流动资产的比例分别为 11.23%、11.71%和 9.24%。公司货币资金主要为银行存款，报告期内货币资金余额保持在安全且合理的范围内，能够满足正常生产经营的需要。

（2）应收票据

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司应收票据余额分别为 935.48 万元、4,368.26 万元和 6,956.30 万元，占流动资产的比例分别为 3.17%、13.89%和 18.75%。

公司应收票据均为银行承兑汇票。2011-2013 年，公司应收票据余额及其占流动资产的比例呈逐年增长趋势，主要原因是宏观经济增长放缓背景下，下游客户为节约现金支出，更倾向于采用银行承兑汇票的方式支付公司货款，报告期内，公司客户采用银行承兑汇票支付的比例有所增加，导致期末应收票据占营业收入的比例逐年增加。

（3）应收账款

①应收账款变动分析

报告期内各期末，公司应收账款账面价值及占营业收入比例情况如下：

项 目	2013-12-31/ 2013 年度	2012-12-31/ 2012 年度	2011-12-31/ 2011 年度
营业收入（万元）	37,467.22	40,634.25	46,396.28
应收账款（万元）	10,346.21	11,355.51	11,066.07
应收账款/营业收入	27.61%	27.95%	23.85%

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款占营业收入的比例分别为 23.85%、27.95%和 27.61%。2012 年公司应收账款绝对金额同比减少，其占营业收入的比例有所提高，主要原因为国内外半导体行业增速有所下滑，且市场资金面较为紧张，客户回款速度放慢，使得 2012 年公司应收账款及其占营业收入的比例增加。

②应收账款质量分析

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 11,066.07 万元、11,355.51 万元和 10,346.21 万元，占流动资产的比例分别为 37.45%、36.11%和 27.88%。

报告期内各期末，公司应收账款占流动资产的比例呈逐年减少的趋势，公司应收账款的账龄大多在 1 年以内，流动性较高，应收账款质量较好，发生坏账的风险较小。

报告期内，公司应收账款账龄情况如下：

单位：万元

账 龄	2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	10,797.58	98.80%	11,831.06	98.54%	11,487.39	98.12%
1-2 年	122.81	1.12%	150.01	1.25%	214.79	1.83%
2-3 年	2.46	0.02%	19.84	0.17%	5.38	0.05%
3-5 年	6.54	0.06%	5.38	0.04%	-	-
合 计	10,929.39	100.00%	12,006.30	100.00%	11,707.56	100.00%

③应收账款金额前五名单位情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款金额前五名客户情况如下：

客户名称	金额(万元)	账龄	占应收账款 总额比例
镇江强凌电子有限公司	806.98	1 年以内	7.39%
四川立泰电子有限公司	805.75	1 年以内	7.37%
宁波明昕微电子股份有限公司	424.81	1 年以内	3.89%
印度 NTL 电子有限公司	403.42	1 年以内	3.69%
宁波凯耀电器制造有限公司	355.48	1 年以内	3.25%
合 计	2,796.45		25.59%

上表可以看出，上述客户的欠款占应收账款总额的比例较为分散，不存在个

别客户欠款比例过大的情况，且应收账款账龄大都在 1 年以内，质量较高，发生坏账损失的可能性较小。

（4）预付款项

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司预付款项余额分别为 1,771.35 万元、1,223.94 万元和 3,626.05 万元，占同期末流动资产的比例分别为 6.00%、3.89%和 9.77%。

公司预付款项账龄基本在 1 年以内，主要为预付的机器设备购置款。2012 年末，公司预付款项减少了 547.41 万元的原因是前期预付购买的设备在当年通过验收后转入固定资产所致。2013 年末，公司预付款项余额同比增加 2,402.11 万元，占流动资产的比例增加，主要原因为 2013 年公司根据生产经营、技术进步的需要以自有资金预先投入 IPO 募投项目，提前购置部分 6 英寸生产线设备以及配套动力设备，导致 2013 年年末公司预付款项大幅增加。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预付款项余额前五名情况如下：

单位名称	与公司关系	金额（万元）	预付时间	未结算原因
绿谷工业	非关联方	2,821.28	2013 年	预付设备款
FMJ TECH CORPORATION	非关联方	201.48	2013 年	预付设备款
ASM Pacific(Hong Kong)Ltd	非关联方	177.79	2013 年	预付设备款
SEMI-SYSTEM TECHNOLOGY,LLC	非关联方	85.60	2013 年	预付设备款
KINGTECH SEMICONDUCTOR EQUIPMENT SERVICE	非关联方	73.47	2013 年	预付设备款
合 计		3,359.61		

（5）存货

报告期内各期末，公司存货账面价值情况如下：

单位：万元

项 目	2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	719.74	6.01%	965.35	8.96%	1,751.55	14.41%
在产品	3,812.69	31.85%	3,916.52	36.36%	3,781.97	31.11%
库存商品	3,391.42	28.33%	2,759.79	25.62%	2,809.09	23.11%
周转材料	265.98	2.22%	332.19	3.08%	794.19	6.53%
自制半成品	3,584.52	29.95%	2,474.04	22.97%	2,671.72	21.98%

项 目	2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
发出商品	194.77	1.63%	322.34	2.99%	336.73	2.77%
委托加工物资	-	-	-	-	9.81	0.08%
合 计	11,969.12	100.00%	10,770.24	100.00%	12,155.06	100.00%

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司存货账面价值分别为 12,155.06 万元、10,770.24 万元和 11,969.12 万元，占当期末流动资产的比例分别为 41.14%、34.25%和 32.26%。

公司存货主要由在产品、库存商品、自制半成品及原材料构成，报告期内各期末合计占存货账面价值比例分别为 90.62%、93.92%和 96.15%，存货账面价值及构成基本保持稳定。公司存货中的库存商品为成品管，自制半成品为芯片产品。

2012 年公司加强了原材料的采购管理，持续优化原材料的库存管理，减少对流动资金的占用，使得 2012 年末原材料库存金额同比降低 786.20 万元。2013 年末，公司自制半成品同比增加 1,110.47 万元，占存货的比例提高了 6.98 个百分点；库存商品同比增加 631.62 万元，占存货比例增加 2.71 个百分点，主要原因公司产品的生产环节较多，生产周期较长，而 2014 年农历新年为 1 月末，为减少年后出货压力，公司适当增加自制半成品、成品管的安全库存。

2、非流动资产的构成

报告期内各期末，公司非流动资产构成如下：

单位：万元

资 产	2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
投资性房地产	570.24	2.17%	670.01	2.57%	264.01	1.09%
固定资产	23,130.78	88.08%	22,995.03	88.16%	22,109.68	91.01%
在建工程	453.24	1.73%	241.75	0.93%	75.57	0.31%
无形资产	1,468.62	5.59%	1,650.39	6.33%	1,499.36	6.17%
递延所得税资产	638.17	2.43%	526.36	2.02%	345.94	1.42%
合 计	26,261.05	100.00%	26,083.54	100.00%	24,294.56	100.00%

(1) 投资性房地产

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司投资性房地产账面价值分别为 264.01 万元、670.01 万元和 570.24 万元。2011 年

公司投资性房地产同比增加 256.17 万元，主要由于公司办公职能部门及封装部由八卦岭搬迁到龙岗新厂区，原厂房用于对外出租转为投资性房地产所致；2012 年公司制造一部搬迁到龙岗新厂区，其原使用的八卦岭厂房第一层及隔层、动力配套房转为对外出租，导致投资性房地产期末账面价值大幅增加。

（2）固定资产

报告期内各期末，公司固定资产具体情况如下：

单位：万元

项 目	2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
房屋及建筑物	14,043.78	60.71%	14,755.24	64.17%	15,649.59	70.78%
机器设备	2,112.86	9.13%	2,565.92	11.16%	2,628.44	11.89%
运输设备	19.62	0.08%	27.48	0.12%	41.97	0.19%
电子设备	6,077.28	26.27%	4,395.47	19.11%	3,029.93	13.70%
其他设备	877.24	3.79%	1,250.93	5.44%	759.75	3.44%
合 计	23,130.78	100.00%	22,995.03	100.00%	22,109.68	100.00%

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司固定资产账面价值分别为 22,109.68 万元、22,995.03 万元和 23,130.78 万元，占各期末非流动资产总额的比例分别为 91.01%、88.16%和 88.08%。公司固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备及电子设备构成，报告期内各期末，合计占固定资产的比例分别为 96.37%、94.44%和 96.12%。

为满足公司生产经营的需要，报告期内公司对固定资产保持持续投入。2011 年末，公司固定资产账面价值较上年末增长 5,534.80 万元，增幅达 33.39%，其中，房屋及建筑物与机器设备期末账面价值明显增加，主要原因是深爱芯园单身宿舍、后封装大楼由在建工程转入固定资产导致。2012 年新增的固定资产主要为购买的电子设备及其他设备，2013 年新增的固定资产主要为电子设备，包括两种设备：一种用于部分生产设备的升级换代，另一种为新增 MOS 芯片研发或生产设备。其他设备主要为电脑、空调等辅助设备。

（3）在建工程

报告期内各期末，公司在建工程具体情况如下：

单位：万元

项 目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
在建工程余额	453.24	241.75	75.57
占非流动资产比重	1.73%	0.93%	0.31%

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司在建工程余额分别为 75.57 万元、241.75 万元和 453.24 万元，分别占非流动资产比重为 0.31%、0.93%和 1.73%。

2011 年末，在建工程余额同比减少 5,401.92 万元，主要原因是深爱芯园单身宿舍、后封装大楼建成投入使用，由在建工程转入固定资产导致。2012 年末，公司在建工程余额同比增加 219.92%，主要由于当年公司根据生产经营需要新增纯水工程、制氮工程等在建工程项目。2013 年末，公司在建工程余额增加 211.49 万元，主要为 6 英寸生产线建设前期费用的支出、新增的尚待验收或安装的设备以及废水回用工程的建设投入。

（4）无形资产

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司无形资产分别为 1,499.36 万元、1,650.39 和 1,468.62 万元，占当年非流动资产总额的比例分别为 6.17%、6.33%和 5.59%。

公司无形资产包括土地使用权、软件、专利及专有技术，具体情况如下：

单位：万元

项 目	2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
土地使用权	333.83	22.73%	342.11	20.73%	350.40	23.37%
软件	30.92	2.11%	40.43	2.45%	30.92	2.06%
专利及专有技术	1,103.88	75.16%	1,267.85	76.82%	1,118.05	74.57%
合 计	1,468.62	100.00%	1,650.39	100.00%	1,499.36	100.00%

2012 年末，公司无形资产同比增加 151.03 万元，主要原因是高压系列功率 MOSFET 项目资本化形成专利及专有技术 289.68 万元所致。

3、公司资产减值准备计提情况

报告期内，公司各项资产减值准备计提情况如下：

单位：万元

项 目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
一、坏账准备	592.34	660.70	661.04

项 目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
其中：应收账款	583.18	650.78	641.50
其他应收款	9.16	9.91	19.54
二、存货跌价准备	435.55	419.13	216.30
合 计	1,027.90	1,079.83	877.34

报告期内，公司计提减值准备的资产主要是应收账款与存货，固定资产、在建工程、无形资产等资产未发生减值情况，故未计提减值准备。

（1）应收款项坏账准备计提情况

截至2013年12月31日，公司坏账准备余额为592.34万元，其中应收账款坏账准备余额为583.18万元，其他应收款坏账准备余额为9.16万元。

报告期内，公司按账龄分析法对期末应收账款、其他应收款计提坏账准备，期末对于单项金额重大，以及单项金额虽不重大但坏账迹象明显的应收款项单独进行减值测试。公司对不单独进行减值测试的应收款项，以及单独测试未发生减值的应收款项，按以期末余额的账龄作为信用风险特征，按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备。具体计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	30	30
2—3 年	50	50
3—5 年	80	80
5 年以上	100	100

公司根据历史收款经验、自身行业特点、货款结算周期等制定坏账准备计提政策。报告期内，公司应收账款账龄大多在1年以内，应收账款回款情况良好，未发生实际坏账情况。

（2）存货减值准备计提情况

公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。截至2013年12月31日，公司存货跌价准备余额为435.55万元。2013年计提的存货跌价准备主要是部分自制半成品单位生产成本较高，公司根据市场价估算其可变现净值并按其低于账面成本的差额计提跌价准备。

4、公司管理层对于资产状况的评价

综合以上分析，公司管理层认为：公司资产流动性强，资产质量良好，资产

结构合理，与公司现阶段发展状况相适应。

（二）负债构成分析

1、负债的主要构成及分析

报告期内各期末，公司各类负债金额及占负债总额的比例如下：

单位：万元

项 目	2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：						
短期借款	7,395.94	30.43%	4,984.05	26.02%	2,800.00	14.71%
应付票据	5,197.59	21.39%	4,113.40	21.47%	3,182.32	16.71%
应付账款	7,136.18	29.37%	6,312.23	32.95%	10,006.40	52.55%
预收款项	24.51	0.10%	76.41	0.40%	214.71	1.13%
应付职工薪酬	884.10	3.64%	546.57	2.85%	467.71	2.46%
应交税费	254.73	1.05%	498.19	2.60%	152.94	0.80%
应付利息	36.76	0.15%	5.08	0.03%	5.78	0.03%
其他应付款	193.47	0.80%	131.93	0.69%	970.43	5.10%
其他流动负债	566.67	2.33%	590.79	3.08%	200.00	1.05%
流动负债合计	21,689.93	89.25%	17,258.64	90.09%	18,000.29	94.54%
非流动负债：						
专项应付款	-	-	-	-	300.00	1.58%
其他非流动负债	2,611.51	10.75%	1,898.18	9.91%	740.00	3.89%
非流动负债合计	2,611.51	10.75%	1,898.18	9.91%	1,040.00	5.46%
负债合计	24,301.44	100.00%	19,156.82	100.00%	19,040.29	100.00%

报告期内，公司负债主要为流动负债。截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日，公司负债总额分别为 19,040.29 万元、19,156.82 万元和 24,301.44 万元，流动负债占负债总额的比例分别为 94.54%、90.09%和 89.25%。

公司负债主要由短期借款、应付票据、应付账款以及其他非流动负债构成。

（1）短期借款

截至2011年12月31日、2012年12月31日和2013年12月31日，公司短期借款余额分别为2,800.00万元、4,984.05万元和7,395.94万元，占负债总额的比例分别为

14.71%、26.02%和30.43%。

报告期内，公司短期借款的构成如下：

单位：万元

项 目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
银行借款	4,100.00	2,600.00	2,800.00
已贴现未到期的应收票据	3,295.94	2,384.05	-
合 计	7,395.94	4,984.05	2,800.00

2011-2012年公司短期借款余额逐年增加的主要原因为：2011年公司根据生产经营需要，向银行借款2,800万元以补充流动资金。2012年公司收到承兑汇票金额较大，因此将部分银行承兑汇票贴现，截至2012年12月31日，尚有2,384.05万元票据已贴现但未到期，公司将该部分票据列入短期借款核算。2013年公司短期借款增加2,411.89万元，主要由于银行借款增加1,500万元，已贴现未到期的应收票据增加911.89万元。

（2）应付票据

截至2011年12月31日、2012年12月31日和2013年12月31日，公司应付票据余额分别为3,182.32万元、4,113.40万元和5,197.59万元，占负债总额的比例分别为16.71%、21.47%和21.39%。

公司应付票据为开具的银行承兑汇票，主要用于支付原材料采购款。为节约流动资金的占用，减少财务费用的发生，公司更倾向于采用银行承兑汇票对供应商进行结算，2011-2013年公司开具银行承兑汇票的金额逐年增加，应付票据余额持续增长。

（3）应付账款

截至2011年12月31日、2012年12月31日和2013年12月31日，公司应付账款余额分别为10,006.40万元、6,312.23万元和7,136.18万元，占负债总额的比例分别为52.55%、32.95%和29.37%。

2011年末，公司应付账款余额较上年末增长了1,880.62万元，主要原因为公司为了增加流动资金，加强应付账款管理，在不违反信用政策的前提下，合理地推迟支付供应商的付款时间，减少对流动资金占用。

2012年末应付账款余额较2011年末减少3,694.17万元是由于：（1）公司当年营业收入有所下降，导致当年采购金额有所减少；（2）公司优化了原材料的采购

管理。

2013年年末，公司应付账款余额同比增加823.95万元，主要由于2013年第四季度公司采购金额同比有所增加。

（4）其他应付款

截至2011年12月31日、2012年12月31日和2013年12月31日，公司其他应付款余额分别为970.43万元、131.93万元和193.47万元，占负债总额的比例分别为5.10%、0.69%和0.80%。

2011年末，公司其他应付款余额较2010年末减少了2,661.77万元，主要原因是2011年公司归还了赛格集团的往来款3,500.00万元，从而使得其他应付款余额减少。2012年末其他应付款余额较2011年末减少了838.50万元，主要原因为完成对相关欠款的支付。

（5）其他非流动负债

截至2011年12月31日、2012年12月31日和2013年12月31日，公司其他非流动负债余额分别为740.00万元、1,898.18万元和2,611.51万元，占负债总额的比例分别为3.89%、9.91%和10.75%。

公司其他非流动负债主要为收到的政府补助款项，该部分政府补助是对公司技术研发项目的支持，须经项目专项验收后方可开始摊销。2012年末，公司其他非流动负债余额较2011年末增加1,158.18万元，主要由于高压系列功率MOSFET器件产业化项目相关政府补贴计入其他非流动负债所致。2013年末，公司其他非流动负债同比增加713.33万元，主要因为收到了IGBT（绝缘栅双极晶体管）器件研发及产业化、功率半导体器件工程实验室政府补助资金共计1,280万元。

2、公司管理层对于负债状况的评价

公司管理层认为：公司实施稳健的财务政策，资产负债率保持在较低水平。截至2013年12月31日，公司资产负债率为38.35%，息税折旧摊销前利润为6,792.37万元，利息保障倍数为16.88倍。公司资产负债状况良好，具备较强的盈利能力和短期偿债能力。

（三）偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动比率	1.71	1.82	1.64
速动比率	1.16	1.20	0.97
资产负债率（%）	38.35	33.30	35.36
财务指标	2013 年度	2012 年度	2011 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	6,792.37	7,650.61	7,319.89
利息保障倍数（倍）	16.88	13.49	62.73

报告期内，公司流动比率和速动比率总体波动较小。2012 年末公司流动比率、速动比率同比有所增加，主要由于 2012 年公司应付账款同比减少 3,694.17 万元；2013 年末流动比率、速动比率同比有所降低，主要由于公司短期借款、应付款项余额同比有所增加。

截至 2011 年末、2012 年末和 2013 年末，公司资产负债率分别为 35.36%、33.30%和 38.35%，总体负债水平较低，表明公司经营较为稳健。

报告期内，公司息税折旧摊销前利润基本保持稳定。2013 年息税折旧摊销前利润同比减少 858.24 万元，主要原因为公司综合毛利率同比减少 1.18 个百分点，毛利同比减少 1,209.89 万元。

报告期内，利息保障倍数处于较高水平，债务利息偿还能够得到保障。2011 年利息保证倍数较 2010 年提高了 376.31%，主要原因系 2011 年盈利水平同比大幅提高所致；2012 年利息保障倍数较 2011 年降低 78.50%，主要原因系 2011 年公司大部分银行借款在 12 月份才发生，而 2012 年全年银行借款余额均较大，使得公司 2012 年利息支出大幅增加。2013 年利息保障倍数增长了 25.13%，主要原因为公司利息支出同比减少了 42.09%。

（四）资产运营能力分析

报告期内，公司资产周转能力指标如下：

单位：次

财务指标	2013 年度	2012 年度	2011 年度
应收账款周转率	3.27	3.43	4.29
存货周转率	2.44	2.61	2.92

报告期内，公司应收账款周转率分别为 4.29 次、3.43 次、3.27 次，整体处于正常水平，但呈现逐年减少的趋势，主要原因为受国内外半导体市场增速放缓

的影响，公司主营业务收入有所下滑。

报告期内，公司存货周转率分别为 2.92 次、2.61 次、2.44 次，整体处于合理水平，但逐年略有下滑，主要原因为报告期内公司存货账面价值较为稳定，而公司营业成本逐年下降，导致存货周转率不断减少。

二、盈利能力分析

报告期内，公司经营情况如下：

单位：万元

项目	2013 年	2012 年	2011 年
营业收入	37,467.22	40,634.25	46,396.28
营业毛利	8,660.54	9,870.43	10,712.60
营业利润	2,396.45	3,715.27	3,366.47
利润总额	2,964.93	4,028.94	3,808.51
净利润	2,681.40	3,571.71	3,494.79
扣除非经常损益后的净利润	2,178.57	3,300.19	3,119.05

公司净利润主要来源于主营业务。报告期内，公司营业收入、营业毛利逐年下滑，实现净利润分别为 3,494.79 万元、3,571.71 万元、2,681.40 万元。2012 年，公司营业毛利同比下滑了 842.17 万元，但净利润同比增长 76.92 万元，主要原因为管理费用中的研发费用同比减少 1,099.58 万元，销售费用同比减少 201.95 万元；2013 年，公司净利润同比减少 890.31 万元，主要原因为销售毛利率降低了 1.18 个百分点，导致营业毛利减少了 1,209.89 万元。

报告期内，公司扣除非经常性损益后的净利润分别为 3,119.05 万元、3,300.19 万元、2,178.57 万元，其变化趋势与净利润变化趋势基本一致，公司非经常性损益主要来自于政府补助。

（一）营业收入分析

1、营业收入构成分析

报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元

项 目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例

主营业务收入	36,441.46	97.26%	39,959.18	98.34%	45,269.82	97.57%
其他业务收入	1,025.76	2.74%	675.08	1.66%	1,126.47	2.43%
合 计	37,467.22	100.00%	40,634.25	100.00%	46,396.28	100.00%

报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务收入，主营业务收入占营业收入的比例均在 97%以上，主营业务非常突出。

2、主营业务收入变动分析

受终端产品销售价格下降以及下游节能照明领域需求增速减缓的影响，报告期内，公司主营业务收入分别为 45,269.82 万元、39,959.18 万元和 36,441.46 万元，呈现逐年下降的趋势。

2012 年公司主营业务收入较 2011 年减少 5,310.64 万元，同比减少 11.73%，其中成品管销售收入减少 2,919.23 万元，同比减少 10.83%；芯片销售收入减少 2,391.42 万元，同比减少 13.05%。2013 年公司主营业务收入减少 3,517.72 万元，同比减少 8.80%，其中成品管销售收入减少 1,649.06 万元，同比减少 6.86%；芯片销售收入减少 1,868.66 万元，同比减少 11.73%。

报告期内，公司主要产品的销售量和单价变化情况如下：

单位：元/只，万只；元/片，片

项 目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	单价	销量	单价	销量	单价	销量
成品管	0.210	106,320.71	0.220	109,257.96	0.227	118,933.93
芯片	247.415	568,468.00	264.094	603,323.00	258.867	707,886.00

2012 年公司主营业务收入降低主要是由于受宏观经济及半导体行业需求增速放缓的影响，公司主要产品的销量、成品管单价均出现一定程度下降，其中主要产品销量减少影响主营业务收入减少 4,898.92 万元，减少比例为 10.82%；成品管单价下滑了 0.007 元/只，芯片单价上涨了 5.227 元/片，主要产品单价变化影响主营业务收入减少 421.45 万元，下降比例为 0.93%。另外，芯片销量减少还因为 2012 年公司 4 英寸芯片停产，相关设备由八卦岭搬迁到龙岗新产区用于 5 英寸芯片生产，当年 4 英寸芯片销量减少 62.54%，5 英寸芯片销量同比增加 15.13%。

2013 年，国内半导体行业并未出现实质性复苏，公司主要产品销量、单价均有所下滑，其中单价下滑对主营业务收入减少的影响最大。主要产品的单价下滑影响主营业务收入减少 2,037.17 万元，减少比例为 5.10%；主要产品的销量减

少影响主营业务收入减少 1,566.40 万元，减少比例为 3.92%。

3、与同行业上市公司营业收入变动分析

报告期内，公司与同行业上市公司营业收入同比变化情况如下：

期 间	华微电子	东光微电	士兰微	平均	本公司
2013 年度	18.27%	43.41%	21.42%	27.70%	-7.79%
2012 年度	-3.92%	-12.36%	-12.74%	-9.67%	-12.43%
2011 年度	-4.34%	-14.50%	1.79%	-5.68%	0.44%

受国内外宏观经济影响，2011-2012 年行业内上市公司营业收入基本呈现下降趋势，同行业上市公司营业收入平均增长率为-5.68%、-9.67%，公司营业收入增长率分别为 0.44%、-12.43%，与同行业上市公司营业收入变化趋势基本一致。

2013 年上半年公司所处行业景气度有所回升，下半年市场需求又出现了回落。2013 年度，同行业上市公司营业收入同比平均增长 27.70%，公司营业收入同比减少 7.79%。其中：华微电子营业收入增长是由于其高端二极管、MOSFET 产品销售和出口销售收入实现稳步增长；东光微电营业收入实现增长的原因为新产品的推广、合并计算收购公司的收入；士兰微营业收入增长的原因为新产品上量进度加快，集成电路、分立器件芯片、功率器件成品、发光二极管产品的营业收入均较去年同期有所增加，其中功率器件成品的营业收入继续保持了快速增长。公司受制于新产品产能较小、新产品尚未实现规模化生产与销售、传统节能灯领域产品受市场环境压制等原因，主要产品价格与销量同时下降，使得当年营业收入出现下滑。

4、主营业务收入的构成分析

(1) 按产品分类

单位：万元

产品名称	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
成品管	22,376.71	61.40%	24,025.77	60.13%	26,945.00	59.52%
芯片	14,064.75	38.60%	15,933.41	39.87%	18,324.82	40.48%
合 计	36,441.46	100.00%	39,959.18	100.00%	45,269.82	100.00%

公司主要从事半导体分立器件芯片及成品管的研发、生产和销售。2011 年度、2012 年度及 2013 年度，成品管销售收入占主营业务收入的比例分别为

59.52%、60.13%和 61.40%，芯片销售收入占主营业务收入的比例分别为 40.48%、39.87%和 38.60%，报告期内，主营业务收入构成较为稳定，其中成品管销售收入占比较高。

（2）主营业务收入地区构成分析

报告期内，公司主营业务收入按照地区构成分类如下：

单位：万元

地 区	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
境内	31,971.09	87.73%	36,021.31	90.15%	41,760.81	92.25%
境外	4,470.37	12.27%	3,937.87	9.85%	3,509.01	7.75%
合 计	36,441.46	100.00%	39,959.18	100.00%	45,269.82	100.00%

中国已成为全球的节能灯生产大国，产量占全球总产量的 80%以上，因此公司的产品主要供应国内相关企业，直接出口销售的金额较少。2011 年度、2012 年度及 2013 年度，公司境内销售占主营业务收入的比例分别为 92.25%、90.15%和 87.73%；境外销售占主营业务收入的比例分别为 7.75%、9.85%和 12.27%。

（二）营业成本

报告期内，公司营业成本构成如下：

单位：万元

项 目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	28,631.60	99.39%	30,673.96	99.71%	34,912.53	97.84%
其他业务成本	175.09	0.61%	89.86	0.29%	771.16	2.16%
营业成本合计	28,806.68	100.00%	30,763.82	100.00%	35,683.69	100.00%

报告期内，公司的成本构成及变动情况如下（包括成品管和芯片）：

单位：万元

项 目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	14,495.73	50.63%	16,808.46	54.80%	19,138.93	54.82%
其中：						
4"单晶片	148.06	0.52%	634.33	2.07%	1,746.18	5.00%
5"单晶片	3,405.23	11.89%	4,202.44	13.70%	3,876.55	11.10%
外延片	1,314.91	4.59%	769.01	2.51%	1,159.00	3.32%

项 目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
抛光片	925.39	3.23%	883.21	2.88%	1,179.14	3.38%
蒸发金	217.37	0.76%	1,164.25	3.80%	1,228.22	3.52%
化学试剂	2,331.03	8.14%	2,523.38	8.23%	2,909.70	8.33%
引线框架	3,340.96	11.67%	3,691.56	12.03%	4,228.45	12.11%
塑封料	714.23	2.49%	794.54	2.59%	741.95	2.13%
其他材料	2,098.54	7.33%	2,145.73	7.00%	2,069.75	5.93%
燃料和动力	4,418.42	15.43%	5,062.31	16.50%	5,048.90	14.46%
其中：水	343.25	1.20%	344.61	1.12%	324.47	0.93%
电力	3,477.75	12.15%	3,380.86	11.02%	3,355.57	9.61%
气体	597.42	2.09%	1,336.84	4.36%	1,368.86	3.92%
直接人工	4,275.16	14.93%	3,748.99	12.22%	4,180.25	11.97%
制造费用	5,442.29	19.01%	5,054.21	16.48%	6,544.45	18.75%
合 计	28,631.60	100.00%	30,673.96	100.00%	34,912.53	100.00%

报告期内，公司成本主要由原材料、燃料和动力、直接人工和制造费用构成。

报告期内，原材料占成本的比例分别为 54.82%、54.80%和 50.63%，2012 年与 2011 年原材料占比基本持平，2013 年原材料成本占比同比下降了 4.17 个百分点，主要原因为公司 2013 年原材料采购单价均出现了不同程度下降，其中 5" 单晶片采购均价同比下降了 10.07%，引线框架采购均价同比下降了 6.02%，使得耗用的原材料成本同比有所降低。

报告期内，燃料和动力占成本的比例分别为 14.46%、16.50%和 15.43%。2012 年燃料和动力占成本比例有所上升，主要由于电价上涨，2012 年同比上涨了 4.17 个百分点。此外，水价同比上涨 21.85%导致水占成本的比例增加 0.18 个百分点。2013 年燃料和动力占成本比例下降了 1.07 个百分点，主要原因为公司租赁制氮设备在厂区内现场制氮气直接供应生产，代替从供应商采购气体后运回公司的方式，使得氮气成本大幅降低。

报告期内，直接人工占成本的比例分别为 11.97%、12.22%和 14.93%，呈现逐年增长的趋势，这是由于报告期内深圳市最低工资标准不断上涨，公司为创造有竞争力的薪酬环境，不断提高生产工人的薪酬待遇，导致人工成本上升。

报告期内，制造费用占成本的比例分别为 18.75%、16.48%和 19.01%。2012

年公司制造费用占成本的比例减少 2.27 个百分点，主要由于公司制造一部由八卦岭整体搬迁到龙岗新厂区，发挥集约化生产优势，芯片制造费用有所减少。2013 年公司制造费用增加了 388.08 万元，主要由于新增设备影响折旧增加 318.16 万元。

（三）营业毛利分析

1、营业毛利构成

报告期内，公司营业毛利构成如下：

单位：万元

项 目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务毛利	7,809.86	90.18%	9,285.22	94.07%	10,357.29	96.68%
其中：成品管	4,692.15	54.18%	4,859.42	49.23%	5,083.09	47.45%
芯片	3,117.72	36.00%	4,425.79	44.84%	5,274.19	49.23%
其他业务毛利	850.67	9.82%	585.21	5.93%	355.31	3.32%
合 计	8,660.54	100.00%	9,870.43	100.00%	10,712.60	100.00%

报告期内，公司营业毛利主要为主营业务毛利，包括成品管与芯片的销售毛利。

2、毛利率分析

报告期内，公司毛利率情况如下：

项 目	2013 年度		2012 年度		2011 年度
	毛利率	同比变动	毛利率	同比变动	毛利率
主营业务毛利率	21.43%	-1.81%	23.24%	0.36%	22.88%
其中：成品管	20.97%	0.74%	20.23%	1.36%	18.86%
芯片	22.17%	-5.61%	27.78%	-1.00%	28.78%
其他业务毛利率	82.93%	-3.76%	86.69%	55.15%	31.54%
综合毛利率	23.11%	-1.18%	24.29%	1.20%	23.09%

报告期内，公司综合毛利率分别为 23.09%、24.29%和 23.11%，基本保持平稳，表明公司具有良好的盈利能力。

报告期内，公司综合毛利率变化主要由于主营业务毛利的变化所致，公司主营业务毛利率分别为 22.88%、23.24%和 21.43%。

（1）2012 年毛利率同比略有增长的原因

2012 年公司毛利率同比略有上升，主要因为 2012 年公司制造一部由八卦岭整体搬迁到龙岗新厂区，有效发挥集约化生产优势，公司制造费用减少 1,118.87 万元，制造费用占成本的比例减少 2.27 个百分点。

另外，公司加强内部生产管理，提高生产人员的操作技能，稳步提升生产效率，芯片的合格率同比得到进一步提高，其中 4 英寸芯片的合格率由 86.78% 提高到 88.38%，5 英寸芯片的合格率由 88.35% 提高到 90.23%。

（2）2013 年毛利率略有下降的原因

2013 年公司主营业务毛利率为 21.43%，同比减少 1.81 个百分点，分产品来看，成品管毛利率为 20.97%，同比增长 0.74 个百分点；芯片毛利率为 22.17%，同比降低 5.61 个百分点。芯片毛利率降低是导致主营业务毛利率降低的主要原因。

芯片毛利率下滑主要受销售均价持续下跌以及芯片销售结构变化的影响。2013 年，单晶片等原材料的价格同比有所下降，但受欧债危机持续蔓延以及国内经济增速放缓的影响，各芯片企业的价格竞争愈加激烈，下游客户对芯片采购的报价持续下滑，导致公司 2013 年芯片平均售价下滑了 6.32%，抵消了部分原材料价格下跌的影响。另外，公司芯片销售结构的变化也是芯片毛利率下降的因素之一。公司在巩固传统节能照明市场的同时正向电源领域和 LED 照明领域应用发展，积极拓展 MOSFET、IGBT 等高端新产品，但由于目前新产品尚未达到规模化生产，生产成本较高，毛利率偏低。2013 年公司新产品的销售数量与金额同比出现较大增长，导致芯片的整体毛利率有所降低。

3、同行业毛利率水平

报告期内，可比上市公司的主营业务毛利率情况如下：

公司名称	2013 年度	2012 年度	2011 年度
华微电子	20.89%	21.97%	28.87%
东光微电	15.42%	17.71%	25.04%
士兰微	25.56%	22.03%	30.92%
平均	20.62%	20.57%	28.28%
本公司	21.43%	23.24%	22.88%

2011 年公司主营业务毛利率低于同行业上市公司主营业务毛利率，2012 年-2013 年同行业上市公司主营业务毛利率大多呈现下降的趋势，公司主营业务毛

利率则在 21%-23%之间波动，略高于同行业上市公司平均水平。公司与上表三家公司虽同属于一个行业，但各自生产的产品及应用领域有所不同，报告期内公司生产的半导体分立器件主要应用于照明领域，同行业上市公司的产品则用于照明领域、小家电领域、通讯领域及消费电子领域等，因此公司的毛利率及变动趋势与同行业上市公司的变动略有差异。

4、主要产品、主要原材料价格变动的敏感性分析

报告期内影响公司综合毛利率的因素众多，现以主要产品销售价格和原材料价格两个主要因素对综合毛利率的敏感性变动分析如下：

假定原材料价格、销量、人工成本及制造费用不变，则公司主要产品售价变动对公司综合毛利率的敏感性影响如下：

产品售价 变动幅度	综合毛利率变动幅度		
	2013 年度	2012 年度	2011 年度
10%	29.48%	27.91%	29.61%
5%	15.43%	14.61%	15.49%
-5%	-17.00%	-16.12%	-17.08%
-10%	-35.84%	-33.99%	-36.02%

假定产品售价、销量、人工成本及制造费用不变，则公司原材料价格变动对综合毛利率的敏感性影响如下：

原材料价格 变动幅度	综合毛利率变动幅度		
	2013 年度	2012 年度	2011 年度
10%	-16.74%	-17.03%	-17.87%
5%	-8.37%	-8.51%	-8.93%
-5%	8.37%	8.51%	8.93%
-10%	16.74%	17.03%	17.87%

从上述敏感性分析结果来看，公司主要产品销售价格变动相对于原材料价格变动对综合毛利率的变动影响更大，综合毛利率对产品销售价格更敏感。

（四）利润表项目分析

公司利润表按主要项目列示如下：

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	37,467.22	40,634.25	46,396.28

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
减：营业成本	28,806.68	30,763.82	35,683.69
营业税金及附加	71.84	184.07	245.33
销售费用	867.33	666.58	868.53
管理费用	4,912.23	4,700.90	5,895.16
财务费用	464.62	401.04	187.59
资产减值损失	-51.93	202.57	149.52
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润	2,396.45	3,715.27	3,366.47
加：营业外收入	708.55	362.79	624.63
减：营业外支出	140.08	49.12	182.59
其中：非流动资产处置损失	35.00	2.45	31.27
三、利润总额	2,964.93	4,028.94	3,808.51
减：所得税费用	283.53	457.23	313.72
四、净利润	2,681.40	3,571.71	3,494.79

1、营业收入、营业成本和营业毛利

关于营业收入的分析请参见本节之“二、盈利能力分析”之“（一）营业收入分析”；关于营业成本和营业毛利的分析请参见本节之“二、盈利能力分析”之“（二）营业成本”和“（三）营业毛利分析”。

2、营业税金及附加

报告期内，公司的营业税金及附加明细情况如下：

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
城市维护建设税	41.91	107.56	143.10
教育费附加	17.96	46.10	61.35
地方教育费附加	11.97	30.41	40.89
合 计	71.84	184.07	245.33

3、期间费用

报告期内，公司期间费用情况如下：

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
-----	---------	---------	---------

	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比
销售费用	867.33	2.31%	666.58	1.64%	868.53	1.87%
管理费用	4,912.23	13.11%	4,700.90	11.57%	5,895.16	12.71%
财务费用	464.62	1.24%	401.04	0.99%	187.59	0.40%
合 计	6,244.18	16.67%	5,768.52	14.20%	6,951.27	14.98%

报告期内，公司各项期间费用占营业收入的比例较为稳定，不存在异常波动的情况。

（1）销售费用

报告期内，公司销售费用主要包括职工薪酬、运输费、业务费以及差旅费，具体明细如下：

单位：万元

项 目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	427.38	49.28%	278.85	41.83%	368.59	42.44%
运输费	199.16	22.96%	156.32	23.45%	165.98	19.11%
业务费	138.00	15.91%	145.78	21.87%	171.52	19.75%
差旅费	69.99	8.07%	50.31	7.55%	57.42	6.61%
租赁费	8.41	0.97%	9.39	1.41%	21.88	2.52%
其他	24.39	2.81%	25.92	3.89%	83.14	9.57%
合 计	867.33	100.00%	666.58	100.00%	868.53	100.00%

报告期内，职工薪酬为销售费用的最主要构成部分。2012 年销售人员职工薪酬有所下降，主要原因是公司销售人员的工资与销售业绩挂钩，而 2012 年半导体分立器件市场需求增速放缓，公司产品销售额出现一定程度的减少，使得销售部门员工的绩效工资大幅减少，导致职工薪酬下降。2013 年公司销售收入同比有所下滑，但销售人员职工薪酬上升了 53.26%，主要原因为公司为加快新产品的推广力度，增加了销售人员数量，并提高了新产品的销售激励力度，使得 2013 年公司新产品销售金额快速增长，销售人员职工薪酬大幅增加。

（2）管理费用

报告期内，公司管理费用主要包括研究开发费与职工薪酬，具体明细如下：

单位：万元

项 目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例

项 目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
研究开发费	2,688.36	54.73%	2,810.49	59.79%	3,910.07	66.33%
职工薪酬	1,013.91	20.64%	823.87	17.53%	760.84	12.91%
职工福利费	113.03	2.30%	15.02	0.32%	26.10	0.44%
折旧摊销费	187.66	3.82%	202.04	4.30%	144.48	2.45%
工会及教育经费	142.34	2.90%	198.90	4.23%	152.58	2.59%
审计咨询费	40.58	0.83%	158.74	3.38%	216.47	3.67%
税金	128.06	2.61%	154.95	3.30%	152.26	2.58%
汽车费用	97.82	1.99%	114.96	2.45%	114.83	1.95%
修理物料消耗	40.83	0.83%	49.72	1.06%	86.96	1.48%
业务招待费	45.04	0.92%	29.16	0.62%	16.50	0.28%
差旅费	25.70	0.52%	14.82	0.32%	36.71	0.62%
租赁费	10.03	0.20%	7.15	0.15%	50.81	0.86%
存货报废损失	117.43	2.39%	52.76	1.12%	47.92	0.81%
技术服务费	53.33	1.09%	-	-	-	-
其他	208.11	4.24%	68.33	1.45%	178.63	3.03%
合 计	4,912.23	100.00%	4,700.90	100.00%	5,895.16	100.00%

报告期内，公司注重内部管理，加强管理费用的控制，在公司营业收入下降的状况下，公司将管理费用控制在合理的水平。研究开发费与职工薪酬为管理费用中重要的构成部分，具体情况如下：

①研究开发费

研究开发费是管理费用中最主要的构成部分，报告期内，公司研究开发费占管理费的比例均超过 50%。公司十分重视新产品、新技术的研发，每年投入较多的费用用于购买研发设备、支付研发人员工资、直接材料及燃料消耗等费用，研发活动发生的开支实行独立核算，各种耗费按研发项目分别归集。报告期内，公司在研项目的数目逐年增加，研究开发费用占营业收入的比例分别为 8.43%、6.92%和 7.18%，投入比例较为稳定。

2011 年公司研究开发费用投入金额较大，占营业收入的比例偏高，主要原因为：2011 年 5 月，国家发改委发布的《国家发展改革委员会办公厅关于 2011 年新型电力电子器件产业化专项项目的复函》（发改办高技（2011）1168 号）文件”将公司“高压系列功率 MOSFET 器件产业化”项目列入国家高技术产业发

展计划及国家资金补助计划，由此公司开始启动第二期 MOSFET 产业化项目的研发，根据“高压系列功率 MOSFET 器件产业化”实施工作计划，公司对 1-60A\400-600V 等系列超过 10 个型号的 MOSFET 器件进行研制和工艺开发，对 MOSFET 相关产品及工艺研发的投入加大，其中仅 MOSFET 条形结构产品开发项目投入金额就达 1,949.19 万元，占当年研究开发费用比例 49.85%，导致当年研究开发费用投入较大。

2012 年公司研究开发费用投入回归正常水平，主要原因为：经过 2011 年对“高压系列功率 MOSFET 器件产业化”项目大量投入，公司已完成该项目大部分的研发工作，2012 年公司投入的相关费用逐渐减少，2012 年 10 月，深圳市发改委受国家发改委的委托，组织专家对“高压系列功率 MOSFET 器件产业化”项目进行现场验收，并最终通过验收。2012 年 MOSFET 条形结构产品开发项目的投入金额为 501.15 万元，同比减少 74.29%，导致当年研究开发费用有所降低。

2013 年公司研究开发费用略有下降，主要原因为：鉴于半导体行业整体增速放缓，公司对研究开发费用的投入继续保持合理水平。

②职工薪酬

报告期内，管理费用中职工薪酬金额及占管理费用比例总体呈上升趋势，主要原因是公司管理人员的工资薪酬持续上涨。

（3）财务费用

报告期内，公司财务费用明细情况如下：

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
利息支出	186.74	322.47	61.69
减：利息收入	13.73	14.07	21.75
承兑汇票贴息	158.50	68.71	42.25
汇兑损失	116.61	7.25	76.83
手续费	16.50	16.67	28.56
合 计	464.62	401.04	187.59

公司财务费用包括利息支出、承兑汇票贴息与汇兑损失。报告期内，公司财务费用呈现逐年递增的趋势，2012 年度，公司财务费用同比增长 113.79%，主要原因为：2011 年，公司大部分银行借款于 12 月份发生，而 2012 年公司全年银行借款平均余额较大，使得公司 2012 年利息支出大幅增加；另外 2012 年银行承

兑汇票贴现金额同比增长较快，使得贴息增加。

2013 年度，公司财务费用同比增加 15.85%，主要原因为：2013 年公司境外销售收入同比增加，而人民币汇率持续升高，导致汇兑损失同比增加了 109.36 万元；另外公司承兑汇票贴息同比增加 89.79 万元；同时，由于公司 2013 年度月度平均银行借款余额同比有所减少，利息支出减少了 135.74 万元。

（4）同行业上市公司期间费用占营业收入比率

报告期内，公司与同行业上市公司各项期间费用占营业收入比率情况如下：

项目	公司名称	2013 年	2012 年	2011 年
管理费用率	华微电子	11.47%	12.59%	13.36%
	东光微电	18.53%	22.06%	16.75%
	士兰微	18.13%	18.88%	16.14%
	平均值	16.04%	17.84%	15.42%
	本公司	13.11%	11.57%	12.71%
销售费用率	华微电子	3.52%	2.81%	3.24%
	东光微电	3.88%	3.91%	3.38%
	士兰微	2.49%	2.81%	2.40%
	平均值	3.30%	3.17%	3.00%
	本公司	2.31%	1.64%	1.87%
财务费用率	华微电子	3.60%	4.88%	5.45%
	东光微电	3.16%	0.10%	-2.43%
	士兰微	3.91%	3.51%	2.92%
	平均值	3.56%	2.83%	1.98%
	本公司	1.24%	0.99%	0.40%

报告期内，公司管理费用占营业收入的比率基本保持稳定，与经营规模相匹配。同行业上市公司华微电子的经营业务与公司最为相似，其管理费用率与公司相比差异较小。

报告期内，公司销售费用率低于同行业上市公司的平均值，主要原因为：公司采用直销的模式，与主要客户经过长期合作，已建立起良好稳定的合作关系，市场开拓费用较少。

报告期内，公司相较于同行业上市公司财务费用率较低，主要原因为公司资产负债率偏低，银行借款金额较少，发生的利息支出较少。

4、资产减值损失

公司资产减值损失主要为坏账损失与存货跌价损失。报告期内，公司资产减值具体情况如下：

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
一、坏账损失	-68.35	-0.26	140.96
二、存货跌价损失	16.42	202.83	8.57
合 计	-51.93	202.57	149.52

2012年存货跌价损失主要为库存商品中新产品计提跌价准备所致。2013年末应收账款余额同比减少1,076.91万元，按账龄计提的坏账损失有所减少。

5、营业外收支

报告期内，公司营业外收支明细情况如下：

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非流动资产处置利得合计	0.08	24.92	3.92
其中：固定资产处置利得	0.08	24.92	3.92
政府补助	703.50	337.62	616.85
其他收入	4.97	0.25	3.87
营业外收入合计	708.55	362.79	624.63
非流动资产处置损失合计	35.00	2.45	31.27
其中：固定资产处置损失	35.00	2.45	31.27
质量补偿款	104.89	29.20	110.24
其他	0.19	17.47	41.07
营业外支出合计	140.08	49.12	182.59

报告期内，公司营业外收入主要来源于政府补助，政府补助明细如下：

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
MOSFET 产业化政府补贴摊销	2,000,000.00	2,000,000.04	2,000,000.04
高压系列功率 MOSFET 器件产业化政府补贴摊销	2,600,000.00	433,333.33	-
产业技术进步资金摊销	1,307,882.64	326,970.66	-
深圳市骨干企业奖励	240,000.00	-	-
2013 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助	300,000.00	-	-

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
龙岗区经济促进局政府补贴（贷款贴息）	390,000.00	-	-
深经贸信息委进口贴息补贴	167,100.00	-	-
深圳市市场监督管理局 2013 年第 4 批专利资助费	10,000.00	-	-
2012 年“鹏城减废”先进企业奖励	20,000.00	-	-
节约用水补贴	-	190,000.00	-
专利资助费	-	15,000.00	-
福田总商会重点企业研发项目资助款	-	400,000.00	-
税费返还收入	-	10,865.38	-
深圳市支持骨干企业资助款	-	-	210,000.00
生产性水电及研发补助款	-	-	3,577,100.00
市场监督局专利资助款	-	-	18,600.00
人居环境委员会鹏城减废奖励	-	-	20,000.00
福田总商会知识产权专项资助款	-	-	25,500.00
深圳市财政委员会管理咨询项目资助款	-	-	117,300.00
福田总商会发展资助款	-	-	200,000.00

上述政府补助的详细情况请参见本招股说明书“第九节 财务会计信息”之“九、发行人最近一年及一期末主要债项”之“（五）其他流动负债”“（六）其他非流动负债”。

6、所得税

报告期内，公司享受高新技术企业优惠所得税税率 15%，所得税费用变化趋势与利润总额的变化趋势一致，具体情况如下：

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
本期所得税费用	395.34	637.64	275.95
递延所得税费用	-111.81	-180.41	37.77
合 计	283.53	457.23	313.72

（五）可能影响公司盈利能力持续性和稳定性的主要因素

1、照明市场需求的增长

公司产品主要应用于下游节能照明产业，我国已成为全球节能灯生产大国，产量占全球总产量的 80%以上，产品出口到 100 多个国家和地区。目前，美国、澳大利亚、日本、中国等国家已相继出台鼓励使用节能照明产品的政策，从长远

来看，下游节能照明市场需求较大，能够持续增长，对公司盈利能力持续性和稳定性具有重要影响。

2、电源市场的拓展

半导体分立器件是用于电源电路和功率控制电路的主体产品，广泛应用于计算机、工业控制、汽车电子、网络通信、消费电子、智能电网、半导体照明、电力电子设备等各个领域，几乎所有的电子产品都会用到半导体器件。电源市场容量巨大，并且保持较快的增长速度。公司目前的产品主要应用于节能照明领域，未来公司将重点开拓电源等其他领域，如手机电源、笔记本电源等，新市场的开拓有利于公司盈利能力保持持续性和稳定性。

3、新产品研发推广

公司将加快面向中高端市场的高性能 LED 驱动 IC 的研发速度，提高产品的稳定性及可靠性，逐步提高机箱电源的市场占有率。同时，公司将积极拓展 DMOS 市场，并提高其在公司销售收入中的所占的比例。公司还将进一步拓展 LED 照明驱动部分的产品，包括 LED 驱动 IC、DMOS、双极、肖特基和快恢复二极管等，增加公司产品在 LED 照明领域的份额。

4、主要产品产能提高

报告期内，公司主要产品需求较大，现有产能已不能满足发展的需要。公司一方面通过委托外协厂商加工以弥补产能的短缺，另一方面不断升级换代生产线，由原来的 4 英寸生产线升级为 5 英寸生产线，本次募集资金将投资建设 6 英寸生产线，主要产品产能的提高将有助于公司盈利能力持续性和稳定性。

（六）非经常性损益及投资收益对净利润的影响

报告期内，公司非经常性损益、投资收益情况如下：

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
非经常性损益	502.82	271.52	375.74
投资收益	-	-	-
净利润	2,681.40	3,571.71	3,494.79
非经常性损益占净利润比重	18.75%	7.60%	10.75%

2011-2013 年，公司各期非经常性损益金额分别为 375.74 万元、271.52 万元、502.82 万元，计入营业外收入的政府补助是构成非经常性损益的重要部分，报告

期内，计入营业外收入的政府补助金额分别为 616.85 万元、337.62 万元、703.50 万元。2013 年度，非经常性损益占净利润的比重偏高，主要原因为 2013 年计入营业外收入的政府补助金额较大，同时，当年实现的净利润同比有所减少。

（七）公司管理层对盈利能力的评价

公司管理层认为：报告期内，受欧债危机及国内宏观调控影响，公司主要产品销量、价格有所降低，导致营业收入逐年减少。公司通过加强内部管理，不断强化成本控制，主营业务毛利率基本保持稳定，具有可持续盈利能力。

三、现金流量分析

报告期内，公司现金流量主要项目列示如下：

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
1、经营活动产生的现金流量净额	1,551.19	2,026.90	2,420.96
经营活动产生的现金流入	28,393.15	28,691.99	30,715.23
经营活动产生的现金流出	26,841.96	26,665.09	28,294.27
2、投资活动产生的现金流量净额	-5,786.19	-3,401.00	-2,483.82
投资活动产生的现金流入	31.10	56.50	5.00
投资活动产生的现金流出	5,817.30	3,457.50	2,488.82
3、筹资活动产生的现金流量净额	4,209.78	1,792.22	1,289.77
筹资活动产生的现金流入	7,395.94	8,484.05	3,600.00
筹资活动产生的现金流出	3,186.15	6,691.82	2,310.23
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13.46	-3.20	-28.35
5、现金及现金等价物净增加额	-38.68	414.92	1,198.56

（一）经营活动现金流量

报告期内，公司经营活动现金流量明细如下：

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	25,790.44	24,233.19	28,815.67
收到的税费返还	248.13	461.93	361.40
收到其他与经营活动有关的现金	2,354.58	3,996.86	1,538.16

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动现金流入小计	28,393.15	28,691.99	30,715.23
购买商品、接受劳务支付的现金	15,582.00	16,522.05	17,838.66
支付给职工以及为职工支付的现金	7,799.44	6,450.77	6,934.15
支付的各项税费	2,154.77	2,335.74	2,840.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,305.75	1,356.52	680.97
经营活动现金流出小计	26,841.96	26,665.09	28,294.27
经营活动产生的现金流量净额	1,551.19	2,026.90	2,420.96

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额均为正数，表明公司经营活动产生现金流量情况良好。

报告期内，经营活动现金净流量逐年分别为 2,420.96 万元、2,026.90 万元和 1,551.19 万元，呈现逐期下滑的趋势，主要因为：（1）国内市场资金面较为紧张，越来越多下游客户为减少流动资金占用成本，采用承兑汇票进行支付，销售商品、提供劳务收到的现金逐年减少；（2）公司将收到的承兑汇票向银行贴现，2012 年末、2013 年末，已贴现承兑汇票在期末未到期的金额分别为 2,384.05 万元、3,295.94 万元，上述金额被列入筹资活动现金流入。

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入存在较大差异，主要原因是：公司客户普遍采用银行承兑汇票进行支付。报告期内，公司收到承兑汇票金额分别为 21,940.10 万元、22,140.16 万元和 21,272.11 万元。

报告期内，公司采购商品、接受劳务支付的现金与采购总额存在较大差异，主要原因为：为节约流动资金，公司将客户支付的承兑汇票背书给供应商，减少了实际支付的采购现金支出。最近三年，公司将承兑汇票背书用于采购商品、接受劳务支付的金额分别为 13,611.03 万元、15,655.90 万元和 9,679.10 万元，因此公司购买商品、接受劳务支付的现金流比实际情况偏低。

（二）投资活动现金流量

报告期内，公司投资活动现金流量净额分别为-2,483.82 万元、-3,401.00 万元和-5,786.19 万元，均为负数，表明公司持续对固定资产、无形资产和其他长期资产进行投资。投资活动现金流出主要用于购置机器设备、电子设备、房屋建筑物等。投资活动现金流出低于实际的投资金额，主要原因是公司将收到的部分承兑汇票背书给相应的供应商，由此抵减了投资活动实际现金流出额。报告期内，

公司背书承兑汇票用于购买固定资产的金额分别为 524.92 万元、872.37 万元和 1,206.92 万元。

（三）筹资活动现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流入分别为 3,600.00 万元、8,484.05 万元和 7,395.94 万元。2011 年筹资活动现金流入主要为银行借款；2012 年和 2013 年筹资活动现金流入主要为取得银行借款和期末尚未到期的承兑汇票贴现资金流入。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流出分别为 2,310.23 万元、6,691.82 万元和 3,186.15 万元。2011 年筹资活动现金流出主要为归还赛格集团借款以及银行借款；2012 年和 2013 年筹资活动现金流出主要为归还银行借款。

（四）公司管理层对于现金流的评价

公司管理层认为：报告期内，公司现金流状况良好。

四、可比上市公司财务指标对比分析

公司选取华微电子（600360）、东光微电（002504）、士兰微（600460）三家与公司同行业且产品相似的公司进行比较，对比分析了几项重要的财务指标。华微电子的主要产品为半导体器件；东光微电的主要产品为半导体功率器件、半导体功率芯片；士兰微的主要产品包括集成电路、器件芯片、器件成品、发光二极管等。

报告期内，公司与上述三家公司的财务指标对比情况如下：

项 目		销售毛利率（%）	净资产收益率（%）	资产负债率（%）	流动比率	速动比率	应收账款周转率（次）	存货周转率（次）
2013 年 12 月 31 日 /2013 年度	华微电子	21.42	2.38	41.95	1.63	1.43	4.13	3.73
	东光微电	15.14	-2.42	23.89	1.90	1.41	1.38	1.57
	士兰微	26.02	6.05	35.33	2.28	1.79	3.66	2.31
	平均值	20.86	2.00	33.72	1.94	1.55	3.06	2.54
	本公司	23.11	6.99	38.35	1.71	1.16	3.27	2.44

项 目		销售毛利率 (%)	净资产收益率 (%)	资产负债率 (%)	流动比率	速动比率	应收账款周转率 (次)	存货周转率 (次)
2012 年 12 月 31 日 /2012 年度	华微电子	22.66	2.59	45.67	1.72	1.41	4.45	3.17
	东光微电	17.70	1.13	15.41	3.17	2.54	1.09	1.46
	士兰微	22.34	1.08	38.33	2.11	1.49	3.59	2.06
	平均值	20.90	1.60	33.14	2.33	1.81	3.04	2.23
	本公司	24.29	9.76	33.30	1.82	1.20	3.43	2.61
2011 年 12 月 31 日 /2011 年度	华微电子	29.31	6.32	46.37	1.03	0.88	4.94	3.10
	东光微电	25.04	3.46	12.51	8.87	7.65	1.43	2.42
	士兰微	30.93	9.08	39.27	2.31	1.69	4.47	2.51
	平均值	28.43	6.29	32.71	4.07	3.41	3.61	2.67
	本公司	23.09	10.57	35.10	1.65	0.97	4.29	2.92

注：①可比公司的数据根据各公司公开披露的年度报告、审计报告计算而得；

②资产负债率为母公司资产负债率；

报告期内，公司销售毛利率基本保持稳定，2013 年公司销售毛利率略高于同行业上市公司毛利率，表明公司具有良好的盈利能力。公司销售毛利率变化主要由于主营业务毛利率变化导致，具体情况请详见本节之“二、盈利能力分析”之“(二) 营业成本和毛利分析”。

报告期内，公司净资产收益率均高于同行业上市公司，一方面原因为公司净资产规模小于同行业上市公司；另一方面表明公司具有良好的净资产回报率，盈利能力较为稳定。

报告期内，公司能够根据生产经营的需要合理调整资产负债结构，资产负债率波动较小，与同行业上市公司相比，公司资产负债率水平偏低，表明公司负债水平不高，经营较为稳健。

报告期内，公司流动比率、速动比率波动较小，符合当前公司的经营现状，低于同行业上市公司平均值，但差距正在逐渐缩小。

与同行业上市公司相比，公司应收账款周转率、存货周转率处于中等水平，且均高于行业平均值，显示出公司良好的应收账款、存货管理能力，应收账款与存货余额能够与公司营业规模相匹配。

五、资本性支出分析

（一）近三年重大资本性支出

公司重大资本性支出主要用于扩大生产产能，包括购置房屋建筑物、机器设备及电子设备。报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 2,488.82 万元、3,457.50 万元和 5,817.30 万元。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

截至招股说明书签署日，除本次发行募集资金投资项目外，公司无可预见的重大资本性支出计划。本次募集资金投资项目具体参见本招股说明书“第十二节 募集资金运用”的有关内容。

六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项说明

截至招股说明书签署日，除招股说明书“第十四节 其他重要事项”之“四、诉讼和仲裁事项”披露的诉讼以外，公司无重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项说明。

七、未来分红回报规划

公司关注自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，积极践行回馈社会、回报投资者的股权文化。公司董事会综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、资金需求、股东回报以及外部融资环境等因素对股利分配政策进行了规划，具体分红回报规划如下：

（一）股东回报规划制订的目的

规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。

（二）股东回报规划的制定原则及考虑因素

公司实行连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼

顾公司的可持续发展。在制订本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，从而健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

（三）股东回报规划的制订和相关决策机制

1、公司应强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。

2、在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司章程、实际情况和发展目标、股东合理回报等因素，提出合理的利润分配预案，并由董事会制订年度利润分配方案 and 中期利润分配方案。利润分配方案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意见并公开披露。

3、董事会审议现金分红具体方案时，须认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事的意见、董事会投票表决情况等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。

4、股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，并应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。公司当年盈利但未提出现金分红方案的，董事会将在定期报告中详细说明理由以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台。

5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董

事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

6、存在公司的股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。

上述分红回报规划已经公司第二届董事会第二次会议和 2013 年年度股东大会审议通过。

第十一节 业务发展目标

一、未来发展规划及目标

（一）经营宗旨

公司的经营宗旨：以自主创新和自主品牌为核心，坚持全面人才培养战略和“技术创新、管理创新和市场创新”的经营理念，致力于使公司成为功率半导体分立器件制造行业的领航者，为客户提供有价值的产品和服务，为全社会的节能和低碳事业做贡献。

（二）发展目标

公司坚持自主知识产权的研发，形成了功率晶体管、MOSFET、肖特基等产品系列，广泛应用于节能照明、电源、通讯等领域。未来公司将继续以节能照明功率半导体分立器件研发、制造与经营为主，积极拓展电源领域，走专业化发展道路，通过引进、消化、吸收及自主创新，实现规模化生产，提升公司功率半导体分立器件产品的销售规模、市场占有率和品牌美誉度，巩固企业在行业中的市场地位和领先优势，并加大海外市场开发力度，实现公司长期可持续发展，给股东和投资者提供长远稳定的回报。

（三）具体业务发展规划

公司专业从事半导体分立器件芯片及成品管的研发、生产及销售。公司将通过丰富产品结构，扩大生产规模，提高产品质量，进一步降低成本，提升公司核心竞争力；持续强化技术研发投入和技术合作，增强自主创新能力；加强市场开拓，为客户创造最大价值；加大技术、管理和营销等方面人才的引进和培养力度；完善薪酬福利及绩效考核体系，确保募集资金投资项目的如期实施。通过实施上述发展规划，强化公司在功率半导体分立器件行业的主导地位。

根据上述发展规划，结合公司经营模式，为达成总体发展目标，公司制定以下业务发展规划以增强公司自主创新能力，提升公司核心竞争力：

1、产品开发计划

公司将继续强化以节能照明用功率半导体器件为主导产品的业务格局。未来两到三年，公司将以科技为导向，以成本控制为目标，通过技术创新及管理改进，提升现有产品的技术含量及品质。在原有产品系列的基础上努力开发其他系列产品，如6英寸0.35微米功率半导体器件芯片等，丰富产品的规格和品种。通过技术升级，实现功率MOSFET、IGBT、肖特基器件、LED驱动电路芯片等新产品的批量生产，持续提升产品在行业中的优势地位。公司将进一步优化产品结构，提高电源和消费电子类产品的占比，至2016年末形成节能照明产品占比70%、电源产品占比20%、消费电子类产品占比10%的产品结构。

2、技术创新及研发平台建设计划

公司将密切关注半导体技术发展趋势及电子产品的市场发展态势，根据客户的需求及时制订技术创新计划。公司将加大科研投入，大力研发具有自主知识产权的核心技术，在现有技术的基础上，不断进行技术创新，提高产品技术含量，进一步提升公司的核心竞争力。未来两到三年，公司将建设更先进的功率器件技术中心，借助这一平台，培养自有人才，并积极寻找公司以外的技术团队和技术人才，通过与公司外的技术团队合作、引进技术人才和自主研发相结合的方式，提高研发速度，优化研发流程，巩固和保持公司在技术水平、产品性能等方面的国内领先地位。

3、生产及质量管理计划

公司将不断优化工艺流程及生产环境，加快生产线改造，将研发和生产紧密结合起来，加大以DMOS产品为代表的新产品研发力度。通过资本市场募集资金建设一条6英寸0.35微米功率半导体器件芯片生产线，实现功率MOSFET、IGBT、肖特基器件、LED驱动电路芯片等新产品的批量生产。在生产过程中，公司将继续强化质量管理意识，完善全面质量控制体系，提高产品合格率。公司始终坚持质量第一、信誉为重的理念，制定相关生产和质量标准，使生产工艺、管理流程规范化、制度化，将全面质量管理意识渗透到产品生产的每一个环节之中。

4、市场开发与营销网络建设计划

公司将不断巩固营销网络，逐步建立较完善的市场营销体系，在巩固成熟市场的同时，加大新产品、新领域的开拓工作，确保公司总体目标的实现。公司将不断加强营销团队的建设，通过提高营销人员的业务能力、完善营销激励制度，提升售前、售中、售后的服务质量，为客户提供专业化、标准化的服务，提高客户的满意度及信赖度。

未来两到三年，公司将加快面向中高端市场的高性能 LED 驱动 IC 的研发速度，提高产品的稳定性及可靠性，逐步提高机箱电源的市场占有率。同时，公司将积极拓展 MOSFET 市场，加大 DMOS 产品的销售力度，并提高其在公司销售收入中的所占比例。

5、人力资源开发计划

根据业务发展需要，公司将人才培养作为公司发展战略的重中之重。未来公司将继续加强员工培训工作，提高技术人员和操作工人的稳定性。鼓励员工通过各种方式进行深造，不断提高员工整体素质。公司将继续与电子科技大学合作开设在职工程硕士班、大专班，提高员工技术素养，培养经营管理骨干力量，进一步带动公司技术开发能力和经营管理水平的全面进步。同时，加大技术、管理和营销等方面的人才引进和培养力度，不断充实公司的人才队伍。另外，通过完善薪酬福利及绩效考核体系，使公司的薪酬福利体系具有更强的激励性和吸引力。

6、国际化经营计划

未来几年，公司将加大技术引进力度，持续提升质量管理体系的运行水平，使公司产品及质量管理水平接近、达到国际领先水平。通过向研发人员提供海外技术交流和参加国际性技术研讨会议的机会，不断提高研发的先进性及与国外技术研发主流的同步性。积极搜集国际市场信息，掌握国际市场动态，在充分了解国际市场的基础上进一步扩大产品出口，开拓在印度、南美等国家和地区的市场，提高公司产品的国际市场份额，逐步迈向国际化经营之路。

7、股权融资计划

公司计划通过本次公开发行股票利用资本市场融资，并将募集资金投资于“6

英寸 0.35 微米功率半导体器件芯片生产线项目”，以实现公司的战略目标。

本次发行上市后，公司将按照相关募集资金管理规定对募集资金妥善管理、合理使用，不断加强资产运营管理，以股东利益最大化为原则，提高股东收益。未来几年，公司将在控制财务风险的前提下，根据产品研发及市场开拓情况，依靠对外融资和自身积累的方式，选择包括发行债券、股票融资、引进战略投资者等渠道满足资金需求，推动公司长远发展。

二、拟定上述发展规划所依据的假设条件

上述业务发展计划是以公司现有的业务发展条件、市场地位和战略优势为基础所制定，主要依据以下假设条件：

- 1、本次股票发行能够在预定时间内完成，募集资金到位,募集资金投资项目如期实施，达到预期效益；
- 2、国际国内宏观经济、政治、法律和社会环境比较稳定，在计划期内不发生对公司经营发展产生重大不利影响的变化；
- 3、国家对电子信息产业和集成电路产业的导向政策、扶持鼓励政策无重大改变，公司经营业务所遵循的国家及地方政策、法规无重大改变；
- 4、半导体分立器件市场继续保持稳定的发展状态，未出现重大的市场突变情形；
- 5、公司经营管理活动处于正常状态，所拥有的主要竞争优势继续发挥应有作用。

三、实现上述规划将面临的主要困难及挑战

为实现上述计划，公司将面临如下三个主要的困难：

1、资金方面

公司为实现上述发展规划面临较大的资金需求，股票发行成功与否对公司发展计划的实施具有决定性意义。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。在募集资金到位前，资金短缺是公司实现上述计划的主要约束。

2、人力资源方面

人才是企业发展的关键，公司十分重视人才队伍的建设。募集资金建设项目的投入将带来公司规模快速扩张，目前人才的数量和水平还不能满足今后公司发展的需求，公司将需要大量技术、管理、营销方面的高素质人才。因此，人才的引进和培养将是公司发展的必要条件。

3、管理方面

根据公司发展规划，未来几年内公司经营业务和生产规模都将大幅度增加，资产、产品、人员、营销网络等方面的规模都将不断扩大，这对公司在财务管理、资金管理、生产管理及营销管理等方面提出了更高的要求。

四、确保实现业务发展目标的方式、方法或途径

1、公司本次发行股票为实现上述业务目标提供了资金支持，是上述发展计划得以实现的重要前提。公司将通过募集资金的投入，组织并保证项目的实施及如期投产，进一步扩大公司的生产规模，设立更先进的研发中心和技术服务中心，促进产品结构的优化升级，实现整体规模和产值迅速增长，巩固公司核心竞争力。

2、公司将不断巩固营销网络，充分利用现有资源，与现有客户建立密切的合作关系，根据客户的多样化需求提供个性化的增值服务。积极开拓国内外市场，加快印度等新兴国家的产品推广，进一步扩大市场占有率，提高公司的社会知名度和市场影响力，增强盈利能力，实现公司规模和产能的迅速增长。

3、本次公开发行股票将极大地提高公司的社会知名度和市场影响力。公司将以本次发行上市为契机，按照人力资源发展计划，加快对优秀人才尤其是高素质专业技术人才及管理、营销人才的培养与引进，进一步提高公司的研发技术水平、管理水平和产品销售能力，增强公司的人才竞争优势，确保公司实现总体经营目标。

4、本次股票上市后，公司将由非公众公司转为公众公司，社会的广泛监督将促进管理水平的改善。公司将严格按照上市公司的要求规范运作，建立更规范的科学管理体系，进一步加强公司治理、风险管理和财务管理的能力，使公司价值与股东利益共同增长。

五、发展规划与现有业务的关系

现有业务是公司未来几年发展计划的基础，发展计划与现有业务密切相关并具有很强的连贯性，属于一脉相承的关系。上述公司发展规划是在现有主营业务基础上，按照公司的发展战略和目标制定的，是现有业务的延伸、深化和提高，是增强公司综合实力的重要举措。本次募集资金投资项目和具体业务发展规划充分利用了现有业务的技术条件、业务模式、人员储备、管理经验、客户基础和营销网络。

实施公司发展规划和目标是对现有业务技术的发展和提升，各项发展计划紧紧围绕公司主营业务展开，与现有业务相辅相成、密不可分。公司产品开发计划、技术创新及研发平台建设计划、生产及质量管理计划、市场开发与营销网络建设计划、人力资源开发计划、国际化经营规划、股权融资计划都将促进现有业务在产品质量、技术水平、营销服务、业务收入方面的大幅提升。上述计划实现后，公司现有业务的综合实力将再上一个新台阶，为参与更高层次的竞争提供了基础。

第十二节 募集资金运用

一、募集资金运用计划

（一）本次发行预计募集资金总额及具体用途

2014年4月10日，公司召开2014年第一次临时股东大会，全体股东一致同意本次发行募集资金投资于以下项目：

本次募集资金投资项目共需资金55,026万元，项目投资额及审批情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资额	核准文号
1	6 英寸 0.35 微米功率半导体器件芯片生产线项目	46,026	深发改备案[2013]0019 号
2	补充生产经营所需营运资金	9,000	
合 计		55,026	

如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决；如果募集资金有剩余，剩余部分将用于补充公司流动资金；如本次发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自主资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

为适应经营发展需要，抢占市场先机，公司于 2013 年 9 月 6 日与绿谷工业签订关于 6 英寸线半导体设备的购置合同，购置部分 6 英寸线设备，合同金额共计 600 万美元。截至 2014 年 1 月 31 日，公司已全额支付设备购置款 600 万美元（合计人民币 3,669.17 万元）。目前，公司正在测试相关设备的可靠性，为启用 6 英寸生产线做前期准备。经深圳市发展和改革委员会批准，该项目被列为“深圳市 2014 年度重大项目”。

（二）募集资金专户存储安排

2012年4月2日，公司2012年度股东大会审议通过了《深圳深爱半导体股份有限公司募集资金专项存储制度》，建立了募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，根据需要逐步投入。

二、6 英寸 0.35 微米功率半导体器件芯片生产线项目概述

（一）项目概述

本项目在公司位于深圳市龙岗区的半导体分立器件产业园预留用地建设6英寸0.35微米功率半导体器件芯片生产线，新建生产厂房及配套动力站房总建筑面积34,300m²。本项目预计总投资46,026万元，其中固定资产投资43,880万元，铺底流动资金2,146万元，全部用募集资金投资。公司建设规模为48万片/年的生产能力；投产第一年产量为75%，投产第二年产量为100%；项目计算期8年，包括建设期2年，投产期1年，满负荷生产期5年。

（二）项目背景及必要性

1、项目提出的行业背景

随着科学技术的飞速发展，半导体技术形成了两大分支：一个是以大规模集成电路为核心的微电子技术，实现对信息的处理、存储与转换；另一个则是以半导体分立器件为主，实现对电能的处理与变换。半导体分立器件与大规模集成电路一样具有重要价值，在国民经济和社会生活中具有不可替代的关键作用。

半导体分立器件主要用于对电流、电压、频率、相位、相数等进行变换和控制，以实现整流（AC/DC）、逆变（DC/AC）、斩波（DC/DC）、开关、放大等各种功能，是能耐高压或者能承受大电流的半导体分立器件和集成电路。在功率电子电路，例如整流电路、变频调速电路、开关电源电路、UPS电路中，半导体分立器件一般都是起开关作用，因为用在开、关两个状态下半导体器件功率损耗较小。上世纪80年代以后，随着新型半导体分立器件如功率MOSFET、IGBT的兴起，半导体分立器件步入一个新的领域，除了驱动电机之外，为信息系统提供电源的功能也越来越引人注目，半导体分立器件在系统中的作用已不仅限于“四肢”，而是为整个系统“供血”的“心脏”。

因此，使用半导体分立器件的最根本的目的，一是为了将电压、电流、频率转换到负载所需要的数值，二是为了更有效地利用电能。功率半导体器件的广泛应用可以实现对电能的传输转换及最佳控制，大幅度提高工业生产效率、产品

质量和产品性能，大幅度节约电能、降低原材料消耗，对我国能源、通信、交通等基础产业的技术改造和技术进步起着不可或缺的作用。例如，使用功率晶体管或功率MOSFET的节能灯与普通白炽灯在光能输出相同的情况下，前者只需耗费后者1/5至1/4的用电量，从而可以节约大量的照明电能和费用，尤其是使用功率MOSFET的节能灯，其性能更好、寿命更长，使节能灯甩掉了寿命短、节电而不省钱的帽子，为节能灯走进千家万户创造了条件。而IGBT（绝缘栅双极晶体管）的出现和应用，则使得空调、UPS电源等整机的效率得到显著提高，同时体积也大幅缩小。如逆变焊机原来要两个人才能拿动，采用了IGBT器件之后，体积只有书包大小，重量仅为几公斤，同时其性能、效率及可靠性等也得到质的改进。

2、项目建设的必要性

目前，公司拥有2条5英寸功率半导体芯片生产线，为了提高公司在行业中的竞争能力和扩大市场占有率，建设6英寸0.35微米功率半导体器件芯片生产线势在必行、迫在眉睫。

本项目建设的必要性如下：

1、促进珠三角区域半导体芯片制造业发展

目前，珠三角地区半导体芯片厂商仅有公司及方正微电子两家，技术水平最高为6英寸，其中公司为IDM制造商，而方正微电子则为典型的代工生产厂商。与半导体芯片制造业发达的华北、长三角、甚至东北等地区相比，珠三角地区半导体芯片制造业的发展水平总体上仍比较低。本项目的建设，有利于缩小珠三角地区半导体芯片制造业与先进水平的差距，有利于改变我国半导体芯片制造业北强南弱的局面，有利于实现国家半导体芯片制造业空间布局的平衡。

2、顺应市场需求、完善区域电子信息产业链

随着市场竞争不断加剧，企业大多希望能够实现元器件采购本地化以降低制造成本，而从我国半导体器件市场的区域结构看，在深圳建设该项目有其坚实的市场基础。作为我国出口加工和电子信息产业最发达的地区以及全国五大乘用车产地之一，珠三角地区已成为我国消费电子产品、通讯（手机、程控交换机等）、计算机及外设、节能照明产品和汽车电子产品的重要生产基地，半导体器件的市场需求多年来一直居全国首位，而其中绝大部分需进口或从外地采购，未形成较

完整产业链，不利于区域经济的持续健康发展。因此，以珠三角地区强大的市场需求为依托，在深圳建设本项目是可行的，也是必要的。

3、缩小行业与国际先进水平差距、打破垄断

我国作为全球重要的电子产品输出国，对高端功率半导体分立器件的需求巨大且逐年快速增长，其中2004年至2008年增长较快，远高于行业平均水平。2008年以来，受全球金融危机和基数不断扩大的共同影响，增速趋缓，但增长的趋势在一个较长时期内不会发生逆转。而我国高端功率半导体分立器件市场完全被欧美半导体巨头垄断，本土企业在高端功率半导体分立器件领域与国外先进水平差距巨大。据统计，在高端功率半导体分立器件十大供应商中，无一本土企业。

近年来，国家发布了促进集成电路产业发展的全方位优惠政策，在一段时间刺激了内外资对我国集成电路产业的持续高强度投资，使我国集成电路技术水平与世界先进水平的差距有了明显缩小。但是，在高端功率半导体分立器件领域，我国与世界先进水平的差距却未得到明显改善。本项目的建设，对打破欧美等半导体巨头对我国功率半导体市场的垄断、缩小功率半导体分立器件领域与世界先进水平的差距可以起到一定的促进作用。

4、促进企业技术和产品更新换代，提高企业竞争力

(1) 加快现有产品结构调整的步伐，尽快形成多个支柱产品，增强企业可持续发展能力和经营稳定性。

(2) 通过设备和技术引进，使公司的工艺技术、产品技术和设备技术在现有基础上获得较大的提升，为更高端半导体器件的研制生产提供平台。

(3) 进一步拓宽服务领域。

6英寸生产线与8英寸生产线相比，设备投资较低、风险相对较小；而与5英寸生产线相比，又具有生产效率更高、备品备件更有保障的优势；选择0.35微米工艺平台使得生产线具备了开发高端产品的条件，同时在技术上兼顾了今后向8英寸生产线扩展的能力。

本建设项目6英寸0.35微米功率半导体器件芯片生产线是目前国内较先进的功率半导体器件芯片生产线，完全能够满足生产新型功率半导体分立器件和功率集成电路的要求。所需的产品技术和工艺技术来源于公司多年积累的经验和技能，技术来源有保障。

（三）项目市场容量

1、国际市场需求情况

半导体分立器件的传统应用领域包括消费类电子、计算机及外设、网络通信等，而电子专用设备与仪器仪表、汽车电子、医疗电子、LCD/PDP显示屏及电子照明等多个领域也正成为半导体分立器件的新兴应用市场。

据世界著名信息咨询机构IHS统计，2012年全球功率半导体分立器件市场销售额为150亿美元，同比降低16%。IHS将该市场的低迷表现，归咎于欧美市场需求的下降和能源计划的延缓，预期该市场2013年才能重新恢复增长。从根本上来说，功率半导体分立器件行业低迷主要受制于经济周期的影响，待宏观经济企稳、恢复增长之后，功率半导体分立器件行业将会迎来新一轮的发展机遇。

在功率半导体分立器件方面，功率MOSFET主要应用于消费电子、计算机、工业控制、网络通信、汽车电子和电力设备等六大领域。IGBT主要用于通信、工业、医疗、家电、照明、交通、新能源、半导体生产设备、航空、航天及国防等诸多领域。在应用市场上，由于双极功率晶体管正在不断地被功率MOSFET及IGBT所替换，因此，目前很多国外厂商已经锁定功率MOSFET及IGBT领域，加大发展力度。

2、国内市场需求情况

半导体分立器件被广泛应用于计算机、工业控制、汽车电子、网络通信、消费电子、风能、太阳能、智能电网、半导体照明、新型显示、电力电子设备各个领域。几乎所有的电子产品都会用到半导体分立器件，随着国内电子信息产业的迅速发展，我国已成为全球最大的半导体分立器件应用市场。

据CSIA统计，2008年-2011年，我国半导体分立器件产业销售额分别为937.80亿元、883.60亿元、1,135.40亿元和1,388.60亿元，增长率分别为12.30%、-5.80%、28.50%和22.3%，同样呈现稳中有升的市场格局。2012年半导体分立器件产业在电子整机需求不旺的影响下，产业没能延续之前两年的快速增长态势。2012年中国分立器件产业销售额为1,390.00亿元，同比虽略有增长，但增幅同比下降较大。预计2013年至2015年我国半导体分立器件产业销售额将保持平稳快速发展，各年预期增长率分布为5.40%、6.20%和8.30%，届时销售额分别达到1,465.10亿元、1,555.90亿元和1,685.00亿元。

另外，从半导体分立器件新增市场来看，功率 MOSFET 和 IGBT 是未来发展的主要方向。2012 年，我国功率 MOSFET 市场总体销售额达到 21.8 亿美元，比 2009 年的 16 亿美元增加 36.25%，增长较快。据 IHS iSuppli 公司预测，2017 年我国功率 MOSFET 销售额将突破 30 亿美元，2013-2017 年功率 MOSFET 销售额年均复合增长率为 7.5%。

由于绿色能源和能源效率得到更多的重视，以及政府投资支持和严格的能源政策，我国 IGBT 2012 年销售额达到 11.10 亿美元，同比增长近 8%。IGBT 市场未来几年将保持平稳快速增长，预计 2016 年我国 IGBT 销售额将达到 17.00 亿美元，2011-2016 年间复合增长率为 12%。

尽管如此，我国半导体分立器件的设计、制造能力还有待提高，我国半导体分立器件企业的生产条件和工艺技术大多仍停留在国外上世纪 90 年代的水平，关键技术仍掌握在 IR、英飞凌、富士电机、三菱等少数国外公司手中。据统计，目前国内市场所需的高端半导体分立器件大部分需要进口，因此我国掌握功率半导体核心技术的企业未来面临巨大的进口替代市场空间。

半导体分立器件行业的市场前景请参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（三）行业概况”。

（四）项目实施的有利条件

1、政策优势

2000 年 6 月颁布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和后续的实施细则对芯片企业实施税收优惠。2008 年 1 月，财政部和国家税务总局发布了《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，对集成电路企业所享受的所得税优惠政策进一步给予明确。2009 年 2 月颁布的《电子信息产业调整和振兴规划》中，更是将“建立自主可控的集成电路产业体系”作为未来国内信息产业发展的三大重点任务之一，并在五大发展举措中明确提出“加大投入，集中力量实施集成电路升级”。2011 年颁布的《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》也顺利出台，在财税政策方面，该文件的相关优惠政策有 9 条之多，除继续执行原来确定的软件增值税优惠政策外，其它税收优惠也得到进一步强化和完善。新政的另一差异，主要还增加了投融资支持等条款，首次提出从税收和资金

方面全力促进软件产业和集成电路产业的优势企业发展壮大和兼并重组，加强产业资源整合，这将有助于行业集中度的提升。

除此之外，在国家确立的十六个科技重大专项中，有两个和半导体产业密切相关，其中“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”（核高基）重大专项的主要目标是：在芯片、软件和电子器件领域，追赶国际技术和产业的迅速发展，攻克高端通用芯片、基础软件和核心电子器件的关键技术。

国家要实现节能减排目标，打造低碳经济，功率半导体技术必须要有突破。2007年科技部根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，在“十一五”国家科技支撑计划重点项目“电力电子关键器件及重大装备研制”中，将“新型电力电子器件及电力电子集成技术”列为该重点项目的第一项课题，重点支持研制IGBT、FRD及PEBB关键技术，中高压百MVA级链式及多电平变流器，电能质量复合控制技术，分布式供能系统高压变流器及软开关技术，铁路同相供电，机车牵引变流器，城市轨道牵引传动系统及能馈式牵引供电等。进入2009年，国家加大对于功率半导体产业的支持力度，在2009年出台的《电子信息产业调整和振兴规划》中，明确提出了“加快电子元器件产品升级”、“充分发挥整机需求的导向作用，围绕国内整机配套调整元器件产品结构”，提高新型电力电子器件、高频频率器件等产品的研发生产能力，“初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系”。2010年3月19日，国家发改委专门出台针对支持功率半导体发展的文件《国家发展改革委办公厅关于组织实施2010年新型电力电子器件产业化专项的通知》，重点支持金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）、集成门极换流晶闸管（IGCT）、绝缘栅双极晶体管（IGBT）、快恢复二极管（FRD）等量大面广的新型电力电子芯片和器件的产业化。2013年1月，国家发改委等六部委联合发布《半导体照明节能产业规划》，提出到2015年，节能灯等传统高效照明产品市场占有率稳定在70%左右，表明政府部门高度重视高效节能照明产品的应用和推广，产品市场空间依然较大。

2、企业优势

公司具有较强的技术开发能力。近年来，在吸收、消化引进技术的基础上不断创新，公司4英寸生产线三重扩散SIPOS钝化平面高压工艺获深圳市科技进步奖；公司严格按照国际标准生产，产品经深圳市电子检测中心检测，各项参数

指标达到国内外同类产品的先进水平，曾获“广东省优秀新产品”奖；2001年公司被评为深圳市300家最具成长性企业；2002年被授予深圳最具竞争力企业；2003年通过ISO9001：2000质量管理体系认证；2007年通过深圳市级企业技术中心认定；2008年被授予“深圳市自主创新行业龙头企业”；2009年通过“高新技术企业”认定，同年，公司“MOSFET功率晶体管”通过新产品鉴定、“功率MOSFET产业化项目”通过深圳发改委验收，2010年，公司跻身国家发改委174家“国家高技术产业化示范工程”，2010年7月和2011年6月，公司又相继承担了国家工信部“新型电力电子器件研发及产业化项目”和国家发改委“高压系列功率MOSFET器件产业化项目”，2011年获得“广东省自主创新标杆企业”，2012年再次通过“高新技术企业”认定，2013年获批准组建深圳功率半导体器件工程实验室。自2008年以来，公司连续3年在全公司全面推行六西格玛管理，至2011年，已进入第三期。六西格玛管理活动的推进，提升了公司的管理水平和技术创新能力，从根本上解决了一些长期存在的问题，大大优化了产品性价比，提高了客户满意度。

3、技术优势

公司以发展民族半导体产业为己任，独立自主，依靠自己的力量，不断吸收消化国外的先进技术，研制生产具有独立知识产权的产品与进口产品争市场，产品在国内绿色照明领域具有较高的品牌效应。公司跟随高新技术发展趋势，抓住国家大力发展半导体产业的机遇，利用自身独具的行业和技术有利条件，顺利完成5英寸芯片生产线的建设。在深圳高新技术产业带龙岗宝龙工业城，占地10余万平方米、集功率器件芯片制造、测试及封装的功率半导体器件产业园已基本建成。

公司将人才培养作为公司发展战略的重中之重，在公司现有的1,067人中，公司参与研发的科研人员共有113人，占公司员工总数的10.59%。在鼓励员工通过各种方式进行深造的同时，公司为加强人才培养力度，自2008年开始与电子科技大学合作，开设了在职工程硕士班和大专班，培养造就了一批研发和经营管理骨干力量。这些来自各个岗位员工们的知识和技能的提升带动了公司技术开发能力和经营管理水平的全面进步。

（五）项目主要建设内容

1、项目投资概算

本项目新增总投资为46,026万元，其中建设投资43,880万元，铺底流动资金2,146万元。其中：建筑工程费14,109万元，设备购置费24,490万元，设备安装费647万元，工具器具费146万元，其他费用4,488万元。项目投资估算表如下：

序号	项目名称	估算投资（万元）	含外汇（万美元）	占投资比例（%）
一	建设投资	43,880.00	2,241.15	96.27
1	建筑工程费	14,109.00		30.95
2	设备购置费	24,490.00	2,241.15	53.73
3	设备安装费	647.00		1.42
4	工具器具费	146.00		0.32
5	其他费用	4,488.00		9.85
二	铺底流动资金	2,146.00		3.73
合 计		46,026.00	2,241.15	100.00

2、项目主要建设内容

- （1）新增进口设备 88 台（套）；
- （2）新建生产厂房及配套动力站房总建筑面积 34,300m²；
- （3）购置生产设备以及配套动力设备；
- （4）项目建成后需新增员工数量为 300 人；
- （5）建设配套的供配电、给排水、通风空调、环保、消防、通信信息等公用工程和道路、围墙、绿化等辅助工程设施。

本项目主要建设数据如下：

序号	名称	单位	数据
1	产品大纲		
	• 功率 MOSFET	片/月	20,000
	• IGBT	片/月	5,000
	• 肖特基二极管	片/月	10,000
	• 快恢复二极管	片/月	2,500
	• LED 驱动电路	片/月	2,500

序号	名称	单位	数据
2	新建建筑面积	m ²	34,300
3	项目总投资	万元	46,026
	其中：固定资产投资	万元	43,880
	铺底流动资金	万元	2,146
4	职工人数	人	300
5	新增设备仪器	台/套	88
6	主要动力用量		
	• 变压器装设容量	KVA	7,200
	• 自来水用量	m ³ /d	3,000

3、产品技术水平、工艺流程和主要设备选择情况

(1) 产品技术水平

本项目新建6英寸0.35微米功率半导体器件芯片生产线，沿用公司现有工艺生产技术，不存在生产技术障碍。

(2) 工艺流程

本项目生产产品定位在量大和具有发展前景的高压功率MOSFET和肖特基二极管，同时根据市场需求和技术储备状况生产IGBT、快恢复二极管和LED驱动电路。

A、高压MOSFET工艺流程：

硅外延片→场氧→环光刻→环刻蚀→环氧化→环注入→环扩散→栅光刻→刻蚀→氧化→注入→氧化→淀积多晶→多晶光刻→刻蚀→氧化→离子注入（1）→扩散→P区光刻→离子注入（2）→离子注入（3）→终止区光刻→刻蚀→源区光刻→源区注入→淀积BPSG→源扩散→引线孔光刻→刻蚀→正面金属化→金属反刻→刻蚀→淀积氮化硅→钝化层光刻→干法刻蚀→合金→背面减薄→背面金属化→PCM。

B、肖特基二极管工艺流程：

硅外延片→清洗（NH₃·H₂O+H₂O₂）→氧化→OAP→匀胶→光刻→刻蚀→注入→去胶→B推进→氧化→引线孔光刻→清洗（NH₃·H₂O+H₂O₂）→P-氧化→P-

注入→刻蚀→清洗（ $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}_2$ ）→蒸Cr→合金→扒Cr→清洗（ $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}_2$ ）→合金→背面减薄→清洗（纯水）→背面金属化。

（3）主要设备选型及投资估算情况

在充分利用现有设备的前提下，根据项目产品生产规模及产品生产工艺的需要，结合装备现状情况进行比较后选型，各种设备以高效率、低能耗、性能先进、性价比合适为原则。

本项目拟新增进口设备88台（套）。为降低成本，生产工艺设备以购买国外二手设备为主，并增加部分专用于功率半导体器件生产的设备。采购时将采取二手6英寸芯片生产线整线设备与翻新设备相结合的方式，必要时部分关键工艺设备甚至采购全新设备，以此保证本报告中提出的产能、产品质量及合格率目标的实现。

根据《6英寸0.35微米功率半导体器件生产线项目可行性研究报告》，本项目新增设备清单如下：

序号	名称	设备来源	型号	数量	单位	单价 (万美元)	总价 (万美元)
一、中测设备							
1	中测台	Electroglas	EG2001X	38	台	1.6	60.8
2	测试仪	上海友能	DTS-1000	19	台	5.9	112.1
二、辅助设备							
1	运载盒清洗机	Semitool	STORM II	3	台	1.5	4.5
2	片盒清洗机	Semitool		3	台	1.5	4.5
3	炉管清洗机	SETechno		2	台	2.5	5
4	烘箱			4	台	1	4
5	紫光灯			10	个	0.025	0.25
6	掩模版储存柜	Timec		2	套	25	50
7	工装夹具			1	套	100	100
三、前工序生产设备							
1	芯片生产设备			1	套	1,000	1,000
2	外延炉			5	台	180	900
合 计				88			2,241.15

4、主要原辅材料和能源供应

半导体芯片生产所需要的主要原辅材料有硅片、掩膜版、扩散源、化学品、金属化材料等，除极少数要求很高的材料需进口外，绝大部分材料均已国产化。本项目不存在原辅材料供应受到限制或制约的情况。

根据《6 英寸 0.35 微米功率半导体器件芯片生产线项目环境影响报告书（报批稿）》，本项目主要原辅材料正常生产时的年消耗情况如下：

工艺类别	序号	名称	规格	单位	年用量	来源
基本材料	1	硅抛光片	6 英寸	片	540,000	国产
	2	测试片及陪片	6 英寸	片	60,000	国产
光刻	1	掩膜版	5"×5"	块	1,200	国产
	2	光刻胶	KMP C5250	加仑	900	国产
	3	增粘剂	AZ® -4	件/6品脱	120	国产
	4	抗反射涂覆剂	BARLi	L	420	进口
	5	显影液	FHD-5	L	108,000	进口
	6	漂洗液	FP-01	L	14,940	进口
	7	剥离液	ZQB-50	L	8,040	进口
	8	N 甲基吡咯烷酮	AZ®-100	L	480	进口
	9	湿法去胶液	MS-2001	瓶(5L)	180	进口
腐蚀	1	氢氧化钠	高纯	公斤	300	国产
清洗	1	双氧水	MOS/1L	L	144,000	国产
	2	氨水	MOS/1L	L	144,000	国产
	3	异丙醇	IPA	瓶	24,000	国产
	4	丙酮	MOS	瓶	48,000	国产
扩散/离子注入	1	三氟化硼	200g	瓶	6.6	进口
	2	三氟化硼	800g	瓶	2	进口
	3	磷烷	40g	瓶	1.32	进口
	4	磷烷	500g	瓶	14	进口
	5	磷烷	6N/13.6kg	瓶	4	进口
	6	砷固态源	MOS	g	2,400	进口
	7	三氯氧磷	GC/400ml	瓶	2.5	国产

工艺类别	序号	名称	规格	单位	年用量	来源
	8	三氯乙烷	MOS	瓶	1,200	国产
CVD	1	硅烷(纯)	12kg	瓶	30	进口
	2	硅烷/氮气混合气	10%	瓶	24	进口
	3	二氯二氢硅	3.5N/10kg	瓶	12	进口
	4	三氯氢硅	高纯	瓶	36	进口
	5	正硅烷乙酯	高纯	瓶	9,600	国产
	6	笑气	27.2kg	瓶	36	进口
	7	三乙基硼	高纯	瓶	30	进口
	8	三乙基磷	高纯	瓶	24	进口
	9	氨气	22.7kg	瓶	6	进口
	10	臭氧	高纯	瓶	24	进口
刻蚀	1	四氟化碳	32kg	瓶	240	进口
	2	三氟甲烷	5N/32kg	瓶	36	进口
	3	六氟化二碳	5N/30kg	瓶	72	进口
	4	六氟化硫	5N/35kg	瓶	24	进口
	5	三氯化硼	36.3kg	瓶	12	进口
	6	氯气	5N/5kg	瓶	60	进口
	7	溴化氢	5N/5kg	瓶	36	进口
	8	氦氧混合气	70He(2L)	瓶	48	进口
	9	氩气	2L	瓶	120	进口
金属化	1	铝硅靶	Al2%Si	块	48	进口
	2	钛靶	5N	块	12	进口
	3	钛(蒸发)	5N	kg	21.6	国产
	4	镍(蒸发)	5N	kg	21.6	国产
	5	银(蒸发)	5N	kg	18	国产
	6	金(蒸发)	5N	kg	14.4	国产
其他	1	聚酰亚胺	HTR3-100	kg	600	进口
	2	石英管	HJ-50-00	只	若干	国产

工艺类别	序号	名称	规格	单位	年用量	来源
	3	石英舟	HJ-50-05	只	若干	国产

本项目所用的能源主要是电、自来水等。主要耗能设备为生产设备、冷水机组、空调机组、水泵等，均为电能消耗设备。

本项目能源消耗及供应情况如下：

序号	能源种类	单位	年实物耗量	折标系数	折标煤量(kg)	供应来源
1	电能	度	38,102,400	0.1229	4,682,785	宝龙工业城供电局
2	自来水	t/a	1,050,000	0.257	269,850	宝龙工业城自来水
合 计					4,952,635	

5、项目的环保情况

本项目建设符合国家对土地利用、环境保护、节能、安全、工业卫生和消防等有关法律、法规、规定及标准规范的要求，并认真执行建设项目“三同时”的原则，确保项目实施节约、安全、清洁、文明生产，保障人身和财产安全。

本项目生产产生的污染物包括酸碱废水、研磨废水，碱性废气、有机废气和工艺尾气及氟化物等，公司将按照国家相关规定实现达标排放。

本项目已经深圳市龙岗区环境保护和水务局批准，并出具了建设项目环境影响审查批复（深龙环批[2013]700294号）

6、项目的选址、占用土地情况

本项目将在公司现有土地上进行建设。2004年11月29日，公司签订了深地合字[2003]5066号《深圳市土地使用权出让合同书》，取得位于深圳市龙岗区宝龙工业城G02314-0013号宗地。该宗地面积为105,269.67平方米，使用年限为50年，自2003年7月1日至2053年6月30日，土地用途为工业用地，其中，建筑容积率不超过0.97，计入容积率总建筑面积不超过102,000平方米（厂房93,300平方米，仓库1,340平方米，管理办公及其它必须的工业配套用房7,360平方米）。

7、项目的组织方式及实施进展

公司成立项目实施领导小组，负责项目全过程的实施管理。领导小组负责项目资金使用计划的落实，组织办公场所和工厂的建筑施工，设备采购，安装调试等工作。

公司将以现有组织机构为基础新增制造部门，对项目实行生产组织和管理。项目建设完成投产后，共需人员300人，生产线实行采用四班三轮制运行。

本项目建设期2年，投产第一年产能利用率为75%，投产第二年产能利用率为100%。

8、投资项目的效益分析

本项目达产后，主要经济效益指标如下：

序号	项目	单位	数据和指标	备注
1	建设投资	万元	43,880	
2	铺底流动资金	万元	2,146	
3	项目总投资	万元	46,026	
4	达产年平均营业收入	万元	33,429	
5	达产年平均利润总额	万元	6,427	
6	增值税及税金附加	万元	2,997	
7	投资回收期	年	6.37	所得税后
8	内部收益率	%	15.32	所得税后
9	财务净现值（ic=12%）	万元	4,192	所得税后

项目经济效益分析的主要结果表明：本项目税后内部收益率为15.32%，预计经过6.37年（含建设期）可收回全部投资，盈亏平衡时的最低产量为设计生产能力的48.73%，说明项目具有较好的盈利能力。从项目投资效益分析情况看，项目是可行的。

9、项目核准情况

本项目已经深圳市发展和改革委员会核准，并取得编号为深发改备案[2013]0019号《社会投资项目备案通知》。

三、补充生产经营所需营运资金概述

（一）补充营运资金的必要性

公司属于半导体分立器件制造业，前期需投入大量资金用于购买生产线，主

要包括外延、光刻、蚀刻、离子注入、扩散等工序所需的生产加工设备和测试设备。一般制造行业具有前期投资较大、生产周期长等特点，公司在生产过程中需要购置大量的原材料和能源动力。公司需要较多的流动资金，用以保证正常生产运营的稳定性和持续性。

公司长期坚持自主创新和自主品牌，未来将继续以节能照明功率半导体分立器件研发、生产与销售为主，积极研发功率 MOSFET、IGBT、肖特基器件、LED 驱动电路芯片等新产品。目前，公司主要固定支出如下：

（1）原材料和能源动力采购。报告期内，公司原材料采购金额平均保持在 2 亿元/年左右，占用的流动资金也较多。

（2）技术改造支出。作为半导体分立器件企业，公司专注于提高产品质量，因此，每年需升级换代一定批次的生产设备，用以改进生产效率、提高成品合格率。报告期内，公司用以更新生产设备的支出约为 4,000 万元/年。

（3）研发投入。公司作为高新技术企业，需要不断地研发新的产品，研发费用投入较大。报告期内，公司发生的研发费用平均约为 3,000 万元/年，费用支出较大。

报告期内，公司流动资产分别为 29,545.99 万元、31,445.26 万元和 37,103.77 万元，占总资产比重分别为 54.88%、54.66%和 58.56%。其中，货币资金分别为 3,317.42 万元、3,683.54 万元和 3,429.87 万元，占流动资产的比例分别为 11.23%、11.71%和 9.24%。公司流动资产较大，但货币资金规模相对较小。随着公司规模的不不断壮大，现有流动资产特别是货币资金无法满足公司发展的需要。

为增强主营业务的稳定性，加快拓展高端功率分立器件领域，提高企业综合实力，结合公司所在半导体分立器件行业的特点、现有的净资产规模及生产经营中所需的资金，公司拟通过本次发行股票募集9,000万元用以补充流动资金。

（二）营运资金使用计划

公司拟定营运资金投入计划包括：（1）增加 3,000 万元用于 5 英寸生产线相关生产设备更新改造支出；（2）增加 3,000 万元用于新增采购原材料、SOP-8 封装设备及更新部分封装设备；（3）增加 2,000 万元用于新产品研究与开发；（4）增加 1,000 万元用于 LED 照明市场推广。

项目分类	内容	计划投资额			合计
		第1年	第2年	第3年	
5英寸线设备更新	购置、改造、安装生产设备等	1,000	1,000	1,000	3,000
SOP-8封装设备及部分封装设备更新	购置原材料、相关设备	1,200	1,000	800	3,000
新产品研究与开发	更新研发设备、技术咨询服务	600	700	700	2,000
LED照明市场推广	市场推广相关费用	500	300	200	1,000
合计	-	3,300	3,000	2,700	9,000

针对上述资金投入计划,公司拟通过本次发行募集9,000万元补充营运资金,实际缺口部分将通过利润滚存积累和进一步提高资金营运效率加以解决。

四、募集资金运用对经营成果和财务状况的影响

(一) 对净资产和净资产收益率的影响

募集资金到位后,公司的净资产总额和每股净资产将大幅增加。净资产的增加将使公司股票的内在价值有较大幅度的提高。由于发行后公司净资产将大幅增加,而投资项目建设期内不能产生效益,因此,公司净资产收益率在短期内将会下降。但募集资金投资项目具有良好的盈利前景,随着募集资金项目的建成并逐步达产,公司盈利水平将不断提高,净资产收益率也会逐步回升。

(二) 资产规模扩大新增折旧、摊销对公司盈利能力的影响

本次募集资金共有建设投资46,026万元,固定资产和无形资产将有较大规模的增长。公司新增固定资产约43,880万元,按公司现行会计政策,项目建成投产后每年新增折旧约4,467万元,每年新增摊销约509万元,合计每年新增折旧和摊销4,976万元。

虽然募集资金项目建设将导致折旧和摊销大幅增加,但是,项目建成后,公司经营规模、营业收入和盈利能力也将大幅增长。公司在报告期内毛利率算术平均值为23.49%,据此测算,项目建成后,在经营环境不发生重大变化的情况下,只要公司营业收入和营业利润较项目建成前分别增加21,183万元、4,976万元,即

可消化掉因本募投项目增加的折旧和摊销费用。

如果募集资金2015年能到位，募集资金项目2017年建成。若以2013年度公司营业收入37,467万元为基础，假设其他经营条件不变，只要公司营业收入2017年达到58,650万元，即复合增长率达到11.86%，就能够确保公司营业利润不会因此而下降。

因此，考虑项目投产带来的营业收入增长和公司目前营业收入增长状况，足以消化上述折旧和摊销费的增加，公司未来经营成果不会因此产生不利影响。

（三）对资产负债率和资本结构的影响

公司发行完成后，货币资金将大规模增加，随着投资项目的建设，货币资金将根据进度转化为在建工程和固定资产。发行募集资金到位后，公司的资产负债率将得到一定幅度的下降，公司偿债能力将得到提高，财务结构进一步优化，抵御风险的能力将得到提高。

第十三节 股利分配政策

一、公司报告期内的股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成分配方案的实施。

公司的利润分配将遵循“同股同权、同股同利”的原则，按股东持有的股份数额进行分配。公司利润分配政策为：

- 1、公司利润分配采用现金、送红股或其他方式进行。
- 2、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
- 3、原则上每个会计年度分配的利润不少于当年可分配利润的百分之三十。

二、公司实际股利分配情况

2010 年 9 月 29 日，公司前身深爱有限 2010 年第四次股东会审议通过《关于深爱公司利润分配方案》的议案，对截止 2010 年 7 月 31 日公司可供分配利润提取法定公积金后向全体股东分配股利 2,070 万元，其中：赛格集团 1,635.30 万元，循杰投资 310.50 万元，远致投资 124.20 万元。

2013年4月2日，公司2012年度股东大会审议通过《深圳深爱半导体股份有限公司2012年度利润分配方案》的议案，2012年度利润分配方案如下：以2012年12月31日股本总数199,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共计分配股利19,900,000.00元（含税）。

2014年3月20日，公司2013年年度股东大会审议通过《深圳深爱半导体股份有限公司2013年度利润分配方案》，由于2013年度公司存在重大投资计划和重大资金支出等事项，公司的现金流较为紧张，为保证公司未来可持续发展，2013年度公司拟不进行利润分配。2013年公司的重大投资计划主要是6英寸0.35微米功率半导体器件芯片生产线项目。

三、本次发行完成前滚存利润的分配方案和已经履行的决策程序

经公司2013年年度股东大会决议通过，公司本次发行前滚存的未分配利润由本次发行后新老股东按共享。

四、发行后的股利分配政策

根据公司2013年年度股东大会审议通过的公司章程（草案），本次发行后的股利分配政策为：

（一）利润分配原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

（二）利润分配形式和期间间隔

公司可以采取现金、股票、现金股票相结合或法律许可的其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

原则上，在符合现金分红的条件下，公司每年度进行一次现金分红，也可以

进行中期现金分红。

（三）现金分红的条件

公司进行现金分红需要同时满足如下条件：

- 1、公司当年可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正数；
- 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（四）现金分红的比例

公司具备现金分红条件的，如无重大投资计划或重大资金支出，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。重大投资计划或重大资金支出是指：公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最新一期经审计净资产的 50%，且超过人民币 5,000 万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（五）利润分配的决策机制与程序

- 1、进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案，公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比

例、调整的条件极其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

3、公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

4、公司当年盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表独立意见。

（六）调整利润分配政策的决策机制与程序

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关利润分配政策调整的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表意见。调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

五、未来三年利润分配计划

根据《深圳深爱半导体股份有限公司未来三年具体利润分配计划和长期回报规划》，公司未来三年的具体利润分配计划如下：

1、未来三年，公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。2013-2015年，公司原则上每年度进行一次现金分红，

公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。但现金分红不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、在公司当年可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正数，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的前提下，如无重大投资计划或重大资金支出，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。

3、在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

六、发行人股东关于股利分配的承诺

公司所有股东对董事会制订上市后适用的公司章程（草案）有关利润分配条款的决议表示赞同，并承诺如下：

同意未来发行人首次公开发行股票并上市后，召开股东大会修改公司章程的利润分配条款时将投赞成票；未来发行人股东大会根据公司章程的规定审议具体的利润分配方案时将投赞成票。

七、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：发行人上市后适用的公司章程（草案）中关于利润分配的相关政策注重给予投资者稳定分红回报，有利于保护投资者的合法权益；发行人公司章程（草案）及招股说明书中对利润分配事项的规定和相关信息披露符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人股利分配决策机制健全、有效，并有利于保护公众股东的合法权益。

第十四节 其他重要事项

一、信息披露和投资者关系相关情况

（一）信息披露制度

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关规定，公司已制订了《深圳深爱半导体股份有限公司信息披露管理制度》，经 2012 年度股东大会审议通过，并计划在公司股票上市后实施。

（二）负责信息披露和投资者关系的机构

负责机构：证券部

负责人：王军立

电话：0755-2597 0821

传真：0755-8240 0426

电子邮箱：sisemi@sisemi.com.cn

二、重要合同

本节重要合同指公司目前正在履行的对公司的经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

截至招股说明书签署日，本公司正在履行之重要合同如下：

（一）重大销售合同

根据行业惯例，公司与主要客户签订销售框架性协议，具体金额以订单为准。目前，公司与主要客户签订的框架协议如下：

1、2010 年 7 月，公司与镇江强凌电子有限公司签订《寄售协议》，公司以库存寄售的方式向镇江强凌电子有限公司销售货物，合同就寄售订单、寄售收货、寄售发票结算及库存管理责任进行了约定。

2、2011 年 3 月，公司与深圳市贵鸿达电子有限公司签订《协议》，向深圳

市贵鸿达电子有限公司销售三极管芯片，合同对订货方式、价格调整方式、验收、付款方式等做了约定，具体参数要求、品种及数量的要求以每月订单为准

3、2012年4月，公司与芯域半导体有限公司签订《CMOS及DMOS产品代工合同》，公司按照芯域半导体有限公司的技术要求为其生产代工产品，合同就代工方式、合格率、预付款、付款周期、代工费计算方式等进行了约定。

4、2013年1月，公司与佛山电器照明股份有限公司签订《佛山照明电子线路板用三极管供货协议》，公司向佛山电器照明股份有限公司销售三极管，对产品规格、技术参数和检验方式，以及其它事项进行了约定。

5、2013年1月，公司与宁波凯耀电器制造有限公司签订《通用（年度）采购合同》，公司向宁波凯耀电器制造有限公司销售三极管，就订单确认方式、运输方式、支付方式等作出约定，具体价格、交货计划、交货日期通过订单确认。

6、2013年3月，公司与深圳市盛元半导体有限公司签订《协议》，向深圳市盛元半导体有限公司销售三极管芯片，合同对订货方式、价格调整方式、验收、付款方式等做了约定，具体参数要求、品种及数量的要求以每月订单为准。

7、2013年3月，公司与宁波明昕微电子股份有限公司签订《协议》，向宁波明昕微电子股份有限公司销售三极管芯片，合同对订货方式、价格调整方式、验收、付款方式等做了约定，具体参数要求、品种及数量的要求以每月订单为准。

8、2013年4月，公司与深圳市晶导电子有限公司签订《协议》，公司向深圳市晶导电子有限公司销售三极管芯片，合同对订货方式、价格调整方式、验收、付款方式等做了约定，具体参数要求、品种及数量以每月订单为准。

9、2013年11月，公司与浙江阳光照明电器集团股份有限公司签订《工矿产品买卖合同》，公司向浙江阳光照明电器集团股份有限公司销售三极管，对产品产地质量要求、质量保证、交货地点、时间、结算方式及期限、包装要求、质量验收等事项进行了约定。

（二）重大采购合同

根据行业惯例，公司与主要供应商签订采购框架性协议，具体金额以订单为准。目前，公司与主要供应商签订的框架协议如下：

1、2014年3月，公司与杭州海纳半导体有限公司签订《买卖合同》，约定

公司向杭州海纳半导体有限公司采购单晶硅片，合同就质量要求、技术标准、订购方式、验收标准、包装要求、结算方式等作了约定，产品规格、数量、单价等由订购单确定。

2、2014年3月，公司与浙江金瑞泓科技股份有限公司签订《买卖合同》，约定公司向浙江金瑞泓科技股份有限公司采购外延片、单晶硅片和抛光片，合同就质量要求、技术标准、订购方式、验收标准、包装要求、结算方式等作了约定，产品规格、数量、单价等由订购单确定。

3、2014年3月，公司与有研半导体材料股份有限公司签订《买卖合同》，约定公司向有研半导体材料股份有限公司采购抛光片，合同就质量要求、技术标准、订购方式、验收标准、包装要求、结算方式等作了约定，产品规格、数量、单价等由订购单确定。

4、2014年3月，公司与江阴市化学试剂厂有限公司签订《买卖合同》，公司向江阴市化学试剂厂有限公司采购有机化学试剂和无机化学试剂，合同就质量要求、技术标准、订购方式、验收标准、包装要求、结算方式等作了约定，产品规格、数量、单价等由订购单确定。

5、2014年3月，公司与深圳市雷洋科技有限公司签订《买卖合同》，公司向深圳市雷洋科技有限公司采购塑封料、清模条和脱模条，合同就质量要求、技术标准、订购方式、验收标准、包装要求、结算方式等作了约定，产品规格、数量、单价等由订购单确定。

6、2014年3月，公司与有研亿金新材料股份有限公司签订《买卖合同》，公司向有研亿金新材料股份有限公司采购靶材、蒸发料，合同就质量要求、技术标准、订购方式、验收标准、包装要求、结算方式等作了约定，产品规格、数量、单价等由订购单确定。

7、2014年2月，公司与宁波华龙电子股份有限公司签订《买卖合同》，约定公司向宁波华龙电子股份有限公司采购框架，合同就质量要求、技术标准、订购方式、验收标准、包装要求、结算方式等作了约定，产品规格、数量、单价等由订购单确定。

8、2014年3月，公司与江阴江化微电子材料股份有限公司签订《买卖合同》，约定公司向江阴江化微电子材料股份有限公司采购负胶显影液、负胶漂洗液和边

胶清洗剂，合同就质量要求、技术标准、订购方式、验收标准、包装要求、结算方式等作了约定，产品规格、数量、单价等由订购单确定。

9、2014年3月，公司与浙江长兴众成电子有限公司签订《买卖合同》，约定公司向浙江长兴众成电子有限公司采购单晶硅片，合同就质量要求、技术标准、订购方式、验收标准、包装要求、结算方式等作了约定，产品规格、数量、单价等由订购单确定。

10、2014年3月，公司与上海新傲新科技股份有限公司签订《买卖合同》，约定公司向上海新傲新科技股份有限公司采购外延片，合同就质量要求、技术标准、订购方式、验收标准、包装要求、结算方式等作了约定，产品规格、数量、单价等由订购单确定。

（三）封装产品委托加工合同

目前，公司与主要外协厂商签订的框架协议如下：

1、2014年3月，公司与广东万源创宝新科技股份有限公司签订《封装产品委托加工协议》，广东万源创宝新科技股份有限公司按照公司要求封装三极管产品。双方就成品质量要求、业务流程、交货方式、交货日期、结算方式及期限等进行了约定。

2、2014年3月，公司与四川立泰电子有限公司签订《封装产品委托加工协议》，四川立泰电子有限公司按照公司要求封装三极管产品。双方就成品质量要求、业务流程、交货方式、交货日期、结算方式及期限等进行了约定。

3、2014年3月，公司与佛山市蓝箭电子股份有限公司签订《封装产品委托加工协议》，佛山市蓝箭电子股份有限公司按照公司要求封装三极管产品。双方就成品质量要求、业务流程、交货方式、交货日期、结算方式及期限等进行了约定。

（四）重大租赁合同

1、2011年4月，公司与深圳市六洲置业有限公司签订《深圳市房屋租赁合同书》，将其位于深圳市福田区八卦三路光纤小区1栋三层（现为2栋）房屋向深圳市六洲置业有限公司出租，租赁期限为2011年4月9日至2016年4月8日。

月租金 99,355.40 元，租金每年按 3%递增。

2、2011 年 4 月，公司与深圳市鑫骄阳印刷有限公司签订《深圳市房屋租赁合同书》，约定将其位于深圳市福田区八卦三路光纤小区 1 栋二层 B 区（现为 2 栋）的房屋向深圳市鑫骄阳印刷有限公司出租，租赁期限为 2011 年 4 月 16 日至 2016 年 4 月 15 日。租金 63,446.40 元。租金按每年 5%递增。

3、2012 年 8 月，公司与深圳市六洲置业有限公司签订《深圳市房屋租赁合同书》，将其位于深圳市福田区八卦三路光纤小区 1 栋（现为 2 栋）的房屋向深圳市六洲置业有限公司出租，租赁期限为 2012 年 8 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日。2012 年 9 月 1 日至 2013 年 8 月 31 日月租金 79,049.10 元，租金按每年 3%递增。

4、2012 年 8 月，公司与深圳市六洲置业有限公司签订《深圳市房屋租赁合同书》，将其位于深圳市福田区八卦三路光纤小区 1 栋一层（现为 2 栋）的房屋向深圳市六洲置业有限公司出租，租赁期限为 2012 年 8 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日。2012 年 9 月 1 日至 2013 年 8 月 31 日 A 部分月租金 125,641.56 元，B 部分月租金 9,385.60 元，租金按每年 3%递增。

5、2012 年 8 月，公司与深圳市鑫骄阳印刷有限公司签订《深圳市房屋租赁合同书》，将其位于深圳市福田区八卦三路光纤小区 1 栋二层 A 区（现为 2 栋）的房屋向深圳市鑫骄阳印刷有限公司出租，月租金 15,025.50 元，租赁期限为 2012 年 8 月 1 日至 2016 年 4 月 15 日。约定租金按每年 5%递增。

（五）借款合同

1、2013 年 6 月，公司与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签署《流动资金借款合同》（编号：2013 年圳中银罗司借字第 000040 号），借款金额 1,000 万元，借款期限为 12 个月；借款利率为浮动利率；每 6 个月为一个浮动周期。

2、2013 年 9 月，公司与招商银行股份有限公司深圳时代广场支行签署《借款合同》（编号：2013 年小罗字第 1013790901 号），借款金额 850 万元，借款期限为 1 年；借款利率为固定利率。

3、2013 年 12 月，公司与招商银行股份有限公司深圳时代广场支行签署《借款合同》（编号：2013 年小罗字第 1013791201 号），借款金额 750 万元，借款期限为 6 个月；借款利率为固定利率。

4、2013 年 12 月，公司与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签署《流动资金借款合同》（编号：2013 年圳中银罗司借字第 000094 号），借款金额 1,000 万元，借款期限为 6 个月；借款利率为浮动利率；每 6 个月为一个浮动周期。

5、2014 年 2 月，公司与招商银行股份有限公司深圳时代广场支行签署《借款合同》（编号：2014 年小罗字第 104790201-01 号），借款金额 600 万元，借款期限为 1 年；借款利率为固定利率。

6、2014 年 2 月，公司与招商银行股份有限公司深圳时代广场支行签署《借款合同》（编号：2014 年小罗字第 104790201-02 号），借款金额 800 万元，借款期限为 1 年；借款利率为固定利率。

（六）授信协议

1、2013 年 9 月，公司与招商银行股份有限公司深圳时代广场支行签订《授信协议》（编号：2013 年小罗字第 0013790801 号），授信金额 3,000 万元。授信期间从 2013 年 9 月 23 日起到 2014 年 9 月 22 日止。（该《授信额度协议》已到期，新的授信协议、相关的抵押和借款合同签署正在办理中）。

（七）担保合同

2013 年 1 月，公司与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签订《最高额抵押合同》（编号：2013 年圳中银罗额抵字第 000001 号），公司以其名下的位于龙岗区宝龙工业城的 4 处房产：10 号单身宿舍、8 号办公楼及 2、4 号厂房（房产证编号分别为深房地字第 6000513551、6000513548、6000513550、6000513549 号），为上述《授信额度协议》以及依据该协议已经或将要签署的单项协议及其修订或补充提供最高额抵押担保，本合同所担保债权之最高本金余额为 74,412,268 元。

三、对外担保情况

截至招股说明书签署日，公司不存在正在履行的对外担保事项。

四、诉讼和仲裁事项

（一）重大诉讼和仲裁事项

截至招股说明书签署日，公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（二）主要关联人的重大诉讼和仲裁事项

截至招股说明书签署日，公司控股股东赛格集团尚未了结或可预见诉讼如下：

1、保证合同纠纷案

根据《民事起诉状》，2008年4月25日，中国食品工业（集团）公司（以下简称“中国食品公司”）起诉深圳中浩（集团）股份有限公司（以下简称“深圳中浩公司”）和赛格集团，要求深圳中浩公司向其返还欠款本金19,246,063.04元，要求赛格集团对上述欠款承担连带赔偿责任。

北京市第一中级人民法院就该案作出一审判决：1、深圳中浩公司于判决生效后十日内返还中国食品公司18,997,840元；2、赛格集团对上述债务承担连带赔偿责任；3、驳回中国食品公司其他诉讼请求。

赛格集团不服一审判决向北京市高级人民法院提起上诉，要求撤销一审判决。2009年8月13日，二审法院就该案作出终审判决：驳回上诉、维持原判。2009年10月22日，法院依据上述判决强制赛格集团支付1,957万元。

2011年12月9日，赛格集团就该案向中华人民共和国最高人民法院提起申诉，要求撤销北京市高级人民法院就本案作出的终审判决，并判令被申请人（中国食品公司和深圳中浩公司）赔偿赛格集团因执行终审判决造成的损失1,957万元及利息。截至本招股说明书签署日，最高人民法院尚未就赛格集团的申诉事项作出裁决。

2、股东损害公司债权人利益责任纠纷

2012年10月，深圳市联合宝利投资担保有限公司（以下简称“联合宝利”）起诉赛格集团，要求赛格集团对深圳赛格运兴电子有限公司在深圳市罗湖区人民法院（1997）深罗法经初字第232号民事判决书中对联合宝利负有的债务承担清偿责任，债务暂计至该判决生效之日为2,728,356元。

2013年1月23日，深圳市福田区人民法院就该案作出一审判决：驳回联合

宝利诉讼请求。

2013年3月，联合宝利不服一审判决提起上诉，2013年6月7日，深圳市中级人民法院就本案作出终审判决，根据（2013）深中法商终字第782号《民事判决书》，二审法院驳回了联合宝利的上诉，维持原判。

联合宝利向广东省高级人民法院申请再审程序。截至本招股书说明书签署日，广东省高院已开庭审理，但尚未作出裁决。

3、强制清算案

根据深圳市福田区人民法院作出的（2013）深福法民二清（预）字第2号《民事裁定书》，深圳市联合宝利投资担保有限公司（以下简称“联合宝利”）申请对深圳赛格运兴电子有限公司（被申请人）强制清算，受理法院于2014年1月15日召开听证会，赛格集团作为被申请人的股东参加了听证会，2014年1月16日，受理法院作出裁决：不予受理联合宝利对被申请人提出的强制清算申请。联合宝利不服上述裁定，已就该案向深圳市中级人民法院提出上诉，二审法院尚未开庭审理。

4、与桑达电子股权转让纠纷案

根据赛格集团于2013年12月12日向深圳市福田区人民法院提交的《民事起诉状》，赛格集团曾于1995年4月6日就海南赛格国际信托投资公司股权转让事宜，与深圳桑达电子集团有限公司（被告）签订《股权转让协议书》，赛格集团现要求法院确认该协议无效，并判令被告返还股转款400万元，赔偿利息900多万元。深圳市福田区人民法院已经受理该案，但尚未开庭审理。

5、与华利电子股权转让纠纷案

根据赛格集团于2013年12月12日向深圳市福田区人民法院提交的《民事起诉状》，赛格集团曾于1995年4月6日就海南赛格国际信托投资公司股权转让事宜，与深圳华利电子集团有限公司（被告）签订《股权转让协议书》，赛格集团现要求法院确认该协议无效，并判令被告返还股转款128万元，赔偿利息300多万元。深圳市福田区人民法院已经受理该案，但尚未开庭审理。

6、与桑达宝电股权转让纠纷案

根据赛格集团于2013年12月12日向深圳市龙岗区人民法院提交的《民事起诉状》，赛格集团曾于1995年4月6日就海南赛格国际信托投资公司股权转让

事宜，与深圳桑达宝电有限公司（被告）签订《股权转让协议书》，赛格集团现要求法院确认该协议无效，并判令被告返还股转款 64 万元，赔偿利息 150 多万元。深圳市龙岗区人民法院已经受理该案，但尚未开庭审理。

截至 2013 年 12 月 31 日，赛格集团经审计的净资产为 183,105.11 万元。赛格集团出具说明和承诺，无论上述未结案件的结果如何，均不会对赛格集团持续经营造成影响，不会对赛格集团所持发行人股份的权属产生影响。

截至招股说明书签署日，公司其他股东循杰投资和远致投资、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的刑事诉讼情况

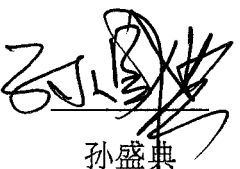
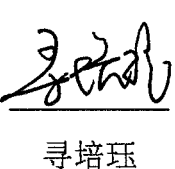
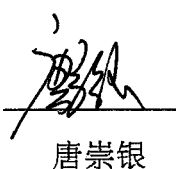
截至招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

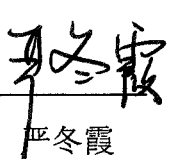
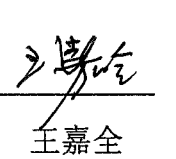
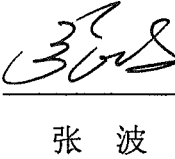
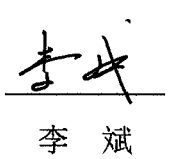
第十五节 董事、监事、高级管理人员

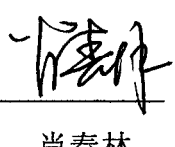
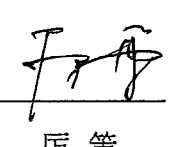
及有关中介机构声明

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

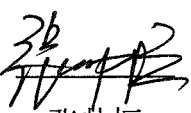
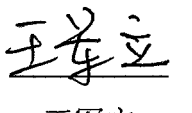
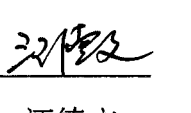
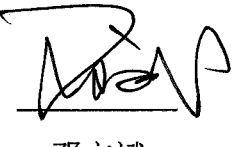
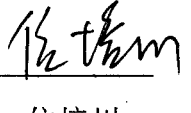
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

全体董事签字：    
孙盛典 寻培珏 唐崇银 何欣纲

    
严冬霞 王嘉全 张波 杨小强 李斌

全体监事签字：   
张光柳 肖春林 厉策

非董事高级管理人员签字：

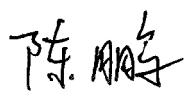
    
张帅恒 王军立 汪德文 邓文斌 位培川



保荐人（主承销商）声明

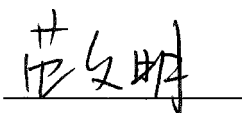
本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

项目协办人签字：

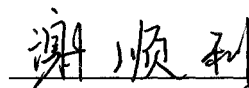


陈鹏

保荐代表人签字：

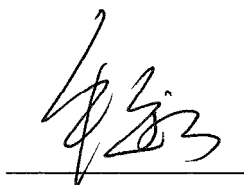


范文明



谢顺利

法定代表人签字：



牛冠兴



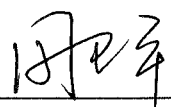
安信证券股份有限公司

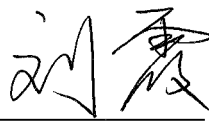
2024年4月15日

发行人律师声明

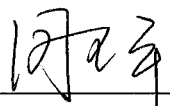
本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师:


周卫平


刘霞

律师事务所负责人签字:


周卫平



北京市友邦律师事务所

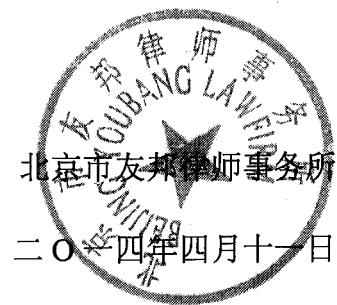
2014年4月15日

北京市友邦律师事务所

承诺函

关于深圳深爱半导体股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（“A股”）并上市项目（以下简称“本次发行上市”），本所作为发行人律师，特作出如下承诺：

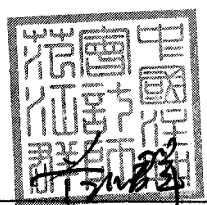
本所为发行人本次发行上市出具的文件，如因本所未尽勤勉尽责义务导致有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，本所将根据人民法院等有权部门最终作出的生效裁决，依法赔偿投资者直接经济损失。



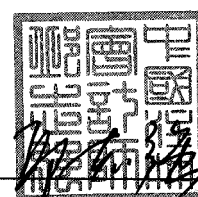
承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中所引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

注册会计师签字：

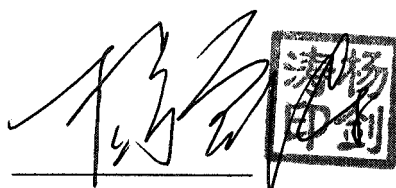


范江群



邱志强

审计机构负责人签字：



杨剑涛

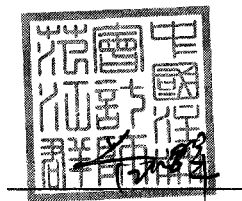


瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
2014年4月15日

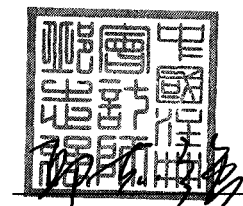
承担验资复核业务的机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

注册会计师签字：



范江群



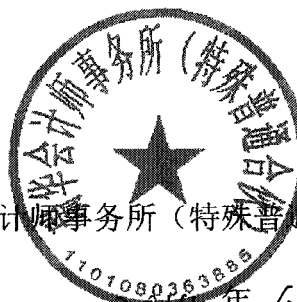
邱志强

验资复核机构负责人签字：



杨剑涛

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



2014年4月15日



通讯地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

Postal Address: 4th Floor of Tower 2, No. 16 Xisihuanzhong Road, Haidian District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100039

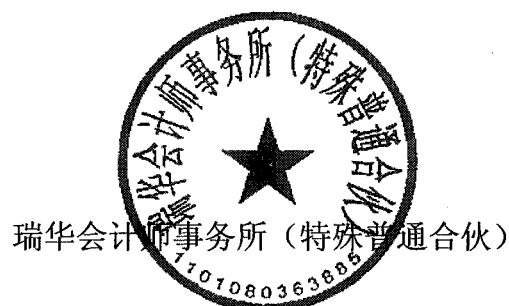
电话 (Tel): +86(10)88219191

传真 (Fax): +86(10)88210558

承 诺 函

我们接受委托，为深圳深爱半导体股份有限公司首次公开发行股份出具了财务报表审计报告（报告编号：瑞华审字【2014】48130004号）、主要税种纳税情况的专项审核报告（报告编号：瑞华核字【2014】48130002号）、非经常性损益的专项审核报告（报告编号：瑞华核字【2014】48130003号）、原始财务报表与申报财务报表差异情况的专项审核报告（报告编号：瑞华核字【2014】48130004号）、内部控制鉴证报告（报告编号：瑞华核字【2014】48130005号）及历次验资的专项复核报告（报告编号：瑞华核字[2013]第830A0002号）。根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的要求，我们承诺如下：

如果因我们出具上述文件的执业行为存在过错，违反了法律法规、中国注册会计师协会依法拟定并经国务院财政部门批准后施行的执业准则和规则以及诚信公允的原则，从而导致上述文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并由此给基于对该等文件的合理信赖而将其用于深圳深爱半导体股份有限公司股票投资决策的投资者造成损失的，我们将依照相关法律法规的规定对该等投资者承担相应的民事赔偿责任。

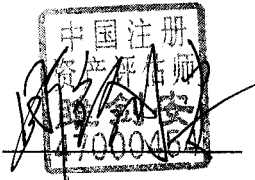


二〇一四年二月二十八日

承担评估业务的资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告(中联评报字[2010]第 813 号、中联评报字[2010]第 40 号)无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

注册资产评估师签字:


中国注册
资产评估师
47000464
魏剑安


中国注册
资产评估师
47000294
莫少霞

资产评估机构负责人签字:


沈琦



中联资产评估集团有限公司

承诺函

关于深圳深爱半导体股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（“A股”）并上市项目（以下简称“本次发行上市”），本公司作为发行人的资产评估机构，特作出如下承诺：

因本公司为发行人本次发行上市出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。


中联资产评估集团有限公司
2014年4月15日

第十六节 备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

- （一）发行保荐书及发行保荐工作报告；
- （二）财务报表及审计报告；
- （三）内部控制鉴证报告；
- （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （五）法律意见书及律师工作报告；
- （六）公司章程（草案）；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；
- （八）其他与本次发行有关的重要文件。

查阅时间：工作日上午8:30～11:30；下午14:00～17:00

查阅地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路三号8号办公楼及活动楼2-3层

发行人：深圳深爱半导体股份有限公司

办公地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路三号8号办公楼及活动楼2-3层

电话：0755-82260060

传真：0755-82400426

联系人：王军立

保荐人(主承销商)：安信证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

电话：0755-82825427

传真：0755-82825424

联系人：范文明、谢顺利、陈鹏、周玲、徐露、王传文